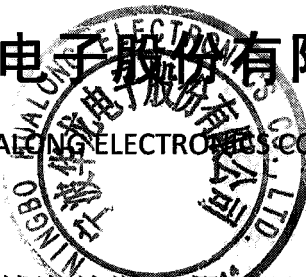




宁波华龙电子股份有限公司

NINGBO HUALONG ELECTRONICS CO., LTD.



(浙江省宁波市东钱湖旅游度假区旧宅村工业园)

首次公开发行股票招股说明书

(申报稿)

保荐机构（主承销商）



海通证券股份有限公司

HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(上海市淮海中路 98 号)

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的批准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。

宁波华龙电子股份有限公司

首次公开发行股票招股说明书

【概 况】

- 1、发行股票类型：人民币普通股（A股）
- 2、发行数量：2,500万股（本招股说明书及摘要中有关数据按发行2,500万股测算），占发行后总股本的25%
- 3、发行后总股本：10,000万股
- 4、每股面值：每股人民币1.00元
- 5、每股发行价：公司和保荐机构通过初步询价确定发行价格
- 6、预定发行日期：年 月 日
- 7、申请上市证券交易所：深圳证券交易所
- 8、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
- 9、招股说明书签署日期：2012年4月17日
- 10、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

公司实际控制人陈亚龙及其一致行动人邬文通、铭龙投资、香港致誉承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司其他发起人明昕电子、香港科恒、南通华达承诺自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

除上述锁定和限售外，担任本公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东陈亚龙承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。

【发行人声明】

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

【重大事项提示】

本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：

一、股份锁定相关承诺

本次发行前本公司总股本为7,500万股，本次拟公开发行不超过2,500万股，发行后总股本不超过10,000万股，上述股份全部为流通股。

本公司实际控制人陈亚龙及其一致行动人邬文通、铭龙投资、香港致誉承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该部分股份。

公司其他发起人明昕电子、香港科恒、南通华达承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该部分股份。

除上述锁定和限售外，担任本公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东陈亚龙承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

二、本次发行前滚存未分配利润分配安排

经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司在本次公开发行股票前滚存的未分配利润全部由本次公开发行股票后的新老股东共享。截止 2011 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 8,423.36 万元。

三、本次发行后的股利分配政策

本公司于 2012 年 2 月 10 日召开 2011 年度股东大会，审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》修正案，修订了第一百六十三条关于公司利润分配政策的记载。根据修订后上市后适用的《公司章程（草案）》，公司上市后的利润分配政策如下：

（一）利润分配原则

公司利润分配应充分重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。

公司在董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见。

公司可以根据盈利状况进行中期现金分红。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

（二）利润分配议案审议程序

公司董事会制订公司利润分配预案，公司监事会对利润分配预案进行审议并出具书面意见，公司独立董事发表独立意见，报公司股东大会审议决定。

如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的预案中不含现金分配方式的，应在定期报告中披露作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，公司独立董事应对此发表独立意见、公司监事会应对此进行审议并出具书面意见。

（三）利润分配形式

公司可以采取现金方式、股票方式、现金和股票相结合的方式或法律允许的其他方式分配股利。

在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，由股东大会审议决定。

在满足上述现金方式分配比例的前提下，董事会可根据公司股本规模、经营规模等因素，拟定股票方式分配预案，由股东大会审议决定。

（四）利润分配政策的修订

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见，监事会应对此事项进行审议并出具书面意见。

调整利润分配政策的议案经董事会审议通过，独立董事发表独立意见，且监事会对此事项进行审议并出具书面意见后提交股东大会审议决定，董事会应对利润分配政策调整向股东大会做出书面说明。

审议调整利润分配政策议案的股东大会除安排现场会议投票外，还应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等上市公司股东大会网络投票系统为社会公众股东参加股东大会提供便利，网络投票按照中国证监会和证券交易所的有关规定执行。

四、公司未来三年的具体股利分配计划

2012年2月10日，公司2011年度股东大会审议并通过了《关于宁波华龙电子股份有限公司2012-2014年度分红计划的议案》。决议未来三年（2012-2014年）公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

关于公司股利分配政策具体内容，请参见“第十四章 股利分配政策”。

四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

（一）半导体行业周期波动的风险

本公司主要生产半导体封装材料引线框架，属于半导体封装测试材料行业中的半导体封装材料支撑行业，公司产品所处行业的发展与半导体行业的发展正相关。半导体行业存在一定周期性，本公司主营业务和经营业绩受半导体行业景气状况影响较大，若半导体产业的发展出现较大波动，将对公司主营业务和经营业绩带来一定影响。

（二）主要原材料价格波动的风险

公司主要从事引线框架的研发、生产和销售，引线框架产品的主要原材料是铜带，产品成本受铜价的波动影响较大。报告期内铜价大幅波动，给公司的成本控制带来一定的压力，未来不排除国内铜价波动导致公司铜带采购价格大幅变动的可能。如果未来本公司不能及时调整产品价格以抵消成本波动的影响，公司的经营业绩可能会受到影响。

（三）所得税政策变化的风险

本公司于2009年9月被认定为高新技术企业，有效期三年，2009年度至2011年度享受15%所得税优惠税率。如公司将来未被继续认定为高新技术企业，则将不再享受高新技术企业所得税税收优惠政策，这对本公司的经营业绩将产生一定影响。

上述风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注“风险因素”一节中关于上述风险的内容。

目 录

| | | |
|------------|---|-----------|
| 第一章 | 释 义 | 10 |
| 第二章 | 概 览 | 13 |
| | 一、简要情况..... | 13 |
| | 二、发行人主要财务数据..... | 14 |
| | 三、本次发行情况..... | 16 |
| | 四、募集资金主要用途..... | 16 |
| 第三章 | 本次发行概况 | 18 |
| | 一、本次发行的基本情况..... | 18 |
| | 二、本次新股发行的有关当事人..... | 19 |
| | 三、发行人与中介机构关系的说明..... | 20 |
| | 四、本次发行的重要日期..... | 20 |
| 第四章 | 风险因素 | 21 |
| | 一、产业周期性波动风险..... | 21 |
| | 二、原材料价格波动的风险..... | 21 |
| | 三、所得税政策变化的风险..... | 22 |
| | 四、客户集中度较高的风险..... | 22 |
| | 五、供应商集中度较高的风险..... | 22 |
| | 六、财务风险..... | 22 |
| | 七、技术风险..... | 23 |
| | 八、净资产收益率下降的风险..... | 23 |
| | 九、募集资金投资项目风险..... | 23 |
| | 十、实际控制人控制的风险..... | 23 |
| 第五章 | 发行人基本情况 | 24 |
| | 一、公司基本情况..... | 24 |
| | 二、公司改制重组情况..... | 24 |
| | 三、公司股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况..... | 29 |
| | 四、公司设立时发起人出资及设立后历次股本变化的验资情况..... | 33 |
| | 五、公司股东结构和组织结构..... | 35 |
| | 六、公司控股子公司情况..... | 37 |
| | 七、发起人、持有公司 5% 以上的主要股东及实际控制人的基本情况..... | 39 |
| | 八、本公司股本的有关情况..... | 47 |
| | 九、员工及社会保障情况..... | 49 |
| | 十、持股 5% 以上的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及其履行情况..... | 53 |
| 第六章 | 业务和技术 | 55 |
| | 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况..... | 55 |
| | 二、发行人所处行业基本情况..... | 56 |
| | 三、发行人竞争地位..... | 75 |
| | 四、发行人主营业务情况..... | 85 |
| | 五、发行人主要固定资产及无形资产情况..... | 94 |

| | |
|--|------------|
| 六、发行人生产技术、研发情况及技术创新机制 | 99 |
| 七、发行人主要产品和服务的质量控制情况 | 102 |
| 第七章 同业竞争和关联交易 | 105 |
| 一、同业竞争 | 105 |
| 二、关联方及关联方关系 | 105 |
| 三、关联交易内容 | 106 |
| 四、关联交易决策程序 | 110 |
| 五、规范和减少关联交易的措施 | 111 |
| 第八章 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 | 112 |
| 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介及提名选聘情况 | 112 |
| 二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接或间接持有本公司股份情况 | 115 |
| 三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况 | 116 |
| 四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的薪酬安排 | 117 |
| 五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他任职情况 | 118 |
| 六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间存在的亲属关系 | 118 |
| 七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员与本公司的协议安排 | 119 |
| 八、董事、监事、高级管理人员任职资格 | 119 |
| 九、公司董事、监事、高级管理人员在近三年内变动情况 | 119 |
| 第九章 公司治理结构 | 121 |
| 一、股东大会相关制度建立健全及运行情况 | 121 |
| 二、董事会建立健全及运行情况 | 122 |
| 三、监事会建立健全及运行情况 | 126 |
| 四、公司重大生产经营决策程序与规则 | 127 |
| 五、公司的规范运作情况 | 129 |
| 六、公司关联交易制度、保护投资者权益的政策安排 | 130 |
| 七、公司内部控制制度 | 132 |
| 第十章 财务会计信息 | 134 |
| 一、近三年经审计的财务报表主要数据 | 134 |
| 二、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况 | 141 |
| 三、报告期内主要会计政策和会计估计 | 142 |
| 四、税项 | 149 |
| 五、非经常性损益 | 150 |
| 六、固定资产、无形资产及股权投资情况 | 150 |
| 七、主要债项 | 151 |
| 八、所有者权益情况 | 153 |
| 九、现金流量 | 154 |
| 十、会计报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 | 154 |
| 十一、主要财务指标 | 154 |
| 十二、资产评估情况 | 156 |
| 十三、历次验资情况 | 156 |
| 第十一章 管理层讨论与分析 | 157 |

| | |
|--|------------|
| 一、财务状况分析..... | 157 |
| 二、盈利能力分析..... | 167 |
| 三、现金流量分析..... | 185 |
| 四、资本性支出分析..... | 187 |
| 五、财务状况和盈利能力的趋势分析..... | 187 |
| 第十二章 业务发展目标..... | 189 |
| 一、发展计划..... | 189 |
| 二、拟订上述计划所依据的假设条件..... | 191 |
| 三、实施上述计划将面临的主要困难..... | 191 |
| 四、业务发展计划与现有业务的关系..... | 191 |
| 五、确保实现上述发展计划的主要途径..... | 192 |
| 第十三章 募集资金运用..... | 193 |
| 一、本次募集资金投资项目概况..... | 193 |
| 二、本次募集资金投资项目具体情况..... | 194 |
| 三、本次募集资金运用对发行人财务状况及经营成果的影响..... | 210 |
| 第十四章 股利分配政策..... | 212 |
| 一、股份公司设立前的利润分配政策..... | 212 |
| 二、股份公司设立后的股利分配政策..... | 212 |
| 三、报告期股利分配情况..... | 212 |
| 四、发行后股利分配政策..... | 212 |
| 五、公司未来三年的具体股利分配计划..... | 214 |
| 六、发行完成前滚存利润的分配安排..... | 214 |
| 第十五章 其他重要事项..... | 215 |
| 一、信息披露制度..... | 215 |
| 二、重大合同..... | 216 |
| 三、对外担保..... | 218 |
| 四、重大诉讼或仲裁..... | 218 |
| 五、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况..... | 218 |
| 第十六章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明..... | 219 |
| 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明..... | 219 |
| 二、保荐机构（主承销商）声明..... | 221 |
| 三、发行人律师声明..... | 222 |
| 四、承担审计业务的会计师事务所声明..... | 223 |
| 五、承担验资业务的机构声明..... | 224 |
| 第十七章 备查文件..... | 225 |
| 一、备查文件目录..... | 225 |
| 二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间..... | 225 |

第一章 释 义

在本招股说明书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下涵义：

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| 本公司、发行人、 公司、华龙电子 | 指 宁波华龙电子股份有限公司 |
| 鄞县华龙 | 指 鄞县华龙电子有限公司，后更名为宁波华龙电子有限公司 |
| 华龙有限 | 指 宁波华龙电子有限公司，发行人之前身 |
| 明昕电子 | 指 宁波明昕微电子股份有限公司，本公司股东 |
| 香港致誉 | 指 致誉有限公司（香港），本公司股东 |
| 香港汇利 | 指 汇利有限公司（香港），曾为本公司股东 |
| 铭龙投资 | 指 宁波铭龙投资有限公司，本公司股东 |
| 香港科恒 | 指 科恒实业有限公司（香港），本公司股东 |
| 南通华达 | 指 南通华达微电子集团有限公司，本公司股东 |
| 泰州华龙 | 指 泰州华龙电子有限公司，本公司控股子公司 |
| 铭龙电子 | 指 宁波铭龙电子技术开发有限公司，本公司控股子公司 |
| 深圳华龙 | 指 深圳市华龙精密模具有限公司 |
| 通富微电 | 指 南通富士通微电子股份有限公司 |
| 公司股东大会 | 指 宁波华龙电子股份有限公司股东大会 |
| 公司董事会、监事会 | 指 宁波华龙电子股份有限公司董事会、监事会 |

| | | |
|-----------|---|--|
| 公司章程 | 指 | 宁波华龙电子股份有限公司章程 |
| 保荐机构、主承销商 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 发行人律师 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 |
| 信永中和 | 指 | 信永中和会计师事务所有限责任公司 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 基准铜价 | 指 | 每月25日上海有色网所公布的1#电解铜的月平均价格，月底公司会根据基准铜价计算下月执行的产品价格并向客户报价 |
| CSIA | 指 | 中国半导体行业协会（China Semiconductor Industry Association） |
| SIA | 指 | 半导体行业协会（美国）（Semiconductor Industry Association） |
| SEMI | 指 | 国际半导体设备材料产业协会（Semiconductor Equipment and Materials International） |
| TO | 指 | Transistor Out-line 的缩写，晶体管外形封装 |
| DIP | 指 | Dual in-line package 的缩写，双列直插式封装 |
| SOP | 指 | Small out-line package 的缩写，小外形塑料封装 |
| SOT | 指 | Small Outline Transistor的缩写，小外形晶体管封装 |
| PLCC | 指 | Plastic leaded chip carrier 的缩写，塑料有引线片式载体封装 |
| QFP | 指 | Quad flat package 的缩写，四边引线扁平封装 |

| | | |
|------|---|--|
| LQFP | 指 | Low profile Quad Flat Package的缩写，薄型四边引线扁平封装 |
| BGA | 指 | Ball Grid Array Package的缩写，球栅阵列封装技术 |
| IC | 指 | Integrate Circuit的缩写，集成电路 |
| CSP | 指 | Chip size package 的缩写，芯片尺寸大小封装 |
| IDM | 指 | Integrated Device Manufacturing的缩写，整合组件制造商 |
| CCVI | 指 | Clustered Virtual Vertical Integration的缩写，群聚虚拟垂直整合 |
| 1mil | 指 | 等于0.001英寸，即0.000254毫米 |
| 报告期 | 指 | 2009、2010及2011会计年度 |

第二章 概 览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、简要情况

(一) 发行人

1、基本情况

发行人名称：（中文）宁波华龙电子股份有限公司

（英文）Ningbo Hualong Electronics Co.,Ltd.

法定代表人：陈亚龙

成立日期：2008年10月16日

注册地址：宁波市东钱湖旅游度假区旧宅村工业园

注册资本：7500万元

邮政编码：315124

联系电话：0574-88378368-8005

传 真：0574-88378258

互联网网址：<http://www.nbhldz.com>

电子信箱：office@nbhldz.com

经营范围：电子元件、继电器配件、电声器配件、接插件、电器配件、半导体器件及半导体元器件专用材料开发生产、电子零件、模具制造、加工。

2、公司主要业务

公司主要从事半导体封装用引线框架产品的研发、生产和销售。公司的主要产品包括分立器件用引线框架和集成电路用引线框架。

公司所处行业为半导体封装测试材料行业。半导体封装测试材料行业是半导体行业的重要子行业，该行业规模随着半导体行业发展持续增长。该行业为充分竞争行业，在本行业内公司积累了多年模具制作和引线框架电镀经验，引线框架

的产销量在国内同行中排名前两位。

3、股份公司设立情况

公司是由宁波华龙电子有限公司整体变更而来，前身可追溯至鄞县华龙电子有限公司。2008年10月16日，根据公司发起人会议决议并经宁波市工商行政管理局核准登记，宁波华龙电子有限公司整体变更为宁波华龙电子股份有限公司。

4、本次发行前各发起人持股情况

| 序号 | 股 东 姓 名 | 股份（股） | 比例（%） |
|----|---------|------------|--------|
| 1 | 明昕电子 | 20,288,079 | 27.05 |
| 2 | 香港致誉 | 14,584,885 | 19.45 |
| 3 | 陈亚龙 | 13,515,806 | 18.02 |
| 4 | 铭龙投资 | 9,978,713 | 13.30 |
| 5 | 南通华达 | 7,507,983 | 10.01 |
| 6 | 邬文通 | 4,948,802 | 6.60 |
| 7 | 香港科恒 | 4,175,732 | 5.57 |
| | 总 计 | 75,000,000 | 100.00 |

（二）控股股东和实际控制人情况

公司实际控制人为陈亚龙。2008年10月，陈亚龙通过与香港致誉、铭龙投资和邬文通签订《一致行动协议》，其实际可支配的公司表决权比例为57.37%。

陈亚龙，中国公民，无永久境外居留权，身份证号码：33022719640718****，住所：浙江省宁波市鄞州区邱隘镇方庄****。

二、发行人主要财务数据

经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司报告期主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项 目 | 2011/12/31 | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---------------|------------|------------|------------|
| 流动资产合计 | 30,795.12 | 27,671.76 | 20,135.16 |
| 非流动资产合计 | 21,033.19 | 17,394.76 | 11,995.40 |
| 资产总计 | 51,828.31 | 45,066.53 | 32,130.56 |
| 流动负债合计 | 30,505.27 | 26,929.29 | 17,805.93 |
| 非流动负债合计 | 548.15 | 607.01 | 49.20 |
| 负债合计 | 31,053.42 | 27,536.30 | 17,855.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 20,774.89 | 17,530.22 | 14,275.43 |
| 股东权益合计 | 20,774.89 | 17,530.22 | 14,275.43 |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 负债及股东权益总计 | 51,828.31 | 45,066.53 | 32,130.56 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

2、合并利润表主要数据

单位：万元

| 项 目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 营业总收入 | 52,048.46 | 50,096.76 | 32,390.82 |
| 营业利润 | 3,018.43 | 3,567.60 | 2,918.70 |
| 利润总额 | 3,631.03 | 3,794.70 | 3,160.51 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,244.67 | 3,254.79 | 2,726.88 |

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

| 项 目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流净额 | 417.18 | 5,009.04 | 2,689.76 |
| 投资活动产生的现金流净额 | -6,674.53 | -6,826.39 | -2,002.58 |
| 筹资活动产生的现金流净额 | 5,573.60 | 3,466.90 | -300.67 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -676.38 | 1,648.56 | 385.73 |

4、主要财务指标

| 财务指标 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| 流动比率 | 1.01 | 1.03 | 1.13 |
| 速动比率 | 0.65 | 0.73 | 0.86 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 54.44 | 56.80 | 53.12 |
| 应收账款周转率（次） | 3.72 | 4.12 | 3.76 |
| 存货周转率（次） | 4.47 | 6.48 | 5.87 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 6,762.45 | 5,892.54 | 4,743.88 |
| 利息保障倍数 | 5.68 | 10.91 | 11.51 |
| 每股经营活动产生的现金流量（元） | 0.06 | 0.67 | 0.36 |
| 每股净现金流量（元） | -0.09 | 0.22 | 0.05 |
| 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例（%） | 1.81 | 2.89 | 2.21 |

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》公司报告期的净资产收益率和每股收益计算如下：

| 报告期利润 | 报告期 | 加权平均 净资产收益率 | 每股收益 | |
|--------------|---------|----------------|------------|------------|
| | | | 基本每 股收益 | 稀释每 股收益 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 2011 年度 | 16.94% | 0.43 | 0.43 |
| | 2010 年度 | 20.47% | 0.43 | 0.43 |
| | 2009 年度 | 21.12% | 0.36 | 0.36 |

| | | | | |
|---------------------------|---------|--------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润 | 2011 年度 | 14.16% | 0.36 | 0.36 |
| | 2010 年度 | 19.18% | 0.41 | 0.41 |
| | 2009 年度 | 19.45% | 0.33 | 0.33 |

三、本次发行情况

- 发行股票类型： 境内上市人民币普通股（A股）股票
- 每股面值： 每股面值为1元（人民币）
- 发行数量： 本次公开发行人民币普通股2,500万股
- 发行方式： 采用网下配售和网上发行相结合的发行方式
或证监会认可的其他方式
- 发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内
自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除
外）
- 发行价格： 由公司和保荐机构通过初步询价确定发行价格
- 发行前每股净资产： 2.77元/股（按2011年12月31日经审计数据）
- 承销方式： 余额包销方式承销

四、募集资金主要用途

经公司2010年第一次临时股东大会决议通过，公司本次拟向社会公开发行2,500万股，占发行后公司总股本的25%，实际募集资金扣除发行费用的净额为【】万元，将全部用于公司主营业务相关项目及主营业务发展所需的营运资金。

公司所募集的全部资金将存储在董事会决定的专门账户集中管理，做到专款专用，募集资金专门账户开户银行为【】，开户账号为【】。

本次募集资金投向经公司股东大会审议批准，由董事会负责具体实施，根据项目轻重缓急顺序拟用于以下项目：

单位:万元

| 项目名称 | 总投资 | 备案情况 |
|-------------------------------|--------|-------------------|
| 1、年产半导体引线框架、接插件等电子电器配件300亿只项目 | 18,000 | 备案号：泰发改备[2010]15号 |
| 2、高精度塑封引线框架工程（技术）中心升级项目 | 5,000 | 甬经信技核[2012]1号 |
| 3、用于公司主营业务发展所需的营运资金 | | |

本次募集资金到位前，公司以自筹资金对年产半导体引线框架、接插件等电子电器配件300亿只项目进行前期投入，截至2011年12月31日，公司已支付该项目的工程款及其他费用8,154.90万元。

公司将严格按照相关规定使用本次公开发行募集资金，募集资金如有不足，资金缺口由公司自行解决。

第三章 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

1、股票种类：人民币普通股（A股）

2、每股面值：人民币1.00元

3、发行数量：2,500万股，占发行后总股本的25%

4、每股发行价：通过向询价对象询价确定发行价格

5、市盈率：【 】倍，以实际发行价格除以发行后每股收益计算。每股收益按发行前一年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股份计算。

6、发行前每股净资产：2.77元（按2011年12月31日经审计数据）

7、发行后每股净资产：【 】元（按发行前一年度净资产和本次募集资金合计额与发行后总股本计算）

8、市净率：【 】（以公司发行后每股净资产值计算）

9、发行方式：采用网下配售和网上发行相结合的发行方式

或证监会认可的其他方式。

10、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

11、承销方式：余额包销

12、预计募集资金总额和净额：

13、拟上市地：深圳证券交易所

14、发行费用概算：

（1）承销费用 本次发行募集资金总额的【 】%

（2）保荐费用 【 】万元

（3）上网发行手续费 本次发行募集资金总额的【 】‰

（4）审计费用 【 】万元

(5) 律师费用 【 】万元

二、本次新股发行的有关当事人

1、发行人：宁波华龙电子股份有限公司

法定代表人： 陈亚龙
注册地址： 宁波市东钱湖旅游度假区旧宅村工业园
电 话： 0574-88378368-8005
传 真： 0574-88378258
董事会秘书： 张秉
联 系 人： 徐良龙

2、保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人： 王开国
办公地址： 上海市淮海中路98号
电 话： （021） 23219000
传 真： （021） 63411627
保荐代表人： 洪晓辉、刘昊
项目协办人： 丁颖芳
项目组成员： 黄洁卉、郑友贤

3、发行人律师：上海市锦天城律师事务所

负 责 人： 吴明德
住 所： 上海市花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电 话： （021） 61059000
传 真： （021） 61059100
经 办 律 师： 徐军、顾海涛

4、会计师事务所：信永中和会计师事务所有限公司

法定代表人： 张克
住 所： 北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
电 话： 010-65542288
传 真： 010-65547190
经办会计师： 詹军 叶胜平

5、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地 址： 深圳市深南路1093号中信大厦18楼
电 话： （0755） 25938000
传 真： （0755） 25988122

6、收款银行：

账 号：
住 所：
电 话：
传 真：

三、发行人与中介机构关系的说明

发行人及全体董事与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、本次发行的重要日期

询价推介时间：【 】
定价公告刊登日期：【 】
申购日期：【 】
预计上市日期：【 】

第四章 风险因素

投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其它各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序不表示风险因素依次发生。

一、产业周期性波动风险

本公司主要生产半导体封装材料引线框架，属于半导体封装测试行业中的半导体封装材料支撑行业，公司产品所处行业的发展与半导体行业的发展正相关。从全球半导体产业发展的历史来看，半导体产业的发展呈现一定的周期性。由于受到市场格局变动、产品技术升级等影响，大约每隔四五年全球半导体产业经历一次景气循环。半导体产业具有技术、市场呈周期性波动的特点，从而导致半导体封装材料行业也呈现相同的趋势。

半导体行业（包含半导体封装材料行业）的周期性波动系行业固有的特点，如公司未来不能及时采取措施适应国内半导体封装行业市场和技术的高速发展，行业的周期性波动会对发行人的盈利水平带来一定影响。

二、原材料价格波动的风险

公司引线框架产品的主要原材料是铜带，2009年、2010年及2011年公司产品引线框架成本中主要原材料铜带所占比重如下表所示：

| 名称 | 2011 | 2010 | 2009 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 铜带占主营业务成本比重（%） | 70.08 | 72.91 | 67.72 |

铜带是公司的重要原材料，铜价的波动对公司采购成本影响较大。2009年以来国内铜价随着国际铜价大幅波动，报告期内公司主要原材料铜带的采购价格如下：

| 名称 | 2011 | 2010 | 2009 |
|----------------|------|------|------|
| 铜带平均采购价格（万元/吨） | 6.49 | 5.44 | 4.10 |

公司主要原材料铜带价格的大幅波动，将影响到公司的成本控制和管理，从而给公司的生产经营带来一定的压力。

由于公司主要原材料采购价格与产品销售价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也存在一定差异，若未来本公司不能及时调整价格抵消成本波动的影响，或采取措施消化原材料价格波动的影响，则可能会对公司盈利构成一定影响。

三、所得税政策变化的风险

本公司于 2009 年 9 月被认定为高新技术企业，有效期三年，2009 年度至 2011 年度享受 15% 所得税优惠税率。如公司将来未被继续认定为高新技术企业，则将不再享受高新技术企业所得税税收优惠政策，这对本公司的经营业绩将产生一定影响。

四、客户集中度较高的风险

2009 年~2011 年发行人向前五名客户销售产品的金额占当年总收入的比例为 37.51%、41.28%、41.45%，客户集中度相对较高。较高的客户集中度符合目前国内半导体封装测试行业的特点及公司现阶段的发展战略。尽管公司与半导体封装测试行业客户一直保持着长期的良好合作关系，但如果今后对主要客户销售出现较大幅度下降，仍将对公司经营业绩产生不利影响。

五、供应商集中度较高的风险

报告期内，本公司向中国铝业公司下属公司采购合计金额占年度采购总额的比例较大，其中 2010 年和 2011 年占年度采购总额的比例分别为 54.41% 和 60.43%，2009 年中国铝业公司下属公司占年度采购总额的比例为 28.86%，但前五大原材料供应商占公司年度主要原材料采购总额的比例达到 83.54%，采购集中程度较高，存在原材料供应商相对集中风险。

六、财务风险

（一）应收账款发生坏账的风险

截至 2009 年、2010 年和 2011 年末，本公司应收账款余额分别为 9,933.74 万元、14,355.81 万元和 13,656.99 万元；报告期各期末公司应收账款余额较大。

截至 2011 年 12 月 31 日，一年期以内的应收账款余额占全部应收账款余额的比例为 97.31%。从应收账款账龄来看，一年期以内应收账款所占比例很高，反映出公司收入质量较好，应收账款回收能力较强。

随着公司经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收、发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生较大影响。

（二）短期偿债能力不足风险

本公司 2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日的流动比率分别为 1.13、1.03 和 1.01，速动比率分别为 0.86、0.73 和 0.65，同时公

公司的负债主要由流动负债构成，流动比率和速动比率显示公司短期偿债有一定的压力。

七、技术风险

半导体行业的高速增长以及新型封装方式的不断出现推动了行业技术的发展。为满足对所封装芯片电气特性的保持、芯片保护、应力缓和等功能，同时适应国内外市场对引线框架产品绿色环保等方面的政策，公司在产品开发以及工艺设计过程中不断应用新技术。新技术由于应用时间相对较短，存在技术不成熟、产品质量不稳定的风险。

八、净资产收益率下降的风险

本次发行后，本公司净资产预计将比报告期末显著增加，由于募集资金投资项目存在一定的建设周期，因此本公司存在发行后净资产收益率被摊薄的风险。

九、募集资金投资项目风险

本次募集资金用于投资：1、年产半导体引线框架、接插件等电子电器配件300亿只项目；2、高精度塑封引线框架工程（技术）中心升级项目；3、用于公司主营业务发展所需的营运资金。前两个项目建成后，公司产品的综合产能将大幅度提高，生产规模得以扩大，产品种类将更加丰富，抗风险能力进一步提高。

上述前两个项目在实施过程中可能受到工程进度、工程管理、设备供应及设备价格等因素的影响，致使项目的实际盈利水平、盈利时间等与预期出现差异。尤其是本次募投项目实施后，公司引线框架产能将由现有250亿只扩大为450亿只，随着产量的增加，公司可能面临产品的市场销售风险，以及由此带来的新客户开发的挑战。

十、实际控制人控制的风险

本公司的实际控制人为陈亚龙。公司现有股东中与陈亚龙签订一致行动协议的股东包括邬文通、铭龙投资和香港致誉。根据上述股东之间所签署的一致行动协议，邬文通、香港致誉、铭龙投资将其所享有的发行人股东大会的投票表决权、提案权，董事、独立董事、监事候选人的提名权以及临时股东大会的召集权等授予陈亚龙。

本次发行前陈亚龙及上述一致行动人合计直接持有公司57.37%的股份，处于绝对控股地位。本次发行后，陈亚龙及其一致行动人将合计直接持有公司43.03%的股份，仍处于相对控股地位。公司存在实际控制人利用控制地位通过行使表决权或其他方式对公司进行不当控制的风险。

第五章 发行人基本情况

一、公司基本情况

发行人名称：（中文）宁波华龙电子股份有限公司

（英文）Ningbo Hualong Electronics Co.,Ltd.

法定代表人：陈亚龙

设立日期：2008年10月16日

公司住所：宁波市东钱湖旅游度假区旧宅村工业园

注册资本：7,500万元

邮政编码：315124

联系电话：0574-88378368-8005

传 真：0574-88378258

互联网网址：<http://www.nbhldz.com>

电子信箱：office@nbhldz.com

经营范围：电子元件、继电器配件、电声器配件、接插件、电器配件、半导体器件及半导体元器件专用材料开发生产、电子零件、模具制造、加工。

二、公司改制重组情况

（一）公司设立方式

本公司是由宁波华龙电子有限公司整体变更设立的股份有限公司，本次变更以2008年5月31日为审计基准日，将经信永中和审计的华龙有限净资产114,126,369.06元中的75,000,000元折为75,000,000股，保留8,147,397.72元作为法定公积金，其余30,978,971.34元作为股份公司的资本公积。2008年10月16日，公司在宁波市工商行政管理局领取了注册号为330200400026232的《企业法人营业执照》。

（二）发起人

公司发起人为陈亚龙、邬文通、明昕电子、香港致誉、铭龙投资、香港科恒、南通华达。公司设立时，各发起人持股情况如下：

| 序号 | 股 东 姓 名 | 股份（股） | 比例（%） |
|----|---------|------------|--------|
| 1 | 明昕电子 | 20,288,079 | 27.05 |
| 2 | 香港致誉 | 14,584,885 | 19.45 |
| 3 | 陈亚龙 | 13,515,806 | 18.02 |
| 4 | 铭龙投资 | 9,978,713 | 13.30 |
| 5 | 南通华达 | 7,507,983 | 10.01 |
| 6 | 邬文通 | 4,948,802 | 6.60 |
| 7 | 香港科恒 | 4,175,732 | 5.57 |
| | 总 计 | 75,000,000 | 100.00 |

公司主要股东具体情况参见本章之七“持有公司 5%股份的主要股东及实际控制人情况”。

（三）公司设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司发起人包括陈亚龙、邬文通、香港致誉、铭龙投资、明昕电子、南通华达和香港科恒。

公司发起人在公司设立前后拥有的主要资产和实际从事的主要业务情况如下：

1、陈亚龙

公司改制设立前，陈亚龙拥有的主要资产为华龙有限 18.02%的股权、铭龙投资 21.50%的股权和深圳华龙 55.56%的股权。

公司改制设立后，陈亚龙将所持有的深圳华龙 55.56%的股权转让给深圳华龙另一名股东，2010年3月完成转让，陈亚龙不再持有深圳华龙股权；陈楠、何仲辉和王成名分别将其持有的铭龙投资 1%、0.67%和 3.33%股权转让给陈亚龙，转让完成后，陈亚龙持有铭龙投资的股权升至 26.50%；陈亚龙所持有的发行人股权在公司改制设立前后没有发生变化。

铭龙投资主要从事实业投资；深圳华龙主要从事精密模具、切筋设备的生产、销售。

2、邬文通

公司改制设立前，邬文通拥有的主要资产为华龙有限 6.60%的股权和铭龙投资 1.67%的股权。本公司改制设立之后，邬文通拥有的主要资产与公司设立之前无变化。

3、香港致誉

公司改制设立前后，香港致誉均从事对外投资业务，拥有的主要资产为华龙

有限 19.45%的股权。

4、铭龙投资

公司改制设立前，铭龙投资的业务为实业投资，主要资产为华龙有限 13.30% 股权。本公司改制设立之后，铭龙投资拥有的主要资产与本公司设立之前无变化，实际从事的业务亦未发生变化。

5、明昕电子

公司改制设立前，明昕电子的业务为半导体器件及其它电子产品制造，是公司的客户；明昕电子拥有的主要资产为该公司从事半导体封装测试业务所需的经营资产以及对华龙有限的股权。本公司改制设立之后，明昕电子拥有的主要资产与本公司设立之前无变化，实际从事的业务亦未发生变化。

6、南通华达

公司改制设立前，南通华达主要从事半导体分立器件、集成电路电子应用产品的生产和销售，是公司的客户。公司改制设立前，南通华达拥有的主要资产包括从事分立器件封装业务所需的经营性资产以及持有南通富士通微电子股份有限公司 36.93% 股权、南通金茂电子科技有限公司 100% 股权、南通金泰科技有限公司 60% 股权、南通尚明精密模具有限公司 26% 股权，以及华龙有限 10.01% 股权。本公司改制设立之后，南通华达于 2008 年 12 月投资北京达博有色金属焊料有限责任公司并持有 35% 的股权，于 2009 年 7 月购买江苏中鹏电子有限公司 5% 股权。2010 年 5 月，江苏中鹏电子有限公司增加注册资本并进行股份改制，更名为江苏中鹏新材料股份有限公司，南通华达持有该公司股权 200 万股，占注册资本 4.76%。本公司改制设立之后，南通华达实际从事的业务未发生变化。

7、香港科恒

公司改制设立前，香港科恒主要经营转口贸易，主要资产包括华龙有限 5.57% 股权、北京大恒图像视觉有限公司 24% 股权、北京大恒医疗设备有限公司 25% 股权和北京大恒倍生制药厂有限公司 25% 股权。本公司改制设立之后，香港科恒拥有的主要资产与本公司设立之前无变化，实际从事的业务亦未发生变化。

（四）公司设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司由华龙有限整体变更设立，在改制设立时承继了华龙有限的全部资产和业务，包括与研发、生产经营等业务相关的机器设备、生产经营厂房、流动资产等。

本公司设立时实际从事半导体行业封装用引线框架的研发、生产、销售，主

要产品包括分立器件用引线框架和集成电路用引线框架。

（五）公司设立前后业务流程

公司是由华龙有限整体变更设立的股份有限公司，设立前后的业务流程没有本质变化，具体业务流程详见本招股说明书第六章“业务与技术”之四“主营业务情况”。

（六）发行人设立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

发行人自 2008 年 10 月设立以来，在生产经营方面与主要发起人明昕电子、南通华达、陈亚龙曾经控制的企业深圳华龙之间，存在关联交易行为，交易价格均依照市场价格确定，并履行了《公司章程》和《关联交易公允决策制度》规定的程序。以上关联交易情况详见本招股说明书“第七章 同业竞争与关联交易之二、关联交易情况”。

报告期内深圳华龙曾经为公司实际控制人陈亚龙控制的企业，2010 年 3 月陈亚龙与深圳华龙另一名股东徐勇完成股权转让，陈亚龙将其持有的深圳华龙 100 万元股权以 100 万元价格转让给徐勇，转让后陈亚龙不再持有深圳华龙股权，深圳华龙亦不再是本公司的关联方。

（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况

公司是由华龙有限整体变更设立而来，华龙有限的资产由本公司承继。机器设备、房产等固定资产的产权、土地使用权证及商标均已过户到公司名下，具体情况详见本招股说明书第六章“业务与技术”之五“发行人主要生产用固定资产及无形资产状况”。

（八）公司独立运营情况

1、业务

公司主要从事半导体行业封装用引线框架的研发、生产和销售业务。公司主营业务突出，拥有独立的生产、供应、销售、研发系统，主营业务产品的生产、技术开发、原料采购、产品销售均独立进行，公司拥有自己独立的品牌和技术，不依赖于股东和其他任何关联方。公司具有独立的主营业务及面向市场自主经营的能力。

2、资产

公司是由华龙有限依法整体变更设立的股份公司，原有限公司的资产独立、

完整。

发起人投入股份公司的资产独立完整、权属清晰。作为生产型企业，公司拥有生产经营所必需的场所、机器设备及其他辅助和相关的配套设施、权利。

公司对其所有的资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东单位、公司高管人员及其关联人员占用而损害公司利益的情况。截至本招股说明书出具之日，公司未以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供担保。

3、人员

公司的总经理、副总经理、财务负责人及财务会计人员、董事会秘书、生产技术负责人等劳动人事关系都在股份公司，并专职在股份公司工作和领薪、未在股东单位及关联单位或其他单位担任除董事、监事以外的其他职务或领薪，与公司股东及各关联方也不存在交叉任职的现象。

4、机构

本公司已自主建立完整的组织管理机构，拥有独立的职能部门，分别设置办公室、财务部、生产部、技术部、业务部、品质部、审计部、人力资源部、证券部。本公司及各职能部门与控股股东及其职能部门不存在上下级关系，各职能部门制定了严格的规章制度并认真执行，不存在控股股东、实际控制人、其他发起人干预公司组织机构设立与运作的情况。

5、财务

本公司设置了独立的财务部门，建立了独立的、规范的会计核算体系和财务管理制度，依法独立进行财务决策。公司财务会计人员未在股东单位及其关联公司兼职。

公司在中国农业银行宁波市鄞州支行开立了独立的基本结算帐户（39412001040000747），未与股东单位及其他任何单位或人士共用银行帐户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与股东单位无混合纳税现象，公司已取得《税务登记证》。

综上所述，本公司资产完整，业务、人员、机构、财务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

三、公司股本的形成及其变化情况和重大资产重组情况

(一) 公司股本的形成及其变化

1、1997年6月鄞县华龙电子有限公司成立

1997年4月，陈亚龙与邬文通共同出资50万元组建鄞县华龙电子，其中陈亚龙投入货币资金36万元、投入设备2万元，共计出资38万元，占76%股权；邬文通投入货币资金12万元，占24%股权。陈亚龙投入的设备经鄞县正平会计师事务所于1997年6月5日出具《资产评估报告》（鄞正会评[1997]68号）评估，评估价值为2万元。本次出资经鄞县正平会计师事务所1997年6月5日出具的《验资报告书》（68号）确认。

1997年6月10日，鄞县华龙电子领取注册号为3302272015299的营业执照，注册资本为50万元，股权结构如下：

| 序号 | 股东 | 出资额（元） | | 合计出资额（元） | 比例（%） |
|----|-----|---------|--------|----------|--------|
| | | 现金 | 实物 | | |
| 1 | 陈亚龙 | 360,000 | 20,000 | 380,000 | 76.00 |
| 2 | 邬文通 | 120,000 | 0 | 120,000 | 24.00 |
| | 总计 | 480,000 | 20,000 | 500,000 | 100.00 |

2、2002年6月更名为宁波华龙电子有限公司及首次增资

2002年5月28日，鄞县华龙电子通过股东会决议，同意将公司更名为“宁波华龙电子有限公司”；同意将公司注册资本增加至300万元，陈亚龙、邬文通分别以现金190万元和60万元认购新增注册资本250万元，各股东出资比例不变。同年6月20日，宁波正源会计师事务所有限公司出具正源会验（2002）2169号《验资报告》，证实注册资本足额到位。2002年6月25日，华龙有限完成工商变更登记，注册号变更为3302272900023。此次增资前后华龙有限股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 增资前 | | 增资后 | |
|----|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | 出资额（元） | 比例（%） | 出资额（元） | 比例（%） |
| 1 | 陈亚龙 | 380,000 | 76.00 | 2,280,000 | 76.00 |
| 2 | 邬文通 | 120,000 | 24.00 | 720,000 | 24.00 |
| | 总计 | 500,000 | 100.00 | 3,000,000 | 100.00 |

3、2004年2月第二次增资

2003年10月31日，华龙有限股东会通过决议，同意以现金、资本公积、未分配利润作为出资，其中陈亚龙以货币出资223.37万元，以资本公积、未分配利润转增314.71万元；邬文通以货币出资70.54万元，以资本公积、未分配利润转增99.38万元。本次增资后，华龙有限注册资本增加至1,008万元，各股东出资比例不变。

2004年2月18日，宁波三港会计师事务所有限公司出具宁三会验[2004]94号《验资报告》，证实注册资本足额到位。3月18日，华龙有限完成工商变更登记。此次增资前后华龙有限股权结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 增资前 | | 新增出资 | | 增资后 | |
|----|------|-----------|--------|--------------|--------------|------------|--------|
| | | 出资额(元) | 比例(%) | 现金(元) | 转增(元) | 出资额(元) | 比例(%) |
| 1 | 陈亚龙 | 2,280,000 | 76.00 | 2,233,652.08 | 3,147,147.92 | 7,660,800 | 76.00 |
| 2 | 邬文通 | 720,000 | 24.00 | 705,363.81 | 993,836.19 | 2,419,200 | 24.00 |
| | 总计 | 3,000,000 | 100.00 | 2,939,015.89 | 4,140,984.11 | 10,080,000 | 100.00 |

4、2004年6月第一次股权转让、第三次增资并变更为中外合资企业

2004年2月20日，华龙有限召开股东会，同意陈亚龙将其持有的华龙有限33.6万元的出资以33.6万元的价格转让给邬文通，转让后陈亚龙持股比例为72.67%，邬文通持股比例为27.33%。

2004年2月21日，华龙有限通过股东会决议，同意香港汇利和明昕电子分别以现金840万元、1,512万元认购华龙有限新增注册资本合计2,352万元，陈亚龙、邬文通出资额不变，公司注册资本增加至3,360万元；增资后华龙有限变更为中外合资经营企业。同年3月8日，宁波市对外贸易经济合作局下发甬外经贸资管函[2004]78号《关于同意外资并购宁波华龙电子有限公司的批复》。3月9日，公司取得商外资甬合字[2004]067号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。6月14日，宁波三港会计师事务所有限公司出具宁三会验[2004]402号《验资报告》，证实华龙有限注册资本足额到位。

2004年6月22日，华龙有限完成工商变更登记，注册号变更为企合浙甬总副字第008121号。

此次增资前后华龙有限股权结构变化如下：

| 序号 | 股东姓名 | 增资前 | | 增资后 | |
|----|------|------------|--------|------------|--------|
| | | 出资额(元) | 比例(%) | 出资额(元) | 比例(%) |
| 1 | 明昕电子 | - | - | 15,120,000 | 45.00 |
| 2 | 香港汇利 | - | - | 8,400,000 | 25.00 |
| 3 | 陈亚龙 | 7,324,800 | 72.67 | 7,324,800 | 21.80 |
| 4 | 邬文通 | 2,755,200 | 27.33 | 2,755,200 | 8.20 |
| | 总计 | 10,080,000 | 100.00 | 33,600,000 | 100.00 |

5、2008年5月第二次股权转让、第四次增资

(1) 2008年5月第二次股权转让

2008年4月16日，华龙有限召开董事会，同意香港汇利将其持有的华龙有限672万元出资以672万元的价格转让给香港致誉(香港汇利与香港致誉实际控

制人均均为李志刚)；同意明昕电子将其持有的华龙有限 312.48 万元出资以 312.48 万元的价格转让给香港科恒（香港科恒为明昕电子股东）。

2008 年 5 月 15 日，华龙有限取得宁波市对外贸易经济合作局甬外经贸资管函[2008]291 号“关于同意合资企业宁波华龙电子有限公司股权转让的批复”。2008 年 5 月 16 日，取得变更后的宁波市人民政府商外资甬合字[2004]067 号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。

2008 年 5 月 19 日，华龙有限向宁波市工商行政管理局进行了股权变更登记，注册号变更为 330200400026232。变更前后股权结构为：

| 序号 | 股东姓名 | 转让前 | | 转让后 | |
|----|------|------------|--------|------------|--------|
| | | 出资额（元） | 比例（%） | 出资额（元） | 比例（%） |
| 1 | 明昕电子 | 15,120,000 | 45.00 | 11,995,200 | 35.70 |
| 2 | 陈亚龙 | 7,324,800 | 21.80 | 7,324,800 | 21.80 |
| 3 | 香港致誉 | - | - | 6,720,000 | 20.00 |
| 4 | 香港科恒 | - | - | 3,124,800 | 9.30 |
| 5 | 邬文通 | 2,755,200 | 8.20 | 2,755,200 | 8.20 |
| 6 | 香港汇利 | 8,400,000 | 25.00 | 1,680,000 | 5.00 |
| | 总计 | 33,600,000 | 100.00 | 33,600,000 | 100.00 |

(2) 2008 年 5 月第四次增资

2008 年 4 月 18 日，华龙有限召开董事会，同意新增注册资本 815.56 万元，其中铭龙投资以现金 1,500 万元认购 555.56 万元新增注册资本，陈亚龙以现金 54 万元认购 20 万元新增注册资本，香港致誉以现金 378 万元认购 140 万元新增注册资本，香港科恒以现金 270 万元认购 100 万元新增注册资本，注册资本增加至 4,175.56 万元。

2008 年 5 月 21 日，华龙有限取得宁波市对外贸易经济合作局甬外经贸资管函[2008]318 号“关于同意合资企业宁波华龙电子有限公司股权变更及增资的批复”。2008 年 5 月 22 日，华龙有限取得变更后的宁波市人民政府商外资甬合字[2004]067 号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。

此次增资事项经宁波三港会计师事务所有限公司 2008 年 5 月 30 日出具的宁三会工验[2008]226 号验资报告审验。2008 年 5 月 30 日华龙有限向宁波市工商行政管理局进行了股权变更登记，增资前后股权结构为：

| 序号 | 股东姓名 | 增资前 | | 增资后 | |
|----|------|------------|-------|------------|-------|
| | | 出资额（元） | 比例（%） | 出资额（元） | 比例（%） |
| 1 | 明昕电子 | 11,995,200 | 35.70 | 11,995,200 | 28.73 |
| 2 | 香港致誉 | 6,720,000 | 20.00 | 8,120,000 | 19.45 |
| 3 | 陈亚龙 | 7,324,800 | 21.80 | 7,524,800 | 18.02 |
| 4 | 铭龙投资 | - | - | 5,555,556 | 13.30 |

| | | | | | |
|---|------|------------|--------|------------|--------|
| 5 | 香港科恒 | 3,124,800 | 9.30 | 4,124,800 | 9.88 |
| 6 | 邬文通 | 2,755,200 | 8.20 | 2,755,200 | 6.60 |
| 7 | 香港汇利 | 1,680,000 | 5.00 | 1,680,000 | 4.02 |
| | 总计 | 33,600,000 | 100.00 | 41,755,556 | 100.00 |

6、2008年8月第三次股权转让

2008年7月18日，华龙有限召开董事会，同意香港汇利、明昕电子、香港科恒分别以604.8万元、252万元、648万元的价格向南通华达转让其所持的华龙有限168万元、70万元、180万元股权。转让后香港汇利不再持有华龙有限股权。

2008年8月19日，华龙有限取得宁波市对外贸易经济合作局甬外经贸资管函[2008]585号“关于同意合资企业宁波华龙电子有限公司股权转让的批复”。2008年8月20日，华龙有限取得变更后的宁波市人民政府商外资甬合字[2004]067号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。

2008年8月21日，华龙有限向宁波市工商行政管理局进行了股权变更登记。转让前后股权结构变化情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 转让前 | | 转让后 | |
|----|------|------------|--------|------------|--------|
| | | 出资额（元） | 比例（%） | 出资额（元） | 比例（%） |
| 1 | 明昕电子 | 11,995,200 | 28.73 | 11,295,200 | 27.05 |
| 2 | 香港致誉 | 8,120,000 | 19.45 | 8,120,000 | 19.45 |
| 3 | 陈亚龙 | 7,524,800 | 18.02 | 7,524,800 | 18.02 |
| 4 | 铭龙投资 | 5,555,556 | 13.30 | 5,555,556 | 13.30 |
| 5 | 南通华达 | — | — | 4180000 | 10.01 |
| 6 | 邬文通 | 2,755,200 | 6.60 | 2,755,200 | 6.60 |
| 7 | 香港科恒 | 4,124,800 | 9.88 | 2,324,800 | 5.57 |
| 8 | 香港汇利 | 1,680,000 | 4.02 | — | — |
| | 总计 | 41,755,556 | 100.00 | 41,755,556 | 100.00 |

7、2008年10月整体变更为股份公司

2008年8月28日，华龙有限召开董事会，同意由陈亚龙、邬文通、明昕电子、香港致誉、铭龙投资、香港科恒、南通华达在整体变更华龙有限的基础上共同发起设立宁波华龙电子股份有限公司，根据信永中和出具的XYZH/2007SHA1013号《审计报告》，将截止于2008年5月31日华龙有限净资产114,126,369.06元中的75,000,000元折为75,000,000股，保留人民币8,147,397.72元作为法定公积金，其余人民币30,978,971.34元作为股份公司的资本公积。股份公司各发起人按照其在华龙有限的持股比例各自持有股份公司的股份。

2008年9月16日，公司取得宁波市对外贸易经济合作局甬外经贸资管函

[2008]674号“关于同意宁波华龙电子有限公司变更为股份有限公司的批复”。2008年9月17日，公司取得变更后的宁波市人民政府商外资甬合字[2004]067号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。

2008年9月25日，信永中和出具《验资报告》(XYZH/2007SHA1013-3)，确认公司注册资本足额到位。

2008年10月16日，公司向宁波市工商行政管理局进行了注册并取得注册号为330200400026232的企业法人营业执照。

公司整体变更设立后股本结构如下：

| 序号 | 股东姓名 | 股份(股) | 比例(%) |
|----|------|------------|--------|
| 1 | 明昕电子 | 20,288,079 | 27.05 |
| 2 | 香港致誉 | 14,584,885 | 19.45 |
| 3 | 陈亚龙 | 13,515,806 | 18.02 |
| 4 | 铭龙投资 | 9,978,713 | 13.30 |
| 5 | 南通华达 | 7,507,983 | 10.01 |
| 6 | 邬文通 | 4,948,802 | 6.60 |
| 7 | 香港科恒 | 4,175,732 | 5.57 |
| | 总计 | 75,000,000 | 100.00 |

8、历次股权变化对公司实际控制人及公司业务、管理层、经营业绩的影响

(1) 历次股权变化对公司实际控制人的影响

历次股权变化未造成公司实际控制人发生变更，详见本章“七、发起人、持有公司5%以上的主要股东及实际控制人的基本情况之（一）实际控制人”。

(2) 历次股权变化对公司管理层、业务及经营业绩的影响

自鄞县华龙电子（后更名为华龙有限）成立以来，经多次股权变化，公司管理层一直保持稳定。公司主营业务一直为半导体封装用引线框架的研发、生产和销售。本公司在发展过程中先后获得重要客户明昕电子、南通华达的战略投资，通过战略合作提升了公司产品档次，丰富了产品品种，进而拓宽了产品市场和销售渠道，促进了公司业务的发展。

(二) 重大资产重组情况

发行人设立以来未发生重大资产重组。

四、公司设立时发起人出资及设立后历次股本变化的验资情况

(一) 公司的历次验资情况

自1997年鄞县华龙电子成立以来，因设立、增资等事项共进行了六次验资，

历次验资情况如下：

1、鄞县华龙电子于 1997 年 6 月成立时的验资情况

1997 年 4 月，陈亚龙与邬文通出资 50 万元成立鄞县华龙电子，鄞县正平会计师事务所 1997 年 6 月 5 日出具《验资报告书》（68 号）确认，截至 1997 年 6 月 5 日，各股东缴纳的注册资本合计 50 万元，已足额到位。

2、华龙有限于 2002 年 6 月第一次增资时的验资情况

2002 年 6 月，华龙有限委托宁波正源会计师事务所有限公司对陈亚龙、邬文通各股东增加注册资本 250 万元进行了验证。根据 2002 年 6 月 20 日宁波正源会计师事务所有限公司出具的正源会验（2002）2169 号《验资报告》，截至 2002 年 6 月 19 日，各股东缴纳的新增注册资本合计 250 万元，已足额到位。

3、华龙有限于 2004 年 2 月第二次增资时的验资情况

2004 年 2 月，华龙有限委托宁波三港会计师事务所有限公司对陈亚龙、邬文通各股东增加注册资本 708 万元进行了验证。根据 2004 年 2 月 18 日宁波三港会计师事务所有限公司出具的宁三会验[2004]94 号《验资报告》，截至 2004 年 2 月 18 日，各股东缴纳的新增注册资本合计 708 万元，已足额到位，其中以货币出资 2,939,015.89 元，以拥有的资本公积、未分配利润出资 4,140,984.11 元。

4、华龙有限于 2004 年 6 月第三次增资时的验资情况

2004 年 6 月，华龙有限委托宁波三港会计师事务所有限公司对香港汇利和明昕电子各股东增加注册资本 2,352 万元进行了验证。根据 2004 年 6 月 14 日宁波三港会计师事务所有限公司出具的宁三会验[2004]402 号《验资报告》，截至 2004 年 6 月 14 日，各股东缴纳的新增注册资本合计 2,352 万元，已足额到位。

5、华龙有限于 2008 年 5 月第四次增资时的验资情况

2008 年 5 月，华龙有限委托宁波三港会计师事务所有限公司对铭龙投资、陈亚龙、香港致誉和香港科恒新增注册资本 815.56 万元进行了验证。根据 2008 年 5 月 30 日宁波三港会计师事务所有限公司出具的宁三会工验[2008]226 号《验资报告》，截至 2008 年 5 月 28 日，四家股东缴纳的新增注册资本合计 815.56 万元已足额到位。

信永中和会计师事务所有限责任公司于 2012 年 1 月 20 日出具了《验资复核报告》（XYZH/2011SHA1003-6），认为宁波三港会计师事务所有限责任公司于 2008 年 5 月 30 日出具的宁三会工验[2008]226 号验资报告符合公司的实际情况。

6、本公司于 2008 年 10 月设立时的验资情况

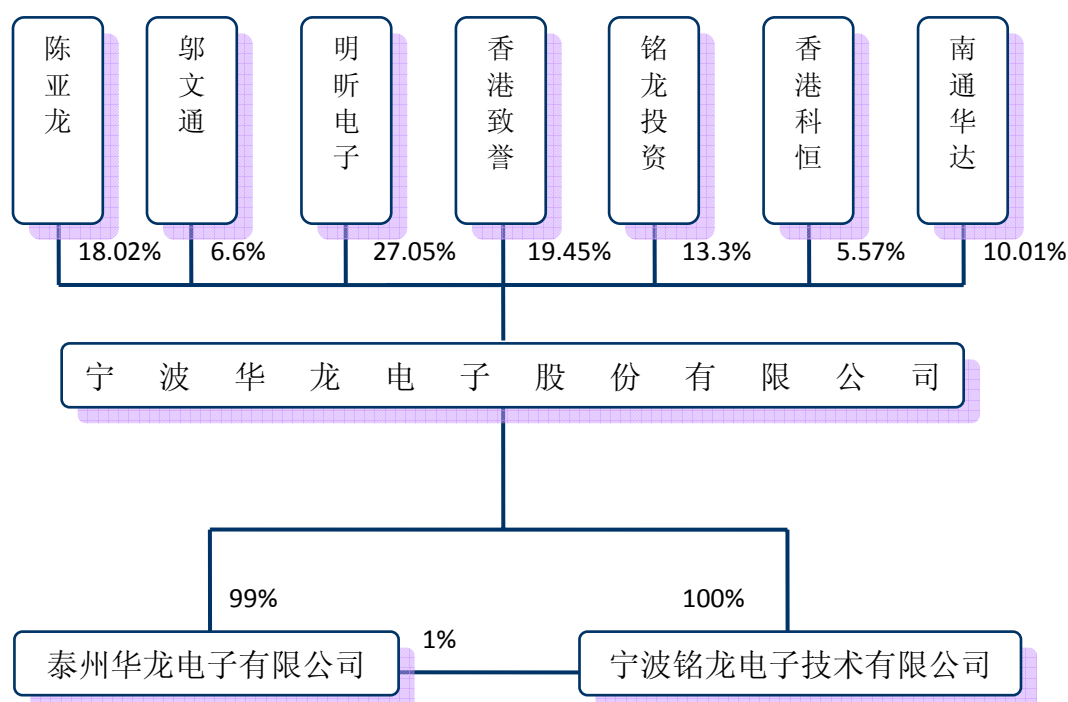
2008年9月，本公司筹备组委托信永中和会计师事务所对宁波华龙电子股份有限公司（筹）注册资本的实收情况进行审验。根据2008年9月25日信永中和出具的《验资报告》（XYZH/2007SHA1013-3），以截至2008年5月31日华龙电子的净资产114,126,369.06元折股，原华龙有限所有者权益除75,000,000元作为股份公司股本，保留8,147,397.72元作为法定公积金外，其余30,978,971.34元作为股份公司的资本公积，股份公司各发起人按照其在华龙有限的出资比例各自持有股份公司的股份。

（二）公司设立时发起人投入资产的计量属性

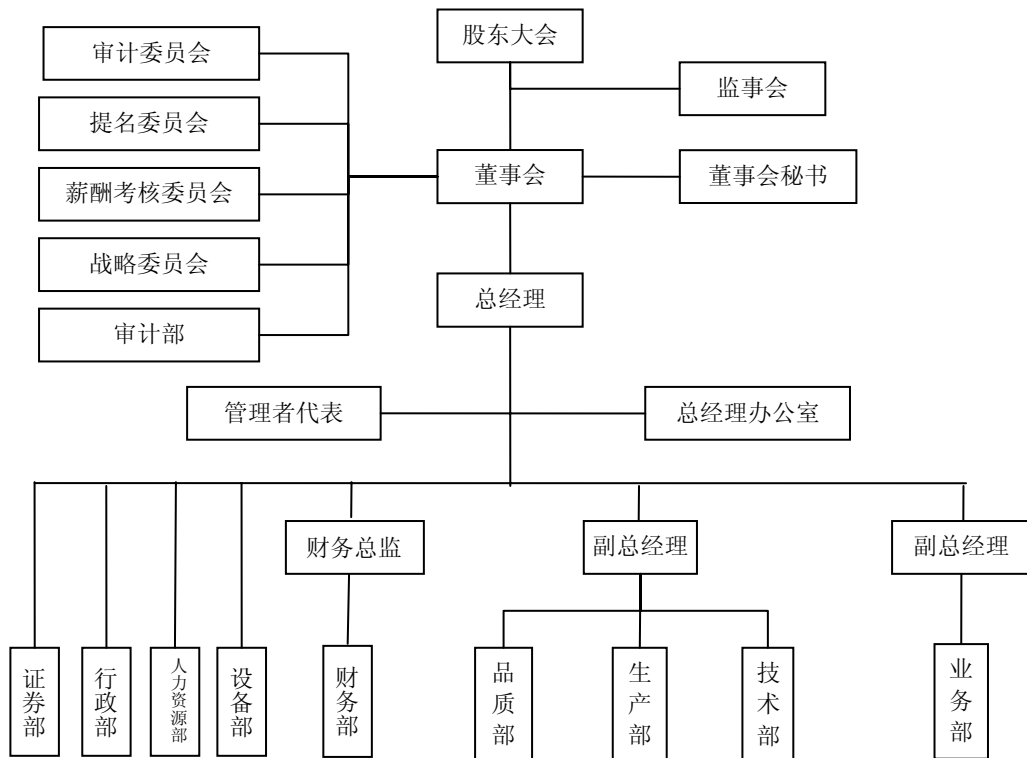
2008年10月，华龙电子有限整体变更设立本公司，发起人以华龙电子有限截至2008年5月31日的经审计的净资产114,126,369.06元按其帐面价值投入本公司，除75,000,000元作为股份公司股本，保留8,147,397.72元作为法定公积金外，其余30,978,971.34元作为股份公司的资本公积。

五、公司股东结构和组织结构

（一）公司股权结构图



（二）公司内部组织机构图



财务部：负责公司的财务管理，由财务总监领导，对总经理负责。

行政部：后勤保障和安全保卫等综合治理，对总经理负责。

人力资源部：主要负责公司人力资源管理和员工培训。

证券部：负责公司证券发行与上市、三会的筹备、投资者关系维护，对外投资管理，对分管领导负责。

业务部：负责原材料的采购、产品的销售、客户反馈、货款催收等工作，对分管领导负责。

生产部：负责引线框架产品各生产科调度、计划、生产组织等工作；负责公司原、辅材料的统计、库管，对分管领导负责。

技术部：负责新产品开发、模具设计和制造、冲压技术支持等工作，对分管领导负责。

品质部：负责公司标准化体系建设、技术文档管理、电镀技术支持等工作，及进料检验、产品质量控制、质量体系管理等工作，对分管领导负责。

设备部：主要负责设备的保养维护及维修。

六、公司控股子公司情况

截至本招股说明书签署之日，发行人拥有2家控股子公司：宁波铭龙电子技术开发有限公司和泰州华龙电子有限公司。

（一）泰州华龙电子有限公司

1、基本情况

住 所： 泰州市海陵工业园泰祥路西侧、凤凰东路北侧

法定代表人： 陈亚龙

成立时间： 2008年7月31日

注册资本： 5000万元

实收资本： 5000万元

注册号： 321200000015091

股权结构： 公司持有其99%股权，铭龙电子持有1%股权

经营范围： 电子元件、继电器配件、电声器配件、接插件、电器配件、半导体器件及半导体引线框架生产销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2、经营业绩及资产状况

泰州华龙最近一年主要财务数据如下表所示：

单位：万元

| | 2011/2011.12.31 |
|-----|-----------------|
| 总资产 | 11,311.61 |
| 净资产 | 4,728.02 |
| 净利润 | 67.22 |

以上数据经信永中和会计师事务所审计。

3、泰州华龙发展定位

公司生产经营地一直位于宁波市东钱湖旅游度假区，但随着企业规模的不断扩大，东钱湖旅游度假区不能及时提供公司发展所需土地，且劳动力资源较为缺乏，用工成本较高。随着公司业务的发展，公司在江苏的市场份额大大提高，公司前十大客户中有3家为江苏企业，江苏市场在公司发展中占有重要地位，且江苏地区可以提供相对充足的土地和人力资源。经过审慎的可行性研究，公司决定成立控股子公司泰州华龙，将其定位为公司本部之外最重要的生产基地，致力于

开拓江苏及其周边省份市场。

本公司公开发行股票后募集资金将用于对泰州华龙增资实施年产半导体引线框架、接插件等电子电器配件 300 亿只项目。项目实施全部完成后泰州华龙将具备 300 亿只引线框架的生产能力，可进一步满足市场需要、增强公司市场竞争力。

（二）宁波铭龙电子技术开发有限公司

1、基本情况

住 所： 宁波东钱湖旅游度假区旧宅村

法定代表人： 陈亚龙

成立时间： 2009年10月14日

注册资本： 150万元

实收资本： 150万元

注册号： 330217000004192

股权结构： 发行人全资持有

经营范围： 电子材料、半导体元器件专用材料及设备、模具的技术服务、技术开发、制造、加工、批发、零售；金属材料、化工原材料的批发、零售（不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

2、经营业绩及资产状况

铭龙电子最近一年主要财务数据如下表所示：

单位：万元

| | 2011/2011.12.31 |
|-----|-----------------|
| 总资产 | 149.85 |
| 净资产 | 149.85 |
| 净利润 | -0.2 |

以上数据经信永中和会计师事务所审计。

3、铭龙电子技术发展定位

根据宁波市人民政府办公厅文件甬政办发[2009]58号《关于推进制造企业二三产业分离发展的实施意见》“将技术中心、研发机构或设计院所组建成专业化的具有科技研发、技术推广、工业设计等功能的服务企业”的精神，公司设立该子公司，将其发展方向定为专业技术咨询和服务。今后本公司高精度塑封引线

框架工程（技术）中心将逐步分离纳入该子公司。

七、发起人、持有公司 5% 以上的主要股东及实际控制人的基本情况

（一）实际控制人

本公司的实际控制人为陈亚龙。

陈亚龙，中国公民，无永久境外居留权，身份证号码：33022719640718****，住所：浙江省宁波市鄞州区邱隘镇方庄****。

1、2004 年 6 月前陈亚龙为控股股东

自 1997 年 6 月鄞县华龙设立以来直至 2004 年 6 月华龙有限变更为中外合资经营企业前，陈亚龙及其姐夫邬文通持有华龙有限（鄞县华龙）全部股权，陈亚龙持股比例一直超过 70%，为绝对控股。

2、2004 年 6 月华龙有限变更为中外合资经营企业后至华龙电子设立前，陈亚龙对华龙有限董事会具有实质影响

2004 年 6 月明昕电子、香港汇利对华龙有限增资使其变更为中外合资经营企业后至华龙电子设立前，华龙有限作为中外合资经营企业，公司不设股东会，仅设立董事会。

在此期间内，陈亚龙的持股比例虽未能达到绝对控股比例，但其通过对董事会的实质影响，陈亚龙仍保持对华龙有限的实际控制权。

（1）2004 年 6 月华龙有限变更为中外合资经营企业后董事会构成变化情况

1) 2004 年华龙有限变更为中外合资企业，根据华龙有限当时的《公司章程》及合资经营合同，华龙有限的董事会由 5 人组成，其中陈亚龙委派 2 人，明昕电子委派 2 人，香港汇利委派 1 人，董事长由陈亚龙委派，副董事长由明昕电子委派。根据上述约定，陈亚龙委派陈亚龙、呼海新为董事，陈亚龙担任董事长；明昕电子委派张善国、王国强为董事，张善国担任副董事长；香港汇利委派陈召芬为董事。

上述董事会成员中，陈亚龙与陈召芬为夫妻关系。

2) 2008 年 3 月，呼海新辞去华龙有限董事职务，陈亚龙委派陈孝龙为华龙有限董事。陈亚龙与陈孝龙为兄弟关系。

3) 2008 年 4 月，华龙有限召开董事会，同意香港汇利将其持有的华龙有限 672 万元出资以 672 万元的价格转让给香港致誉；同意明昕电子将其持有的华龙

有限 312.48 万元出资以 312.48 万元的价格转让给香港科恒，华龙有限股东签署了新的《公司章程》。根据该《公司章程》，华龙有限的董事会由 5 人组成，其中陈亚龙委派 2 人，明昕电子委派 2 人，香港汇利委派 1 人，董事长由陈亚龙委派，不设副董事长。根据上述约定，陈亚龙委派陈亚龙、陈孝龙为董事，陈亚龙担任董事长；明昕电子委派张善国、王国强为董事；香港汇利委派陈召芬为董事。

4) 2008 年 7 月，南通华达通过股权转让，分别受让了香港汇利、明昕电子、香港科恒所持有的华龙有限 168 万元、70 万元、180 万元股权。华龙有限的股东签订新的《公司章程》及合资经营合同，约定华龙有限的董事会由 5 人组成，其中陈亚龙委派 2 人，明昕电子委派 1 人，香港致誉委派 1 人，南通华达委派 1 人，董事长由陈亚龙委派。根据上述约定，陈亚龙委派陈亚龙、陈孝龙为董事，陈亚龙担任董事长；明昕电子委派张善国为董事；香港致誉委派陈召芬为董事，南通华达委派石磊为董事。

(2) 关于董事会的议事规则

华龙有限自 2004 年 6 月变更为中外合资经营企业后至 2008 年 10 月整体变更为华龙电子前历次制定的《公司章程》对董事会的议事规则未发生改变，主要如下：出席董事会议的法定人数为全体董事的三分之二，不够三分之二人数时，其通过的决议无效；合资公司合同、章程的修改，合资公司的终止和解散，合资公司的注册资本的增加和转让，合资公司与其他经济组织的合并以及生产规模的更改，以及总经理任命等事项需经董事会全体成员一致通过。

(3) 认定陈亚龙为实际控制人的理由

通过对华龙有限自 2004 年 6 月变更为中外合资经营企业后至 2008 年 10 月整体变更为华龙电子前董事会成员构成情况以及该期间内陈亚龙对华龙有限董事会决议实质影响的分析，保荐机构认为自 2004 年 6 月变更为中外合资经营企业后至 2008 年 10 月整体变更为华龙电子前，陈亚龙为华龙有限的实际控制人，原因如下：

1) 对董事会席位的实质性影响。该段期间内华龙有限董事会由五人构成，其中陈亚龙委派两名董事，香港汇利（或香港致誉）委派一名董事；香港汇利（或香港致誉）所委派的董事为陈召芬，陈召芬为陈亚龙配偶。根据 2010 年 1 月 13 日海通证券与发行人律师与香港汇利、香港致誉的实际控制人李志刚就香港汇利（或香港致誉）委派陈召芬为华龙有限董事相关情况的现场访谈笔录，李志刚自投资华龙有限以后，根据华龙有限的章程及合资经营合同，通过香港汇利（或香港致誉）向华龙电子推荐了一名董事，即陈召芬，在推荐前，李志刚与陈亚龙进行了充分沟通，采纳了陈亚龙对于推举董事人选的意见；因此，陈亚龙能够控制

五个董事会席位中的 2 个，同时对香港汇利（或香港致誉）控制的董事会席位具有实质性影响。

2) 关于权利行使。根据上述访谈笔录，李志刚因其主要投资业务在香港且其本人对陈亚龙充分信任，故在投资华龙有限时李志刚曾与陈亚龙约定：香港汇利仅以财务投资者身份参股华龙有限，李志刚将通过香港汇利（或香港致誉）投资华龙有限的股权所涉及的除转让、质押、收益以外的其他一切股东权利均委托陈亚龙代为行使，如李志刚亲自行使相关权利，则应在事前与陈亚龙进行充分沟通并与之保持一致；

3) 虽然该段期间内明昕电子为持股比例最大的股东，2008 年 7 月前华龙有限五名董事中的两名由明昕电子委派，但是明昕电子及其委派董事不参与华龙有限的生产经营管理；

4) 在 2004 年华龙有限变更为中外合资企业后，需要董事会决议的与公司经营管理相关的事项，包括生产规划、年度营业报告、资金借款、利润分配方案、制定修改公司的重要规章制度等，均由华龙有限董事长陈亚龙提议，其历次董事会决议中未出现董事否决议案的情形，陈亚龙对华龙有限的经营方针、决策具有实质影响；

5) 华龙有限的经理管理层均由总经理陈亚龙提名后经董事会聘请，该段期间内未发生陈亚龙提名人员未获董事会聘请的情况，陈亚龙对经营管理层的任免具有实质影响。

3、华龙电子设立后，通过签订《一致行动协议》，陈亚龙实际可支配华龙电子表决权比例为 57.37%

华龙电子于 2008 年 10 月 16 日设立。2008 年 10 月 15 日，陈亚龙与邬文通、香港致誉、铭龙投资签订《一致行动协议》，其主要内容如下：

(1) 邬文通、香港致誉、铭龙投资将其所享有的发行人股东大会的投票表决权、提案权，董事、独立董事、监事候选人的提名权，以及临时股东大会的召集权等授予陈亚龙；

(2) 邬文通、香港致誉、铭龙投资如亲自出席发行人股东大会并审议相关议案时，应当提前与陈亚龙充分沟通并确保与陈亚龙保持一致。

2008 年 10 月华龙电子设立后，陈亚龙的持股比例虽未能达到绝对控股比例，但其通过与邬文通、香港致誉、铭龙投资签订一致行动协议，上述股东将其所享有的发行人股东大会的投票表决权、提案权，董事、独立董事、监事候选人的提名权，以及临时股东大会的召集权等授予陈亚龙，陈亚龙实际所能支配的表决权

比例达到57.37%，陈亚龙仍保持其对公司的实际控制权。

4、陈亚龙自 1997 年至今一直担任公司董事长、总经理

1997年6月鄞县华龙成立以来，公司历经几次股本变化，陈亚龙一直担任公司董事长、总经理，保证了公司管理和经营的连续性和稳定性。

综上所述，保荐机构和发行人律师认为发行人的实际控制人为陈亚龙，自1997年鄞县华龙设立以来一直未发生变化。

(二) 其他发起人、持有公司 5%以上股东

截至本招股说明书签署之日，邬文通、明昕电子、香港致誉、铭龙投资、香港科恒、南通华达均持有公司 5%以上股份，其基本情况如下：

1、邬文通

中国公民，无永久境外居留权，身份证号码：33022719590812****，住所：浙江省宁波市鄞州区横溪镇梅福村****。

2、明昕电子

公司全称：宁波明昕微电子股份有限公司

成立时间：1992 年 1 月 3 日

注册资本：17,800 万元

实收资本：17,800 万元

法定代表人：张家林

住所：宁波市高新区沧海路 168 号

主要生产经营地：宁波

股东构成：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 占注册资本的比例（%） |
|------------------|-----------|-------------|
| 大恒新纪元科技股份有限公司 | 8,395.70 | 47.17 |
| 香港科恒实业有限公司 | 4,509.33 | 25.33 |
| 宁波电子信息集团有限公司 | 3,560.00 | 20.00 |
| 宁波科技园区合泰科技投资有限公司 | 1,246.00 | 7.00 |
| 中国大恒（集团）有限公司 | 88.97 | 0.50 |
| 合计 | 17,800.00 | 100.00 |

主营业务：半导体器件及其它电子产品制造，电子技术服务和技术咨询。

明昕电子最近一年主要财务数据如下表所示：

单位：万元

| | 2011 / 2011.12.31 |
|-----|-------------------|
| 总资产 | 49,675.44 |
| 净资产 | 22,622.39 |
| 净利润 | -912.79 |

以上数据未经审计。

3、香港致誉

公司全称：致誉有限公司（香港）

成立时间：2008年3月3日

法定股本：港币 10000 元

董事：李志刚

住所：香港铜锣湾伊荣街 3 号欣荣商业大厦 13 楼 7-8 室

主要生产经营地：香港

股东构成：李志刚持有 100% 股权

主营业务：对外投资

香港致誉最近一年主要财务数据如下表所示：

单位：万港元

| | 2011 / 2011.12.31 |
|-----|-------------------|
| 总资产 | 1,189.23 |
| 净资产 | 84.44 |
| 净利润 | -9.25 |

以上数据未经审计。

4、铭龙投资

公司全称：宁波铭龙投资有限公司

成立时间：2008年4月10日

注册资本：1,500 万元

实收资本：1,500 万元

法定代表人：陈亚龙

住所：宁波东钱湖旅游度假区旧宅村 263 号

主要生产经营地：宁波

铭龙投资持有本公司 9,978,713 股，占公司发行前总股本的 13.30%，占发行后总股本的 9.98%。该公司的股东主要为公司高级管理人员和业务骨干，股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（元） | 比例（%） |
|----|------|------------|--------|
| 1 | 陈亚龙 | 3,975,000 | 26.50 |
| 2 | 陈孝龙 | 2,200,000 | 14.67 |
| 3 | 徐良龙 | 1,600,000 | 10.67 |
| 4 | 陈召芬 | 1,000,000 | 6.67 |
| 5 | 张秉 | 1,000,000 | 6.67 |
| 6 | 陈幼芬 | 950,000 | 6.33 |
| 7 | 殷普君 | 675,000 | 4.50 |
| 8 | 刘燕 | 500,000 | 3.33 |
| 9 | 陈格 | 500,000 | 3.33 |
| 10 | 邬文通 | 250,000 | 1.67 |
| 11 | 陈永德 | 250,000 | 1.67 |
| 12 | 吴太湖 | 150,000 | 1.00 |
| 13 | 俞赛龙 | 150,000 | 1.00 |
| 14 | 忻忠勇 | 150,000 | 1.00 |
| 15 | 陈明明 | 150,000 | 1.00 |
| 16 | 陈永开 | 150,000 | 1.00 |
| 17 | 钱明洪 | 150,000 | 1.00 |
| 18 | 王安康 | 100,000 | 0.67 |
| 19 | 马耀楣 | 100,000 | 0.67 |
| 20 | 王一夫 | 100,000 | 0.67 |
| 21 | 陈克勋 | 100,000 | 0.67 |
| 22 | 毕德君 | 100,000 | 0.67 |
| 23 | 戴家波 | 100,000 | 0.67 |
| 24 | 张志伟 | 100,000 | 0.67 |
| 25 | 戴燕军 | 100,000 | 0.67 |
| 26 | 李东亚 | 100,000 | 0.67 |
| 27 | 王志光 | 100,000 | 0.67 |
| 28 | 史龙达 | 100,000 | 0.67 |
| 29 | 毕海宏 | 100,000 | 0.67 |
| | 合计 | 15,000,000 | 100.00 |

铭龙投资最近一年主要财务数据如下表所示：

单位：万元

| | 2011 / 2011.12.31 |
|-----|-------------------|
| 总资产 | 1,500.93 |
| 净资产 | 1,497.28 |
| 净利润 | -1.03 |

以上数据未经审计。

5、南通华达

公司全称：南通华达微电子集团有限公司

成立时间：1990年10月11日

注册资本：2,000万元

实收资本：2,000万元

法定代表人：石明达

住所：江苏省南通市紫琅路99号

主要生产经营地：江苏

股东构成：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|---------|---------|
| 1 | 石明达 | 781.88 | 39.09 |
| 2 | 章小平 | 114.18 | 5.71 |
| 3 | 高峰 | 108.20 | 5.41 |
| 4 | 夏鑫 | 108.18 | 5.41 |
| 5 | 戴玉峰 | 107.19 | 5.36 |
| 6 | 张洞 | 97.20 | 4.86 |
| 7 | 仲美玲 | 97.20 | 4.86 |
| 8 | 赵霞 | 92.19 | 4.61 |
| 9 | 吴晓纯 | 84.75 | 4.24 |
| 10 | 石磊 | 78.94 | 3.95 |
| 11 | 郑剑华 | 65.20 | 3.26 |
| 12 | 高巧珍 | 23.87 | 1.19 |
| 13 | 戴锦文 | 19.24 | 0.96 |
| 14 | 成群 | 18.12 | 0.91 |
| 15 | 李金健 | 18.00 | 0.90 |
| 16 | 羌志恒 | 17.99 | 0.90 |
| 17 | 施宁峰 | 17.99 | 0.90 |
| 18 | 王建荣 | 17.99 | 0.90 |
| 19 | 曹亚群 | 17.99 | 0.90 |
| 20 | 王建华 | 14.75 | 0.74 |
| 21 | 谢红星 | 14.62 | 0.73 |
| 22 | 曹清波 | 13.50 | 0.68 |
| 23 | 赵亚俊 | 13.50 | 0.68 |
| 24 | 张岳平 | 13.50 | 0.68 |
| 25 | 吴品忠 | 13.49 | 0.67 |
| 26 | 严学军 | 13.49 | 0.67 |
| 27 | 周士琳 | 12.35 | 0.62 |
| 28 | 刘凤祥 | 4.50 | 0.23 |
| | 合计 | 2000.00 | 100 |

主营业务：生产销售半导体分立器件，集成电路电子应用产品等。

南通华达最近一年主要财务数据如下表所示：

单位：万元

| | 2011 / 2011.12.31 |
|-----|--------------------------|
| 总资产 | 112,528.00 |
| 净资产 | 85,984.00 |
| 净利润 | 1,072.91 |

以上数据未经审计。

6、香港科恒

公司全称：科恒实业有限公司（香港）

成立时间：1988年9月23日

注册资本：港币100万元

实收资本：港币100万元

董事：田文光

住所：香港新界火炭山尾街18-24号沙田商业中心18楼05室

主要生产经营地：香港

股东构成：

| 股东名称 | 出资额（港元） | 比例（%） |
|--------------|------------------|-----------------|
| 中国大恒（集团）有限公司 | 999,992 | 99.9992 |
| 田文光 | 1 | 0.0001 |
| 杨耀宏 | 1 | 0.0001 |
| 张家林 | 1 | 0.0001 |
| 关华 | 1 | 0.0001 |
| 孙夏安 | 1 | 0.0001 |
| 龚茜华 | 1 | 0.0001 |
| 朱柯 | 1 | 0.0001 |
| 邓锡铭 | 1 | 0.0001 |
| 合计 | 1,000,000 | 100.0000 |

主营业务：转口贸易

香港科恒最近一年主要财务数据如下表所示：

单位：万元

| | 2011 / 2011.12.31 |
|-----|--------------------------|
| 总资产 | 2,217.99 |
| 净资产 | 1,309.30 |
| 净利润 | -41.16 |

以上数据未经审计。

上述股东持有的本公司股票未被质押，也不存在其他争议。

（三）控股股东和实际控制人控制的其他企业

报告期内深圳华龙曾经为公司实际控制人陈亚龙控制的企业，2010年3月陈亚龙与深圳华龙另一名股东徐勇完成股权转让，陈亚龙将其持有的深圳华龙100万元股权以100万元价格转让给徐勇，转让后陈亚龙不再持有深圳华龙股权。

深圳华龙的基本情况如下：

公司全称：深圳市华龙精密模具有限公司

住 所：深圳市宝安区石岩同富裕工业区1-6#厂房1楼

成立时间：2004年11月12日

注册资本：180万元

实收资本：180万元

主营业务：精密模具、切筋设备的生产、销售

2009年12月31日，深圳华龙总资产为658.60万元，净资产为178.24万元，2009年全年实现净利润34.03万元。深圳华龙2009年度财务数据经中联会计师事务所有限公司深圳分所审计。

八、本公司股本的有关情况

（一）本次发行前后股本情况

本次发行前公司总股本为 7,500 万股，本次拟发行股份数量不超过 2,500 万股，发行后总股本不超过 10,000 万股，本次拟发行股份数量占发行后总股本的比例不超过 25%。具体情况如下：

| 序号 | 项 目 | 发行前 | | 发行后 | | 股权性质 |
|----|----------|-----------------|---------------|------------------|---------------|-------|
| | | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | 持股数 (万股) | 持股比例 (%) | |
| | 有限售条件的股份 | 7,500.00 | 100.00 | 7,500.00 | 75.00 | - |
| 1 | 明昕电子 | 2,028.81 | 27.05 | 2,028.81 | 20.29 | 境内法人股 |
| 2 | 香港致誉 | 1,458.49 | 19.45 | 1,458.49 | 14.58 | 外资股 |
| 3 | 陈亚龙 | 1,351.58 | 18.02 | 1,351.58 | 13.52 | 自然人股 |
| 4 | 铭龙投资 | 997.87 | 13.30 | 997.87 | 9.98 | 境内法人股 |
| 5 | 南通华达 | 750.80 | 10.01 | 750.80 | 7.51 | 境内法人股 |
| 6 | 邬文通 | 494.88 | 6.60 | 494.88 | 4.95 | 自然人股 |
| 7 | 香港科恒 | 417.57 | 5.57 | 417.57 | 4.18 | 外资股 |
| | 本次发行的股份 | - | - | 2,500.00 | 25.00 | - |
| | 总 计 | 7,500.00 | 100.00 | 10,000.00 | 100.00 | - |

（二）公司前十名股东

本次发行前，本公司共有七名股东，持股情况如上表。

（三）公司自然人股东及其在本公司担任的职务

公司股东中有两名自然人股东，陈亚龙担任本公司董事长兼总经理，邬文通在公司业务部任职。

（四）股东中的战略投资者持股及其简况

公司股东中战略投资者包括明昕电子和南通华达，其持股情况见上表。

明昕电子与南通华达的基本情况请参见招股说明书“第五章 发行人基本情况 七（二）其他发起人、持有公司5%以上股东”。

明昕电子是一家专业从事半导体器件研究、开发和制造的国家级高新技术企业，拥有TO-251、TO-251/5L、TO-252（DPAK）、TO-252/5L、TO-220、TO-262、TO-263（D2PAK）、TO-126、SOT-82、TO-92、TO-92SP、SOT-54、SOT-23、SOT-223、TO-247等20条单机自动化生产线，专业生产各类双极型晶体管、可控硅、场效应管、MOSFET以及BSIT、功率IC等各类大、中、小功率半导体器件。产品广泛地应用于计算机及外围设备、通讯设备、家用电器、汽车电子、绿色照明、仪器仪表、各类控制器、马达驱动器、传声器、音响系统、电控玩具及其它消费电子电器等领域。

南通华达也是国内一流的功率器件封装测试厂，为国家第一批集成电路认定企业，2009年被认定为国家高新技术企业，连续多年被评为“中国电子百强企业”。南通华达的主导产品包括TO-92、TO-92S、TO-94、TO-126、TO-220、TO-220F、TO-220C等。

本公司主营业务为半导体封装用引线框架的研发、生产和销售。本公司在发展过程中先后获得重要客户明昕电子、南通华达的战略投资，通过战略合作提升了公司产品档次，丰富了产品品种，进而拓宽了产品市场和销售渠道，促进了公司业务的发展。

（五）本次发行前各股东间的关联关系

截至本招股说明书签署之日，本次发行前各股东间存在如下关联关系：邬文通为陈亚龙姐夫；香港致誉、邬文通、铭龙投资与陈亚龙为一致行动人；香港科恒持有明昕电子25.33%股份，并与明昕电子受同一实际控制人控制。

（六）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司实际控制人陈亚龙及其一致行动人邬文通、铭龙投资、香港致誉承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司其他发起人明昕电子、香港科恒、南通华达承诺自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

除上述锁定和限售外，担任本公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东陈亚龙承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。

九、员工及社会保障情况

（一）员工人数及变化情况

2009-2011各年末，公司及控股子公司在册员工数分别是540人、690人、635人。

（二）员工专业结构

截至2011年12月31日，公司员工专业结构如下：

| 分工 | 人数（人） | 比例（%） |
|------|-------|--------|
| 生产人员 | 390 | 61.42% |
| 销售人员 | 4 | 0.63% |
| 技术人员 | 172 | 27.09% |
| 财务人员 | 12 | 1.89% |
| 管理人员 | 57 | 8.98% |
| 合计 | 635 | 100% |

（三）员工受教育程度

截至2011年12月31日，公司员工受教育程度如下：

| 教育程度 | 人数（人） | 比例（%） |
|---------|-------|--------|
| 大学及以上 | 17 | 2.68% |
| 大专 | 148 | 23.31% |
| 中专技校及高中 | 170 | 26.77% |
| 其他 | 360 | 47.24% |
| 合计 | 635 | 100% |

（四）员工年龄结构

截至2011年12月31日，公司员工年龄结构如下：

| 年龄区间 | 人数（人） | 比例（%） |
|--------|-------|--------|
| 30岁以下 | 326 | 51.34% |
| 31-40岁 | 172 | 27.09% |
| 41-50岁 | 110 | 17.32% |
| 51岁以上 | 27 | 4.25% |
| 合计 | 635 | 100% |

（五）公司执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况

1、执行标准

报告期内华龙电子执行的社保和住房公积金缴纳标准如下：

| 项目 | | 2011 | 2010 | 2009 |
|-----------|----|-----------|-----------|----------|
| 本地基本保险： | | | | |
| 缴费基数 | | 1685 | 1565 | 1439 |
| 养老 | 单位 | 12.0% | 12.0% | 12.0% |
| | 个人 | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
| 医疗 | 单位 | 11.0% | 11.0% | 11.0% |
| | 个人 | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| 失业 | 单位 | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| | 个人 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| 生育 | 单位 | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| 工伤 | 单位 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| 外来务工社会保险： | | | | |
| 缴费基数 | | 1685/1310 | 1565/1100 | 1439/850 |
| 养老 | 单位 | 13.0% | 13.0% | 13.0% |
| 医疗 | 单位 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 失业 | 单位 | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| 生育 | 单位 | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| 工伤 | 单位 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| 住房公积金： | | | | |
| 缴费基数 | | 1685 | 1565 | 1439 |
| 比例 | 单位 | 5% | 5% | 5% |
| | 个人 | 5% | 5% | 5% |

报告期内泰州华龙执行的社保和住房公积金缴纳标准如下：

| 项目 | | 2011 | 2010 |
|------------|----|-----------|-----------|
| 本地基本保险： | | | |
| 缴费基数 | | 1724/1583 | 1583/1409 |
| 企业基本养老保险 | 单位 | 21%/20.5% | 22%/21% |
| | 个人 | 8% | 8% |
| 基本医疗（大病救助） | 单位 | 9.5% | 9.5% |

| | | | |
|--------|----|---------|------|
| | 个人 | 2.5% | 2.5% |
| 失业 | 单位 | 2% | 2% |
| | 个人 | 1% | 1% |
| 生育 | 单位 | 1% | 1% |
| | 单位 | 1%/0.8% | 1% |
| 住房公积金: | | | |
| 缴费基数 | | 1724 | 1583 |
| 比例 | 单位 | 8% | 8% |
| | 个人 | 8% | 8% |

本年度社会保险缴费基数自本年6月至次年5月间执行；住房公积金缴费基数自本年7月至次年6月间执行。

2、实际缴纳情况

(1) 公司及子公司社保和住房公积金账户开立时间

公司及子公司社保和住房公积金账户开立时间如下：

| 单位 | 社保账户开立时间 | 住房公积金账户开立时间 |
|--------------|----------|-------------|
| 宁波华龙电子股份有限公司 | 2005年11月 | 2011年3月 |
| 泰州华龙电子有限公司 | 2010年8月 | 2011年5月 |

(2) 报告期内，公司及子公司社保及住房公积金缴纳情况

报告期内华龙电子缴纳社会保险情况如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2011 | | 2010 | | 2009 | |
|------|------|--------|------|--------|------|--------|
| | 缴纳人数 | 金额 | 缴纳人数 | 金额 | 缴纳人数 | 金额 |
| 养老保险 | 452 | 138.80 | 526 | 166.53 | 518 | 144.37 |
| 医疗保险 | 452 | 78.47 | 526 | 96.58 | 518 | 87.43 |
| 失业保险 | 449 | 14.69 | 523 | 19.33 | 515 | 16.44 |
| 工伤保险 | 449 | 18.64 | 523 | 10.15 | 515 | 8.77 |
| 生育保险 | 449 | 5.07 | 523 | 7.11 | 515 | 6.15 |
| 合计 | | 255.67 | | 299.70 | | 263.15 |

上表中缴费人数是指各年度12月份的缴费人数。

报告期内泰州华龙缴纳社会保险情况如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2011 | | 2010 | |
|------|------|-------|------|-------|
| | 缴纳人数 | 金额 | 缴纳人数 | 金额 |
| 养老保险 | 166 | 40.10 | 152 | 11.53 |
| 医疗保险 | 166 | 98.79 | 152 | 30.35 |
| 失业保险 | 166 | 10.17 | 152 | 2.02 |

| | | | | |
|------|-----|--------|-----|-------|
| 工伤保险 | 166 | 3.75 | 152 | 1.01 |
| 生育保险 | 166 | 3.39 | 152 | 0.81 |
| 合计 | 166 | 156.21 | 152 | 45.71 |

上表中缴费人数是指各年度 12 月份的缴费人数。

2009 年 12 月、2010 年 12 月、2011 年 12 月，公司及控股子公司聘用已退休人员而无需缴纳社保人数分别为 22 人、12 人、17 人。

报告期内公司及子公司均按照社保相关规定，自用工之日起三十日内为新入职员工缴纳社会保险。报告期内公司及子公司均不存在应缴未缴社保之情形。

华龙电子、泰州华龙分别于 2011 年 3 月、2011 年 5 月开立了住房公积金账户。报告期内华龙电子及控股子公司缴纳住房公积金情况如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2011 | | 2010 | | 2009 | |
|------|------|-------|------|-------|------|----|
| | 缴纳人数 | 金额 | 缴纳人数 | 金额 | 缴纳人数 | 金额 |
| 华龙电子 | 446 | 55.30 | 277 | 13.11 | - | - |
| 泰州华龙 | 20 | 4.35 | 0 | 0.00 | - | - |

截止 2011 年 12 月，华龙电子已为 446 名员工办理了住房公积金缴存手续；泰州华龙由于员工大部分为农村户籍，住房公积金缴费人数为 20 人。

3、合规证明出具情况

(1) 2012 年 1 月 30 日，宁波东钱湖旅游度假区人力资源和社会保障局出具《关于宁波华龙电子股份有限公司及其控股子公司劳动和社会保障情况的说明》，截止 2011 年 12 月 31 日，华龙电子和铭龙电子共拥有在册员工 452 人，全部与公司签订劳动合同，且所有劳动合同均已办理备案手续；华龙电子和铭龙电子已经按照国家及地方性规定，为其员工办理了各项社会保险并能按时足额缴纳，至今未发现违反劳动方面的法律法规而被处罚的情形。

(2) 2012 年 2 月 1 日，泰州市人力资源和社会保障局出具《关于泰州华龙电子有限公司劳动和社会保障情况的证明》，证实“泰州华龙电子有限公司已按国家及地方性规定，为其员工办理了各项社会保险并能按时足额缴纳，至今未发现违反劳动方面的法律法规而被处罚的情形。”

(3) 2011 年 12 月 31 日，宁波市住房公积金管理中心出具证明，证实发行人“已在本中心为员工办理住房公积金缴存登记手续。已为员工缴存住房公积金。该公司自建立住房公积金制度至本证明出具之日期间没有因违反住房公积金法律法规被我中心处罚”。

(4) 2012 年 2 月 1 日，泰州市住房公积金管理中心出具证明，证实泰州华

龙“不存在因违反住房公积金有关法律、法规而被本中心处罚的情况”。

4、实际控制人及其控制的股东出具的承诺

报告期内，公司及子公司不存在被政府有关部门要求补缴社会保险、住房公积金和被处罚的情形，但仍存在因未按国家法律法规全员缴纳住房公积金而补缴的可能。根据测算，报告期内公司及子公司可能需补缴金额对当期归属于母公司股东的净利润的影响情况如下：

单位：万元

| | 2011 | 2010 | 2009 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| 测算欠缴住房公积金金额 | 23.12 | 66.24 | 44.72 |
| 影响归属于母公司股东的净利润的金额 | 19.66 | 56.30 | 38.02 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 3,244.67 | 3,254.79 | 2,726.88 |
| 住房公积金补缴金额占当期归属于母公司股东的净利润的比例 | 0.61 | 1.73 | 1.39 |

公司可能需补缴的住房公积金金额占当期净利润比重较小，如补缴上述住房公积金，对报告期内公司经营业绩和经营业务影响较小，不影响公司的持续经营。

发行人实际控制人陈亚龙作出承诺：“如政府主管部门要求宁波华龙电子股份有限公司及其控股子公司泰州华龙电子有限公司补缴住房公积金，则本人将按政府主管部门核定的金额无偿代宁波华龙电子股份有限公司及其控股子公司泰州华龙电子有限公司补缴住房公积金，并承担由此产生的一切费用。”

5、中介机构意见

经核查，保荐机构和发行人律师认为，发行人及其控股子公司泰州华龙虽存在按国家法律法规补缴住房公积金的可能，但其住房公积金的补缴义务已由陈亚龙承诺予以承担，故不会影响发行人的持续经营，亦不会对发行人本次发行产生实质性法律障碍。

十、持股 5%以上的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及其履行情况

公司股东均作出了以下承诺：

1、股份锁定承诺（详见本招股说明书第五章“发行人基本情况”之八“本公司股本的有关情况”）；

2、不占用公司资金承诺：“将不以任何理由和方式占用股份公司的资金或其他资源”；

3、确保公司独立运作的承诺：“本公司（本人）及本公司（本人）具有控制

权的企业将不会以任何方式直接或间接影响股份公司的独立规范运作，也不会通过显失公允的关联交易行为损害股份公司及其他股东的利益”。

公司实际控制人陈亚龙及其一致行动人邬文通、铭龙投资、香港致誉，还作出以下承诺：

1、不竞争承诺函（详见本招股说明书第七章“同业竞争与关联交易”之一“同业竞争”）；

2、华龙电子公开发行股票并上市前，未经陈亚龙书面同意，香港致誉、邬文通、铭龙投资不得向第三方转让其所持有华龙电子的股权；如华龙电子通过中国证监会的审核获准公开发行并上市，则香港致誉、邬文通、铭龙投资确保其所持华龙电子的股份锁定事宜上与陈亚龙保持一致；

3、香港致誉、邬文通、铭龙投资承诺，华龙电子公开发行股票上市后，如香港致誉、邬文通、铭龙投资所持华龙电子的全部或部分股份对外转让时（通过二级市场减持的除外），将确保受让方与陈亚龙保持一致行动，并签署书面承诺或与陈亚龙达成一致行动协议；

4、香港致誉、邬文通、铭龙投资均同意，在《一致行动协议》合法存续期间香港致誉、邬文通、铭龙投资均将持续、不间断的履行其在《一致行动协议》中所做承诺，所有承诺均为不可撤销承诺。

第六章 业务和技术

一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况

公司所处的行业为半导体行业中的半导体封装材料子行业。半导体封装直观上就是将生产出来的芯片封装起来，为芯片的正常工作提供能量、控制信号，并提供散热及保护功能。半导体封装工艺流程如下图所示：



上图中的装片、键合、塑封等工序即为半导体封装的主要工序，各工序所需使用的封装材料分别为引线框架、键合丝、塑封树脂。

半导体封装不仅起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用，还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上，这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接，从而实现内部芯片与外部电路的连接。

公司主要从事半导体封装用引线框架的研发、生产和销售。公司的主要产品为半导体封装用引线框架，具体可分为分立器件封装用引线框架和集成电路封装用引线框架两大类。报告期内公司主营业务收入构成如下表所示：

单位：万元，%

| | 2011 | | 2010 | | 2009 | |
|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 分立器件引线框架 | 42,045.37 | 87.66 | 37,387.00 | 89.09 | 22,005.35 | 90.25 |
| 集成电路引线框架 | 5,917.60 | 12.34 | 4,579.78 | 10.91 | 2,376.57 | 9.75 |
| 合计 | 47,963.03 | 100.00 | 41,966.79 | 100.00 | 24,381.93 | 100.00 |

分立器件引线框架是公司主要的收入来源，公司分立器件引线框架产品种类丰富，其使用范围涵盖二极管、三极管、光电器件和功率器件等主流的分立器件产品。与之相对应，公司分立器件封装用引线框架主要有 TO 系列、SOT 系列、功率模块系列、光电系列等四大系列。随着分立器件行业细分领域发展，普通二极管、三极管等分立器件产品已日渐成熟，而以 LED 为代表的光电器件和功率器

件被大量应用于新兴市场，光电器件和功率器件的需求量增速较快。伴随着分立器件行业上述发展特征，公司分立器件引线框架产品中应用于光电器件、功率器件的引线框架产品比重逐步上升，其中包括应用于汽车电子、功率场效应管（VDMOS）、高端电源开关等新型电力电子器件封装的 TO252、TO220、TO3P 系列引线框架以及大型 LED 模块封装用功率模块系列引线框架。

公司集成电路封装用引线框架品种主要包括 DIP 系列。报告期内集成电路引线框架产品实现的销售收入增长较快。

公司一直从事半导体封装关键材料引线框架的研发、生产和销售，自设立以来主营业务一直未发生变化。

二、发行人所处行业基本情况

本公司主要生产半导体封装材料引线框架，属于半导体行业中的半导体封装材料子行业。

（一）行业管理体制和产业政策

1、行业管理体制

本公司所处行业的主管部门是国家工业和信息化部。工业和信息化部电子信息司承担电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信息技术推广应用。

中国半导体行业协会是中国半导体分立器件和集成电路制造业的行业自律管理机构，是由全国半导体行业从事集成电路、半导体分立器件、半导体材料和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的单位，专家及其它相关的企、事业单位自愿结成的行业性的全国性的非营利性的社会组织。中国半导体行业协会下设集成电路分会、半导体分立器件分会、半导体封装分会、集成电路设计分会和半导体支撑业分会共 5 个分会。本公司是半导体行业协会半导体支撑业分会会员。

本公司所处行业已实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

2、产业政策

我国一直将半导体产业作为我国国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，颁布了多项优惠政策以鼓励该产业的发展。

2000 年 6 月，为推动我国软件产业和集成电路产业的发展，增加信息产业

创新能力和国际竞争力，带动传统产业改造和产品升级换代，进一步促进国民经济持续、快速、健康发展，国务院发布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》。该政策从投融资、税收、产业技术、出口等方面制定了优惠措施，直接推动了我国半导体行业的迅速发展。

2005年3月，财政部、国家发展改革委员会和信息产业部联合下发《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》，为鼓励集成电路企业加强研究与开发活动，国家设立了集成电路产业研究与开发专项资金。

2006年2月，国务院颁布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》，该纲要在重点领域中确定一批优先主题的同时，围绕国家目标，进一步突出重点，筛选出若干重大战略产品、关键共性技术或重大工程作为重大专项，《规划纲要》将“极大规模集成电路制造技术及成套工艺”确定为16个重大专项之一。

2009年4月，为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保电子信息产业稳定发展，国务院出台了《电子信息产业调整和振兴规划》，明确了我国将从“落实扩大内需措施、加大国家投入、加强政策扶持、完善投融资环境、支持优势企业并购重组、进一步开拓国际市场、强化自主创新能力建设”等方面促进我国电子信息产业发展。

2011年3月，国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》明确了我国产业结构调整的方向和重点，其中将“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料”列入鼓励类投资项目。

2011年12月，国家发展改革委和商务部公布的《外商投资企业产业指导目录》（2011年修订）将“电子专用材料开发与制造（光纤预制棒开发与制造除外）”列入鼓励外商投资产业目录。

2012年2月，国家工业和信息化部颁布的《电子信息制造业“十二五”发展规划》中提出，在关键电子元件和材料方面，积极发展用于支撑、装联和封装等使用的金属材料、非金属材料和高分子材料；在发光二极管（LED）方面，加大对封装结构设计、新封装材料、新工艺、荧光粉性能、散热机理的研究与开发。

2012年2月，国家工业和信息化部颁布的《集成电路产业“十二五”发展规划》中提出，要加强12英寸硅片、SOI、引线框架、光刻胶等关键材料的研发与产业化，支持国产集成电路关键设备和仪器、原材料在生产线上规模应用。

上述政策的颁布大大促进了我国半导体产业的发展，进而拉动了半导体封装

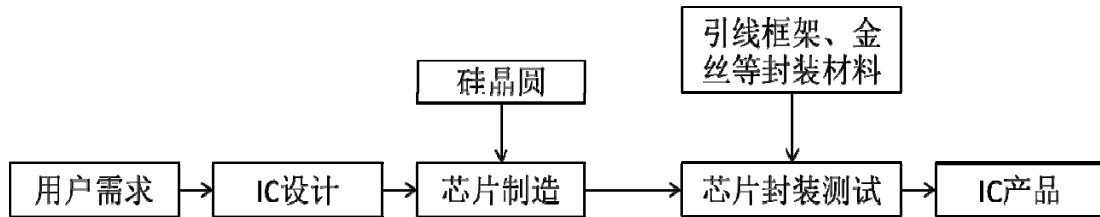
材料行业的发展。

（二）发行人所处行业发展概况

1、半导体行业发展直接拉动半导体封装材料行业的需求

（1）全球半导体行业

半导体可划分为集成电路和分立器件，集成电路产业链如下图所示：



分立器件产品由于其功能单一、产品结构稳定、更新换代较慢，其产业链主要由芯片制造和芯片封装测试两个环节构成。

所有半导体行业内的企业按商业模式可划分为两类，一类是IDM（Integrated Device Manufacture，整合组件制造）模式，另一类是垂直分工模式。IDM厂商的经营范围涵盖了IC设计、芯片制造、芯片封装测试等各环节，甚至延伸至下游电子终端。而在垂直分工商业模式下，随着分工的逐渐深入，形成了专业的无生产线的IC设计（Fabless）、芯片制造（Foundry、晶圆代工）以及芯片封装测试（Package & Testing）厂商。

根据中国半导体行业协会《中国半导体产业发展状况报告（2011年版）》，2010年度全球前十大半导体厂商销售收入及其商业模式如下表所示：

| 序号 | 企业名称 | 国家/地区 | 销售额(亿美元) | 商业模式 |
|----|-----------|-------|----------|---------|
| 1 | 英特尔 | 美国 | 400.20 | IDM |
| 2 | 三星电子 | 韩国 | 182.37 | IDM |
| 3 | 东芝 | 日本 | 130.81 | IDM |
| 4 | 德州仪器 | 美国 | 129.66 | IDM |
| 5 | 瑞萨电子 | 日本 | 118.40 | IDM |
| 6 | Hynix 半导体 | 韩国 | 105.77 | IDM |
| 7 | 意法半导体 | 欧洲 | 102.90 | IDM |
| 8 | 美光科技 | 美国 | 88.53 | IDM |
| 9 | 高通 | 美国 | 72.00 | Fabless |
| 10 | 尔必达 | 日本 | 68.78 | IDM |

从上表可以看出，目前全球半导体产业主要的商业模式还是IDM。美国、日本和欧洲半导体产业主要采用这一模式，典型的IDM厂商有英特尔、三星、德

州仪器、东芝、意法半导体等。

由于半导体制造业具有规模经济性特征，适合大规模生产。企业扩大生产规模会降低单位产品的成本，提高企业竞争力。但半导体产业所需的投资十分巨大，沉没成本高。这意味着除了少数实力强大的 IDM 厂商有能力扩张外，其他的厂商根本无力扩张。垂直分工商业模式正式在这种产业背景下产生。台湾积体电路制造股份有限公司的设立标志着半导体产业垂直分工模式的形成。台积电只做晶圆代工（Foundry），不做设计。Foundry 的出现降低了 IC 设计业的进入门槛，众多的中小型 IC 设计厂商纷纷成立，绝大部分是无生产线的 IC 设计公司（Fabless）。Fabless 与 Foundry 的快速发展，促成垂直分工模式的繁荣。

2010 年全球销售收入排名前五的集成电路设计企业如下表所示：

| 序号 | 企业名称 | 国家/地区 | 销售额（亿美元） |
|----|---------|-------|----------|
| 1 | 高通 | 美国 | 72.00 |
| 2 | 博通 | 美国 | 65.40 |
| 3 | AMD | 美国 | 64.60 |
| 4 | 联发科 | 台湾 | 36.10 |
| 5 | Marvell | 美国 | 36.02 |

2010 年销售收入排名前五的晶圆代工企业如下表所示：

| 序号 | 企业名称 | 国家/地区 | 销售额（亿美元） |
|----|-----------------|-------|----------|
| 1 | 台积电 | 台湾 | 133.07 |
| 2 | 联电 | 台湾 | 39.65 |
| 3 | Globalfoundries | 美国 | 35.10 |
| 4 | 中芯国际 | 中国 | 15.56 |
| 5 | TowerJazz | 以色列 | 5.10 |

随着半导体产业的发展，两种商业模式下的半导体企业会呈现出不同的竞争关系。

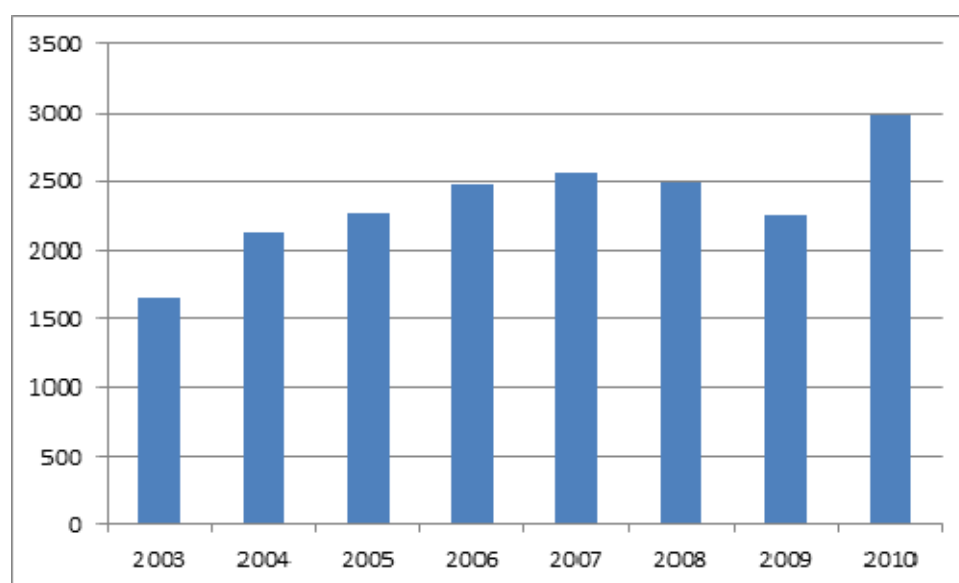
Fabless 与 IDM 之间的竞争激烈。Fabless 与 IDM 厂商都要直接面对客户，处于同一个竞争层面，二者之间存在激烈的竞争。相对而言，IDM 的品牌优势更为明显，有些 IDM 拥有强大的电子终端品牌，如三星、松下、索尼等，众多 Fabless 厂商只能通过捕捉市场热点并迅速推出产品制胜，也有少数技术实力强大的 Fabless 可以立足研发，推出自己的差异化产品，成为细分子行业的龙头。

芯片制造厂商、封装测试厂商与 IDM 之间的合作会更紧密。由于 IC 制造前期投入资金量较大，固定成本较高，如果一条生产线建立后不能进行大量生产则无法收回成本。由于加工工艺和设备的成本直线上升，许多 IDM 厂商无法通过投资生产线实现收益，而芯片制造厂商、封装测试厂商可以通过为多家客户代工同类型产品而获益，在这种情况下，许多 IDM 厂商将制造环节外包给芯片制造

厂商、封装测试厂商。两者的合作不但可以分担研发先进工艺所需的费用及所面临的风险，而且一旦一个新工艺投入量产，IDM 和芯片制造厂商、封装测试厂商都能从中获益。随着技术进一步发展，建设 IC 制造生产线的固定成本将更高，IDM 厂商将有更多的业务外包给芯片制造厂商、封装测试厂商，双方的共同研发也会越来越深入，二者之间的合作将更加密切。

近 10 年来，除 2001 年受互联网泡沫破裂影响及 2008 年、2009 年受国际金融危机影响以外，全球半导体行业总体呈现较为快速的增长。2010 年，全球半导体销售总额为 2,983.2 亿美元。

全球半导体行业销售额（亿美元）



资料来源：SIA，<http://www.sia-online.org/>

1990 年至 2000 年间，全球半导体销售总额年均复合增长率达到 15%。2001 年受互联网泡沫破灭影响该年度全球半导体销售总额骤降 32%，随后半导体行业在工艺技术创新以及宽带应用的带领下快速走出低迷，2001 年至 2007 年间年均复合增长率达到 10%。

2008 年以来，受国际金融危机的影响全球半导体行业出现负增长，2008 年和 2009 年分别较上年下降 3%和 9%；之后，在 PC、手机和消费电子市场增长的驱动下，全球半导体市场正进入反弹期。

根据 SIA 的统计，2010 年起全球半导体市场出现强劲反弹，在移动互联智能终端应用市场的强力推动下，在 PC、平板电视等市场增长的保障下，2010 年全球半导体产业同比大幅增长 31.8%，规模达 2,983.2 亿美元，创历史新高。预计未来全球半导体市场仍将保持增长，主要动力仍然在于 PC、手机等电子产品的

消费需求上升，在区域方面中国地区将是全球半导体产业增长的一个重要区域和增长动力。

（2）我国半导体行业

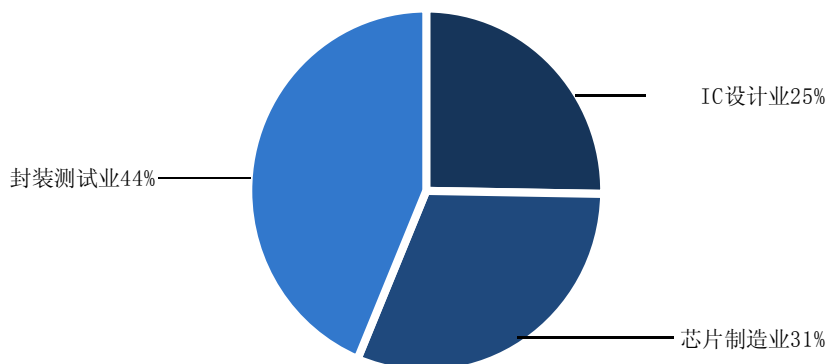
2000年6月国务院发布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》后，我国半导体产业开始进入高速发展阶段，经过近几年的快速发展，我国半导体行业正逐渐成为世界半导体行业一个重要的组成部分，但无论在技术水平和产业规模上与其他起步较早国家的差距较大。

我国半导体行业起步较晚，在全球半导体产业出现垂直分工商业模式后逐步出现了IC设计企业、芯片制造企业和芯片封装测试企业。

IC设计行业是一个高度技术密集的产业，欧美、日本企业经过几十年的技术积累，现在已经基本把芯片设计的核心技术掌握在手中，并且建立了垄断的态势。芯片制造行业是一个资本和技术密集产业，但以资本密集为主。晶圆厂的关键设备——光刻机的价格在千万美元到亿美金级别，一个晶圆工厂的投资现在是以十亿美金的规模来计划。相对于IC设计、芯片制造而言，芯片封装行业是一个技术和劳动力密集产业，在半导体产业链中是劳动力最密集的。结合各半导体产业链技术、资金特点，半导体封装行业是半导体产业链三层结构中技术要求最低，同时也是劳动力最密集的一个领域，最适合中国企业借助于相对较低的劳动力优势去切入的半导体产业的。半导体芯片封装测试产业也是全球半导体企业最早向中国转移的产业。

根据中国半导体行业协会《中国半导体产业发展状况报告》，2010年我国半导体集成电路产业结构如下图所示：

中国集成电路市场构成



数据来源：CSIA，《中国半导体产业发展状况报告（2011年版）》

根据中国半导体行业协会《中国半导体产业发展状况报告》，2010年我国十大集成电路设计企业如下表所示：

| 序号 | 企业名称 | 销售额（亿元） |
|----|------------------|---------|
| 1 | 深圳海思半导体有限公司 | 44.2 |
| 2 | 展讯通信有限公司 | 25 |
| 3 | 中国华大集成电路设计集团有限公司 | 14.6 |
| 4 | 深圳市国微控股股份有限公司 | 11 |
| 5 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 10 |
| 6 | 格科微电子（上海）有限公司 | 8.4 |
| 7 | 联芯科技有限公司 | 7.9 |
| 8 | 上海华虹集成电路有限公司 | 6.9 |
| 9 | 北京中星微电子股份有限公司 | 6.7 |
| 10 | 无锡华润矽科微电子股份有限公司 | 6.2 |

2010年我国十大集成电路与分立器件制造企业如下表所示：

| 序号 | 企业名称 | 销售额（亿元） |
|----|-----------------|---------|
| 1 | 海力士半导体（中国）有限公司 | 121.1 |
| 2 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 104.6 |
| 3 | 华润微电子有限公司 | 45.3 |
| 4 | 上海华虹 NEC 电子有限公司 | 24.8 |
| 5 | 台积电（中国）有限公司 | 17.8 |
| 6 | 上海宏力半导体制造有限公司 | 15.5 |
| 7 | 和舰科技（苏州）有限公司 | 15.1 |
| 8 | 天津中环半导体有限公司 | 15.02 |
| 9 | 首钢日电电子有限公司 | 12.1 |
| 10 | 吉林华微电子股份有限公司 | 11 |

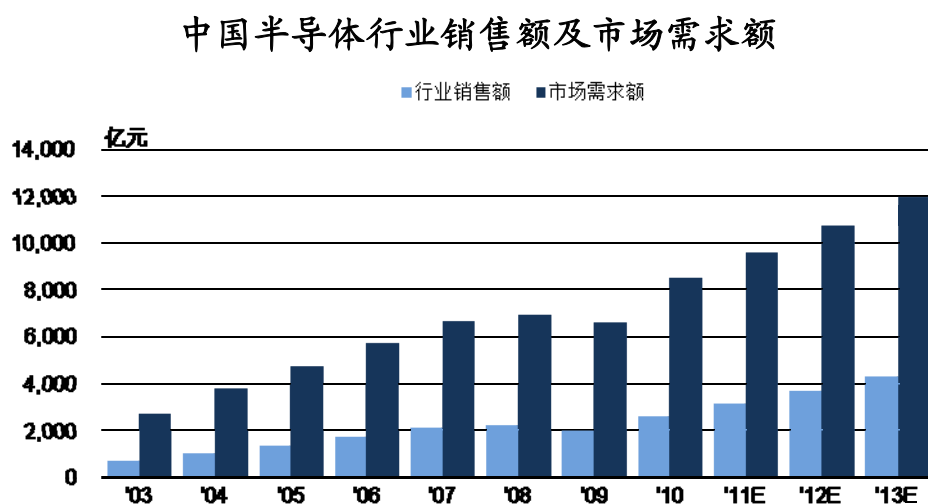
2010年我国十大半导体封装测试企业如下表所示：

| 序号 | 企业名称 | 销售额（亿元） |
|----|-----------------|---------|
| 1 | 飞思卡尔半导体（中国）有限公司 | 85.3 |
| 2 | 威迅联合半导体（北京）有限公司 | 64.4 |
| 3 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 63.9 |
| 4 | 南通华达微电子集团有限公司 | 41.8 |
| 5 | 上海松下半导体有限公司 | 39.4 |
| 6 | 深圳赛意法半导体有限公司 | 32.1 |
| 7 | 日月光封装测试（上海）有限公司 | 29.7 |
| 8 | 瑞萨半导体（北京）有限公司 | 26.2 |
| 9 | 乐山无线电股份有限公司 | 24.2 |
| 10 | 英飞凌科技（无锡）有限公司 | 22.2 |

现阶段国内具有规模的封装测试厂家可以分为四大类。第一类是国际大型整合组件制造商（IDM）的封装测试厂，包括飞思卡尔半导体（中国）有限公司、英特尔（上海）有限公司等，此类企业业务模式主要是承接母公司的 IC 产品后道封装测试加工，一般不从事代工业务；第二类是国际大型整合组件制造商控股的合资封装测试厂，深圳赛意法半导体有限公司、英飞凌科技（无锡）有限公司；

上海松下半导体有限公司，此类企业业务模式兼有 IDM 和专业封装代工；第三类是台资封装测试厂，如日月光公司（上海）有限公司、矽品科技（苏州）有限公司、京元电（苏州）有限公司等；第四类是国内本土封装测试厂，包括南通富士通微电子股份有限公司、江苏长电科技股份有限公司、华润华晶微电子技术有限公司、天水华天电子科技有限公司等。台资封装测试厂和国内本土封装测试厂则主要从事专业封装代工。

尽管我国半导体产业发展落后于其他国家，但我国半导体消费市场增长速度大大超过世界平均增长速度。2003 年至 2013 年我国半导体行业销售额及市场需求额如下图所示：



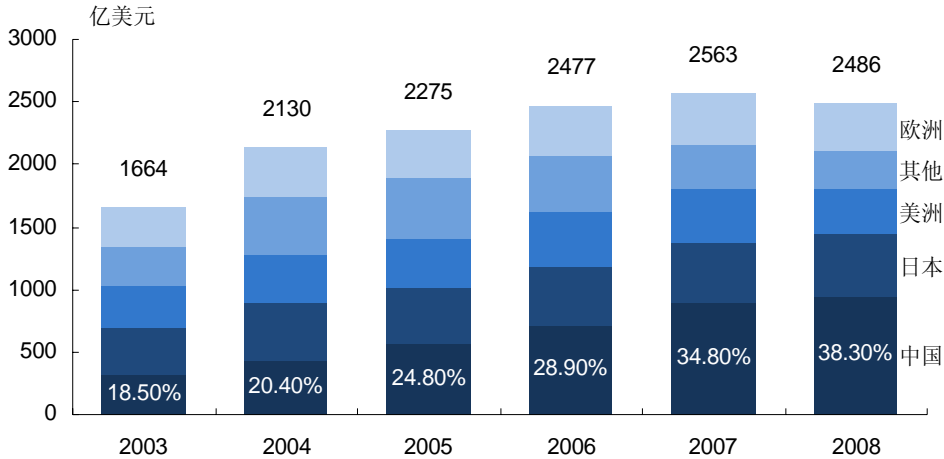
数据来源：中国半导体行业协会

1) 我国是整机生产大国，半导体需求量巨大

我国是整机产品的生产大国，彩电、冰箱、洗衣机、空调、汽车、手机、PC、数字影碟机等产量在世界均名列前茅，对各种电接插元件需求呈持续旺盛的态势。整机业的快速发展给我国半导体行业带来了较好的市场机遇。

我国是世界上第一大半导体消费市场，近几年我国半导体消费市场占全球半导体消费市场比例如下图所示：

全球半导体市场构成



数据来源：SIA

从 2005 年开始我国就成为世界半导体消费第一大国，尽管 2008 年受金融危机影响全球半导体消费市场萎缩 3%，我国半导体消费金额在 2008 年仍保持上升趋势，当年我国半导体消费额占到全球销售额的 38.3%。

在经历了 2008 年金融危机后，国家颁布了一系列措施促进国内需求增长，尤其是《电子信息产业调整和振兴规划》的颁布以及家电下乡、第三代移动通信网络、下一代互联网、数字广播电视网络、宽带光纤接入网络和数字化影院建设等一系列扩大内需措施的实施，电子信息产业的发展空间进一步拓展，直接拉动国内半导体消费需求。2010 年我国半导体消费额占全球销售额的比例上升到 42.4%。

2) 国内半导体供给不足，供需缺口巨大

尽管近年来我国半导体行业通过快速发展，规模得到了迅速提升，国内半导体需求的自给率逐步提高，但是截至目前供需缺口仍然较大。根据中国半导体行业协会的统计，2010 年我国半导体产业销售额 2,575.6 亿元，同期我国半导体总需求为 8,477.0 亿元，我国半导体产业的总供给仅能满足国内需求的 30.38%。

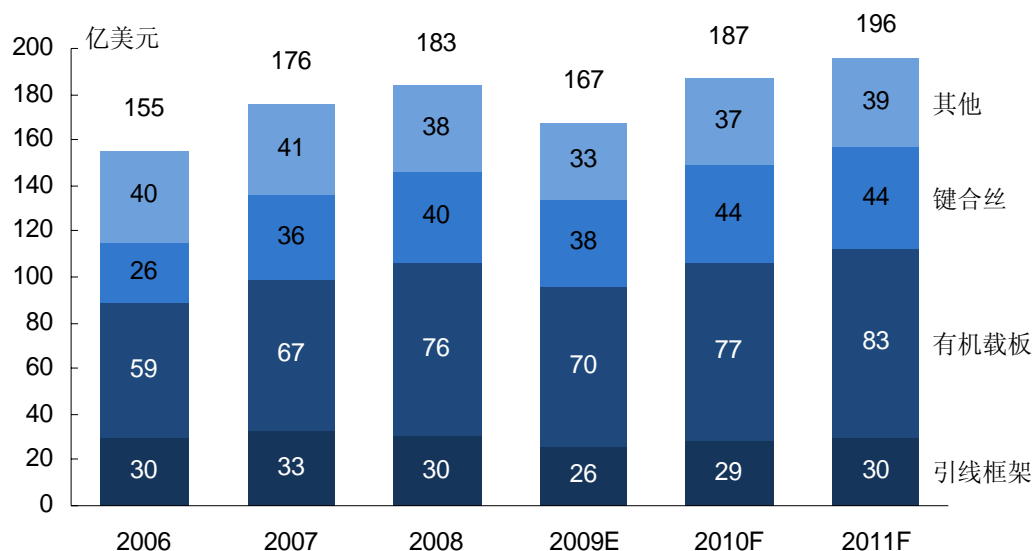
在巨大需求的拉动下，一方面国内企业由于产能和技术水平的提高，生产规模将逐步变大，另一方面国外企业将生产基地逐步向国内转移，我国的半导体行业面临较为长期的发展机遇。根据中国半导体行业协会的预测，我国半导体产业在未来 5 年内仍将保持高速发展。伴随着我国半导体产业的快速发展，引线框架等上游基础产业也将面临重大的发展机遇。

(3) 封装材料市场需求情况

引线框架是半导体封装的主要材料之一，其他半导体封装材料包括有机载板

(Organic Substrates)、陶瓷封装材料(Ceramic Packages)、封装树脂(Encapsulation Resins)、键合丝(Bonding Wire)、贴片材料(Die Attach Materials)等。根据 SEMI 统计资料，全球半导体封装材料市场消费额主要构成如下图所示：

全球封装材料市场



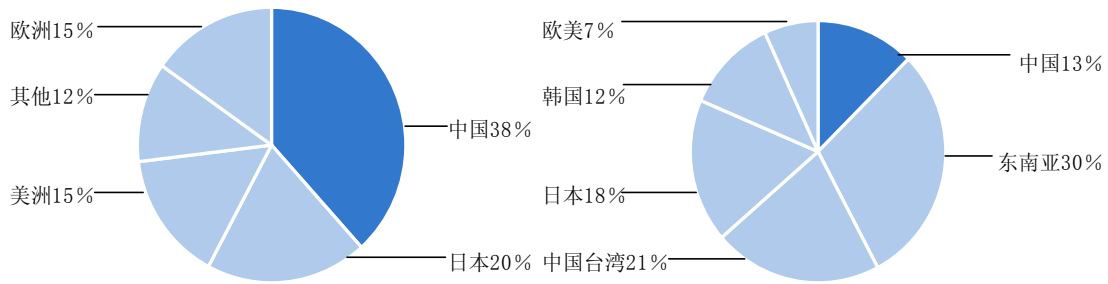
数据来源：SEMI

半导体封装材料消费金额与半导体产品产量以及所需主要金属材料的价格密切相关。对引线框架产品的而言，其消费金额的变化主要受半导体封装行业的需求量以及铜价和银价这几方面的因素影响。

半导体行业发展水平直接决定了封装材料市场需求状况。我国虽然是半导体消费大国，但我国半导体产业的发展水平远远落后于日本、韩国等半导体生产大国，目前半导体封装材料的主要市场在日本、韩国以及我国台湾地区等一些半导体产业起步较早的国家（地区），我国半导体封装材料市场占全球市场比例不大。

全球半导体市场区域分布和全球封装材料市场区域分布比较如下图所示：

2008年全球半导体消费市场区域构成 2008年全球封装材料消费市场区域构成



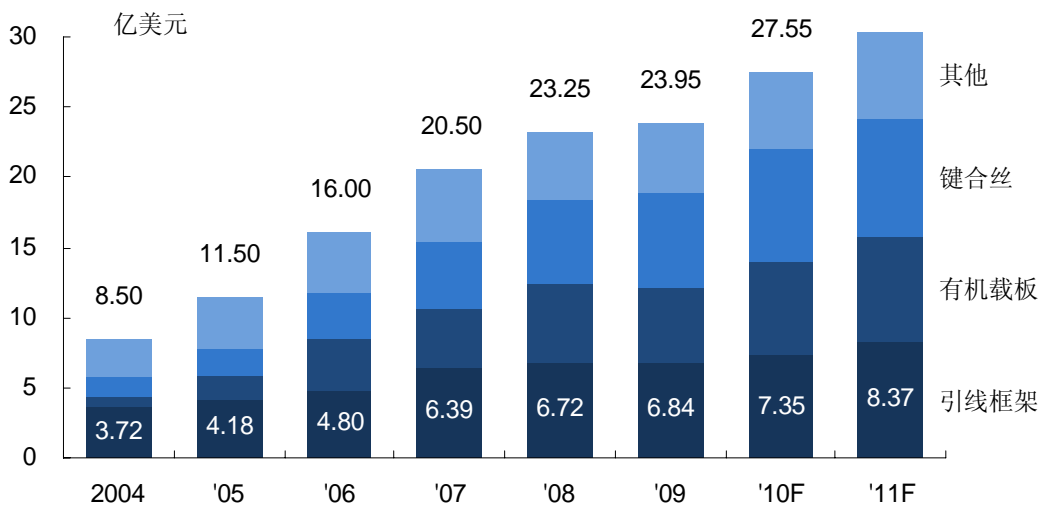
数据来源：SIA

数据来源：SEMI

从上图可以看出，我国是半导体的主要消费市场，2008年我国半导体消费额占全球半导体消费额的38%，但全球半导体封装材料消费市场我国仅占13%，半导体封装材料的消费量直接反映半导体器件的产量，我国半导体产业远远落后于我国整机产业的发展。

根据SEMI统计资料，中国大陆地区2009年封装材料市场占全球市场份额约为14%左右，金额约为24亿美元。近几年我国封装材料市场发展情况如下表所示：

中国封装材料市场



数据来源：SEMI

2004年中国半导体封装材料市场消费额为8.50亿美元，2009年达到23.95亿美元，预计2011年超过30亿美元，其中，引线框架市场需求将保持稳定增长的趋势，中国2009年引线框架市场消费额约为6.84亿美元，根据SEMI的预测，这一数值在2011年预计会达到8.37亿美元。中国引线框架市场占全球比重会持

续提高，主要原因是中国台湾封测企业对大陆的持续投资和日本韩国将低脚数的引线框架封装转移至中国大陆。

随着《电子信息产业调整和振兴规划》的颁布以及家电下乡、第三代移动通信网络、下一代互联网、数字广播电视网络、宽带光纤接入网络和数字化影院建设等一系列扩大内需措施的实施，下游整机厂商对半导体产品的需求量将会进一步上升，直接拉动国内半导体封装测试行业和封装材料行业的需求。

2、封装材料行业竞争格局和市场化程度

目前半导体封装材料行业被日本企业主导，2009 年全球半导体封装材料销售额中，超过 65%的销售收入来源于日本企业（含日本企业在其他国家投资的企业）；韩国企业也通过出口逐步扩大其市场份额。目前全球知名的封装材料供应商如下表所示：

| 封装材料 | 供应商名称 |
|------|---------------|
| 引线框架 | 日本住友金属矿业公司 |
| | 日本三井高科技股份公司 |
| | 日本日立电线有限公司 |
| | 日本新光电气工业公司 |
| 有机载板 | 日本揖斐电公司 |
| | 日本新光电气工业公司 |
| | 台湾南亚电路板股份有限公司 |
| 键合丝 | 日本田中贵金属工业有限公司 |
| | 德国贺利氏集团公司 |
| | 日本住友金属矿业公司 |
| | 日本日铁微金属有限公司 |

（资料来源于 SEMI: Japanese Companies Continue to Dominate the Packaging Materials Market）

国内目前从事引线框架生产的企业较少，整体技术水平也低于国外同行业生产企业，产品多以分立器件用引线框架为主，集成电路用引线框架所占比率相对较低。在国际上，日本住友、日本三井高科技、荷兰柏狮电子、荷兰先进半导体等行业地位显著的公司纷纷在中国设立子公司生产中低档的引线框架产品，以降低产品成本。根据 SEMI 统计数据，2010 年全球主要引线框架企业市场份额如下表所示：

| 排名 | 企业名称 | 营业收入（百万美元） | 市场份额（%） |
|----|--------------|------------|---------|
| 1 | 日本住友金属矿业公司 | 431 | 12.7 |
| 2 | 日本三井高科技股份公司 | 345 | 10.2 |
| 3 | 台湾顺德工业股份有限公司 | 301 | 8.9 |
| 4 | 日本新光电气工业公司 | 288 | 8.5 |
| 5 | 日本日立电线有限公司 | 211 | 6.2 |

| | | | |
|----|---------------------------|------|-----|
| 6 | 香港先进半导体物料科技有限公司 | 206 | 6.1 |
| 7 | 韩国三星技术有限公司 | 204 | 6.0 |
| 8 | 德国柏狮电子集团 | 185 | 5.5 |
| 9 | 台湾一詮集团 | 125 | 3.7 |
| 10 | 日本益能达精密电子有限公司 | 114 | 3.4 |
| 11 | 马来西亚 Dynacraft industries | 98 | 2.9 |
| 12 | 韩国丰山微电子有限公司 | 96 | 2.8 |
| 13 | 台湾复盛股份有限公司 | 94 | 2.8 |
| 14 | 大日本印刷公司 | 78 | 2.3 |
| 15 | 韩国 LG 伊诺特公司 | 76 | 2.2 |
| 16 | 宁波华龙电子股份有限公司 | 74 | 2.1 |
| 17 | 宁波康强电子股份有限公司 | 65 | 1.9 |
| 18 | 台湾健策精密工业股份有限公司 | 60 | 1.8 |
| 19 | 香港品质有限公司 | 50 | 1.5 |
| 20 | 日本凸版印刷有限公司 | 47 | 1.4 |
| 21 | 韩国 Flec 公司（前身是 LS 电缆） | 42 | 1.2 |
| | 其他 13 家公司 | 204 | 6.3 |
| | 合计 | 3394 | 100 |

2010 年分地区引线框架生产商收入排名如下表所示：

| 东南亚 | 日本 | 中国台湾 | 韩国 | 中国（含香港） |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1、日本住友金属矿业公司 | 1、日本三井高科技股份公司 | 1、日本住友金属矿业公司 | 1、韩国三星技术有限公司 | 1、台湾顺德工业股份有限公司 |
| 2、日本新光电气工业公司 | 2、日本日立电线有限公司 | 2、台湾复盛股份有限公司 | 2、韩国 Flec 公司 | 2、香港先进半导体物料科技 |
| 3、日本三井高科技股份公司 | 3、日本住友金属矿业公司 | 3、日本新光电气工业公司 | 3、韩国丰山微电子有限公司 | 3、日本三井高科技股份公司 |
| 4、日本日立电线有限公司 | 4、大日本印刷公司 | 4、台湾一詮集团 | 4、韩国 LG 伊诺特公司 | 4、日本住友金属矿业公司 |
| 5、德国柏狮电子集团 | 5、日本新光电气工业公司 | 5、日本三井高科技股份公司 | | 5、宁波华龙电子 |

（资料来源：SEMI Industry Research and Statistics, November 2011）

根据上表统计资料，2010 年我国引线框架行业中仅有 2 家企业在全球的市场份额排名进入前 20 位，这两家企业分别为本公司和康强电子。2010 年引线框架收入在国内市场（含香港）排名中本公司进入了前 5 位。

近几年，由于国内半导体封装企业发展速度快于上游半导体封装用材料引线框架生产企业的发展速度，造成国内引线框架产品供不应求，这一局面促进半导体封装材料引线框架生产企业不断的进行扩产和技术创新。随着国内的引线框架生产企业规模不断扩大，产品生产工艺不断创新，将逐渐取代国内进口引线框架的市场份额。目前，中国封装材料供应商也开始加入国际封装材料市场竞争行列。

3、进入本行业的主要障碍

(1) 产品开发能力

顺应半导体工业的发展，一些比较先进的封装类型将具有较大的市场需求，与此相适应的引线框架产品的需求量将会逐年上升。引线框架生产企业需要投入巨额资金购买设备和进行技术研发，资金不够充裕、技术研发实力弱小的企业将随着中低端产品的需求量的下降而被市场淘汰。缺乏产品的设计开发能力，将难以适应市场不断变化的需求，难以取得较大的市场份额。

(2) 产品制造能力

目前引线框架制造方法有冲压法和蚀刻法两种。冲压法可进行高速大批量低成本生产，但是需要具备较强的模具设计和制造能力，模具制造成本较高，不适合多脚位小批量生产；蚀刻法初期投资少，设计有机动性，适合新产品开发和多脚位、小间距、中小批量生产，但产品价格高，生产效率低，不适合大批量生产。目前我国引线框架企业大都采用冲压法对市场需求量较大的引线框架产品进行大批量生产。由于引线框架具有较高的精密度要求，企业的模具设计和制作能力决定了产品成率的高低，这些能力的取得需要依赖多年经验的积累。缺乏模具的设计和制造能力的企业难以适应市场需求变化。

另一方面，随着人们环保意识提高，电子产品的环保要求也越来越高。随着世界各国纷纷出台电子产品的环保标准（例如欧盟的 RoHS 指令、我国制定的《电子信息产品污染控制管理方法》等），绿色封装技术成为企业进入市场的通行证。新的生产工艺和方法对企业的产品创新能力提出更高的要求，提高了行业进入壁垒。

(3) 客户资源

根据半导体行业的特性，产品在向下游企业供货前，必须先经过下游企业严格的合格供应商认证，认证标准通常远远高于国家或行业制定的标准，而且认证周期较长，一般在半年以上，严格的合格供应商认证制度使新企业进入行业难度增大。

(4) 资金需求量大

引线框架行业属于资金密集型的行业，行业的进入需要较高的资金投入购买相关设备。近年来，引线框架的主要原材料铜带价格持续上涨，公司运营需要大量的流动资金，增加了行业新进入者的市场风险。

4、发行人所处行业利润水平的变动趋势及变动原因

引线框架行业与半导体行业的景气程度密切相关，其利润水平受到半导体行业整体利润水平影响较大。随着全球半导体行业逐渐复苏特别是国内信息产业在国家一系列扩大内需政策推出后的快速发展，引线框架行业利润水平会有所提升。此外，行业利润率水平与其创新能力息息相关，半导体行业包括整个信息产业产品更新换代很快，老产品的利润率水平必然逐渐走低甚至于迅速被新产品替代，而新产品由于市场空间较大一般可以获得较高的利润率。

（三）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）产业政策

2011年3月，国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》明确了我国产业结构调整的方向和重点，其中将“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料”列入鼓励类投资项目。

2011年12月，国家发展改革委和商务部公布的《外商投资企业产业指导目录》（2011年修订）将“电子专用材料开发与制造（光纤预制棒开发与制造除外）”列入鼓励外商投资产业目录。

2012年2月，国家工业和信息化部颁布的《电子信息制造业“十二五”发展规划》中提出，在关键电子元器件和材料方面，积极发展用于支撑、装联和封装等使用的金属材料、非金属材料和高分子材料；在发光二极管（LED）方面，加大对封装结构设计、新封装材料、新工艺、荧光粉性能、散热机理的研究与开发。

2012年2月，国家工业和信息化部颁布的《集成电路产业“十二五”发展规划》中提出，要加强12英寸硅片、SOI、引线框架、光刻胶等关键材料的研发与产业化，支持国产集成电路关键设备和仪器、原材料在生产线上规模应用。

（2）我国电子消费产品的市场巨大

半导体产品主要应用领域包括计算机、消费电子、通信等。2008年金融危机后，国家颁布了一系列措施促进国内需求增长，尤其是《电子信息产业调整和振兴规划》的颁布以及家电下乡、第三代移动通信网络、下一代互联网、数字广播电视网络、宽带光纤接入网络和数字化影院建设等一系列扩大内需措施的实施，电子信息产业的发展空间进一步拓展，直接拉动国内半导体相关产业发展。

（3）产业转移

经济全球化导致资本、技术、人员等生产要素在世界范围内大规模调整和重组，近年来中国高速发展的经济，庞大的需求市场，日益完善的基础设施和较低的制造成本，以及先期进入的企业取得的良好发展业绩，进一步推动了全球 IT 产业向中国转移的步伐。在可预见的未来一段时间，全球经济结构调整与产业转移趋势仍将继续进行，对我国的产业转移还有很大的空间，为我国半导体产业提供了良好的发展机遇。国际半导体公司及半导体封装材料制造厂家向我国的转移，不仅扩大了我国半导体封装材料的市场规模，更将先进的技术带入我国，迅速提高我国半导体封装材料及半导体封装业的整体水平，必将带动行业的快速增长。

2、不利因素

（1）国内技术水平与国际技术水平存在差距

目前，国际集成电路封装技术以 BGA、CSP 为主流技术，而国内厂商则仍然以 DIP、SOP、QFP 为主，产品以中、低端为主，发达国家在技术水平上占有优势。我国下游封装测试企业的技术水平决定了我国封装材料产品结构。目前我国引线框架产品主要以 TO、DIP 等低脚数产品为主，高端引线框架产品无法自主生产或者无法进入高端封装测试企业的供应商行列。我国半导体行业的壁垒主要是技术壁垒，要在高端封装如 BGA、CSP、SIP 等框架设计与制造上赶超国际先进水平，在技术、人才上有一定的困难。

（2）原材料供应

目前我国引线框架用铜合金带产品，在分立器件用引线框架铜带方面的生产和国外差距并不太大，但在集成电路用高端引线框架铜材的研究和生产方面还存在着较大的差距。主要表现为：一是合金材料的种类少、产品的规格少，不能和为数众多的电子封装材料相匹配；二是产品性能的均匀一致性及稳定性稍差，影响集成电路的性能可靠性和加工的高效化；三是对高精度带材产品的应用性能缺乏系统的研究，目前缺乏系统的评价体系及简单易行的现场评价方法，影响其后续冲裁、电镀或蚀刻的使用。目前国内铜板带材高端产品尚需进口。

（3）原材料价格波动剧烈

铜带成本约占引线框架成本的 70%，铜带的价格与金属铜的价格直接相关。近几年金属铜的价格波动幅度较大，对本行业内企业的生产经营产生一定负面影响。引线框架生产企业必须控制采购成本的同时，尽可能的研发、生产具有高附加值的产品，以降低原材料价格波动所带来的影响。

（四）行业特征

1、行业技术水平及技术特点

（1）封装技术发展是推动引线框架品种更新的主要动力

半导体封装发展的历史证明，封装材料在封装技术的更新换代过程中具有决定性的作用，基本形成了一代封装、一代材料的发展定式。不同的半导体封装方式需要采用不同的引线框架，因此半导体封装方式的发展趋势决定了引线框架的发展趋势。总体上半导体封装方式受表面安装技术的影响在向薄型化、小型化方向发展。

半导体分立器件包括二极管、光电二极管、三极管和功率晶体管。分立器件封装技术的发展趋势以片式器件为发展方向，以适应各种电子设备小型化、轻量化、薄型化的需要。一是往小型化方向发展，由常用的 SOT-23、SOD-123 型向尺寸更小的，如 SOD-723/923 等封装型式发展；二是片式小型化往功率器件方向延伸，从 1W 功率的 SOT-89 一直到功耗 10W 的 TO-252 以及功率更大的大功率封装，如 TO-247、TO-3P 等；三是往更大尺寸、更大体积以满足各类更大功率的新型电力电子封装，如全压接式大功率 IGBT 及各类封装模块等。

目前集成电路的主要发展趋势是高密度、高脚位、薄型化、小型化，封装方式从最初的 DIP 封装方式逐步向 SOP、QFP、BGA、CSP 等封装方式发展。目前国内市场的主要需求仍在 DIP、SOP、QFP 等中低端产品上，但随着数字电视、信息家电和 3G 手机等消费和通信领域技术的迅猛发展，国内集成电路市场对高端集成电路产品的需求不断增加，集成电路设计公司和系统整机企业对 QFP 高脚数产品及 MCM、BGA、CSP、SiP 等中高端封装产品的需求已呈现较大的增长态势。

（2）我国引线框架行业与国外的差距

我国半导体封装业整体水平和全球主流技术还存在一定的差距，主要集成电路封装技术还处于表面贴装阶段水平，国内本土集成电路封装测试企业主要采用的封装形式是 DIP、SOP、PLCC 以及 QFP 等传统技术，产品大都属于中低档类，附加值较高的 BGA、FC、CSP 等高尖封装技术目前还未完全掌握，而外资封装测试厂已经实现在全球生产资源配置，多采用主流 BGA、CSP、MCM、MEMS 等封装形式，技术水平高于国内本土企业。

随着中高档封装形式（SSOP、TSOP、QFP、TQFP、PBGA 等）市场需求不断增长，引线框架的设计不断向多排、MTX、小基岛、IDF 方向发展，电镀朝着宽排、环镀方向发展。目前国内主要供应 70×250mm 框架，而国外厂商主要适用的

框架片宽片长都是 78×250mm 以上，以后会朝着 90×290mm 更大的片宽设计。冲压朝着深打凸、引线小间距方向发展，目前国内供应的框架引脚间距在 3.9mil，引脚宽在 4.3mil，而国外厂商要求引脚间距最小 3.6mil，引脚宽最小 3.8mil。高档引线框架目前依然依赖于进口，特别是细间距、多引脚产品。

为了提升我国半导体产品结构，《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020 年)》中将“极大规模集成电路制造技术及成套工艺”确定为 16 个重大专项之一。在该重大专项中，公司承担了“LQFP 引线框架的研发和产业化”子项目，从事国内极大规模集成电路相配套的 LQFP 引线框架研发和产业化。

(3) 引线框架技术特点

国际上引线框架的生产工艺主要有冲制型和蚀刻型两种生产工艺，国内目前量产的只有冲制型生产工艺。

随着半导体产业的发展，引线框架的引脚来增多，引脚间距越来越小，引线框架的精度越来越高。公司目前采用的冲压法关键技术包括：

①冲压模具设计：引线框架制造的核心和关键技术，是制造引线框架的前提。冲压模具设计的好坏直接关系到模具的精度、寿命和生产效率。冲压模具设计技术，主要取决于模具设计人员的技术水平和经验积累。模具的精度和形状决定了引线框架的档次和质量。模具的精度影响到产品的成本。

②冲压模具的装配技术：也是引线框架制造的关键技术。冲压模具装配的好坏直接影响所冲制的引线框架产品的精度和稳定性。冲压模具的装配技术主要取决于模具装配工人的技术水平和经验。

③引线框架冲压技术：引线框架冲压技术，主要取决于冲床的精度，模具的先进性，以及工人的素质和敬业精神。

④引线框架的电镀技术：引线框架的电镀技术，主要取决于电镀设备的性能、电镀液的配方、模具的精度和电镀线操作人员的经验和敬业精神。

2、行业特有的经营模式

由于半导体行业上下游关系比较紧密，封装测试行业的产能集中度较高，为了能够与客户保持良好合作关系，引线框架制造企业通常会与下游的半导体封装企业形成直接股权关系。目前国内生产规模最大的两家企业康强电子与本公司都与下游封装测试企业有直接股权关系。

3、行业的周期性、区域性或季节性特征

(1) 行业周期性

从全球半导体产业发展的历史来看，半导体行业是典型的周期性行业。由于受到市场格局变动、整机市场发展状况、产品技术升级等影响，大约每隔四五年全球半导体产业就经历一次“景气循环”。受此影响，半导体产业的发展会有技术、时间和价格的波动，在经过一段长时间的高速增长以后，整个行业会经历一段时间的低速增长期，甚至负增长，这些状况属于产业的正常调整。半导体产业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点，从而导致半导体封装材料行业也呈现相同的趋势。

(2) 行业的区域性

我国经济最为发达的长三角，通过近几年的快速发展，随着台积电、中芯国际等世界级芯片大厂的入驻，半导体产业链已经成型，产业发展环境已经成熟。

目前，长江三角洲地区已初步形成了包括研究开发、设计、芯片制造、封装测试及相关产业在内的较为完整的集成电路产业链。全国 55%的集成电路制造企业、80%的封装测试企业以及近 50%的集成电路设计企业集中在该地区，已经初步形成了集成电路产业集群的基础，显现出了很强的综合实力和集群效应，在全国半导体产业中占有重要地位。

另外，我国京津地区和珠三角地区也是半导体产业发展相对领先的区域。

(3) 行业的季节性特征

半导体行业以及封装材料行业没有明显的季节性特征。但是由于春节长假因素，半导体行业企业往往在前一年的四季度备货较多，因此来年一季度的需求不旺。

(五) 发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性

1、发行人所处行业与上游行业的关系

引线框架行业的上游行业主要为铜合金带加工行业，由于铜基材料具有导电、导热性能好，价格低以及和环氧模塑料密着性能好等优势，当前已成为主要的引线框架材料，铜带价格（直接体现为金属铜价格）波动直接影响本行业的采购成本。

(1) 我国引线框架用铜合金带加工行业基本情况

引线框架铜带产品的生产由日本厂商占据着主导地位，其产量约占全球需求

量 50%左右，主要生产厂商包括三菱伸铜、神户制钢、古河电工、日立电线、同和金属、住友金属等企业；其他主要生产商还包括美国的奥林黄铜、德国的维兰德、KME、德马克、法国的格里赛、韩国的丰山、中国的洛铜集团、宁波兴业等。

目前我国引线框架用铜合金带产品，在分立器件用引线框架铜带方面的生产和国外差距并不太大，但在集成电路用高端引线框架铜材的研究和生产方面还存在着较大的差距。主要表现在为：一是合金材料的种类少、产品的规格少，不能为众多的电子封装材料相匹配；二是产品性能的均匀一致性和稳定性稍差，影响集成电路的性能可靠性和加工的高效化；三是对高精带材产品的应用性能缺乏系统的研究，目前缺乏系统的评价体系及简单易行的现场评价方法，影响其后续冲裁、电镀或蚀刻的使用。

（2）铜合金带加工行业向引线框架行业延伸的障碍

全球主要的引线框架铜带生产企业中，仅有少数几家在集团内部从事引线框架的生产，例如日立电线、住友金属、韩国丰山等，大部分的铜合金带生产企业均不从事引线框架的生产。

铜合金带加工行业向引线框架行业延伸的主要障碍为市场障碍。铜合金带加工行业属于传统的有色金属行业，而引线框架行业及其下游半导体封装测试行业均属于半导体行业。铜合金带加工行业向引线框架行业延伸，首先需要积累一定数量的半导体封装测试客户；其次引线框架产品质量需要获得半导体封装测试企业认证，而在大多数情况下，封装测试企业从半导体终端用户（整合组件制造商）获得订单时该终端用户就已指定所使用引线框架品牌，因此引线框架产品通常还需要通过整合组件制造商认证。缺乏在引线框架行业内的经验积累，很难从半导体封装测试企业、整合组件制造商处获得大额订单，从而限制铜合金带加工行业从业企业向引线框架行业延伸。

2、发行人所处行业与下游行业的关系

引线框架行业的下游行业为半导体封装测试行业。半导体封装测试行业与引线框架行业关系紧密，引线框架产品的发展依赖于半导体封装技术的发展，半导体封装测试行业的起伏将直接传递到引线框架行业，行业波动性趋于一致。

三、发行人竞争地位

（一）发行人市场占有率

报告期内公司产品销量及销售收入情况如下表：

| 2011 | 2010 | 2009 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 公司引线框架销量（万只） | 1,512,982.40 | 1,498,431.17 | 1,033,253.97 |
| 营业收入（亿元） | 5.20 | 5.01 | 3.23 |

根据 SEMI 统计资料，2010 年我国引线框架消费额约为 9.30 亿美元，据此测算，公司 2010 年国内市场占有率约为 8% 左右。

2010 年分地区引线框架生产商收入排名如下表所示：

| 东南亚 | 日本 | 中国台湾 | 韩国 | 中国（含香港） |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1、日本住友金属矿业公司 | 1、日本三井高科技股份公司 | 1、日本住友金属矿业公司 | 1、韩国三星技术有限公司 | 1、台湾顺德工业股份有限公司 |
| 2、日本新光电气工业公司 | 2、日本日立电线有限公司 | 2、台湾复盛股份有限公司 | 2、韩国 Flec 公司 | 2、香港先进半导体物料科技 |
| 3、日本三井高科技股份公司 | 3、日本住友金属矿业公司 | 3、日本新光电气工业公司 | 3、韩国丰山微电子有限公司 | 3、日本三井高科技股份公司 |
| 4、日本日立电线有限公司 | 4、大日本印刷公司 | 4、台湾一詮集团 | 4、韩国 LG 伊诺特公司 | 4、日本住友金属矿业公司 |
| 5、德国柏狮电子集团 | 5、日本新光电气工业公司 | 5、日本三井高科技股份公司 | | 5、宁波华龙电子 |

（资料来源：SEMI Industry Research and Statistics, November 2011）

根据上述资料，2010 年引线框架收入在国内市场（含香港）排名中本公司进入了前 5 位，排名前 4 位的企业分别来自香港、台湾和日本。

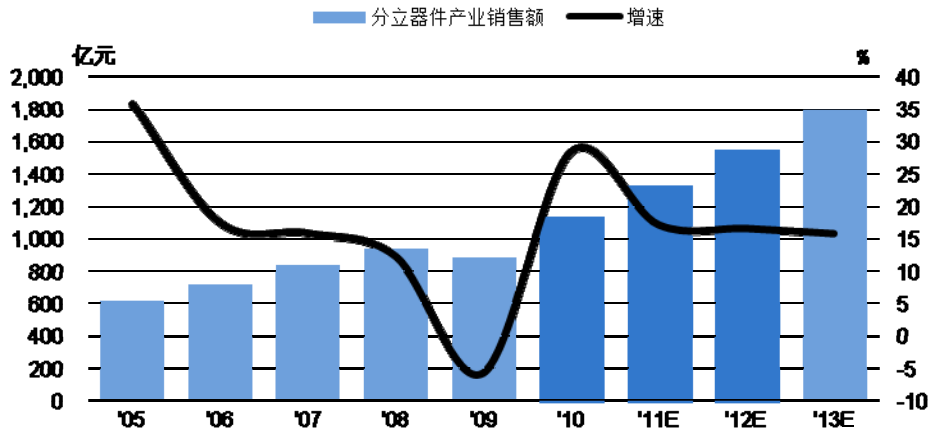
未来三年内，公司产能计划扩大至现有产能的 1.8 倍，而我国引线框架市场预计会保持 10% 的增幅，至 2014 年公司的国内市场占有率预计会进一步提升。

（二）发行人提高市场占有率的途径

1、以普通二极管、三极管分立器件引线框架为基础，积极开发市场需求增长较快的光电器件、功率器件分立器件引线框架产品

中国半导体行业协会对我国半导体分立器件产业销售额预测如下图所示：

我国分立器件产业销售额及增速



数据来源：中国半导体行业协会

根据中国半导体行业协会预测，我国半导体分立器件产业销售额 2011 年、2012 年、2013 年增速分别为 17.2%、16.6%和 15.8%，2013 年我国半导体分立器件产业销售额将达到 1,796.4 亿元。我国分立器件产业销售额的增长将直接增加对分立器件引线框架的需求量。

结合对分立器件行业细分领域来看，普通二极管、三极管等分立器件产品已日渐成熟，产品竞争激烈，此细分领域将维持平稳发展；以 LED 为代表的光电器件和功率器件被大量应用于新兴市场，成为低碳经济实体化的关键要素之一，未来几年分立器件产业的增长主要动力将来自于光电器件和功率器件。发改委、工业和信息化部 2009 年 8 月联合发文《关于进一步做好电子信息产业振兴和技术改造项目组织工作的通知》，也将光电器件和功率器件（也称为电力电子器件）作为重点支持对象，该文指出“重点支持功率场效应管（VDMOS）、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、快恢复二极管（FRD）等新型半导体电力电子器件的开发与产业化”，“重点支持大功率、高亮度半导体发光二极管的外延片和芯片制造、封装、光源模块及相关材料等”。

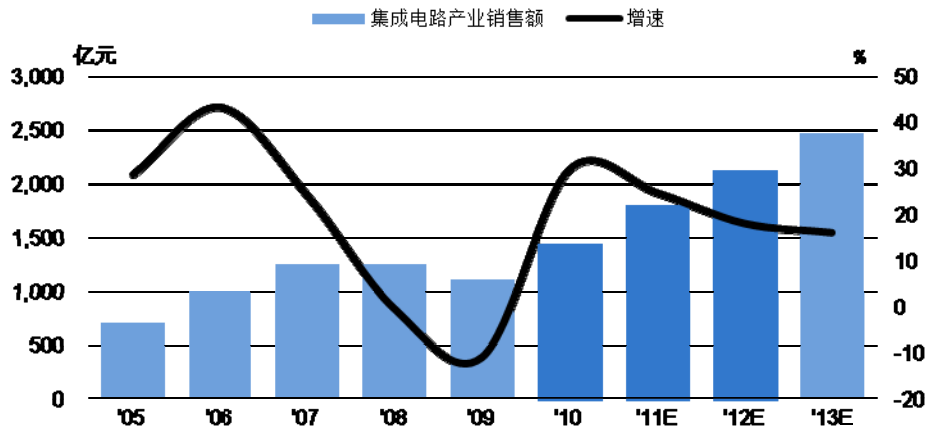
目前公司在功率器件封装用引线框架的产品开发上在国内已处于领先地位，应用于汽车电子、功率场效应管（VDMOS）、高端电源开关等新型功率器件封装的 TO252 系列、TO220、TO3P 系列引线框架以及大型 LED 模块封装用功率模块系列引线框架都已大规模量产。目前公司正准备研发绝缘栅双极型晶体管（IGBT）封装用引线框架产品。

公司的分立器件引线框架业务将以传统产品为基础，积极开发增速较快的光电器件和功率器件引线框架产品，提升公司分立器件引线框架产品结构。

2、在集成电路国产化的过程中扩大集成电路引线框架产品的市场份额

中国半导体行业协会对我国半导体集成电路产业销售额预测如下图所示：

我国集成电路产业销售额及增速



数据来源：中国半导体行业协会

根据协会预计，2011年、2012年、2013年，我国半导体集成电路产业销售额增速分别为24.80%、18.10%和16.10%，2013年我国集成电路产业销售额将达到2465.6亿元。集成电路产业的快速增长将带动集成电路引线框架需求量在未来两年内保持10%以上的增速。

集成电路产业高速发展态势给公司发展毛利率较高的集成电路引线框架业务创造了较好的时机。公司将凭借自身的研发实力，参与高端集成电路国产化的过程，以争取扩大在集成电路引线框架领域内原由进口产品占据的市场份额。公司已参与了国家科技重大专项《极大规模集成电路制造装备及成套工艺》项目，在该项目中承担“LQFP引线框架的研发和产业化”子项目。公司的LQFP引线框架已开发成功，目前正经下游客户试用。此项目的顺利实施将会积极促进公司集成电路引线框架业务的发展，取代进口产品的市场份额。

目前公司已可生产44脚集成电路引线框架，目前正在开发64脚、128脚集成电路引线框架。高脚数产品的开发将能提升公司产品结构，巩固公司在行业内的技术领先地位。公司集成电路用引线框架的销售额占主营业务收入比例呈上升趋势，2011年集成电路用引线框架的销售额占主营业务收入比例已超过12%。

3、新品种开发情况

公司积极配合客户需要开发新产品，以此作为扩大市场占有率的有效手段。客户提出产品要求，公司按照要求开发模具，实现量产。新产品在市场上供应商数量较少时可以创造较好的毛利水平。

2009年工程技术中心开发38个新品，其中12个为集成电路引线框架，18个为功率器件引线框架，8个为表面贴装引线框架。38个新品中大规模量产的产品数量为34个，2009年实现收276.65万元，2010年实现收入2937.01万元，2011年实现收入3134.67万元。

2010年工程技术中心开发43个新品，其中19个为集成电路引线框架，11个为表面贴装引线框架，13个为功率器件引线框架。新品中33个产品大规模量产，2010年实现收入320.55万元，2011年实现收入2697.9万元。

2011年开发45个新品，其中28个为集成电路引线框架，11个功率器件引线框架，6个表面贴装引线框架。新品中42个产品大规模量产，2011年实现收入1874.36万元。

（三）主要竞争对手情况

1、宁波康强电子股份有限公司

宁波康强电子股份有限公司为国内生产规模最大的塑封引线框架生产基地，年产能达250亿只，产品包括TO-92、TO-126、TO-220、TO-3P系列和大中小功率三极管引线框架、SOT系列的表面贴装引线框架及IC系列的集成电路引线框架100余种规格。宁波康强电子股份有限公司产品除引线框架产品外，还包括键合金丝、智能卡IC载带等产品，2011年宁波康强电子股份有限公司实现引线框架销售收入6.34亿元。（资料来源：上市公司网站及年报）

2、厦门永红集团有限公司

厦门永红集团有限公司前身是厦门永红电子有限公司，是中国第一家专业从事高精度集成电路引线框架开发、生产及精密模具制造的专业厂家，获国家级火炬计划项目证书的重点高新技术企业。永红集团电子产品主要有：SOT系列、SOP系列、DIP系列、QFP系列及TO-220系列等200余种引线框架。目前公司已成为国内引线框架生产的龙头企业，年产各类引线框架100亿只，精密冷冲模60副。（资料来源：www.xmyonghong.com）

3、三井高科技（上海、天津、东莞）有限公司

三井高科技株式会社创建于1949年，是世界上著名的集成电路引线框架、精密模具和精密磨床的专业生产厂家。本着“就近为顾客服务”的方针，三井高科技株式会社从上世纪七十年代开始，相继在世界各地半导体产业集中地区建立海外分公司，为当地的半导体和电器制造厂商源源不断地提供质量高、交货期短、价格优惠的IC引线框架和高性能的马达铁芯等产品。

目前三井高科技株式会社在中国大陆投资设立三家企业，分别是三井高科技（上海）有限公司、三井高科技（天津）有限公司、三井高科技（东莞）有限公司。三井高科技（天津）有限公司主要生产和销售分立器件和集成电路引线框架、高精度马达转子定子叠片，同时涉及冲压模具和平面磨床的销售业务；三井高科技电子（东莞）有限公司主要生产高精密度集成电路引线框架及微型马达铁芯等，

年产量达 25 亿块以上；三井高科技（上海）有限公司成立于 1996 年 3 月，1998 年 6 月开始批量生产，主要产品品种包括 SIP、CDIP、PDIP、HDIP、QFP、TQFP、QFJ、SOJ、LCC、VSOP、SOP、TSOP、SSOP 等。

4、顺德工业（江苏）有限公司

顺德工业于 1953 年 10 月在台湾创立，迄今已超过五十周年，主营业务为五金文具、单体导线架、集成电路引线框架及精密模具开发、制造和销售。1997 年 11 月，顺德工业投资美金 3580 万元，在江苏省张家港保税区成立顺德工业（江苏）有限公司。该公司主要生产及销售五金文具产品系列，集成电路框架产品系列以及精密模具开发，跻身于国内大中型电子导线框架制造企业和国际大型文具产品制造企业之列。（资料来源：www.sdi.com.cn）

5、铜陵丰山三佳微电子有限公司

铜陵丰山三佳微电子有限公司是由韩国丰山微电子株式会社和铜陵三佳电子（集团）有限责任公司共同出资组建的中外合资公司，丰山三佳第一期总注册资金 2000 万美元，其中丰山微电子株式会社占 51% 股份，三佳集团占 49% 股份。该公司引进国际先进的技术和生产装备，生产 IC、TR 类引线框架和硬质合金级进冲模具，已建成年产 40 亿只引线框架的规模。

（三）发行人竞争优势

1、产品设计与开发优势

公司是一家专业从事半导体封装用引线框架研发、生产和销售的企业，在我国半导体引线框架行业中生产规模排名靠前。公司具备较强的引线框架研发、制造能力，自设立以来，公司一直从事引线框架的研发、生产，致力于引线框架的国产化及其生产工艺的改进。在十余年的发展过程中，公司在国内引线框架行业开创了数项领先的生产工艺。

公司发展过程中在产品研发上所取得的成果如下表所示：

| 时间 | 工艺描述 | 涉及产品 | 工艺领先水平 |
|------|--|-------|--------|
| 1998 | 引线框架生产过程中将镀银工艺改进为镀镍镀银工艺，下游封装企业使用改进后的引线框架时在压焊工序中不需要使用价值较高的金丝，使用铝丝就可取得满意效果 | TO126 | 国内首创 |
| 2001 | 成功使用铁带替代铜带生产 TO92 型引线框架，直接降低引线框架产品生产成本 | TO92 | 国内首创 |
| 2006 | 开发出 TO220 防水型引线框架产品，克服了现有产品存在的水汽易渗入芯片区域、腐蚀芯片及其连接金丝或者铝丝的缺陷。该工艺的使用阻挡了水汽 | TO220 | 国内领先 |

| | | | |
|------|---|----------|-----------------|
| | 进入芯片区域，增强了塑封件与基片的结合强度，提高了产品的使用寿命 | | |
| 2008 | 本项产品技术克服了现有产品存在的基材厚度大、材料成本难以下降的不足，产品封装后，双侧散热突缘仍暴露在外界，可将芯片岛区域热量快速传递并散发，有利于延长使用寿命 | TO126 | 国内首创 |
| 2008 | 成功使用铁镍合金替代铜材生产引线框架，同时每个基本单元设有呈纵向六排和横向二列设置的十二个引线框架，产品生产过程中克服了现有铜质产品强度低和加工制造效率不高的缺陷 | SOT23 | 取代进口 |
| 2008 | 市场上常见的集成电路引线框架多由单排引线框架单元通过连接筋和边带相互连接而成，随着原材料涨价和能源成本上升，现有的单排集成电路引线框架已难以参与市场竞争。公司成功开发出双排并列的集成电路引线框架，每个基本单元设有上下两个相邻的引线框架，大大提高生产效率，克服原材料利用率不高缺陷 | DIP8 | 国内首创 |
| 2009 | 公司研发的大功率引线框架产品制造技术，本技术克服了现有同类产品存在的轧制冲压力大、模具寿命短的缺陷。本产品芯片岛侧边形状简单、轧制加工方便；抗机械冲击和耐热疲劳强度明显提升，成品使用寿命延长 | TO247 | 国内首创 |
| 2009 | 公司研发的一种集成电路引线框架产品制造技术，本技术克服了现有同类产品存在的贵金属浪费和镀银焊区性能不一致的缺陷。采用本技术生产产品大大简化了电镀模版的刻制；加工后的镀银焊区形状一致，成品性能稳定 | SOP 系列 | 国内领先 |
| 2010 | 公司成功研发大规模集成电路引线框架生产工艺，该工艺克服了现有技术制造的引线框架引脚共面性和位移量指标合格率较低的缺陷。公司大规模集成电路引线框架生产工艺可大大提高成品引线框架引脚共面性和位移量合格率 | LQFP44 | 承担国家科技部重大专项规划课题 |
| 2011 | 公司自主研发开发了 DIP 系列密集排列（3-5 排）集成电路引线框架，该产品主要解决目前同类产品原材料利用率不高、产品成本难以下降的不足。该集成电路引线框架生产效率和材料利用率更高，成品使用寿命更长 | DIP 系列 | 国内领先 |
| 2011 | 公司自主研发了一种阵列式集成电路引线框架产品制造技术，该技术克服了现有技术制造的引线框架在封装过程中分层现象，并适应多种芯片封装技术。该技术向半导体封装行业提供一种生产效率高、产品质量好、封装通用新型集成电路引线框架 | SOP 系列 | 国内领先 |
| 2011 | 公司自主研发一种高精度冲、切成型一体化大功率引线框架模具，该工艺的创新可减少生产工序，提高产品成品合格率，减少人工费用 | TO220 系列 | 国内领先 |

公司是国家高新技术企业，且被宁波市科技局认定为宁波市专利示范企业。公司设立了宁波华龙电子高精度塑封引线框架工程（技术）中心，现有技术研发

人员 60 余名，其中拥有高级工程师 2 人、工程师 8 人。公司的研发团队了解国际半导体封装用引线框架发展的新技术和新工艺，能够根据客户的意见改善设计引线框架产品图纸，通过采用计算机辅助设计，保证引线框架设计精度和准确性，有助于公司的产品结构逐步向中高档引线框架产品转移。

公司依靠自身技术实力，先后开发了 IDF 系列、SOT 系列、SOP 系列、DAPK 系列封装阵列式引线框架等众多新产品，目前公司拥有 33 项专利，另有 3 项专利已取得授予通知书，2 项专利已申请并获受理。公司“TO-220 防水塑封引线框架产业化”项目列入国家科技部 2008-2009 年国家火炬计划项目，TO-220 防水塑封引线框架认定为 2008 年中国半导体创新产品。

2009 年 1 月，公司承担国家 02 科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”子项目“LQFP 引线框架的研发和产业化”。2010 年 12 月，公司产品已经通过验证单位江苏长电科技股份有限公司和南通富士通微电子股份有限公司可靠性试验，目前已经完成小批量供货签约手续，公司具备大批量生产条件。我国目前尚无 LQFP 系列引线框架的专业化生产企业，该项目完成后将可以为国家“成套封装设备与材料生产示范线工程”提供取代进口的引线框架产品。

2、模具设计和制造能力

随着封装技术的发展，集成电路和分立器件都朝着更小的外形、更高的性能方向发展，这就对半导体封装材料引线框架提出更高的要求，引线框架也逐步向多脚数、小尺寸、高精度方向发展。冲制材料铜带经数控冲床和模具自动冲压形成引线框架，精密模具制造技术则是冲压法生产引线框架的核心。

公司的模具设计、制造能力为引线框架产品的开发奠定了坚实的基础。目前我国大多数引线框架制造企业不具备模具制造能力，在冲压法生产引线框架过程中所需的模具需要外购。在模具外购过程中，引线框架生产企业需要与模具制造企业就模具技术指标进行多次沟通，还需要经历反复试用的过程，周期较长。具备模具设计制造能力的企业无疑在产品研发以及生产成本方面拥有一定的优势。

公司具备年开发 60 副模具的生产能力，拥有高精度光学曲线磨床、精密数控慢走丝、精密平面磨床、数控加工中心、光学测量仪等精良装备，与引线框模具设计技术相配套，确保了公司精密高速级进模具和精密零件加工达到 μ 级精密水平。

公司通过运用计算机模具设计软件，模具设计品质得以提高，模具设计时间进一步缩短，推动模具结构的优化。模具制造技术实现了数控化，通过对数控慢走丝切割机床、数控光学曲线磨床等精密数控设备的灵活运用，构建形成了加工精密级进模零件的主要手段和技术，这不仅保证了模具制造精度和品质，同时也

缩短了模具制造周期。

目前公司引线框架级进模制造精度达 $2\mu\text{m}$ ，易损备件可互换，模具在高速冲床上使用，寿命达到两千万冲次以上。公司制造的模具所生产的引线框架已有 8 排，脚数 44 条，最小间距尺寸为 0.13mm 。公司模具制造水平在行业内处于领先地位。

3、电镀工艺优势

为了保证封装工艺中装片/键合性能，使芯片和金丝与引线框架形成良好的扩散焊接，引线框架的装片/键合区域（内引线脚上和小岛）一般要求压印，然后在上面电镀。通过精压可以形成一个光滑致密的表面以获得高质量的镀层，同时提供一个充足平坦的键合点区域。镀层的质量直接影响装片和金丝的键合强度，从而最终影响产品的成品率和可靠性。

公司在引线框架表面处理领域积累了多年经验，多项电镀技术在行业内保持领先水平。这些电镀技术的使用在降低生产成本、提高产品可靠性等方面作用显著。公司目前主要电镀技术如下表：

| 主要电镀技术 | 工艺特征 |
|-----------------|--|
| 全自动连续高速选择电镀技术 | 实现引线框架单面局部电镀功能，比传统浸镀工艺节省镀种材料（主要是银）50%以上 |
| 全自动连续高速选镀镍电镀技术 | 提高引线框架与芯片的结合力，使得下游封装企业使用铝丝替代价格昂贵的金丝作为键合丝，减少下游企业封装成本 |
| 全自动连续高速选择喷镀技术 | 提高引线框架电镀精度，精度达到 $\pm 0.1\text{mm}$ ，比传统浸镀工艺节省镀种材料（主要是银）75%以上 |
| 全自动连续高速选择点镀技术 | 实现在引线框架关键部位点镀，比传统浸镀工艺节省镀种材料（主要是银）85%以上 |
| 全自动连续高速选择环岛电镀技术 | 为目前国内引线框架行业较高端镀银工艺，该项技术主要应用于极大规模集成电路，提高了芯片、塑封料与引线框架之间的结合力，增强了集成电路可靠性，延长其使用寿命 |

4、客户优势

在公司的发展过程中，公司始终十分重视构建与客户之间的合作关系。目前本公司主要客户覆盖了主要的大型内资封装测试企业，其中包括南通富士通微电子股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、深圳深爱半导体股份有限公司、吉林华微电子股份有限公司、佛山市蓝箭电子有限公司、江苏长电科技股份有限公司、无锡华润华晶微电子有限公司等。其次，公司正在努力进入 IDM 在国内设立的外资封装测试企业供应商行列，以此推动公司业务快速增长。由于公司在功率器件引线框架产品制造上已经具有一定的知名度，吸引了一些国外大厂商主

动联系合作。公司部分产品经用户送检，已经通过 NXP（飞利浦公司创立）、FAIRCHILD（仙童半导体）、TI（德州仪器）及日本瑞萨电子（2010年4月由瑞萨科技和 NEC 半导体合并而来）的可靠性考核，可以大量生产以替代进口产品。公司也有部分品种正在经英飞凌试用。

公司还引进了重要客户作为公司的战略投资者，其中包括南通华达（通富微电子的控股股东）和宁波明昕微电子股份有限公司。

5、产品定价能力

公司产品定价以铜价为基准，并考虑一定的利润。此种定价模式有利于降低原材料价格波动对公司经营业绩带来的风险。一般情况下新产品的利润比较高，当其他生产商也能够提供同类产品时客户要求价格协商，利润会有所降低。公司每年均按照客户要求与客户配套推出一定数量的新产品，获得了较好的收益。

公司产品销售有两种模式，（1）与客户签订短期合同，价格根据上海有色网最新铜价测算出成本加上一定的目标利润确定；（2）根据客户要求，对未来的销售价格进行锁定。公司与客户锁定价格具体操作方法是，公司与客户达成锁定价格的长期供货意向后，会立即与铜带供应商签订“锁铜”协议，将所需铜带的价格锁定，在此基础上，测算出成本加上一定的目标利润进行报价并签订锁定价格的长期供货合同。

公司产品定价以铜价为基准，铜价波动对公司经营业绩的风险大幅降低，尤其在“锁铜”模式下，铜价波动所产生的风险基本规避。

（四）发行人竞争劣势

本公司目前的竞争劣势主要表现为：

1、发行人产品结构、技术水平与全球知名引线框架企业有一定差距

目前销售收入排名靠前的日本、韩国引线框架企业主要采用蚀刻法生产高脚数的集成电路引线框架产品，此类产品附加值较高。华龙电子目前的产品结构以分立器件引线框架为主，集成电路引线框架为辅。此外，华龙电子仅能采用冲制法生产分立器件引线框架及中低脚数集成电路引线框架，尚不具备采用蚀刻法生产引线框架的能力。上述在生产工艺以及产品结构上与知名企业的差距是发行人参与全球竞争的劣势之一。

2、产品单一劣势

下游封装行业在半导体封装过程中需要封装设备、封装材料（包括塑封模具、引线框架、金丝、塑封料、粘结材料等）。为了能够更好的服务于下游客户，全

球主要的引线框架企业除了生产引线框架外，通常还具备封装设备和其他封装材料的生产能力。由于华龙电子仅能为客户提供引线框架一种封装材料，在与能为封装企业同时提供封装设备、多种封装材料的企业竞争时处于劣势。

3、资金劣势

发行人所属行业属于资金密集型行业，对于资金需求较大，目前华龙电子融资渠道相对单一，主要依赖于银行贷款和自身滚存利润的积累。近年随着华龙电子经营规模的快速扩大以及铜价的上涨，产能限制和流动资金压力已成为制约华龙电子发展的主要瓶颈。

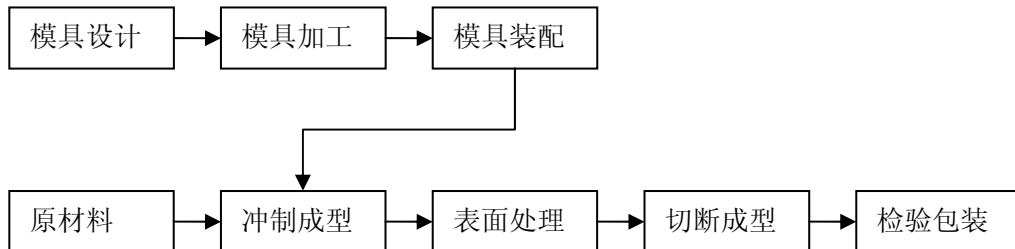
四、发行人主营业务情况

（一）发行人主要产品用途

公司的主要产品引线框架用于半导体的封装，并包含在半导体中广泛地运用于各种消费电子产品、计算机及外围设备、网络通信、各种智能卡、设备及仪器仪表、汽车电子、显示屏、电子照明设备等。

（二）发行人主要产品的工艺流程图

公司主要产品引线框架的生产工艺流程图如下图所示：



（三）发行人业务经营模式

1、采购模式

公司业务部采购科负责原材料采购，并协同品质部、技术部等相关部门做好供应方的监控，保证所采购的原材料质量。业务部会根据生产计划的安排、原材料的安全库存数量和采购周期，结合原材料市场的供求状况安排采购计划。

公司业务部采购科在实施采购时，在客户无特殊要求的情况下，只选择与公司确定的《合格供方名单》中的供应商签订采购文件，包括采购合同、技术协议和质量保证协议等。

目前公司对主要原材料铜带的定价依据有两种：上月平均价或者订单日现货平均价，在铜价上升情况下，公司会提前一个月与供应商协商确定采取上月平均价进行采购的策略。

其次，在主要原材料铜带的采购方式上，尽可能保证所签订铜带采购合同与产品销售合同相匹配，缩短铜带库存周期，避免铜价波动对公司经营带来的不利影响。当客户提出需要与公司签订供货量较大的产品销售合同时，公司会同时向原材料供应商提出用固定价格采购同等数量的铜带。公司对铜带供应商的议价能力较强，在上述固定价格采购协议中，一般会约定在上海金属交易所的铜价低于一定价格时，价格另行调整。

通过上述措施，公司的原材料采购价格风险得到较好的控制。

2、生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式。公司生产部根据销售计划、合同或订单要求的交货期、数量并考虑运输周期安排生产计划，部分常规产品公司会保持少量的库存。

3、销售模式

公司产品直接面向半导体封装测试企业销售。

公司的定价模式是“原材料成本+加工费+目标毛利”，原材料成本根据单位产品所消耗的铜带数量与当期铜价共同确定，加工费主要考虑模具成本、人工成本、设备折旧及水电费，目标毛利则根据产品的市场供求状况由双方协商确定。此种定价模式有利于降低原材料价格波动对公司经营业绩带来的风险。

公司产品销售有两种模式，（1）与客户签订短期合同，价格根据上海有色网最新铜价测算出成本加上一定的目标毛利确定；（2）根据客户要求，对未来的销售价格进行锁定。公司与客户锁定价格具体操作方法是，公司与客户达成锁定价格的长期供货意向后，会立即与铜带供应商签订“锁铜”协议，将所需铜带的价格锁定，在此基础上，测算出成本加上一定的目标毛利进行报价并签订锁定价格的长期供货合同。

通常情况下，每月底公司会根据上月 26 日至本月 25 日市场平均铜价（下称“基准铜价”）计算各客户下月执行的产品价格并进行报价，客户在确认报价后下订单，公司在收到订单后 1 周内发货。

部分客户根据实际需求情况与公司锁定在一段期间内所执行的产品价格。公司在与客户签订此种类型的销售合同后，会及时以上述合同所对应的基准铜价采购相应数量的铜带。报告期内公司共与客户签订三份锁铜协议，并相应地与供应

商签订三份价格、数量均大体相当的铜带采购协议，详细情况如下：

(1) 公司 2010 年 2 月 28 日与客户深圳市晶导电子有限公司签订框架价格协议，锁定 2010 年 2 月 9 日上海期铜 52900 元/吨，共计 300 吨，后又签订补充协议增加 100 吨铜；晶导电子自 3 月份起按照锁定价格执行，10 个月内将 400 吨铜所做产品数量用完，公司每月底以书面形式与晶导电子核实实际铜消耗数量；协议按照铜价加上利润、加工费制定出晶导电子采购框架的明细价格；晶导电子预付铜带采购款保证金 15% 给公司；当上海金属交易所的月平均铜价低于 45000 元/吨时，价格另行调整。公司在获取框架协议后即与中铝华中铜业有限公司按照 2010 年 2 月 29 日上海期铜 52950 元/吨订货 350 吨铜，交货时间为 2010 年 4-5 月。

(2) 公司 2010 年 1 月 5 日与客户佛山市蓝箭电子有限公司签订框架价格协议，锁定 2010 年 1-6 月紫铜铜价为 55000 元/吨；佛山蓝箭将紫铜部分 80% 订单交给公司，并预付 600 万元采购款；当上海金属交易所的月平均铜价低于 52500 元/吨时，价格另行调整。公司在获取框架协议后即与中铝华中铜业有限公司按照长江电解铜现货 2009 年 11 月 25 日至 12 月 26 日均价 55017.73 元/吨订货 540 吨铜，交货时间为 2010 年 2 月 13 日前。

(3) 公司 2010 年 6 月 22 日与客户佛山市蓝箭电子有限公司签订框架价格协议，锁定 2010 年 7 到 12 月紫铜铜价为 51599 元/吨；佛山蓝箭将紫铜部分 80% 订单交给公司，并预付 600 万元采购款；当上海金属交易所的月平均铜价低于 48000 元/吨时，价格另行调整。公司在获取框架协议后即与中铝华中铜业有限公司按照 52000 元/吨订货 180 吨铜，交货时间为 2010 年 7 月 31 日前。

上述协议实际执行情况如下表所示：

| 项目 | 锁铜协议 实际销售金额 | 实际消耗 铜带数量 | 与供应商 锁铜数量 |
|---------------------|----------------|--------------|--------------|
| 深圳市晶导电子有限公司 | 14,244,568.55 | 400 吨 | 400 吨 |
| 佛山市蓝箭电子有限公司 | 42,472,130.44 | 887 吨 | 720 吨 |
| 小计 | 56,716,698.99 | | |
| 2010 年主营业务收入 | 419,667,854.72 | | |
| 占比 | 13.51% | | |
| 2011 年铜带及委外加工铜带采购数量 | | | 7,828 吨 |
| 2011 年自产铜带数量 | | | 1,451 吨 |
| 占比 | | | 12.07% |

2010 年上海有色金属市场各月平均铜价的最低值为 53,096.25 元，最高值为 65,582.14 元，全年平均价格为 58,866.74 元，由于各期价格均高于公司与客户锁铜协议所拟定的最低调整价格，因此报告期内没有未执行的锁铜协议。公司执行锁铜业务的产品销售收入占全年主营业务收入的比例为 13.51%，“锁铜”采购数量

占全年采购及自产铜带的数量为 12.07%。

公司产品定价以铜价为基准，铜价波动对公司经营业绩的风险大幅降低，尤其在“锁铜”模式下，铜价波动所产生的风险基本规避。

（四）发行人主要产品的产能及销售情况

1、发行人主要产品的产能、产量

报告期内，公司主要产品的产能、产量数据如下表所示：

| | 2011 | 2010 | 2009 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 产能（万只） | 2,500,000 | 1,750,000 | 1,355,600 |
| 产量（万只） | 1,525,320 | 1,509,752 | 1,048,867 |

注：2009 年、2010 年产能系全年加权平均数。

报告期内，华龙电子引线框架的产能由原有的 91.46 亿只增加至 250 亿只。公司在 2008 年年中开始筹划扩大产能，于 2009 年 4 月公司产能达到 150 亿只（2009 年全年实际产能为 135.56 亿只）。泰州华龙于 2010 年 9 月开始试生产，新增产能为 100 亿只（2010 年全年实际产能为 25 亿只）。

引线框架企业的产能一般以生产框架的只数来粗略框定，其中包含了不同的引线框架产品结构。生产不同类型的引线框架需要耗用的工时差别较大，其中 TO-92 系列引线框架和 SOT 系列引线框架每班平均产量最大，约相当于 TO-220 系列引线框架每班平均产量的 7-10 倍。由于冲制设备的通用性，所以准确衡量设备的利用率需要将产能折算成标准产能和标准产量来计算。以全部按照生产 TO-92 系列产品为标准，折标后公司主要产品的产能、产量和产能利用率数据如下表所示：：

| | 2011 | 2010 | 2009 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 标准产能（万只） | 4,134,417 | 3,191,750 | 2,610,146 |
| 标准产量（万只） | 2,983,765 | 2,892,865 | 1,911,903 |
| 产能利用率（%） | 72.17 | 90.64 | 73.25 |

2、发行人主要产品的销量、销售收入

公司报告期内主要产品销量数据如下表所示：

单位：亿只

| 产品名称 | 2011 年度 | | | 2010 年度 | | | 2009 年度 | | |
|---------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|-------|--------|
| | 产量 | 销量 | 产销率 | 产量 | 销量 | 产销率 | 产量 | 销量 | 产销率 |
| 分立器件 引线框架 | 138.06 | 137.29 | 99.44% | 140.42 | 139.39 | 99.27% | 99.54 | 97.92 | 98.37% |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|------|------|---------|
| 集成电路 引线框架 | 14.47 | 14.01 | 96.82% | 10.55 | 10.46 | 99.15% | 5.35 | 5.40 | 100.93% |
|--------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|------|------|---------|

公司报告期内主要产品销售收入如下表所示：

单位：万元

| | 2011 | 2010 | 2009 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 分立器件用引线框架 | 42,045.42 | 37,387.00 | 22,005.35 |
| 集成电路用引线框架 | 5,917.60 | 4,579.78 | 2,376.57 |

3、发行人主要产品销售价格的变动情况

公司报告期内主要产品销售单价数据如下表所示：

单位：元/万只

| | 2011 | 2010 | 2009 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 分立器件用引线框架 | 306.26 | 268.23 | 224.73 |
| 集成电路用引线框架 | 422.40 | 437.97 | 439.72 |

4、主要客户

本公司报告期内主营业务收入对前五名客户的销售收入及其占公司总销售收入的比重如下表所示：

单位：万元

| 客户名称 | 金额 | 比例 |
|---------------|-----------|-------|
| 2009 年度 | | |
| 宁波明昕微电子股份有限公司 | 3,431.65 | 10.59 |
| 佛山市蓝箭电子有限公司 | 2,834.14 | 8.75 |
| 无锡华润华晶微电子有限公司 | 2,348.70 | 7.25 |
| 深圳深爱半导体股份有限公司 | 1,942.06 | 6.00 |
| 深圳市晶导电子有限公司 | 1,592.58 | 4.92 |
| 合计 | 12,149.12 | 37.51 |
| 2010 年 | | |
| 宁波明昕微电子股份有限公司 | 6,892.12 | 13.76 |
| 佛山市蓝箭电子有限公司 | 4,865.77 | 9.71 |
| 无锡华润 | 3,487.21 | 6.96 |
| 深圳市晶导电子有限公司 | 2,946.16 | 5.88 |
| 深圳深爱半导体股份有限公司 | 2,487.56 | 4.97 |
| 合计 | 20,678.82 | 41.28 |
| 2011 年 | | |
| 宁波明昕微电子股份有限公司 | 5,391.62 | 10.36 |
| 深圳深爱半导体股份有限公司 | 4,983.86 | 9.58 |
| 佛山市蓝箭电子有限公司 | 4,750.86 | 9.13 |
| 无锡华润 | 3,344.38 | 6.43 |
| 天水华天 | 3,103.13 | 5.96 |
| 合计 | 21,573.85 | 41.45 |

上表中对受同一控制人控制客户的销售额合并计算，具体情况如下：

(1) 公司对无锡华润的销售包括对无锡华润华晶微电子有限公司和无锡华润安盛科技有限公司的销售, 其中无锡华润华晶微电子有限公司的控股股东为无锡华润微电子有限公司, 无锡华润微电子有限公司同时间接持有无锡华润安盛科技有限公司 75% 股权, 公司对上述两家客户销售情况如下:

单位: 万元

| 客户名称 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---------------|----------|----------|----------|
| 无锡华润华晶微电子有限公司 | 2,947.25 | 3,229.84 | 2,348.70 |
| 无锡华润安盛科技有限公司 | 397.13 | 257.37 | - |
| 合计 | 3,344.38 | 3,487.21 | 2,348.70 |

(2) 公司对天水华天的销售包括对天水华天科技股份有限公司及其控股股东天水华天微电子股份有限公司的销售, 具体情况如下:

单位: 万元

| 客户名称 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---------------|----------|----------|--------|
| 天水华天科技股份有限公司 | 3,089.62 | 1,116.49 | 287.29 |
| 天水华天微电子股份有限公司 | 13.51 | 190.75 | - |
| 合计 | 3,103.13 | 1,307.24 | 287.29 |

公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50% 或严重依赖于少数客户的情况。

报告期内公司前五大客户之间不存在关联关系。

(五) 原材料和能源供应情况

1、主要原材料采购情况

公司主要原材料的采购金额如下表所示:

单位: 万元

| | 2011 | 2010 | 2009 |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 铜带 | 32,740.01 | 36,691.24 | 21,985.11 |
| 化工原料 | 6,654.08 | 4,221.47 | 2,591.97 |
| 铁带 | 1,697.53 | 1,352.17 | 850.22 |
| 备品备件 | 1,314.60 | 1,097.07 | 723.62 |
| 采购合计 | 42,406.22 | 43,571.75 | 26,150.92 |

公司生产所需的主要原材料为铜带, 报告期内公司原材料铜带等的平均价格如下表所示:

单位: 万元/吨

| 名称 | 2011 | 2010 | 2009 |
|-----------------|------|------|------|
| 铜带平均采购价格 (万元/吨) | 6.49 | 5.52 | 4.09 |

2、主要能源及其采购情况

公司生产所用主要能源为电力，公司生产用电由宁波市和泰州市电力部门提供。公司报告期电力消耗情况如下表所示：

| | 2011 | 2010 | 2009 |
|---------|---------|---------|--------|
| 电费（万元） | 976.95 | 826.89 | 524.30 |
| 数量（万度） | 1213.00 | 1051.49 | 678.74 |
| 单价（元/度） | 0.81 | 0.79 | 0.77 |

3、主要原材料和能源占主营业务成本的比重

本公司报告期主要原材料和能源占主营业务成本的比重情况如下表：

| 项 目 | 2011 | 2010 | 2009 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 原材料成本（万元） | 33762.30 | 29,968.20 | 16,514.53 |
| 电力消耗（万元） | 976.95 | 826.89 | 524.30 |
| 主营业务成本（万元） | 38,467.45 | 33,660.79 | 19,025.95 |
| 原材料占比（%） | 87.77 | 89.03 | 86.80 |
| 电力占比（%） | 2.54 | 2.45 | 2.76 |

4、主要供应商情况

本公司报告期内向前五名供应商采购原材料的金额及合计采购金额占当期采购总额的比例如下表所示：

单位：万元

| 期间 | 供应商名称 | 采购金额 | 采购总金额 | 比例（%） |
|------|---------------|-----------|-----------|--------|
| 2009 | 中国铝业公司下属公司 | 7,546.49 | 26,150.92 | 83.54 |
| | 宁波科士金属材料有限公司 | 4,885.72 | | |
| | 常州金方圆铜业有限公司 | 4,330.89 | | |
| | 辽宁铜业集团有限公司 | 3,709.40 | | |
| | 宁波市鄞州甬达贵金属回收厂 | 1,375.22 | | |
| | 合计 | 21,847.72 | | |
| 2010 | 中国铝业公司下属公司 | 23,709.23 | 43,571.75 | 85.57 |
| | 辽宁铜业集团有限公司 | 4,834.87 | | |
| | 宁波科士金属材料有限公司 | 3,172.49 | | |
| | 宁波市鄞州甬达贵金属回收厂 | 2,826.27 | | |
| | 常州金方圆铜业有限公司 | 2,741.25 | | |
| 合计 | 37,284.11 | | | |
| 2011 | 中国铝业公司下属公司 | 25,626.06 | 42,406.22 | 85.36% |
| | 宁波市鄞州甬达贵金属回收厂 | 4,239.03 | | |
| | 宁波科士金属材料有限公司 | 2,769.03 | | |
| | 常州金方圆铜业有限公司 | 2,337.21 | | |
| | 日立金属株式会社 | 1,227.68 | | |
| | 合计 | 36,199.01 | | |

公司2010年向中国铝业公司下属公司合计采购占年度采购总额54.41%，2011年向中国铝业公司下属公司合计采购占年度采购总额的60.43%。

（六）发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东在上述供应商或客户中所占的权益情况

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东不存在在上述供应商中占有权益的情况。

报告期内公司的前五名客户中，宁波明昕微电子股份有限公司为本公司的关联方，并为持有本公司 5%以上的股份的股东，除此以外，截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东不存在在上述客户中占有权益的情况。

（七）安全与环保

1、环保措施

公司生产废水主要包括电镀废液和电镀清洗废水。公司投资新建了电镀废水处理设施，采用中和、沉淀、过滤、离子交换、反渗透等工艺对电镀废水进行分类处理，实现生产废水超过 80%循环回用，其余废水达标排放，其中 COD、BOD 和石油类达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准，其余指标达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准和第一类污染物最高允许浓度。

公司生产固废主要是电镀工序产生的废渣、废品等。公司委托绍兴县金冶熔炼有限公司进行综合利用，促进清洁生产和循环经济发展。

公司生产废气主要是电镀酸腐蚀工序中产生的酸雾。公司采用封闭收集、碱液喷淋吸收处理后高空排放，排放废气达到国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）“新污染源大气污染物排放限值”二级标准。

华龙电子及泰州华龙三废处理情况如下表所述：

| | 华龙电子 | 泰州华龙 |
|-------|---|--|
| 废水 | 生产废水主要包括电镀废液、电镀清洗废水和铜带车间酸洗废水。 | 生产废水主要包括电镀废液和电镀清洗废水。 |
| 主要污染源 | 华龙电子建有 4 套废水处理回用装置、1 套纯水系统及 1 套综合废水处理设施。电镀生产废液经 4 套废水处理回用装置分类处理并 80%回用，其余通过综合废水处理系统达标排放；铜带车间酸洗废水通过废水处理系统处理后达标 | 泰州华龙建有 5 套废水处理回用装置、1 套纯水系统及 1 套综合废水处理设施。电镀生产废液经 5 套废水处理回用装置分类处理并 80%回用，其余通过综合废水处理系统达标排放。 |
| 环保设施 | | |

| | | | |
|----------|----------|---|--|
| | | 排放。 | |
| 环保设施运行情况 | | 华龙电子的废水处理设施均有效运行，2010年电镀废水处理设施维护6次，稳定运行率为98.2%，电镀废水处理设施与主题设施同步运转率100%。 | 泰州华龙1套纯水系统及1套综合废水处理设施均正常运行。 |
| 废气 | 主要污染源 | 生产废气主要是全自动电镀生产线酸腐蚀工序中产生的硫酸雾废气和铜带车间熔炼炉烟尘。 | 主要是全自动电镀生产线酸腐蚀工序中产生的硫酸雾废气及预镀银、镀银、预镀铜工序产生的含氰废气 |
| | 环保设施 | 对电镀生产线产生的硫酸雾废气采用封闭收集、碱液喷淋吸收处理后高空排放的方法。华龙电子现有酸雾喷淋吸收设施7套，由宁波鄞州横街山峰环保防腐设备厂生产，处理后的废气通过12.5m/15m排气筒高空排放。对铜带车间熔炼炉烟尘采用脉冲除尘设施，现有处理设施1套，由余姚益民环保设备厂生产，处理后的废气通过15m排气筒高空排放。 | 泰州华龙对上述废气采用封闭收集、碱液或次氯酸钠溶液喷淋吸收处理后高空排放的方法。目前泰州华龙共有废气吸收处理设施2套，由宁波市鄞州横街山峰环保防腐设备厂生产，分别收集处理硫酸雾废气及含氰废气，处理后的废气分别经20m、25m高的排气筒排放。 |
| | 环保设施运行情况 | 华龙电子所购置的废气处理环保设施均有效运行，2010年废气碱液喷淋设施、铜带车间熔炼炉粉尘处理设施稳定运行率均为100%。 | 泰州华龙电子所购置的废气处理环保设施均有效运行。 |
| 固废 | 主要污染源 | 华龙电子危险废物主要为电镀废物和废矿物油，一般工业固体废物包括金属边角料和废成品。 | 泰州华龙危险废物主要为电镀废物和废矿物油，一般工业固体废物包括金属边角料和废成品。 |
| | 处理措施 | 2010年电镀废物委托绍兴县金冶熔炼有限公司处理，废矿物油委托宁波港强实业有限公司处理，上述公司具备处理表面处理废物的经营资质。 | 2010年电镀废物委托绍兴县金冶熔炼有限公司处理，废矿物油委托泰州宇新固废处置有限公司处理，上述公司具备处理表面处理废物的经营资质。 |

公司通过了ISO14001环境管理体系认证，为公司进一步提升环境管理水平提供了组织和制度保障。

浙江省环境保护厅对公司现有业务进行了核查并于2010年3月25日出具了《关于宁波华龙电子股份有限公司上市环保核查情况的函》（浙环函[2010]75号），对公司2007年1月至2009年12月的环保情况进行了核查，认为“宁波华龙电子股份有限公司基本符合上市公司环保核查有关要求，同意通过上市环保核查”。2011年3月25日，浙江省环境保护厅出具了《关于宁波华龙电子股份有限公司上市环保核查情况的补充意见》，对公司2010年1月至12月的环保情况进行了补充核查，认为“宁波华龙电子股份有限公司基本符合上市公司环保核查有关要求，同意通过上市环保核查”。

2012年2月6日,宁波市环境保护局出具《关于宁波华龙电子股份有限公司生产经营环保守法情况证明》,确认2011年1月1日至2011年12月31日宁波华龙电子股份有限公司生产经营符合国家、地方有关环境保护规定,未有因违反环境保护方面的法律法规和规范性文件而被处罚的情况。

2012年2月8日,泰州市环境保护局出具证明,确认2008年7月31日至今泰州华龙电子有限公司生产经营符合国家、地方有关环境保护规定,未有因违反环境保护方面的法律法规和规范性文件而被处罚的情形。

2、安全生产情况

公司建立了完善的管理制度,包括《安全生产责任制》、《安全生产规章制度》、《剧毒物品安全管理制度》、《安全生产教育》、《事故管理》、《安全操作规程》、《危险源管理》、《现场安全监督检查》、《宁波华龙电子股份有限公司应急救援预案》等。

公司电镀工序使用的氰化银钾、氰化银、氰化钾等氰化物属于化学危险物品。公司按照《化学危险物品安全管理条例》、《化学危险物品安全管理条例实施细则》等有关规定建立了相应的安全管理制度,并对危险化学品生产、储存装置每年进行一次安全评价。

宁波市东钱湖旅游度假区安全生产监督管理局于2012年2月2日出具证明,确认:“最近36个月该公司未发生重大安全生产事故,也未有因违反有关安全生产方面的法律法规而受到我局行政处罚的情形。”

五、发行人主要固定资产及无形资产情况

(一) 与业务相关的主要固定资产

1、发行人拥有的主要生产设备

截至2011年12月31日,公司固定资产净值为12,989.97万元,具体明细如下:

| 项目 | 原值 | 累计折旧 | 净值 | 成新率(%) |
|-------|-----------|----------|-----------|--------|
| 房屋建筑物 | 5,298.49 | 679.56 | 4,618.93 | 87.17 |
| 机器设备 | 11,045.66 | 3,496.77 | 7,548.88 | 68.34 |
| 运输设备 | 1,147.47 | 594.54 | 552.93 | 48.19 |
| 办公设备 | 694.39 | 425.16 | 269.23 | 38.77 |
| 合计 | 18,186.01 | 5,196.04 | 12,989.97 | 71.43 |

公司各工序拥有的主要生产设备如下表所示:

| 工序名称 | 主要生产设备 | 数量 | 原值(万元) | 净值(万元) | 成新率(%) |
|------|--------|----|--------|--------|--------|
|------|--------|----|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|-----------|------------|-------|----------|----------|-------|
| 模具制造工序 | 进口精密数控慢走丝 | 5 台 | 650.03 | 342.36 | 52.66 |
| | 光学曲线磨 | 2 台 | 282.60 | 170.26 | 60.24 |
| | 国产线切割机 | 10 台 | 15.76 | 8.09 | 51.33 |
| | 电火花机 | 4 台 | 23.88 | 16.52 | 69.18 |
| | 数控精密加工中心 | 1 台 | 41.00 | 25.63 | 62.51 |
| | 进口精密磨床 | 2 台 | 108.68 | 63.99 | 58.88 |
| | 各类磨床 | 16 台 | 104.93 | 59.03 | 56.25 |
| | 万能工具显微镜 | 2 台 | 32.63 | 24.34 | 74.62 |
| | 三坐标测量仪 | 1 台 | 28.92 | 7.23 | 25.00 |
| | 尺寸测量投影仪 | 8 台 | 34.79 | 8.92 | 25.64 |
| | 铜带制造工序 | 水平连铸机 | 2 台 | 58.23 | 41.66 |
| 井式真空退火炉 | | 5 台 | 34.96 | 22.62 | 64.70 |
| 二辊冷轧机 | | 4 台 | 26.53 | 15.70 | 59.18 |
| 轧机 1750 号 | | 1 台 | 2.30 | 1.73 | 75.22 |
| 二辊清刷机 | | 1 台 | 5.50 | 3.02 | 54.90 |
| 冲制工序 | 日本电产京利高速冲床 | 10 台 | 1,499.37 | 952.44 | 63.52 |
| | 台湾振力高速冲床 | 1 台 | 88.70 | 74.06 | 83.49 |
| | 东泰精密高速冲床 | 5 台 | 152.41 | 39.21 | 25.73 |
| | 振力精密高速冲床 | 19 台 | 733.27 | 412.14 | 56.21 |
| 表面处理工序 | 全自动电镀线 | 9 条 | 1811.96 | 1,149.30 | 63.43 |
| | 镀层测厚仪 | 2 台 | 36.83 | 27.9 | 75.75 |
| | 原子吸收风光光度计 | 1 台 | 17.65 | 6.53 | 37.00 |
| 切断工序 | 国产全自动切断机 | 40 台 | 283.81 | 137.11 | 48.31 |
| | 进口集成电路切断机 | 3 台 | 319.04 | 286.08 | 89.85 |

子公司泰州华龙的主要生产设备如下所示：

| 工序名称 | 主要生产设备 | 数量 | 原值 | 净值 | 成新率 |
|--------|-----------------|------|--------|--------|-------|
| 模具制造工序 | 进口精密数控慢走丝 | 2 台 | 198.13 | 176.21 | 88.94 |
| | 国产线切割机 | 2 台 | 4.44 | 3.91 | 88.06 |
| | 电火花机 | 2 台 | 10.91 | 9.91 | 90.83 |
| | 平面磨床 | 3 台 | 22.58 | 20.04 | 88.75 |
| | 万能工具显微镜 | 1 台 | 7.86 | 6.98 | 88.80 |
| | 硬度计 | 1 台 | 3.42 | 3.04 | 88.89 |
| | 尺寸测量投影仪 | 2 台 | 4.32 | 3.85 | 89.12 |
| 冲制工序 | 日本电产京利高速冲床 | 4 台 | 573.8 | 504.94 | 88.00 |
| | 振立精密高速冲床(即国产冲床) | 8 台 | 295.35 | 262.13 | 88.75 |
| | 螺杆压缩机 | 1 台 | 7.09 | 6.29 | 88.72 |
| 表面处理工序 | 全自动电镀线 | 3 条 | 539.33 | 494.74 | 91.73 |
| | 测厚仪 | 1 台 | 23.08 | 20.48 | 88.73 |
| 切断工序 | 全自动切断机 | 10 台 | 68.38 | 60.86 | 89.00 |
| | 尺寸测量投影仪 | 2 台 | 4.32 | 3.86 | 89.35 |

2、发行人拥有的房屋建筑物

本公司及控股子公司拥有 6 处房产，具体情况如下：

| 序号 | 权属人 | 权证号 | 面积 (平方米) | 对应土地使用权证 | 房屋位置 |
|----|-----|-----|-------------|----------|------|
|----|-----|-----|-------------|----------|------|

| 序号 | 权属人 | 权证号 | 面积 (平方米) | 对应土地使用权证 | 房屋位置 |
|----|------|-----------------------|-------------|------------------------|----------|
| 1 | 华龙电子 | 甬房权证东旅字第 F200903471 号 | 5283.49 | 甬东旅国用(2010)第 36-007 号 | 东钱湖镇旧宅村 |
| 2 | 华龙电子 | 甬房权证东旅字第 F200900553 号 | 4053.83 | 甬东旅国用(2009)第 36-0033 号 | 东钱湖镇旧宅村 |
| 3 | 泰州华龙 | 泰房权证海陵字第 1000045347 号 | 18358.13 | 泰州国用(2009)第 7016 号 | 泰州海陵工业园区 |
| 4 | 泰州华龙 | 泰房权证海陵字第 1000045348 号 | 5628.52 | 泰州国用(2009)第 7016 号 | 泰州海陵工业园区 |
| 5 | 泰州华龙 | 泰房权证海陵字第 1000045349 号 | 1593.75 | 泰州国用(2009)第 7016 号 | 泰州海陵工业园区 |
| 6 | 泰州华龙 | 泰房权证海陵字第 1000045350 号 | 2526.14 | 泰州国用(2009)第 7016 号 | 泰州海陵工业园区 |

房屋建筑物抵押情况见本招股书“第十五章 其他重要事项之二、重大合同”。

3、发行人租赁的房屋建筑物

本公司租有 1 处房产，具体情况如下：

| 序号 | 出租人 | 租赁期限 | 面积 (平方米) | 租金 (万元/年) | 房屋位置 |
|----|---------------|-------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| 1 | 宁波市鄞州三联电镀有限公司 | 2011 年 6 月 15 日 -2013 年 6 月 14 日 | 4073.58 | 51.33 | 东钱湖镇旧宅村 |

上述租赁房产主要用于铜带车间生产用房。

(二) 与业务相关的主要无形资产

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无形资产账面价值为 6,121.96 万元，具体明细如下：

单位：万元

| 项目 | 2011 年 12 月 31 日 |
|----------|------------------|
| 土地使用权 | 5,744.90 |
| 专利权 | 362.38 |
| ERP 管理软件 | 14.68 |
| 合计 | 6,121.96 |

1、商标

截至本招股说明书出具日，发行人所有的商标如下：

| 商标名称 | 申请号 | 商品类别 | 有效期限 | 取得方式 |
|------|-----|------|------|------|
|------|-----|------|------|------|



7109010

9

2010.10.14-2020.10.13

申请

2、专利

(1) 截至本招股说明书出具之日，发行人共有 33 项专利已获得专利证书，具体情况为：

| 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | 申请日期 |
|------|--------------------|---------------------|------------|
| 发明 | 一种大规模集成电路引线框架的制造方法 | ZL 2009 1 0101391.5 | 2009.07.31 |
| 实用新型 | 一种防水型塑料封装系列引线框架 | ZL 2007 2 0107304.3 | 2007.03.15 |
| 实用新型 | 小功率三极管引线框架版件 | ZL 2008 2 0153816.8 | 2008.10.07 |
| 实用新型 | 一种双排双列的三极管引线框架版件 | ZL 2008 2 0153817.2 | 2008.10.07 |
| 实用新型 | 一种双排并列的集成电路引线框架版件 | ZL 2008 2 0153815.3 | 2008.10.07 |
| 实用新型 | 一种四排双列的三极管引线框架版件 | ZL 2008 2 0153818.7 | 2008.10.07 |
| 实用新型 | 一种铁镍合金引线框架版件 | ZL 2008 2 0153819.1 | 2008.10.07 |
| 实用新型 | 一种双排双列的薄型引线框架版件 | ZL 2008 2 0167650.5 | 2008.11.07 |
| 实用新型 | 一种具双侧散热突缘的引线框架版件 | ZL 2008 2 0167651.X | 2008.11.07 |
| 实用新型 | 耐热防潮大功率引线框架 | ZL 2009 2 0142080.9 | 2009.03.19 |
| 实用新型 | 一种环镀焊区的集成电路引线框架 | ZL 2009 2 0142081.3 | 2009.03.19 |
| 实用新型 | 一种薄型集成电路引线框架 | ZL 2009 2 0142440.5 | 2009.04.16 |
| 实用新型 | 四方扁平的集成电路引线框架 | ZL 2009 2 0077878.X | 2009.07.02 |
| 实用新型 | 集成电路引线框架的连续电镀装置 | ZL 2009 2 0191449.5 | 2009.08.14 |
| 实用新型 | 一种高频三极管引线框架件 | ZL 2009 2 0244612.X | 2009.12.22 |
| 实用新型 | 直插式三极管引线框架 | ZL 2009 2 0244616.8 | 2009.12.22 |
| 实用新型 | 一种大功率贴片式引线框架 | ZL 2009 2 0244618.7 | 2009.12.22 |
| 实用新型 | 一种密集排列的微电子三极管引线框架件 | ZL 2009 2 0244614.9 | 2009.12.22 |
| 实用新型 | 一种双二极管引线框架 | ZL 2009 2 0244615.3 | 2009.12.22 |
| 实用新型 | 一种晶体管集成电路引线框架件 | ZL 2009 2 0244613.4 | 2009.12.22 |

| | | | |
|------|-------------------|---------------------|------------|
| 新型实用 | 一种防水增强型引线框架 | ZL 2010 2 0168189.2 | 2010.04.16 |
| 新型实用 | 陈列式环岛镀引线框架版件 | ZL 2010 2 0168203.9 | 2010.04.16 |
| 新型实用 | 一种密集排列的集成电路引线框架版件 | ZL 2010 2 0168192.4 | 2010.04.16 |
| 新型实用 | 一种抗裂防渗的集成电路引线框架 | ZL 2010 2 0585968.2 | 2010.10.28 |
| 新型实用 | 一种多重防裂的三极管引线框架 | ZL 2010 2 0585894.2 | 2010.10.28 |
| 新型实用 | 一种功率二极管引线框架 | ZL 2010 2 0585918.4 | 2010.10.28 |
| 新型实用 | 一种密集排列组合的三极管引线框架件 | ZL 2010 2 0585926.9 | 2010.10.28 |
| 新型实用 | 直板式薄型三极管引线框架 | ZL 2010 2 0585948.5 | 2010.10.28 |
| 新型实用 | 短脚三极管引线框架 | ZL 2010 2 0585962.5 | 2010.10.28 |
| 新型实用 | 防渗防裂的直插式三极管引线框架版 | ZL 2011 2 0295997.X | 2011.08.12 |
| 新型实用 | 多用途引线框架封装基板 | ZL 2011 2 0295988.0 | 2011.08.12 |
| 新型实用 | 一种错位排列的三极管引线框架版 | ZL 2011 2 0295963.0 | 2011.08.12 |
| 新型实用 | 一种双重增强的集成电路引线框架版 | ZL 2011 2 0295968.3 | 2011.08.12 |

此外，发行人“一种引线框架贴膜电镀工艺及其专用装置”（申请号：201110027556.6）已获得《授予发明专利权通知书》，“防管芯滑移的微电子三极管引线框架版”（申请号：201120295984.2）已获得《授予实用新型专利权通知书》，“错位式密集排列的集成电路引线框架版”（申请号：201120295954.1）已获得《授予实用新型专利权通知书》，截至本招股说明书出具之日，相关权证正在办理过程之中。

公司于2008年11月18日与南通富士通微电子股份有限公司签订《专利实施许可合同》，通富微电将“新型集成电路焊接引线框架”、“新型集成电路多排矩阵式引线框架”、“集成电路多排矩阵式引线框架”和“集成电路焊接引线框架”共四项专利以独占许可的方式许可华龙电子实施，许可期限均为2008年11月18日至2013年11月17日，每项专利权的使用费为1万元。华龙电子已向通富微电支付了上述专利实施许可使用费合计4万元，截至本招股说明书签署日，上述《专利实施许可合同》均处于正常履行过程中。

（2）截至本招股说明书出具之日，发行人共有2项专利申请被国家知识产权局受理，正处于审查阶段，具体情况为：

| 专利类型 | 专利名称 | 申请号 | 申请日期 |
|------|---------------------|----------------|------------|
| 实用新型 | 交叉错位排列的增强型集成电路引线框架版 | 201120478697.5 | 2011.11.21 |
| 实用新型 | 一种多重定位的集成电路引线框架版 | 201120478706.0 | 2011.11.21 |

3、土地使用权

公司及控股子公司共拥有 4 处土地使用权，其用途均为工业用地，使用权类型均为国有出让，具体情况如下表：

| 序号 | 权属人 | 权证号 | 面积 (M ²) | 土地位置 | 有效期限 |
|----|------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| 1 | 华龙电子 | 甬东旅国用 (2010) 第 36-007 号 | 4,139 | 宁波市东钱湖镇旧宅村 | 2057.6.21 |
| 2 | 华龙电子 | 甬东旅国用 (2009) 第 36-0033 号 | 8,224 | 宁波市东钱湖镇旧宅村 | 2052.9.16 |
| 3 | 泰州华龙 | 泰州国用 (2009) 第 7016 号 | 74,051 | 泰州海陵工业园区凤凰东路 86 号 | 2058.10.9 |
| 4 | 华龙电子 | 甬东旅国用 (2011) 第 36-085 号 | 32,701 | 宁波市东钱湖镇红林村 | 2061.2.24 |

土地使用权抵押情况见本招股书“第十五章 其他重要事项之二、重大合同”。

六、发行人生产技术、研发情况及技术创新机制

(一) 主要产品生产技术所处的阶段

发行人主要产品生产技术所处阶段如下：

| 主要产品 | 生产技术 | 所处阶段 |
|--------------------|-----------------------------|------------|
| TO 系列分立器件引线框架 | 连续高速冲压成型和全自动连续高速选择电镀技术 | 处于大规模生产阶段 |
| TO 系列汽车电子封装系列引线框架 | 连续高速冲压成型和全自动连续高速贴膜选择电镀技术 | 已接近大规模生产阶段 |
| DIP、IDF 系列集成电路引线框架 | 连续高速冲压成型和全自动连续高速选择喷镀技术 | 处于大规模生产阶段 |
| SOT 系列表面贴装引线框架 | 连续高速冲压成型和全自动连续高速选择点镀技术 | 处于大规模生产阶段 |
| SOP 系列中小规模集成电路引线框架 | 连续高速冲压成型和全自动连续高速选择电镀及环岛电镀技术 | 处于大规模生产阶段 |
| SSOP 系列大规模集成电路引线框架 | 连续高速冲压成型和全自动连续高速选择电镀及环岛电镀技术 | 处于大规模生产阶段 |
| TSOP 系列大规模集成电路引线框架 | 连续高速冲压成型和全自动连续高速选择电镀及环岛电镀技术 | 处于大批量生产阶段 |
| LQFP 系列大规模集成电路引线框架 | 连续高速冲压成型和全自动连续高速选择电镀及环岛电镀技术 | 已接近大规模生产阶段 |

为了保证封装工艺中装片/键合性能，使芯片和金丝与引线框架形成良好的扩散焊接，引线框架的装片/键合区域（内引线脚上和小岛）一般要求精压，然后在上面电镀。通过精压可以形成一个光滑致密的表面以获得高质量的镀层，同

时提供一个充足平坦的键合点区域。镀层的质量直接影响装片和金丝的键合强度，从而最终影响产品的成品率和可靠性。

公司在引线框架表面处理领域积累了多年经验，多项电镀技术在行业内保持领先水平，公司于 2011 年 10 月 28 日被宁波市电镀行业协会授予先进企业称号。公司目前主要电镀技术如下表：

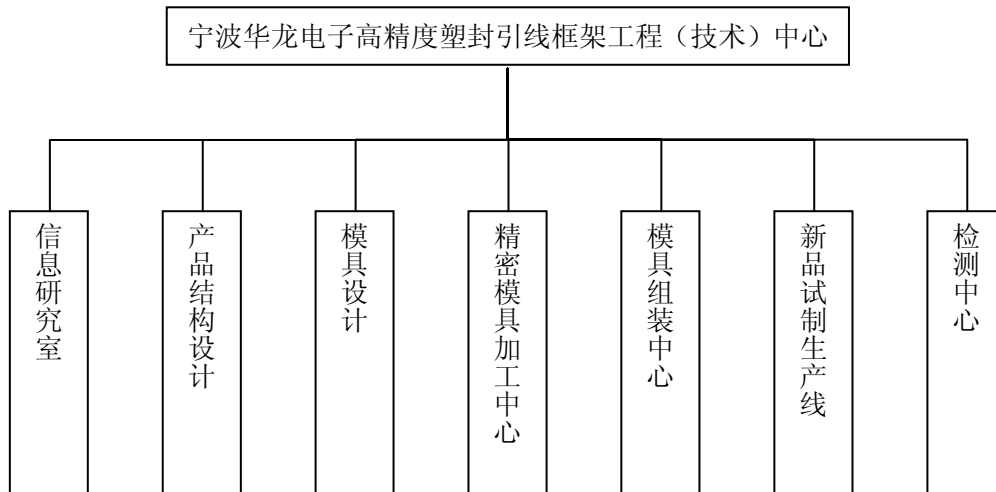
| 主要电镀技术 | 工艺特征 |
|-----------------|--|
| 全自动连续高速选择电镀技术 | 实现引线框架单面局部电镀功能，比传统浸镀工艺节省镀种材料（主要是银）50%以上 |
| 全自动连续高速选镀镍电镀技术 | 提高引线框架与芯片的结合力，是下游封装企业使用铝丝替代价格昂贵的金丝作为键合丝，减少下游企业封装成本 |
| 全自动连续高速选择喷镀技术 | 提高引线框架电镀精度，精度达到 $\pm 0.1\text{mm}$ ，比传统浸镀工艺节省镀种材料（主要是银）75%以上 |
| 全自动连续高速选择点镀技术 | 实现在引线框架关键部位点镀，比传统浸镀工艺节省镀种材料（主要是银）85%以上 |
| 全自动连续高速选择环岛电镀技术 | 为目前国内引线框架行业较高端镀银工艺，该项技术主要应用于极大规模集成电路，提高了芯片、塑封料与引线框架之间的结合力，增强了集成电路可靠性，延长其使用寿命 |

上述电镀技术的使用在降低生产成本、提高产品可靠性等方面作用显著。

（二）发行人研发情况

1、研究机构设置及人员情况

公司建有宁波华龙电子高精度塑封引线框架工程（技术）中心，下设机构如下：



该工程（技术）中心主要从事高精度塑封引线框架产品结构开发、模具设计和电镀工艺等方面研究，目前重点研发大规模集成电路（SOP/SSOP/LQFP 等）系

列、功率模块系列、TO 高脚数系列、表面贴装（SOT/SOD/SMD 等）系列引线框架的设计与生产技术。

工程（技术）中心现有研发人员 60 余人，其中中高级技术人员 10 人。

2、发行人正在从事的研发项目及进展情况、拟达到的目标

| 正在研发项目 | 拟达到目标 | 进展情况 |
|-----------------------|-------------------------|------|
| DIP-40 系列大规模集成电路引线框架 | 与高端客户封装技术配套用的引线框架，替代进口 | 批量生产 |
| LQFP-44 系列大规模集成电路引线框架 | 与高端客户封装技术配套用的引线框架，替代进口 | 批量生产 |
| TSOT 系列表面贴装引线框架 | 与高端客户封装技术配套用的引线框架，替代进口 | 批量生产 |
| SSOP 系列大规模集成电路引线框架 | 与高端客户封装技术配套用的引线框架，替代进口 | 批量生产 |
| LQFP-64 系列大规模集成电路引线框架 | 与长电科技、通富微电配套用的引线框架，替代进口 | 开发阶段 |
| LED 系列表面贴装引线框架 | 与高端客户封装技术配套用的引线框架，替代进口 | 开发阶段 |

3、发行人研发投入

公司报告期内研发投入占营业收入的比例如下表所示：

| | 2011 | 2010 | 2009 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 研发投入 | 1,647.98 | 1,538.71 | 994.51 |
| 营业收入 | 52,048.46 | 50,096.76 | 32,390.82 |
| 比例（%） | 3.17 | 3.07 | 3.07 |

（三）发行人集成电路引线框架的技术来源、业务发展历程及现状

鄞县华龙设立后产品以分立器件引线框架为主，2002 年开始华龙有限客户陆续向公司提出了采购集成电路引线框架的需求。相对于分立器件引线框架而言，集成电路引线框架具有产品体积小、引脚数量多的特点，同时集成电路引线框架基岛需要与集成电路芯片接触并进行电气传输，因此集成电路引线框架基导表面处理工艺要求更高。由于集成电路引线框架自身结构的特点在生产工艺上难度较大，同时为了确保集成电路成品的质量，集成电路终端用户对集成电路封装企业下订单时都会指定所使用的引线框架品牌，因此我国集成电路引线框架主要依赖进口。

公司获取客户中存在集成电路引线框架需求后，集中研发力量进行集成电路引线框架生产工艺的研发。公司最初研发的 IDF 系列集成电路引线框架通过绍兴力响电子有限公司的质量认证，公司集成电路引线框架产品经该公司使用后取得良好的效果，价格比进口产品低 20%左右，各项性能指标均能达到预期要求。此后公司陆续取得浙江芯旺电子有限公司（前身是绍兴力响电子有限公司）、无锡

华润安盛科技有限公司、南通富士通微电子股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、深圳矽格电子有限公司、安徽国晶微电子有限公司等多家集成电路封装企业订单。

目前公司具备包括 DIP、SOP、TSOP、SSOP 等多个系列集成电路引线框架的能力。集成电路的主要发展趋势是高密度、高脚位、薄型化、小型化，国内市场的主要需求仍在 DIP、SOP、QFP 等中低端产品上，但随着数字电视、信息家电和 3G 手机等消费和通信领域技术的迅猛发展，国内集成电路市场对高端集成电路产品的需求不断增加。

为了提升我国半导体产品结构，《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020 年)》中将“极大规模集成电路制造技术及成套工艺”确定为 16 个重大专项之一。在该项目中，公司承担了“LQFP 引线框架的研发和产业化”子项目，从事国内极大规模集成电路相配套的 LQFP 引线框架研发和产业化。

七、发行人主要产品和服务的质量控制情况

(一) 质量控制标准

公司已根据 ISO/TS16949:2009 版体系要素要求以及公司的实际情况建立了《质量手册》和 27 个管理程序。

ISO/TS16949:2009 版体系是国际标准化组织 (ISO) 与国际汽车工作组 (IATF) 公布的国际汽车质量的技术规范，这项技术规范适用于整个汽车产业生产零部件与服务件的供应链。目前，国内外众多汽车制造商已强制要求其供应商通过 TS16949 的认证。

由于汽车电子产品是本公司产品的应用领域之一，公司在 2008 年根据 ISO/TS16949:2002 版体系要素要求建立 27 个管理程序，涵盖供方管理、采购管理、生产过程管理、产品监视和测量控制、产品交付管理等众多方面。目前公司的管理体系已通过审核，符合 ISO/TS16949:2009 版体系要求。

(二) 质量控制措施

从原材料采购入库直至产品交付客户，公司建立了完整的质量控制程序。

首先，在供应商的选择上，公司建立有《供方管理程序》。所有进入公司《合格供方名单》的供应商都需要经过公司业务部及相关部门的初选、供方能力和质量体系评审、样品考核和综合评价。公司每半年对供方的整体业绩进行一次综合评价，根据综合评价结果对供方资格重新确认；在采购过程中，公司建立有《采购管理程序》，对于采购的材料需与供应商签订相关采购文件，包括采购合同或

协议、技术协议和质量保证协议，公司品质部进料检验员对运抵公司的原材料进行检验，经检验合格移交仓库管理人员。

公司建立有《产品监视与测量管理程序》，保证生产过程质量可靠性。公司产品在生产过程中要经历首检、自检、巡检和最终检验。各生产车间作业人员在接到生产制造任务后，按作业指导书进行准备、作业。所生产的首件产品确认品质后，交各车间检验人员进行首检，首检合格后检验人员方可通知作业人员进行生产；生产过程中各车间作业人员需对生产的产品进行自检；品质部检验人员对生产的产品做巡检检验；最终产品生产出后由检验人员对入库前的产品进行最终验收。

（三）产品质量纠纷

针对客户的质量投诉，公司品质部应在三小时内与客户取得联系，详细了解质量投诉问题点、异常批次、数量及应急处理意见等。公司根据客户提供的外部质量信息，收集内部相关质量追溯信息，包括该产品图纸、作业指导书等，以判断该问题是否为公司内部质量问题。如被认定为内部质量问题，公司立即召开相关部门参加质量会议，提出整改措施。公司品质部自接到客户投诉后 5 个工作日内向客户回复改善的相关信息。

本公司自成立以来，未因产品品质问题发生过重大质量纠纷。

（四）发行人生产经营所需的资质

华龙电子已依法取得《企业法人营业执照》，《企业法人营业执照》载明的经营范围为“电子元件、继电器配件、电声器配件、接插件、电器配件、半导体器件及半导体元器件专用材料开发生产、电子零件、模具制造、加工。”

华龙电子的主要产品为半导体封装引线框架，属于半导体器件及半导体元器件专用材料。根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 440 号）、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》（国家质量监督检验检疫总局令 第 130 号）、《关于公布实行生产许可证制度管理的产品目录的公告》（国家质量监督检验检疫总局 2010 年 90 号公告），引线框架未列入实行生产许可证制度管理的 product 目录。

华龙电子引线框架产品生产过程中需要使用氰化钾、氰化银钾等危险化学品，华龙电子已按照《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 591 号）等相关法律法规的要求，在剧毒化学品采购、储存、使用和废弃四个环节制定了相应的措施，并按《危险化学品安全管理条例》要求每年进行一次安全评价。

华龙电子及其控股子公司现有生产经营项目均已办理了固定资产投资立项、环评手续。

综上，华龙电子及其控股子公司已取得生产经营所需的全部资质。

第七章 同业竞争和关联交易

一、同业竞争

(一) 同业竞争情况

本公司实际控制人为陈亚龙；邬文通、铭龙投资、香港致誉为陈亚龙的一致行动人，本次发行前，上述各方合计持有公司57.37%股权。

铭龙投资和香港致誉的主要业务均为对外投资，除了华龙电子外，陈亚龙及其一致行动人不存在其他拥有控制权的企业。

公司与以上法人股东之间不存在同业竞争。

(二) 避免同业竞争的承诺

发行人实际控制人为陈亚龙及其一致行动人邬文通、铭龙投资、香港致誉作出如下承诺：

(1) 不直接或间接从事与发行人主营业务相同或相似的生产经营和销售。

(2) 不从事与发行人主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营的方式从事与发行人的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

(3) 在今后的经营范围和投资方向上，避免同发行人相同或相似；对发行人已经进行建设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资。

(4) 在生产、经营和市场竞争中，不与发行人发生任何利益冲突。

二、关联方及关联方关系

报告期内，发行人存在的关联方包括：

1、存在控制关系的关联方

| 关联方 | 与本公司关系 | 报告期内是否存在关联交易 |
|------|--|--------------|
| 陈亚龙 | 持有本公司 5%以上股权、本公司实际控制人、董事长兼总经理 | 是 |
| 邬文通 | 持有本公司 5%以上股权、实际控制人的一致行动人 | 否 |
| 香港致誉 | 2008 年 5 月成为本公司股东，持有本公司 5%以上股权，实际控制人的一致行动人 | 否 |
| 铭龙投资 | 持有本公司 5%以上股权，实际控制人的一致行动人 | 否 |
| 泰州华龙 | 本公司控股子公司 | - |

铭龙电子 本公司控股子公司

-

2、其他关联法人

| 关联方名称 | 与本公司关系 | 报告期内是否存在关联交易 |
|-------|---|--------------|
| 深圳华龙 | 2010年3月前与本公司同受实际控制人陈亚龙控制，2010年3月陈亚龙将股权转让给不具有关联关系的第三方并完成相关工商登记手续 | 否 |
| 明昕电子 | 持有本公司5%以上股权 | 是 |
| 通富微电 | 该公司董事、总经理石磊同时任本公司董事 | 是 |
| 南通华达 | 持有本公司5%以上股份的股东 | 是 |
| 香港科恒 | 持有本公司5%以上股份的股东 | 否 |

3、其他关联自然人

| 关联方名称 | 与发行人的关联关系 |
|-------|---------------|
| 陈召芬 | 发行人董事 |
| 张善国 | 发行人副董事长 |
| 石磊 | 发行人董事 |
| 陈孝龙 | 发行人董事、副总经理 |
| 徐良龙 | 发行人董事 |
| 王建章 | 发行人独立董事 |
| 刘忠立 | 发行人独立董事 |
| 包新民 | 发行人独立董事 |
| 王国强 | 发行人监事会主席 |
| 李东亚 | 发行人监事 |
| 陈永开 | 发行人监事 |
| 陈永德 | 发行人副总经理 |
| 戴家波 | 发行人财务总监 |
| 张秉 | 发行人董事会秘书、副总经理 |

发行人董事、监事、高级管理人员在关联方的任职情况与领取薪酬情况详见第八章“董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之四“董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的薪酬安排”。

三、关联交易内容

(一) 经常性关联交易事项

1、关联方销售

报告期内华龙电子向关联方销售产品及其占主营业务收入比例如下表所示：

单位：万元，%

| 企业名称 | 2011 | | 2010 | | 2009 | |
|------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 明昕电子 | 5,391.62 | 11.24 | 6,892.12 | 16.42 | 3,431.65 | 14.07 |

| | | | | | | |
|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| 通富微电 | 2,788.49 | 5.81 | 2,372.11 | 5.65 | 1,383.54 | 5.67 |
| 南通华达 | 42.04 | 0.09 | 67.49 | 0.16 | 114.13 | 0.47 |
| 合计 | 8,222.15 | 17.14 | 9,331.72 | 22.23 | 4,929.32 | 20.21 |
| 主营业务收入 | 47,963.03 | | 41,966.79 | | 24,381.93 | |

报告期内，公司向明昕电子、通富微电和南通华达销售引线框架产品。

(1) 关联交易的必要性以及对关联方是否构成重大依赖

明昕电子为我国大型的分立器件封装测试企业，其与发行人保持了多年良好的合作关系，将明昕电子纳入发行人的销售体系与发行人的发展战略相符；南通华达为通富微电控股股东，为我国十大半导体封装测试企业之一，将通富微电和南通华达纳入发行人的销售体系与发行人的发展战略相符；发行人向明昕电子、通富微电和南通华达销售引线框架产品是发行人开展正常生产经营的需要，具有必要性。

报告期内，公司对明昕电子的产品销售是市场化原则下双方互利共赢的正常商业行为，保荐机构核查后认为发行人对明昕电子不构成重大依赖，主要原因如下：

1) 公司的综合实力是与明昕电子合作的先决条件

在国内引线框架行业，公司拥有突出的技术研发能力，针对客户的应用需求，能迅速提出解决方案，并及时地开发出符合要求的高品质且具备价格优势的产品；在产品后续应用过程中，公司提供全程的跟踪服务，并结合客户在产品使用过程中产生的问题提出科学、合理的改进建议，提高产品的契合度和适用性。因此，公司的研发能力、产品质量、服务水平等综合实力是获得明昕电子认可并确立战略合作关系的先决条件。

2) 公司与明昕电子的合作是双方共赢的选择

明昕电子是宁波地区最大的半导体封装测试企业，其分立器件封装测试产能在国内位居前列。通过与明昕电子的合作，公司实现了快速切入功率器件引线框架市场，通过明昕电子这一平台使公司的引线框架产品质量获得众多半导体器件终端用户以及半导体封装测试同行的认可，逐步扩大了公司知名度和影响力。因此，与明昕的战略合作，有利于公司业务发展和产品升级，符合公司的发展战略和全体股东的利益需求。

3) 发行人努力开拓新客户，降低客户集中度

随着公司的发展，公司凭借自身的综合实力积极开拓新客户。报告期内公司新开发的客户包括天水华天、汕尾德昌、华润安盛、杭州友旺、福州福顺、上海

勤益、四川大雁等。随着客户数量增加，公司客户集中风险逐步降低。

报告期内公司对通富微电以及南通华达的销售收入占主营业务收入比例稳定在6%左右，比例较小。

综上，保荐机构认为发行人向明昕电子、通富微电和南通华达销售引线框架产品是发行人开展正常生产经营的需要，具有必要性；发行人对明昕电子、通富微电和南通华达不构成重大依赖。

(2) 发行人与明昕电子关联交易公允性

报告期内发行人向明昕电子销售主要产品系列如下表所示：

| 产品系列 | 2011 | 2010 | 2009 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TO-220 | 2,535.07 | 3,131.89 | 1,273.21 |
| TO-92 | 975.51 | 1,285.61 | 942.20 |
| TO-251 | 790.77 | 944.96 | 467.21 |
| TO-126 | 360.54 | 1,079.46 | 436.47 |
| 小计 | 4,661.89 | 6,441.92 | 3,119.09 |
| 全年销售金额 | 5,391.62 | 6,892.12 | 3,431.65 |
| 占全年向该客户销售的比例 (%) | 86.47 | 93.47 | 90.89 |

发行人向明昕电子销售上述产品系列毛利率与第三方毛利率比较如下：

| 产品系列 | 客户 | 2011 | 2010 | 2009 |
|--------|---------|-------|-------|-------|
| TO-220 | 明昕电子毛利率 | 25.75 | 22.68 | 19.88 |
| | 其他客户毛利率 | 25.79 | 21.98 | 20.45 |
| | 所有客户毛利率 | 25.78 | 22.12 | 20.36 |
| TO-92 | 明昕电子毛利率 | 5.95 | 9.35 | 14.67 |
| | 其他客户毛利率 | 7.29 | 7.10 | 13.46 |
| | 所有客户毛利率 | 7.14 | 7.43 | 13.65 |
| TO-251 | 明昕电子毛利率 | 32.95 | 29.77 | 37.18 |
| | 其他客户毛利率 | 31.93 | 29.61 | 40.19 |
| | 所有客户毛利率 | 32.34 | 29.51 | 38.67 |
| TO-126 | 明昕电子毛利率 | 23.81 | 19.27 | 15.35 |
| | 其他客户毛利率 | 23.60 | 19.75 | 14.20 |
| | 所有客户毛利率 | 23.61 | 19.66 | 14.31 |

(3) 发行人与通富微电关联交易公允性

报告期内发行人向通富微电销售主要产品系列如下表所示：

| 产品系列 | 2011 | 2010 | 2009 |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DIP | 1,458.99 | 1,723.10 | 1,084.03 |
| SOT | 677.96 | -- | -- |
| TO-92 | 354.61 | 247.53 | 181.31 |
| 小计 | 2,491.56 | 2,262.02 | 1,265.34 |
| 全年销售金额 | 2,788.49 | 2,372.11 | 1,383.54 |

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| 占全年向该客户销售的比例 (%) | 89.35 | 83.07 | 91.46 |
|------------------|-------|-------|-------|

发行人向通富微电销售上述产品系列毛利率与第三方毛利率比较如下:

| 产品系列 | 客户 | 2011 | 2010 | 2009 |
|-------|---------|-------|-------|-------|
| DIP | 通富微电毛利率 | 18.17 | 31.55 | 48.10 |
| | 其他客户毛利率 | 15.02 | 28.15 | 51.57 |
| | 所有客户毛利率 | 15.80 | 29.43 | 49.99 |
| SOT | 通富微电毛利率 | 16.68 | -- | -- |
| | 其他客户毛利率 | 14.77 | -- | -- |
| | 所有客户毛利率 | 15.07 | -- | -- |
| TO-92 | 通富微电毛利率 | 5.67 | 8.17 | 14.82 |
| | 其他客户毛利率 | 7.20 | 7.41 | 13.61 |
| | 所有客户毛利率 | 7.14 | 7.43 | 13.65 |

(4) 中介机构的核查意见

保荐机构、发行人律师、会计师对发行人向明昕电子、通富微电和南通华达的销售价格与向第三方公司销售同种产品的价格进行对比分析,经核查,报告期内发行人关联方销售价格与同种产品第三方销售价格接近,关联交易价格公允。

保荐机构对发行人向明昕电子、通富微电销售产品的毛利率同其他客户同系列产品综合毛利率以及该系列产品综合毛利率进行比较分析,经核查,报告期内发行人向明昕电子、通富微电、南通华达等关联方销售产品的毛利率与向其他客户销售同系列产品的毛利率接近,发行人与关联方之间不存在利用关联交易转移利润的情况。

2、经常性交易所产生的关联方应收应付款项余额

单位:万元

| 关联方 | 内容 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | 2009.12.31 |
|------|------|------------|------------|------------|
| 明昕电子 | 应收帐款 | 411.64 | 3,196.37 | 1,054.73 |
| 南通华达 | 应收帐款 | 0.64 | 1.46 | 6.28 |
| 通富微电 | 应收帐款 | 405.12 | 539.16 | 376.71 |

以上关联方应收款项均为发行人应收关联方货款。

(二) 偶发性关联交易情况

1、设立泰州华龙及股权转让

2008年7月,本公司与陈亚龙共同出资设立泰州华龙,泰州华龙注册资本5000万元,其中本公司认缴出资4950万元,占注册资本99%,陈亚龙认缴出资50万元,占注册资本1%。本公司已于2008年7月24日前实缴出资1312万元。

2009年12月,陈亚龙将持有的泰州华龙1%股权转让给本公司子公司铭龙电子技术,转让价格0万元(陈亚龙尚未实际出资)。泰州华龙于2009年12月11日在

泰州市工商局办理了变更登记。

2、担保

截至 2011 年 12 月 31 日，关联方对公司提供担保情况如下：

| 担保人 | 担保金额 (万元) | 债权人 | 合同名称 | 担保期限 |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 陈亚龙 | 2000 | 浦发银行鄞州支行 | 《最高额保证合同》 (660763号) | 2008年12月2日至 2013年12月2日 |
| 明昕电子 | 250 | 宁波银行高新区支行 | 《保证合同》 (05001BJ20100064) | 2010年2月5日至 2012年2月4日 |
| 明昕电子 | 150 | 宁波银行高新区支行 | 《保证合同》 (05001BJ20100065) | 2010年2月5日至 2012年2月4日 |
| 明昕电子 | 250 | 宁波银行高新区支行 | 《保证合同》 (05001BJ20100080) | 2010年3月3日至 2012年3月2日 |
| 明昕电子 | 300 | 宁波银行高新区支行 | 《保证合同》 (05001BJ20100001) | 2010年1月4日至 2012年1月3日 |
| 陈亚龙 | 5000 | 浦发银行鄞州分行 | 《最高额保证合同》 (661028号) | 2010年5月10日至 2015年5月10日 |
| 明昕电子 | 7000 | 农业银行鄞州支行 | 《最高额保证合同》 (NO.82100520110000003) | 2011年1月1日至 2012年12月31日 |
| 明昕电子 | 2000 | 宁波银行东钱湖支行 | 《最高额保证合同》 05004BY20110043 | 2010年8月1日起至 2012年7月31日 |
| 明昕电子 | 2000 | 工商银行东门支行 | 《最高额保证合同》 2011年东门(保)字0057 | 2011年7月7日起至 2012年12月31日 |
| 明昕电子 | 3000 | 浦发银行鄞州支行 | 《最高额保证合同》 ZB9417201100000001号 | 2011年1月6日起至 2012年12月31日 |
| 陈亚龙 | 2600 | 宁波鄞州农村合作银行五乡支行 | 《最高额保证合同》 最保字第20110615号 | 2011年6月15日至 2013年6月15日 |

四、关联交易决策程序

本公司报告期内已发生的关联交易均履行了公司章程规定的程序，公司独立董事对对关联交易履行的审议程序的合规性及交易价格的公允性发表了独立意见。

(一) 公司章程等规章制度对规范关联交易的安排

为规范本公司与控股股东及其他关联方的交易行为，保护公司及中小股东的利益，本公司在《公司章程》、《关联交易公允决策制度》等规章制度中，对公司关联交易的决策权力与程序作出了严格的规定，制定了关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度，及独立董事对关联交易的监督制度。详见第九章 公司治理结构 之六“公司关联交易制度、保护投资者权益的政策安排”。

（二）最近三年关联交易履行公司章程情况及独立董事意见

发行人自设立以来发生的关联交易均履行了公司章程规定的程序。

发行人独立董事对最近三年发生的关联交易的意见为：“近三年关联交易为股份公司正常生产经营所必需的，关联交易协议的签署履行了必要的决策和批准程序，交易价格公允合理，该等关联交易没有损害股份公司及各股东的合法权益。”

五、规范和减少关联交易的措施

（一）规范和减少关联交易的措施

公司制定了《公司章程》、《关联交易公允决策制度》、《独立董事工作制度》等规章制度，对关联交易的决策权力与程序作出了严格的规定，并制定了关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度以及独立董事对关联交易发表意见的制度。独立董事对关联交易的独立公正的表决权利，确保关联交易决策程序的合法性和关联交易价格的公允性，切实保障公司中小股东的合法权益不受损害。

针对公司与明昕电子、通富微电和南通华达等关联方之间持续存在的关联交易，公司拟通过开拓新客户，提高非关联方销售的比例等措施降低关联交易的比例。随着公司的发展，公司凭借自身的综合实力积极开拓新客户。报告期内公司新开发的客户包括天水华天、汕尾德昌、华润安盛、杭州友旺、福州福顺、上海勤益、四川大雁等。

（二）避免关联方利用关联交易损害其他股东利益的措施

为避免关联方利用关联交易损害其他股东的利益，发行人所有股东均作出承诺如下：承诺人及所控制的其他公司将尽量避免、减少与发行人发生关联交易；如关联交易无法避免，承诺人及所控制的其他公司将严格遵守中国证监会和发行人章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行。

第八章 董事、监事、高级管理人员 与核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介及提名选聘情况

本公司董事会由 9 名董事组成,其中 3 名独立董事;监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事为 1 人;高级管理人员 6 人,包括 1 名总经理,3 名副总经理,1 名财务总监,1 名董事会秘书。

(一) 董事简介

董事长 陈亚龙:男,1964 年出生,中国国籍,无境外居留权,浙江大学高级研修班结业;曾任宁波沪东无线电厂技术部部长、鄞县华龙总经理,现任华龙电子董事长、总经理;在半导体引线框架行业有 20 多年的任职经历和管理经验。

副董事长 张善国:男,1950 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,经济师职称。曾任宁波无线电二厂厂长,现任宁波明昕微电子股份有限公司总经理,本公司董事。

董事 石磊:男,1972 年出生,中国国籍,无境外居留权,工学学士,高级经营师。曾任南通振南股份有限公司外贸业务员、南通市华利康医疗用品有限公司销售地区经理、南通崇川开发区总公司销售经理;现任南通华达微电子集团有限公司董事、南通富士通电子股份有限公司董事和总经理、南通金茂电子科技有限公司董事长、南通尚明精密模具有限公司董事长、南通金泰科技有限公司董事长、北京达博有色金属焊料有限责任公司董事长、江苏中鹏新材料股份有限公司董事、香港海耀实业有限公司董事、无锡通芝微电子有限公司董事、本公司董事。

董事 陈召芬:女,1966 年出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历。曾在华龙有限财务科工作;现任华龙电子董事。

董事 陈孝龙:男,1967 年出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历。曾在鄞县晶体管元件厂从事半导体引线框架模具工作、在宁波沪东无线电厂从事半导体引线框架技术工作;现任华龙电子技术副总经理;具有半导体引线框架行业 21 年的任职经历和管理经验;现任华龙电子董事。

董事 徐良龙:男,1978 年出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历。曾任宁波佳安电子有限公司生产主管、电子产品开发、设计技术工作,现任本公司

董事、办公室主任。

独立董事 王建章：男，1946年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任机械电子工业部综合规划司投资二处副处长、机械电子工业部电子行业发展司技改处处长、电子工业部综合规划司副司长、信息产业部综合规划司司长；现同时任北京歌华有线电视网络股份有限公司、恒宝股份有限公司独立董事。

独立董事 刘忠立：男，1940年生，毕业于清华大学半导体材料及器件专业，研究员，博士生导师及博士后合作导师。曾任中国科学院半导体研究所课题组长，德国多特蒙德大学课题组长，中国科学院半导体研究所微电子研发中心主任，中国科学院半导体研究所学术委员会副主任，国家传感技术实验室副主任，德国HMI研究所客座教授等。现任中国科学院微电子研究所资深研究员，国家传感技术实验室学术委员会委员，北京市传感技术实验室学术委员会委员，中国电子学会核辐射及电磁脉冲专委会专家委员，微电子学杂志编辑委员会委员等。

独立董事 包新民：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任宁波海运股份有限公司、宁波韵升股份有限公司、南宁百货大楼股份有限公司、宁波先锋新材料股份有限公司独立董事、宁波市注册税务师协会理事、宁波市注册会计师协会理事兼专业技术、后续教育委员会主任、宁波市鄞州区会计学会副会长；现任宁波地平线企业管理咨询有限公司董事长。

（二）监事简介

监事会主席 王国强：男，1954年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任宁波无线电二厂财务科副科长；现任宁波明昕微电子股份有限公司财务部经理。

监事 李东亚：女，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现在发行人财务部从事成本会计工作。

职工代表监事 陈永开：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。曾任鄞县华龙电子有限公司技术员；宁波华龙电子有限公司销售经理；现任宁波华龙电子股份有限公司销售经理。

（三）高级管理人员简介

总经理 陈亚龙：详见本章第一部分“董事简介”。

副总经理 陈孝龙：详见本章第一部分“董事简介”。

副总经理 陈永德：男，1956年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学

历。曾任宁波邱隘区机电站（后改为鄞县液压机械厂）车间主任、销售科长；现任华龙电子业务副总经理。

财务总监 戴家波：女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾在宁波厚生股份有限公司财务部担任会计稽核、成本控制工作；曾任宁波华龙有限财务部主办会计；现任宁波华龙电子股份有限公司财务总监。

董事会秘书 张秉：男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理经济师。曾任中日合资宁波 ALPS 电子有限公司平面研磨组组长、中国电子进出口宁波有限公司下属功放厂采购部部长；现任宁波华龙电子股份有限公司董事会秘书、副总经理。

（四）核心技术人员简介

陈孝龙 详见本章第一部分“董事简介”。

陈明明 男，1976 年出生，中国国籍，无境外居住权，北京大学高级研修班结业。曾任宁波华龙有限电镀技术员、宁波华龙电子股份有限公司电镀车间主任；现任公司电镀总工程师。

李靖 男，1976 年出生，中国国籍，无境外居住权，大学本科学历，中级职称。曾在安徽铜陵三佳山田模具股份有限公司从事 PLC 编程及设备调试工作、在铜陵丰山三佳微电子股份有限公司从事引线框架模具设计工作；现任宁波华龙电子股份有限公司技术部部长。

（五）公司董事、监事的提名和选聘情况

2011 年 10 月 12 日，发行人召开 2011 第三次临时股东大会，选举陈亚龙、张善国、石磊、陈召芬、陈孝龙、徐良龙、刘忠立、王建章、包新民为发行人第二届董事会董事，其中刘忠立、王建章、包新民为独立董事；选举王国强、李东亚、陈永开为第二届监事会监事，其中陈永开为职工监事。

公司现任董事、监事任期如下：

| 序号 | 姓名 | 董事/监事 | 任期 |
|----|-----|-------|-----------------|
| 1 | 陈亚龙 | 董事 | 2011.10-2014.10 |
| 2 | 张善国 | 董事 | 2011.10-2014.10 |
| 3 | 陈召芬 | 董事 | 2011.10-2014.10 |
| 4 | 陈孝龙 | 董事 | 2011.10-2014.10 |
| 5 | 石磊 | 董事 | 2011.10-2014.10 |
| 6 | 徐良龙 | 董事 | 2011.10-2014.10 |
| 7 | 刘忠立 | 独立董事 | 2011.10-2014.10 |
| 8 | 包新民 | 独立董事 | 2011.10-2014.10 |
| 9 | 王建章 | 独立董事 | 2011.10-2014.10 |

| | | | |
|----|-----|----|-----------------|
| 10 | 王国强 | 监事 | 2011.10-2014.10 |
| 11 | 李东亚 | 监事 | 2011.10-2014.10 |
| 12 | 陈永开 | 监事 | 2011.10-2014.10 |

二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接或间接持有本公司股份情况

(一)发行前董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接、间接持有发行人股份情况

1、直接持股情况

本公司董事长陈亚龙直接持有本公司13,515,806股股份，直接持股比例为18.02%，陈亚龙姐夫邬文通直接持有本公司4,948,802股股份，直接持股比例为6.60%。

2、间接持股情况

(1)通过铭龙投资间接持股

铭龙投资持有本公司9,978,713股股份，占公司发行前总股本的13.30%。

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员通过铭龙投资间接持有公司股份，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在铭龙投资中的持股情况如下表所示：

| 序号 | 股东名称 | 职务 | 出资额（元） | 直接持股比例（%） | 间接持股比例（%） |
|----|------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 陈亚龙 | 董事长、总经理 | 3,975,000 | 26.50 | 3.52 |
| 2 | 陈孝龙 | 董事、副总经理 | 2,200,000 | 14.67 | 1.95 |
| 3 | 徐良龙 | 董事 | 1,600,000 | 10.67 | 1.42 |
| 4 | 陈召芬 | 董事 | 1,000,000 | 6.67 | 0.89 |
| 5 | 张秉 | 董事会秘书、副总经理 | 1,000,000 | 6.67 | 0.89 |
| 6 | 陈永德 | 副总经理 | 250,000 | 1.67 | 0.22 |
| 7 | 陈永开 | 监事 | 150,000 | 1.00 | 0.13 |
| 8 | 李东亚 | 监事 | 100,000 | 0.67 | 0.09 |
| 9 | 陈明明 | 核心技术人员 | 150,000 | 1.00 | 0.13 |
| 10 | 戴家波 | 财务总监 | 100,000 | 0.67 | 0.09 |

除了上述间接持股情况外，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属在铭龙投资中的持股情况如下表所示：

| 序号 | 股东名称 | 身份 | 出资额（元） | 直接持股比例（%） | 间接持股比例（%） |
|----|------|--------|---------|-----------|-----------|
| 1 | 陈幼芬 | 陈召芬的妹妹 | 950,000 | 6.33 | 0.84 |
| 2 | 邬文通 | 陈亚龙的姐夫 | 250,000 | 1.67 | 0.22 |

(2) 通过明昕电子间接持股

明昕电子持有本公司20,288,100股股份，占公司发行前总股本的20.29%。

本公司董事张善国、监事王国强通过合泰科技间接持有明昕电子股权，从而间接持有本公司股权。合泰科技持有明昕电子7%股权，张善国持有合泰科技47.89%股权，王国强持有合泰科技5.35%股权。

除上述情况外，本次发行前，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属无其他直接或间接持有本公司股份的情况。

(二) 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属近三年所持股份的增减变动及质押、冻结情况

除陈亚龙外，本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属近三年所持股份未发生变动。陈亚龙所持铭龙投资股权近三年变动情况如下：

2010年6月25日，陈楠与陈亚龙签订股权转让协议，将其持有的铭龙投资1%股权转让给陈亚龙，转让后，陈亚龙持有铭龙投资22.50%的股权。

2010年9月2日，何仲辉与陈亚龙签订股权转让协议，将其持有的铭龙投资0.67%股权转让给陈亚龙，转让后，陈亚龙持有铭龙投资23.17%的股权。

2010年12月20日，王成名与陈亚龙签订股权转让协议，将其持有的铭龙投资3.33%股权转让给陈亚龙，转让后，陈亚龙持有铭龙投资26.50%的股权。

截至本招股说明书签署日，上述人员直接或间接持有的本公司股份不存在质押或冻结情况。

三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况

本公司董事、监事、高级管理人员、技术核心人员对外投资情况如下：

| 姓名 | 在本公司职务 | 对外投资企业 | 出资额 (万元) | 持股比例 (%) | 与发行人是否存在利益冲突 |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 陈亚龙 | 董事长、 总经理 | 铭龙投资 | 397.50 | 26.50 | 否 |
| 陈孝龙 | 董事、 副总经理 | 铭龙投资 | 220.00 | 14.67 | 否 |
| 徐良龙 | 董事 | 铭龙投资 | 160.00 | 10.67 | 否 |
| 陈召芬 | 董事 | 深圳市云天投资有限公司 | 50.00 | 4.76 | 否 |
| | | 铭龙投资 | 100.00 | 6.67 | 否 |

| | | | | | |
|-----|------------|-------------------|--------|-------|---|
| 石磊 | 董事 | 南通华达微电子集团有限公司 | 78.94 | 3.95 | 否 |
| | | 北京达博有色金属焊料有限责任公司 | 358.00 | 10.40 | 否 |
| | | 江苏中鹏新材料股份有限公司 | 200.00 | 4.76 | 否 |
| 张善国 | 董事 | 宁波市科技园区合泰科技投资有限公司 | 295.00 | 43.25 | 否 |
| 王国强 | 监事 | 宁波市科技园区合泰科技投资有限公司 | 33.00 | 4.84 | 否 |
| 张秉 | 董事会秘书、副总经理 | 铭龙投资 | 100.00 | 6.67 | 否 |
| 陈永德 | 副总经理 | 铭龙投资 | 25.00 | 1.67 | 否 |
| 陈永开 | 监事 | 铭龙投资 | 15.00 | 1.00 | 否 |
| 李东亚 | 监事 | 铭龙投资 | 10.00 | 0.67 | 否 |
| 陈明明 | 核心技术人员 | 铭龙投资 | 15.00 | 1.00 | 否 |
| 戴家波 | 财务总监 | 铭龙投资 | 10.00 | 0.67 | 否 |

除上述情况外，截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他的对外投资情况。

四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬安排

本公司董事、监事、高级管理人员、技术核心人员2011年从本公司领取的税前收入情况如下：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 2011年从发行人处 领取收入（万元） | 备注 |
|----|-----|------------|------------------------|----------|
| 1 | 陈亚龙 | 董事长兼总经理 | 30 | |
| 2 | 张善国 | 副董事长 | -- | 未在发行人处领薪 |
| 3 | 陈召芬 | 董事兼财务 | 12 | |
| 4 | 陈孝龙 | 董事兼副总经理 | 20 | |
| 5 | 石磊 | 董事 | -- | 未在发行人处领薪 |
| 6 | 徐良龙 | 董事兼办公室主任 | 12 | |
| 7 | 刘忠立 | 独立董事 | 3.6 | |
| 8 | 包新民 | 独立董事 | 3.6 | |
| 9 | 王建章 | 独立董事 | 3.6 | |
| 10 | 王国强 | 监事会主席 | -- | 未在发行人处领薪 |
| 11 | 李东亚 | 监事 | 3.6 | |
| 12 | 陈永开 | 监事 | 12 | |
| 13 | 陈永德 | 副总经理 | 16 | |
| 14 | 马耀楣 | 原副总经理 | 12 | |
| 15 | 戴家波 | 财务总监 | 12 | |
| 16 | 张秉 | 董事会秘书、副总经理 | 12 | |
| 17 | 陈明明 | 电镀总工程师 | 16 | |
| 18 | 李靖 | 技术部部长 | 15 | |

张善国和王国强均在在公司关联方明昕电子领薪，2011年分别从明昕电子领取收入30万元和7.2万元；石磊在公司关联方通富微电领薪，2011年其从通富微电领取收入80.79万元。

公司按照国家和地方的有关规定，依法办理失业、养老、医疗、工伤等保险，目前不存在其它特殊待遇和退休金计划。

五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他任职情况

本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在其他单位任职情况如下表所示：

| 姓名 | 现任本公司职务 | 其他任职情况 | 兼职单位与本公司关系 |
|-----|---------|--|--------------------------------------|
| 张善国 | 董事 | 宁波明昕微电子股份有限公司总经理 | 股东 |
| 石磊 | 董事 | 南通华达微电子集团有限公司董事 南通富士通微电子股份有限公司董事、总经理 南通金茂电子科技有限公司董事长 南通尚明精密模具有限公司董事长 南通金泰科技有限公司董事长 北京达博有色金属焊料有限责任公司董事长 江苏中鹏新材料股份有限公司董事 香港海耀实业有限公司董事 无锡通芝电子有限公司董事 | 南通华达为本公司股东，通富微电为本公司关联方，其他兼职单位与本公司无关系 |
| 王国强 | 监事 | 宁波明昕微电子股份有限公司财务部经理 | 股东 |
| 刘忠立 | 独立董事 | 中国科学院半导体研究所研究员、课题组长、室主任 | 无关联关系 |
| 包新民 | 独立董事 | 宁波地平线企业管理咨询有限公司董事长 | 无关联关系 |

本公司其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未有在其他法人单位任职的情况。

六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间存在的亲属关系

本公司董事陈亚龙与董事陈召芬为夫妻关系，陈亚龙与董事陈孝龙为兄弟关系，董事张善国与董事会秘书张秉为父子关系，陈亚龙与董事徐良龙为表兄弟关系，副总经理陈永德与陈亚龙为堂兄弟关系。

七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员与本公司的协议安排

本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与本公司签有《劳动合同》，合同对上述人员的诚信义务，特别是知识产权和商业秘密方面的义务作了详细规定。

同时，本公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签有《商业秘密保密及竞业禁止协议书》，合同对上述人员在保密内容及范围和竞业禁止方面作了详细定义和规定。

八、董事、监事、高级管理人员任职资格

本公司董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不存在下列情形：

- (1) 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；
- (2) 最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责；
- (3) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

九、公司董事、监事、高级管理人员在近三年内变动情况

(一) 董事的变化

1、2008年10月15日，发行人召开发起人会议暨第一次股东大会，选举陈亚龙、张善国、石磊、陈召芬、陈孝龙、徐良龙、刘忠立、王建章、包新民为发行人第一届董事会董事，其中刘忠立、王建章、包新民为独立董事。

2、2011年10月12日，发行人召开2011第三次临时股东大会，选举陈亚龙、张善国、石磊、陈召芬、陈孝龙、徐良龙、刘忠立、王建章、包新民为发行人第二届董事会董事，其中刘忠立、王建章、包新民为独立董事。

(二) 监事的变化

1、2008年10月15日，发行人召开发起人会议暨第一次股东大会，选举戴家波、王国强为公司监事，与职工代表监事吴太湖共同组成第一届监事会。

2、2009年11月30日，发行人召开2009年第二次临时股东大会，同意戴家波辞去公司第一届监事会监事及监事会主席，选举邬佩娜为第一届监事会监事。

3、2011年10月12日，发行人召开2011第三次临时股东大会，选举王国强、李东亚为公司非职工监事，与职工监事陈永开组成第二届监事会。

（三）高级管理人员的变化

1、2008年10月15日，发行人一届一次董事会决定聘任陈亚龙为总经理，聘任张秉为董事会秘书，聘任钟征远为财务总监，聘任陈孝龙、周锋、陈永德为副总经理。

2、2009年4月7日，钟征远因个人原因提出辞职请求，辞去财务总监职务。

3、2009年11月28日，周锋因个人原因提出辞职请求，辞去副总经理职务。

4、2009年12月15日，发行人第一届董事会第八次会议决定聘任戴家波为公司财务总监，聘任马耀楣为公司副总经理。

5、2011年10月12日，发行人二届一次董事会决定聘任陈亚龙为总经理，聘任张秉为董事会秘书兼副总经理，聘任戴家波为财务总监，聘任陈孝龙、马耀楣、陈永德为副总经理。

6、2011年12月28日，马耀楣因退休提出辞职请求，辞去副总经理职务，现在泰州华龙担任工程师。

第九章 公司治理结构

公司建立、健全了法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和高级管理人员相互协调，相互制衡，独立董事、董事会秘书勤勉尽责，有效地增强了决策的公正性和科学性，确保了公司依法管理、规范运作。

一、股东大会相关制度建立健全及运行情况

2008年10月15日，本公司召开创立大会暨第一次股东大会选举产生了第一届董事会和监事会，并审议通过了《公司章程》和《股东大会议事规则》对股东的权利及义务进行了明确约定。

《公司章程》规定：公司股东享有下列权利：1) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；2) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；3) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；4) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；5) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；6) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；7) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；8) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其它权利。

同时公司股东需承担下列义务：1) 遵守法律、行政法规和本章程；2) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；3) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；4) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；5) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

《公司章程》规定：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：1) 决定公司经营方针和投资计划；2) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3) 审议批准董事会的报告；4) 审议批准监事会的报告；5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；8)

对发行公司债券作出决议；9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；10) 修改公司章程；11) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；12) 审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项；13) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；14) 审议批准变更募集资金用途事项；15) 审议股权激励计划；16) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

本公司还依据《公司法》、《公司章程》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定。

公司历次股东大会均按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开、表决，决议，会议记录规范。股东大会对公司的投资计划、章程修订、董事和监事的选举、利润分配方案、公司重要规章制度制定和修改、首次公开发行股票等重大事宜的决策作出了有效决议。

二、董事会建立健全及运行情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人。2008 年 10 月 15 日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《董事会议事规则》，对董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。本公司董事会设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。其中提名、薪酬与考核委员会、审计委员会独立董事占多数并担任主任委员，目前审计委员会中独立董事包新民为会计专业人士。

(一) 董事会

董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 $\frac{1}{2}$ 。

董事会行使下列职权：1) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；2) 执行股东大会的决议；3) 决定公司的经营计划和投资方案；4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；7) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；8) 在股

东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；9）决定公司内部管理机构的设置；10）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；11）制订公司的基本管理制度；12）制订公司章程的修改方案；13）管理公司信息披露事项；14）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；15）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；16）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

公司历次董事会均按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定的程序召集、召开、表决，决议，会议记录规范。除审议日常事项外，在高级管理人员聘任、投资事项、一般性规章制度的制定等方面切实发挥了作用。

（二）董事会专门委员会

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会等专门委员会，委员由董事会从董事中选举产生，分别负责公司的发展战略、审计和财务、董事及高级管理人员的提名与薪酬设计、绩效考核等工作。

1、战略委员会

2009年12月25日，公司召开第一届董事会第八次会议，通过董事会战略委员会委员组成的议案。公司第一届董事会战略委员会由三人组成，分别为公司董事长陈亚龙、董事张善国以及独立董事包新民组成，其中陈亚龙担任召集人。

公司战略委员会主要职责为：（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（2）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（3）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（5）对以上事项的实施进行检查；（6）董事会授权的其他事宜。

2、审计委员会

2009年12月25日，公司召开第一届董事会第八次会议，通过董事会审计委员会委员组成的议案。公司第一届董事会审计委员会由公司独立董事包新民、刘忠立和董事陈孝龙组成，其中包新民担任召集人。

公司审计委员会的主要职责为：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司内控制度,对重大关联交易进

行审计；（6）公司董事会授予的其他事宜。

3、提名委员会

2009年12月25日，公司召开第一届董事会第八次会议，通过董事会提名与薪酬考核委员会委员组成的议案。公司第一届董事会提名委员会由公司独立董事包新民、刘忠立及董事长陈亚龙组成。

公司提名与薪酬考核委员会的主要职责为：（1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（2）研究董事、总经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（3）广泛搜寻合格的董事、总经理人员的人选；（4）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；（5）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；（6）董事会授权的其他事宜。

4、薪酬考核委员会

2009年12月25日，公司召开第一届董事会第八次会议，通过董事会薪酬考核委员会组成的议案。公司第一届薪酬考核委员会由独立董事王建章、刘忠立及董事徐良龙组成。

薪酬考核委员会的主要职责为：（1）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（2）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（3）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（4）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（5）董事会授权的其他事宜。

（三）董事会秘书

经公司2011年10月12日二届一次董事会审议，聘任张秉担任公司董事会秘书。公司2009年11月13日第一届第七次董事会审议通过了《董事会秘书工作制度》，对董事会秘书的权利、职责进行了明确约定。

董事会秘书是公司高级管理人员，公司董事会秘书承担法律、行政法规以及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，也享有相应的工作职权，对公司治理有着重要作用，促进了公司的规范运作。公司董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。根据《公司章程》规定，本公司董事会设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

董事会秘书的主要职责是：

(1) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

(2) 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

(3) 组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

(4) 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；

(5) 关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复证券交易所所有问询；

(6) 组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规等其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

(7) 督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向证券交易所报告；

(8) 《公司法》、《证券法》、中国证监会、证券交易所及《公司章程》要求履行的其他职责。

(四) 独立董事

根据《公司章程》规定，本公司董事会设 3 名独立董事。经 2008 年 10 月 17 日公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《独立董事制度》对独立董事任职资格、选聘、任期、职权、独立意见发表等作了详细规定。同时，公司聘任王建章、刘忠立和包新民担任第二届董事会独立董事。

独立董事发挥作用的制度安排如下：

1、独立董事的特别职权

根据《公司章程》和《独立董事工作制度》规定，独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还应赋予独立董事以下特别职权：

(1) 重大关联交易（系指在连续十二个月内与同一关联人的关联交易金额在 300 万元以上，或占公司最近一期经审计资产绝对值 5%以上的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构

出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

- (2) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
- (3) 向董事会提请召开临时股东大会；
- (4) 提议召开董事会；
- (5) 独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2、独立董事发表独立意见

独立董事除行使上述职权外，还应就以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

- (1) 提名、任免董事；
- (2) 聘任或解聘高级管理人员；
- (3) 公司董事、高级管理人员的薪酬；

(4) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

- (5) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
- (6) 证券监管部门、证券交易所要求独立董事发表意见的事项。

如有关事项属于披露事项，公司应将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

独立董事制度的建立进一步完善了本公司的法人治理结构，为保护股东利益，科学决策等方面提供了制度保障。自公司建立独立董事制度以来，独立董事严格按照《公司章程》的相关规定，履行职责，积极参与公司的重大生产经营决策，对公司经营管理、发展战略的选择发挥了积极作用

三、监事会建立健全及运行情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，不设副主席。监事会应当包括二名股东代表和一名职工代表。监事每届任期3年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会行使下列职权：1) 检查公司的财务；2) 对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时的行为进行监督；3) 当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；4) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行本章程规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东会

议；5) 向股东大会提出提案；6) 依照公司法第 152 条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；7) 股东大会授予的其他职权。

本公司还依据《公司法》、《公司章程》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定。2008 年 10 月 15 日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《监事会议事规则》，对监事会的职权、工作程序、议事规则等进行了细化，有效地保证了监事会的规范运行。

公司历次监事会的召集、召开均遵守了《公司章程》和《监事会议事规则》规定，公司监事会对董事会的决策程序、公司董事、高管履行职责情况进行了有效监督，在检查公司财务、审查关联交易等方面发挥了重要作用。

四、公司重大生产经营决策程序与规则

公司重大生产经营的决策程序和规则主要依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大事项处置制度》和《关联交易公允决策制度》的规定进行。

(一) 对外交易、投资

对外交易、投资指包括不限于资产收购、转让、股权投资、新建及改扩建项目投资。公司就同一项目分次进行的,按照十二个月内投资额累计计算。

达到下列权限标准的对外交易、投资事宜由公司股东大会决定:

(1) 对外交易、投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30% 以上,该交易、投资涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据;

(2) 对外交易、投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 30% 以上,且绝对金额超过 3000 万元;

(3) 对外交易、投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30% 以上,且绝对金额超过 300 万元;

(4) 对外交易、投资的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 30% 以上,且绝对金额超过 3000 万元;

(5) 对外交易、投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30% 以上,且绝对金额超过 300 万元;

达到下列权限标准且未达到公司股东大会权限标准的对外交易、投资事宜由

公司董事会决定：

(1) 对外交易、投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

(2) 对外交易、投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10% 以上，且绝对金额超过 1000 万元；

(3) 对外交易、投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元；

(4) 对外交易、投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，且绝对金额超过 1000 万元；

(5) 对外交易、投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。未达到公司董事会权限标准的对外交易、投资事宜由公司总经理决定，并报董事会备案。

（二）银行借款

(1) 年度累计净余额在 5000 万元以上或单笔金额在 1000 万元以上的银行借款由股东大会决定；

(2) 未达到上述股东大会权限标准且单笔金额在 300 万元以上的银行借款由董事会决定；

(3) 未达到上述董事会权限标准的银行借款由总经理决定，并报董事会备案，但贷款银行要求公司董事会作出借款决议的除外。

（三）担保

1、达到下列标准的担保事宜由公司股东大会决定：

(1) 公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；

(2) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；

(3) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；

(4) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；

(5) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

未达到上述标准的担保事宜由公司董事会决定。对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的 $\frac{2}{3}$ 以上董事同意；上述第 2 项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上通过。

2、公司或控股子公司原则上不提供两者之间以外的对外担保，如为业务需要提供对外互保，须经上述第(1)项规定的程序批准。

(四) 购买、出售资产

公司发生“购买或者出售资产”交易，不论交易标的是否相关，若所涉及的资产总额或者成交金额在连续 12 个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上通过。

资产买卖行为须达到优化资产结构，实现发展战略的目标。

未达到上述标准的资产收购与出售须经董事会审议批准。

(五) 委托理财

公司委托理财所使用的资金仅限于除公司在证券市场公开募集的资金之外的自有资金。

年度累计净余额在 1000 万元以上的委托理财事宜由公司股东大会决定，年度累计净余额少于 1000 万元的事宜由公司董事会决定。

(六) 派出或提名董事、监事

对注册资本在 500 万元以上的控股子公司或参股公司，其派出或提名董事、监事事宜，由董事会按该公司章程规定决定；不超过 500 万元的由总经理决定，并报董事会备案。

五、公司的规范运作情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。公司在公司章程中对股东大会、董事会、监事会的议事规则作出了专门和具体的规定。公司历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。公司股东大会和董事会历次授权或重大决策

等行为合法、合规、真实、有效。

公司在经营过程中，未曾出现被相关主管机关处罚的情况。

公司近三年不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用的情况。

报告期内公司曾经为明昕电子提供担保，具体情况如下：

2007年9月1日，华龙有限与中国工商银行宁波市东门支行签订了“2007年保限031号”《最高额保证合同》，华龙有限为明昕电子与中国工商银行宁波东门支行发生的借款提供最高授信额度为1亿元的保证担保，担保期限为2007年9月1日至2012年9月1日。华龙有限整体变更为股份公司后，发行人与中国工商银行宁波市东门支行重新签订了“2008年东门保字0098号”《最高额保证合同》，担保期限为2007年9月1日至2012年9月1日。

2010年3月4日，中国工商银行宁波市东门支行出具“甬A00017832号”《资信证明书》，证实上述“2008年东门保字0098号”《最高额保证合同》已于2010年2月8日取消。

除了上述为明昕电子提供担保外，报告期内公司不存在其他为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

六、公司关联交易制度、保护投资者权益的政策安排

（一）关联交易制度

为了规范公司的关联交易行为，公司制订了《关联交易公允决策制度》，以确保公司的关联交易行为不损害公司和股东利益。

公司关联交易决策权限为：

1、股东大会：公司与其关联法人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上的，关联交易在获得公司股东大会批准后实施；公司与其关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上的关联交易在获得公司股东大会批准后实施。

2、公司与其关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%以上的，且尚未达到本条第（一）项标准的，关联交易在获得公司董事会批准后实施；公司与其关联自然人发生的交易金额超过 30 万元且不足 300 万元的关联交易在获得公司董事会批准后实施。

公司董事会审议关联交易时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

公司应及时披露的内容包括：

1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（公司提供担保除外），应当及时披露。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

2、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），应当及时披露。

3、公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当按照相关规定，聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估，并将该交易提交股东大会审议。

4、本公司就关联交易进行披露应当包括但不限于以下内容：

- （1）交易日期、交易地点；
- （2）有关各方的关联关系；
- （3）有关交易及其目的的简要说明；
- （4）交易的标的、价格及定价政策；
- （5）关联人在交易中所占权益的性质及比重；
- （6）关联交易涉及收购或者出售某一公司权益的，应当说明该公司的实际持有人的详细情况，包括实际持有人的名称及其业务状况；
- （7）董事会关于本次关联交易对本公司影响的意见；
- （8）监事会关于关联交易表决程序及公平性的意见；
- （9）有关监管部门要求的其它内容。

5、本公司与关联人就同一标的在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额达到应及时披露所述条件的，本公司按规定予以披露。

（二）保护投资者权益政策

发行人重视保护投资者特别是中小投资者的权益，通过制订《宁波华龙电子股份有限公司信息披露事务管理制度》、《宁波华龙电子股份有限公司投资者关系管理制度》等相关公司治理文件，有利地保障了投资者的信息获取、收益享有、

参与公司重大决策和选择管理者的权利，相关内容如下：

1、信息披露

公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，制订信息披露管理办法及信息披露内部工作制度，真实、准确、完整、及时地披露信息。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。

2、投资者沟通

公司董事会秘书负责投资者关系工作。公司可以视需要采取以下方式与投资者交流：公告，包括定期报告和临时报告；股东大会；公司网站；分析师会议或说明会；一对一沟通；邮寄资料；电话咨询；广告、宣传单或其他宣传材料；媒体采访和报道；现场参观；路演。

七、公司内部控制制度

（一）公司内部控制的有关情况

1、控制环境

本公司按照建立现代企业制度的要求，为了进一步规范公司股东大会、董事会、监事会和经理层的议事方式和决策程序，促使股东、董事会、监事会和经理层有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关监管部门要求及《宁波华龙电子股份有限公司章程》规定，在完善经营机制、强化经营管理的同时制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》。

2、会计系统

公司已按《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规及其补充规定的要求制定了适应本公司业务特点的会计制度和财务管理制度，并明确制订了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，财务人员岗位、职责控制。会计与出纳分设，会计原始凭证由财务经理审核；会计报表经财务经理复核后经财务总监、总经理审批报出。

3、控制程序

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独

立稽查控制、电子信息系统控制等。

同时公司相继通过了《内部控制规范—货币资金》、《内部控制制度—筹资》、《内部控制制度—对外投资》、《内部控制制度—固定资产》、《内部控制制度—销售》、《内部控制制度—销售退回》、《内部控制制度—存货》、《付款审批制度》、《经费支付管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易公允决策制度》、《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》，进一步完善了公司治理结构。

（二）公司管理层的自我评估意见

本公司董事会认为，公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

随着本公司的不断发展，业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的提高，以及内部控制具有固有的限制，难免存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，目前的内部控制制度将随着情况变化和执行中发现的问题，需要不断改正、充实和完善。

（三）会计师的鉴证意见

根据信永中和出具的 XYZH/2011SHA1003-1《内部控制审核报告》认为：“华龙电子公司按照财政部有关内部控制的规定所设定的标准于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。”

第十章 财务会计信息

信永中和会计师事务所审计了本公司 2009 年 12 月 31 日、2010 年 12 月 31 日及 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2009、2010 及 2011 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表，出具了标准无保留意见的“XYZH/2011SHA1003《审计报告》”。

以下引用的财务会计信息，非经特别说明，均引自经信永中和审计的公司财务会计报表。本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司近三年经审计的会计报表及有关附注的重要内容，投资者若欲详细了解本公司近三年的财务会计信息，请阅读本招股说明书备查文件“财务报表及审计报告”。

一、近三年经审计的财务报表主要数据

(一) 合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

| 项 目 | 2011 年 12 月 31 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 2009 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 4,586.83 | 4,365.58 | 3,527.02 |
| 交易性金融资产 | - | -- | - |
| 应收票据 | 1,912.09 | 899.54 | 1,820.68 |
| 应收账款 | 12,768.59 | 13,475.41 | 9,314.03 |
| 预付款项 | 256.89 | 304.79 | 101.12 |
| 其他应收款 | 350.27 | 635.09 | 602.98 |
| 存货 | 10,920.46 | 7,991.35 | 4,769.33 |
| 流动资产合计 | 30,795.12 | 27,671.76 | 20,135.16 |
| 非流动资产： | | | |
| 固定资产 | 12,989.97 | 13,173.96 | 7,485.08 |
| 在建工程 | 848.71 | 40.32 | 669.54 |
| 无形资产 | 6,121.96 | 3,154.97 | 3,020.99 |
| 开发支出 | - | - | 127.19 |
| 长期待摊费用 | 765.08 | 795.37 | 589.40 |
| 递延所得税资产 | 307.47 | 230.14 | 103.20 |
| 非流动资产合计 | 21,033.19 | 17,394.76 | 11,995.40 |
| 资产总计 | 51,828.31 | 45,066.53 | 32,130.56 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 15,560.00 | 9,210.00 | 5,360.00 |
| 应付票据 | 6,475.24 | 6,900.00 | 5,100.00 |
| 应付账款 | 7,100.53 | 8,556.52 | 5,172.61 |
| 预收款项 | 117.45 | 126.68 | 96.21 |
| 应付职工薪酬 | - | 28.58 | - |

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 应交税费 | -29.79 | 228.47 | 208.83 |
| 应付股利 | - | | |
| 其他应付款 | 1,281.84 | 1,879.03 | 1,868.28 |
| 流动负债小计 | 30,505.27 | 26,929.29 | 17,805.93 |
| 非流动负债: | | - | - |
| 其他非流动负债 | 548.15 | 607.01 | 49.20 |
| 非流动负债小计 | 548.15 | 607.01 | 49.20 |
| 负债合计 | 31,053.42 | 27,536.30 | 17,855.13 |
| 股东权益: | | - | - |
| 股本 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 资本公积 | 3,097.90 | 3,097.90 | 3,097.90 |
| 盈余公积 | 1,753.63 | 1,429.16 | 1,103.68 |
| 未分配利润 | 8,423.37 | 5,503.16 | 2,573.85 |
| 归属于母公司股东权益小计 | 20,774.89 | 17,530.22 | 14,275.43 |
| 股东权益合计 | 20,774.89 | 17,530.22 | 14,275.43 |
| 负债和股东权益总计 | 51,828.31 | 45,066.53 | 32,130.56 |

2、合并利润表

单位：万元

| 项 目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 2009 年度 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 一、营业总收入 | 52,048.46 | 50,096.76 | 32,390.82 |
| 其中:营业收入 | 52,048.46 | 50,096.76 | 32,390.82 |
| 二、营业总成本 | 49,030.02 | 46,529.16 | 29,482.04 |
| 其中: 营业成本 | 42,514.34 | 41,452.12 | 26,763.61 |
| 营业税金及附加 | 165.16 | 52.58 | 17.94 |
| 销售费用 | 240.16 | 201.43 | 134.47 |
| 管理费用 | 4,237.85 | 3,666.61 | 2,170.07 |
| 财务费用 | 1,781.50 | 911.93 | 376.57 |
| 资产减值损失 | 91.01 | 244.50 | 19.38 |
| 加: 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 8.37 |
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
| 三、营业利润 | 3,018.43 | 3,567.60 | 2,918.70 |
| 加: 营业外收入 | 665.54 | 233.60 | 258.89 |
| 减: 营业外支出 | 52.94 | 6.50 | 17.09 |
| 四、利润总额 | 3,631.03 | 3,794.70 | 3,160.51 |
| 减: 所得税费用 | 386.36 | 539.91 | 433.63 |
| 五、净利润 | 3,244.67 | 3,254.79 | 2,726.88 |
| 其中:归属于母公司股东的净利润 | 3,244.67 | 3,254.79 | 2,726.88 |

3、合并现金流量表

单位：万元

| 项 目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 2009 年度 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,760.78 | 51,382.76 | 28,046.67 |

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 收到的税费返还 | - | 189.61 | 133.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,222.24 | 2,312.79 | 1,753.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,983.01 | 53,885.16 | 29,933.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,368.52 | 41,436.64 | 21,919.44 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,516.77 | 3,151.25 | 1,902.51 |
| 支付的各项税费 | 2,181.05 | 1,678.61 | 1,078.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,499.50 | 2,609.62 | 2,344.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,565.84 | 48,876.11 | 27,244.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 417.18 | 5,009.04 | 2,689.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 收回投资收到的现金 | - | 120.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 1.34 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 11.77 | 9.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 133.11 | 9.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,674.53 | 6,959.49 | 1,912.38 |
| 投资支付的现金 | - | 0.00 | 100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,674.53 | 6,959.49 | 2,012.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,674.53 | -6,826.39 | -2,002.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 20,310.00 | 9,660.00 | 6,360.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,310.00 | 9,660.00 | 6,360.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,960.00 | 5,810.00 | 6,360.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 776.40 | 383.10 | 300.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,736.40 | 6,193.10 | 6,660.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,573.60 | 3,466.90 | -300.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.38 | -1.00 | -0.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -676.38 | 1,648.56 | 385.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,055.58 | 2,407.02 | 2,021.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,379.21 | 4,055.58 | 2,407.02 |

4、合并股东权益变动表

单位：万元

| 项目 | 2011 年度 归属于母公司股东权益 | | | | 小计 | 股东权益合计 |
|----------------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年年末余额 | 7,500.00 | 3,097.90 | 1,429.16 | 5,503.16 | 17,530.22 | 17,530.22 |
| 二、本年初余额 | 7,500.00 | 3,097.90 | 1,429.16 | 5,503.16 | 17,530.22 | 17,530.22 |
| 三、本年增减变动金额(减少以 | | | 324.47 | 2,920.20 | 3,244.67 | 3,244.67 |

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| "-"号填列) | | | | | | |
| (一)净利润 | | | | 3,244.67 | 3,244.67 | 3,244.67 |
| (二)利润分配 | | | 324.47 | -324.47 | | |
| 提取盈余公积 | | | 324.47 | -324.47 | | |
| 四、本年年末余额 | 7,500.00 | 3,097.90 | 1,753.63 | 8,423.36 | 20,774.89 | 20,774.89 |

单位：万元

| 项目 | 2010 年度 | | | | | 小计 | 股东权益合计 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|--------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 归属于母公司股东权益 | | |
| 一、上年年末余额 | 7,500.00 | 3,097.90 | 1,103.68 | 2,573.85 | 14,275.43 | 14,275.43 | |
| 二、本年初余额 | 7,500.00 | 3,097.90 | 1,103.68 | 2,573.85 | 14,275.43 | 14,275.43 | |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | | | 325.48 | 2,929.31 | 3,254.79 | 3,254.79 | |
| (一)净利润 | | | | 3,254.79 | 3,254.79 | 3,254.79 | |
| (二)利润分配 | | | 325.48 | -325.48 | | | |
| 提取盈余公积 | | | 325.48 | -325.48 | | | |
| 四、本年年末余额 | 7,500.00 | 3,097.90 | 1,429.16 | 5,503.16 | 17,530.22 | 17,530.22 | |

单位：万元

| 项目 | 2009 年度 | | | | | 小计 | 股东权益合计 |
|-----------------------|----------|----------|--------|----------|------------|-----------|--------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 归属于母公司股东权益 | | |
| 一、上年年末余额 | 7,500.00 | 3,097.90 | 828.53 | 122.13 | 11,548.55 | 11,548.55 | |
| 二、本年初余额 | 7,500.00 | 3,097.90 | 828.53 | 122.13 | 11,548.55 | 11,548.55 | |
| 三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) | | | 275.16 | 2,451.72 | 2,726.88 | 2,726.88 | |

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| (一) 净利润 | | | | | | |
| 润 | | | | 2,726.88 | 2,726.88 | 2,726.88 |
| (二) 利润分配 | | | | | | |
| 提取 | | | | | | |
| 盈余公积 | 275.16 | | | -275.16 | | |
| 四、本年年末余额 | 7,500.00 | 3,097.90 | 1,103.68 | 2,573.85 | 14,275.43 | 14,275.43 |

(二) 母公司财务报表

1、资产负债表

单位：万元

| 项 目 | 2011 年 12 月 31 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 2009 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 4,279.82 | 4,214.35 | 3,352.67 |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 1,912.09 | 899.54 | 1,820.68 |
| 应收账款 | 13,022.25 | 14,005.58 | 9,314.03 |
| 预付款项 | 183.75 | 29.91 | 101.12 |
| 其他应收款 | 473.54 | 592.63 | 602.98 |
| 存货 | 8,827.59 | 6,793.08 | 4,769.33 |
| 流动资产合计 | 28,699.04 | 26,535.09 | 19,960.80 |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 5,100.00 | 5,100.00 | 1,462.00 |
| 固定资产 | 7,564.52 | 7,915.35 | 7,485.08 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 无形资产 | 3,969.18 | 955.16 | 780.33 |
| 开发支出 | - | - | 127.19 |
| 长期待摊费用 | 757.06 | 776.26 | 589.40 |
| 递延所得税资产 | 243.49 | 230.14 | 103.20 |
| 非流动资产合计 | 17,634.25 | 14,976.91 | 10,547.20 |
| 资产总计 | 46,333.29 | 41,512.00 | 30,508.01 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 14,560.00 | 9,210.00 | 5,360.00 |
| 应付票据 | 6,475.24 | 6,900.00 | 5,100.00 |
| 应付账款 | 3,099.16 | 6,135.26 | 5,172.61 |
| 预收款项 | 117.45 | 126.68 | 96.21 |
| 应付职工薪酬 | - | - | - |
| 应交税费 | 417.58 | 549.19 | 208.83 |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 4.46 | 50.26 | 219.07 |
| 流动负债小计 | 24,673.88 | 22,971.40 | 16,156.72 |
| 非流动负债： | | | |
| 其他非流动负债 | 548.15 | 607.01 | 49.20 |
| 非流动负债小计 | 548.15 | 607.01 | 49.20 |
| 负债合计 | 25,222.03 | 23,578.41 | 16,205.92 |
| 股东权益： | | | |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 股本 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 资本公积 | 3,097.90 | 3,097.90 | 3,097.90 |
| 盈余公积 | 1,784.60 | 1,466.83 | 1,103.68 |
| 未分配利润 | 8,728.76 | 5,868.85 | 2,600.50 |
| 股东权益合计 | 21,111.25 | 17,933.59 | 14,302.08 |
| 负债和股东权益总计 | 46,333.29 | 41,512.00 | 30,508.01 |

2、利润表

单位：万元

| 项 目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 2009 年度 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | 53,063.75 | 50,343.94 | 32,390.82 |
| 减：营业成本 | 44,102.44 | 41,682.85 | 26,763.61 |
| 营业税金及附加 | 165.16 | 52.58 | 17.94 |
| 销售费用 | 201.51 | 189.04 | 134.47 |
| 管理费用 | 3,767.90 | 3,319.69 | 2,145.33 |
| 财务费用 | 1,730.24 | 910.99 | 376.64 |
| 资产减值损失 | 83.47 | 244.50 | 19.38 |
| 加：公允价值变动收益 | - | - | 8.37 |
| 投资收益 | - | - | 1.56 |
| 二、营业利润 | 3,013.03 | 3,944.28 | 2,943.38 |
| 加：营业外收入 | 663.54 | 233.60 | 258.89 |
| 减：营业外支出 | 48.57 | 6.50 | 17.09 |
| 三、利润总额 | 3,628.00 | 4,171.38 | 3,185.18 |
| 减：所得税费用 | 450.33 | 539.88 | 433.63 |
| 四、净利润 | 3,177.67 | 3,631.50 | 2,751.55 |
| 五、其他综合收益 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 3,177.67 | 3,631.50 | 2,751.55 |

3、现金流量表

单位：万元

| 项 目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 2009 年度 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,394.04 | 50,510.60 | 28,046.67 |
| 收到的税费返还 | - | 189.61 | 133.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,462.11 | 2,615.20 | 1,733.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,856.15 | 53,315.41 | 29,913.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,725.29 | 41,816.16 | 21,919.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,786.94 | 2,930.88 | 1,902.51 |
| 支付的各项税费 | 2,106.08 | 1,597.35 | 1,078.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,862.06 | 2,938.38 | 2,462.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,480.36 | 49,282.76 | 27,362.16 |

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -624.21 | 4,032.65 | 2,551.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 120.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 1.34 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 11.77 | 9.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 133.11 | 9.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他、长期资产支付的现金 | 4,828.83 | 2,322.97 | 1,796.06 |
| 投资支付的现金 | - | 3,638.00 | 250.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,828.83 | 5,960.97 | 2,046.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,828.83 | -5,827.86 | -2,036.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 19,310.00 | 9,660.00 | 6,360.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,310.00 | 9,660.00 | 6,360.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,960.00 | 5,810.00 | 6,360.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 737.47 | 383.10 | 300.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,697.47 | 6,193.10 | 6,660.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,612.53 | 3,466.90 | -300.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.35 | -0.01 | -0.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -832.15 | 1,671.68 | 213.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,904.35 | 2,232.67 | 2,018.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,072.20 | 3,904.35 | 2,232.67 |

4、股东权益变动表

单位：万元

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 2011 年度 | | 股东权益合计 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | | 盈余公积 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 7,500.00 | 3,097.90 | 1,466.83 | 5,868.85 | 17,933.59 |
| 二、本年初余额 | 7,500.00 | 3,097.90 | 1,466.83 | 5,868.85 | 17,933.59 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | 317.77 | 2,859.90 | 3,177.67 |
| （一）净利润 | | | | 3,177.67 | 3,177.67 |

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| (二) 利润分配 | | | 317.77 | -317.77 | |
| 提取盈余公积 | | | 317.77 | -317.77 | |
| 四、本年年末余额 | 7,500.00 | 3,097.90 | 1,784.60 | 8,728.76 | 21,111.25 |

单位：万元

| 项目 | 2010 年度 | | | | 股东权益合计 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 7,500.00 | 3,097.90 | 1,103.68 | 2,600.50 | 14,302.08 |
| 二、本年初余额 | 7,500.00 | 3,097.90 | 1,103.68 | 2,600.50 | 14,302.08 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | 363.15 | 3,268.35 | 3,631.50 |
| (一) 净利润 | | | | 3,631.50 | 3,631.50 |
| (二) 利润分配 | | | 363.15 | -363.15 | |
| 提取盈余公积 | | | 363.15 | -363.15 | |
| 四、本年年末余额 | 7,500.00 | 3,097.90 | 1,466.83 | 5,868.85 | 17,933.59 |

单位：万元

| 项目 | 2009 年度 | | | | 股东权益合计 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 7,500.00 | 3,097.90 | 828.53 | 124.10 | 11,550.53 |
| 二、本年初余额 | 7,500.00 | 3,097.90 | 828.53 | 124.10 | 11,550.53 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | 275.16 | 2,476.40 | 2,751.55 |
| (一) 净利润 | | | | 2,751.55 | 2,751.55 |
| (二) 利润分配 | | | 275.16 | -275.16 | |
| 提取盈余公积 | | | 275.16 | -275.16 | |
| 四、本年年末余额 | 7,500.00 | 3,097.90 | 1,103.68 | 2,600.50 | 14,302.08 |

二、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况

(一) 财务报表编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制。

本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》。本公司2009年度、2010年度及2011年度财务报表已按上述准则的相关规定编报。

（二）合并财务报表范围及变化情况

1、合并财务报表范围

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。报告期纳入合并范围的子公司情况如下：

| 公司名称 | 主营业务 | 注册资本(万元) | 持股比例(%) | 期末投资金额 |
|----------------|---------------|----------|---------|--------|
| 泰州华龙电子有限公司 | 制造销售半导体引线框架 | 5,000 | 99% | 4950 万 |
| 宁波铭龙电子技术开发有限公司 | 制造销售半导体元器件、模具 | 150 | 100% | 150 万 |

2、合并财务报表范围变化情况

2008年投资成立了泰州华龙电子有限公司，2008年将其纳入本公司合并会计报表范围内。2009年投资成立了宁波铭龙电子技术开发有限公司，2009年将其纳入本公司合并会计报表范围内。

三、报告期内主要会计政策和会计估计

（一）收入的确认

本公司的营业收入主要为销售商品收入，收入确认原则如下：

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（二）金融资产和金融负债

1、金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融

资产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益；对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。

2、金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（三）存货

（1）存货的分类：本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、委托加工物资、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

（3）低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

（4）期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

（5）库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（四）长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能

控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。在合并（购买）日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对

被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期损益。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（五）固定资产

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率为10%，分类折旧年限、折旧率如下：

| 序号 | 类别 | 折旧年限（年） | 年折旧率（%） |
|----|-------|---------|---------|
| 1 | 房屋建筑物 | 20 | 4.5% |
| 2 | 机器设备 | 10 | 9% |
| 3 | 运输设备 | 5 | 18% |
| 4 | 办公设备 | 5 | 18% |

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（六）无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（七）资产减值准备

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（八）借款费用资本化的依据及方法

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（九）应收款项坏账准备

本公司对单项金额超过100万元的应收款项做为重大应收款项，当该重大应收款项存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。本公司将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

应收账款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

| 账龄 | 计提比例（%） |
|-----------|---------|
| 1年以下（含1年） | 5% |

| 账龄 | 计提比例 (%) |
|---------------|----------|
| 1-2 年 (含 2 年) | 10% |
| 2-3 年 (含 3 年) | 20% |
| 3-4 年 (含 4 年) | 50% |
| 4-5 年 (含 5 年) | 80% |
| 5 年以上 | 100% |

本公司对其他应收款按个别认定法进行减值测试，计提坏账准备。

四、税项

本公司适用的主要税种及税率如下：

1、企业所得税

根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司之子公司泰州华龙电子有限公司、宁波铭龙电子技术开发有限公司的企业所得税税率均为25%。

根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)文件，高新技术企业可按15%的税率进行所得税预缴申报或享受过渡性税收优惠。本公司2009年9月15日被宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局认定为高新技术企业(证书号GR200933100019)，有效期三年，2009年度至2011年度本公司享受15%所得税优惠税率。

本公司2009年度、2010年度、2011年度实际税率为15%。

2、增值税

本公司商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为17%。

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为17%。其中：为出口半导体引线框架而支付的进项税可以申请退税，退税率为17%。

增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

3、城建税及教育费附加

根据2010年12月1日起施行的《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》(国发[2010]35号文)，本公司2010年12月起城建税、教育费附加均以增值税为计税依据，适用税率分别为7%和3%

4、地方教育费附加

本公司地方教育费附加均以应纳增值税额为计税依据，适用税率为2%。

根据《宁波市地方税务局关于地方教育费附加征收管理若干问题的通知》（甬地税二〔2006〕132号）规定，自2006年5月1日起，对宁波市范围内所有缴纳“三税”的单位和个人按实际缴纳“三税”税额的2%征收地方教育附加。

5、水利基金

本公司按收入额的0.1%计缴水利基金。

6、房产税

本公司以房产原值的70%为计税依据，适用税率为1.2%。

五、非经常性损益

报告期内本公司非经常性损益明细如下：

单位：万元

| 项目 | 2011 | 2010 | 2009 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| 非流动资产处置损益 | -0.10 | 4.76 | -0.94 |
| 计入当期损益的政府补助 | 664.32 | 228.85 | 258.89 |
| 投资收益 | - | - | 9.93 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -51.62 | -6.50 | -16.15 |
| 小计 | 612.60 | 227.10 | 251.73 |
| 所得税影响额 | 79.93 | 22.66 | 36.75 |
| 非经常性净损益合计 | 532.66 | 204.44 | 214.98 |
| 其中：归属于母公司股东 | 532.66 | 204.44 | 214.98 |

报告期扣除非经常性损益后的净利润如下表所示：

单位：万元

| | 2011 | 2010 | 2009 |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 3,244.67 | 3,254.79 | 2,726.87 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 2,712.01 | 3,050.35 | 2,511.89 |

2009年、2010年公司非经常性损益对当期经营成果影响较小，对公司经营业绩无重大影响。2011年公司非经常性损益主要为政府上市补贴150万元和企业获得省级企业技术中心认定政府奖励160万元。

六、固定资产、无形资产及股权投资情况

（一）固定资产

主要固定资产的折旧年限见本章“三、报告期内主要会计政策和会计估计

（五）固定资产”。截至2011年12月31日，固定资产原价及净值情况如下：

单位：万元

| 项目 | 原价 | 累计折旧 | 账面价值 |
|-------|-----------|----------|-----------|
| 房屋建筑物 | 5,298.49 | 679.56 | 4,618.93 |
| 机器设备 | 11,045.66 | 3,496.77 | 7,548.88 |
| 运输设备 | 1,147.47 | 594.54 | 552.93 |
| 办公设备 | 694.39 | 425.16 | 269.23 |
| 合计 | 18,186.01 | 5,196.04 | 12,989.97 |

期末不存在固定资产减值的情况。

（二）无形资产

无形资产的取得方式及年限见本章“三、报告期内主要会计政策和会计估计（六）无形资产”。截至2011年12月31日，公司无形资产的原值及摊余价值如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 原价 | 累计摊销 | 账面价值 | 取得方式 |
|----------|----------|--------|----------|------|
| 土地使用权 | 5,952.58 | 207.69 | 5,744.90 | 外购 |
| 专利权 | 641.40 | 279.01 | 362.38 | 开发取得 |
| ERP 管理软件 | 34.70 | 20.02 | 14.68 | 外购 |
| 合计 | 6,628.68 | 506.72 | 6,121.96 | |

期末无形资产未发生减值。

（三）长期股权投资情况

截至2011年12月31日公司合并报表无长期股权投资。

七、主要债项

（一）短期借款

单位：万元

| 借款类别 | 2011年12月31日 |
|------|-------------|
| 抵押借款 | 2,500.00 |
| 保证借款 | 7,560.00 |
| 质押借款 | 3,000.00 |
| 信用借款 | 2,500.00 |
| 合计 | 15,560.00 |

截至2011年12月31日无到期未偿还的短期借款。

(二) 应付票据

单位：万元

| 项目 | 2011年12月31日 |
|--------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 6,475.24 |

(三) 应付账款

单位：万元

| 项目 | 2011年12月31日 |
|----|-------------|
| 合计 | 7,100.53 |

期末应付账款中不含应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(四) 预收账款

单位：万元

| 项目 | 2011年12月31日 |
|----|-------------|
| 合计 | 117.45 |

期末预收款项中不含预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(五) 其他应付款

单位：万元

| 项目 | 2011年12月31日 |
|---------|-------------|
| 合计 | 1,281.84 |
| 其中：1年以上 | 1,281.39 |

期末大额其他应付款：

单位：万元

| 项目 | 金额 | 账龄 | 性质或内容 |
|-------------|----------|------|--------|
| 泰州市鑫海投资有限公司 | 1,277.39 | 2-3年 | 投资扶持资金 |
| 合计 | 1,277.39 | | |

(六) 其他非流动负债

单位：万元

| 项目 | 2010年12月31日 | 本期增加 | 本期结转 | 2011年12月31日 |
|----|-------------|------|------|-------------|
|----|-------------|------|------|-------------|

| 项目 | 2010年12月31日 | 本期增加 | 本期结转 | 2011年12月31日 |
|----------------|-------------|-------|-------|-------------|
| 极大规模集成电路专项拨款 | 563.96 | 33.65 | 86.36 | 511.25 |
| 5+5 技改项目设备投资拨款 | 43.05 | - | 6.15 | 36.90 |
| 合计 | 607.01 | | 92.51 | 548.15 |

(七) 或有负债

报告期末本公司无重大或有负债。

八、所有者权益情况

(一) 股本

单位：万元

| 股东名称 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | 2009.12.31 |
|---------------|------------|------------|------------|
| 陈亚龙 | 1,351.58 | 1,351.58 | 1351.58 |
| 邬文通 | 494.88 | 494.88 | 494.88 |
| 宁波明昕微电子股份有限公司 | 2,028.81 | 2,028.81 | 2028.81 |
| 科恒实业有限公司（香港） | 417.57 | 417.57 | 417.57 |
| 致誉有限公司（香港） | 1,458.49 | 1,458.49 | 1458.49 |
| 宁波铭龙投资有限公司 | 997.87 | 997.87 | 997.87 |
| 南通华达微电子集团有限公司 | 750.80 | 750.80 | 750.80 |
| 合计 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7500.00 |

(二) 资本公积

单位：万元

| 项目 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | 2009.12.31 |
|------|------------|------------|------------|
| 股本溢价 | 3,097.90 | 3,097.90 | 3,097.90 |
| 合计 | 3,097.90 | 3,097.90 | 3,097.90 |

(三) 盈余公积

单位：万元

| 项目 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | 2009.12.31 |
|------|------------|------------|------------|
| 储备基金 | 1,753.63 | 1,429.16 | 1,103.68 |
| 合计 | 1,753.63 | 1,429.16 | 1,103.68 |

(四) 未分配利润

单位：万元

报告期内，公司未分配利润变动如下表所示：

| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 2009 年度 |
|----------|----------|----------|----------|
| 期初未分配利润 | 5,503.16 | 2,573.85 | 122.13 |
| 加：本年净利润 | 3,244.67 | 3,254.79 | 2,726.88 |
| 减：提取储备基金 | 324.67 | 325.48 | 275.16 |
| 期末未分配利润 | 8,423.37 | 5,503.16 | 2,573.85 |

九、现金流量

单位：万元

| 项 目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 2009 年度 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 417.18 | 5,009.04 | 2,689.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,674.53 | -6,826.39 | -2,002.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,573.60 | 3,466.90 | -300.67 |
| 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | - | - | - |

十、会计报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

本公司董事会提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项、重大关联交易及其他重要事项。

（一）资产负债表日后事项

本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

（二）或有事项

除关联担保事项外，截至2011年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

（三）重要财务承诺事项

截至2011年12月31日，本公司无其他重大承诺事项。

十一、主要财务指标

（一）近三年的主要财务指标

| 财务指标 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
|---------------|--------|--------|--------|
| 流动比率 | 1.01 | 1.03 | 1.13 |
| 速动比率 | 0.65 | 0.73 | 0.86 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 54.44 | 56.80 | 53.12 |
| 应收账款周转率（次） | 3.72 | 4.12 | 3.76 |
| 存货周转率（次） | 4.47 | 6.48 | 5.87 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 6,762.45 | 5,892.54 | 4,743.88 |
| 利息保障倍数 | 5.68 | 10.91 | 11.51 |
| 每股经营活动产生的现金流量（元） | 0.06 | 0.67 | 0.36 |
| 每股净现金流量（元） | -0.09 | 0.22 | 0.05 |
| 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例（%） | 1.81 | 2.89 | 2.21 |

主要财务指标计算：

流动比率 = 流动资产/流动负债

速动比率 = (流动资产-存货-待摊费用)/流动负债

资产负债率 = (负债总额/资产总额) × 100%

应收帐款周转率 = 营业收入/应收帐款平均余额

存货周转率 = 营业成本/存货平均余额

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧费用+摊销

利息保障倍数=息税前利润/利息支出（息为利息支出、税为所得税）

无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例=
(无形资产—土地使用权—水面养殖权—采矿权) / 期末净资产

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量/股本

每股净现金流量=净现金流量/股本

（二）净资产收益率与每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

报告期净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 报告期 | 加权平均 净资产收益率 | 每股收益 | |
|---------------------------|---------|----------------|------------|------------|
| | | | 基本每 股收益 | 稀释每 股收益 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 2011 年度 | 16.94% | 0.43 | 0.43 |
| | 2010 年度 | 20.47% | 0.43 | 0.43 |
| | 2009 年度 | 21.12% | 0.36 | 0.36 |
| 扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润 | 2011 年度 | 14.16% | 0.36 | 0.36 |
| | 2010 年度 | 19.18% | 0.41 | 0.41 |
| | 2009 年度 | 19.45% | 0.33 | 0.33 |

十二、资产评估情况

（一）有限公司设立时的评估情况

宁波华龙电子有限公司（原名“鄞县华龙电子有限公司”）于1997年6月10日成立时，委托鄞县正平会计师事务所对股东用于出资的设备采用重置成本法进行了评估，评估基准日为1997年6月5日，该设备评估前的账面值即重置完全价值为20,000元，评估价值20,000元。

（二）有限公司变更设立股份公司时的资产评估情况

本公司在以2008年5月31日为审计基准日由有限公司变更设立时，委托浙江天源资产评估有限公司对原有限公司的全部资产及负债采用资产基础法进行了评估。评估前净资产账面价值为人民币114,126,369.06元，经评估的以2008年5月31日为基准日的净资产价值为人民币124,862,864.10元，评估增值10,736,495.04元，增值率9.41%，浙江天源资产评估有限公司出具浙源评报字（2008）第0024号评估报告予以确认。

十三、历次验资情况

公司历次验资情况参与见本招股说明书第五章“发行人基本情况”之四“公司设立时发起人出资及设立后历次股本变化的验资情况”

第十一章 管理层讨论与分析

一、财务状况分析

(一) 资产构成分析

报告期内公司资产状况如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2011年12月31日 | | 2010年12月31日 | | 2009年12月31日 | |
|---------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 流动资产合计 | 30,795.12 | 59.42 | 27,671.76 | 61.40 | 20,135.16 | 62.67 |
| 非流动资产合计 | 21,033.19 | 40.58 | 17,394.76 | 38.60 | 11,995.40 | 37.33 |
| 资产总额 | 51,828.31 | 100.00 | 45,066.53 | 100.00 | 32,130.56 | 100.00 |

公司报告期内总资产金额不断上升，由 2009 年末的 32,130.56 万元增长到 2011 年末的 51,828.31 万元，增长了 61.31%，其中流动资产由 2009 年末的 20,135.16 万元增长到 2011 年末的 30,795.12 万元，增长了 52.94%；非流动资产由 2009 年末的 11,995.40 万元增长到 2011 年末的 21,033.19 万元，增长 75.34%。报告期内非流动资产的增长快于流动资产的增长，主要原因是公司为扩大生产经营规模，固定资产及无形资产增长较快。

尽管公司生产规模在报告期内不断扩大，但公司资产结构保持稳定。

1、流动资产构成分析

单位：万元

| 项目 | 2011年12月31日 | | 2010年12月31日 | | 2009年12月31日 | |
|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 货币资金 | 4,586.83 | 14.89 | 4,365.58 | 15.78 | 3,527.02 | 17.52 |
| 应收票据 | 1,912.09 | 6.21 | 899.54 | 3.25 | 1,820.68 | 9.04 |
| 应收账款 | 12,768.59 | 41.46 | 13,475.41 | 48.70 | 9,314.03 | 46.26 |
| 预付款项 | 256.89 | 0.83 | 304.79 | 1.10 | 101.12 | 0.50 |
| 其他应收款 | 350.27 | 1.14 | 635.09 | 2.30 | 602.98 | 2.99 |
| 存货 | 10,920.46 | 35.46 | 7,991.35 | 28.88 | 4,769.33 | 23.69 |
| 流动资产合计 | 30,795.12 | 100.00 | 27,671.76 | 100.00 | 20,135.16 | 100.00 |

公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成。

公司流动资产总额由 2009 年末的 20,135.16 万元增长到 2011 年末的 30,795.12 万元，增长了 52.4%，主要原因是随着生产经营规模的扩大和泰州华龙的投产，应收账款和存货的金额有所上升。

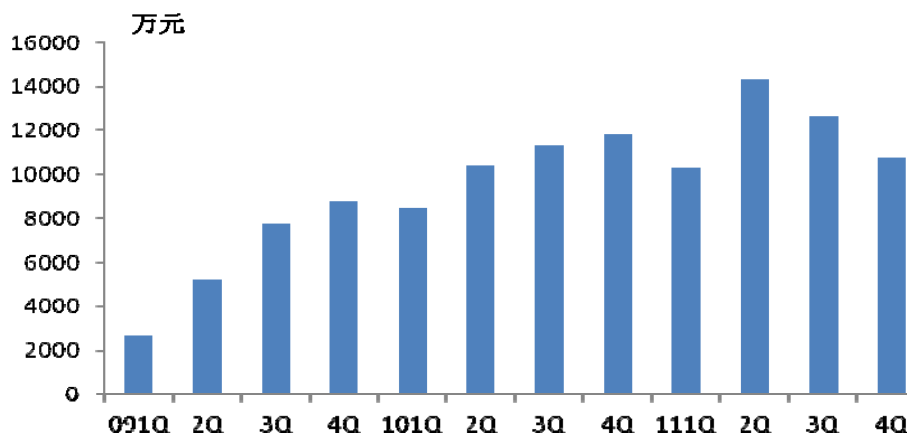
(1) 应收票据和应收账款

1) 应收票据和应收账款余额变化分析

报告期内应收账款及应收票据变动趋势及相关财务指标如下：

| | 2011/2011.12.31 | 2010/2010.12.31 | 2009/2009.12.31 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 营业收入（万元） | 52,048.46 | 50,096.76 | 32,390.82 |
| 营业收入增长（%） | 3.90 | 54.66 | |
| 应收账款余额（万元） | 12,768.59 | 13,475.41 | 9,933.74 |
| 应收账款余额增长（%） | -11.06 | 44.52 | |
| 应收票据（万元） | 1,912.09 | 899.54 | 1,820.68 |
| 应收票据增长（%） | 112.56 | -50.59 | |
| 应收账款应收票据合计（万元） | 14,680.68 | 14,374.95 | 11,754.42 |
| 增长率（%） | 2.13 | 22.29 | |

报告期各期末应收账款余额主要由各期四季度所发生的销售收入构成。2009年~2011年各季度销售收入变化情况如下图所示：



受金融危机的影响，2008年第四季度公司订单锐减，2009年1季度华龙电子的销售收入降至2,668.69万元，为报告期内最低。2009年第二季度公司逐步摆脱金融危机的影响，随着客户将前期库存逐步消耗，公司订单在2009年第三季度迅速增长，2009年4季度实现销售收入达到8,765.36万元；2010年公司全年销售保持了增长，整体销售规模较2009年上升，该年第四季度销售收入为11,797.53万元；2011年华龙电子季度间销售收入波动较大，2011年2季度销售收入达到最高峰后由于市场需求下降以及铜价下跌等因素影响销售收入逐步下降，第四季度销售销售收入为10,755.84万元。

2010年末应收账款较2009年增加4,422万元，增长率为44.52%，主要是由于2010年第四季度的销售收入较2009年同期增加3,032万元，增长率为34.59%，同时结合2010年末应收票据余额比2009年减少921万元，相应增幅均在正常范

围之内。

2011年四季度公司主营业务收入同比略有下降，应收账款规模有所缩小。

2) 应收账款客户明细

2011年末应收账款前十名客户情况如下表所示：

| 序号 | 客户名称 | 应收账款余额 | 应收账款余额占比 |
|----|---------------|----------|----------|
| 1 | 深圳深爱半导体股份有限公司 | 1,840.98 | 13.48% |
| 2 | 广州华微电子有限公司 | 1,262.92 | 9.25% |
| 3 | 深圳市晶导电子有限公司 | 1,120.51 | 8.20% |
| 4 | 汕头华汕电子器件有限公司 | 903.75 | 6.62% |
| 5 | 无锡红光微电子有限公司 | 853.71 | 6.25% |
| 6 | 佛山市蓝箭电子有限公司 | 789.05 | 5.78% |
| 7 | 天水华天科技股份有限公司 | 632.78 | 4.63% |
| 8 | 无锡华润华晶电子有限公司 | 532.21 | 3.90% |
| 9 | 四川大雁微电子有限公司 | 462.19 | 3.38% |
| 10 | 宁波明昕微电子股份有限公司 | 411.64 | 3.01% |
| | 合计 | 8,809.74 | 64.50 |

2010年末应收账款前十名客户情况如下表所示：

| 序号 | 客户名称 | 应收账款余额 | 应收账款余额占比 |
|----|----------------|----------|----------|
| 1 | 宁波明昕微电子股份有限公司 | 3,196.37 | 22.27 |
| 2 | 佛山市蓝箭电子有限公司 | 988.39 | 6.88 |
| 3 | 深圳市晶导电子有限公司 | 931.25 | 6.49 |
| 4 | 广州华微电子有限公司 | 895.22 | 6.24 |
| 5 | 无锡红光微电子有限公司 | 837.08 | 5.83 |
| 6 | 无锡华润华晶电子有限公司 | 783.11 | 5.45 |
| 7 | 汕头华汕电子器件有限公司 | 707.82 | 4.93 |
| 8 | 四川大雁微电子有限公司 | 600.09 | 4.18 |
| 9 | 南通富士通微电子股份有限公司 | 539.16 | 3.76 |
| 10 | 深圳深爱半导体股份有限公司 | 379.87 | 2.65 |
| | 合计 | 9,858.36 | 68.67 |

2009年末应收账款前十名客户情况如下表所示：

| 序号 | 客户名称 | 应收账款余额 | 应收账款余额占比 |
|----|---------------|----------|----------|
| 1 | 宁波明昕微电子股份有限公司 | 1,054.73 | 10.62 |
| 2 | 佛山市蓝箭电子有限公司 | 820.71 | 8.26 |
| 3 | 四川大雁微电子有限公司 | 803.55 | 8.09 |
| 4 | 汕头华汕电子器件有限公司 | 674.90 | 6.79 |
| 5 | 深圳市晶导电子有限公司 | 644.74 | 6.49 |
| 6 | 吉林华微电子股份有限公司 | 587.96 | 5.92 |
| 7 | 无锡红光微电子有限公司 | 563.03 | 5.67 |
| 8 | 无锡华润华晶电子有限公司 | 471.48 | 4.75 |
| 9 | 深圳深爱半导体股份有限公司 | 380.80 | 3.83 |
| 10 | 南通富士通电子股份有限公司 | 376.71 | 3.79 |
| | 合计 | 6,378.60 | 64.21 |

3) 应收账款坏账准备提取情况

公司将单项金额超过 100 万元的应收账款列为重大应收款项。对每笔重大应收款项，公司年末均逐笔核实是否存在客观证据表明将无法按应收款项的原有条款收回所有款项。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的应收款项一起以应收账款账龄划分组合计提坏账准备。

公司及同行业上市公司康强电子应收账款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

| 账龄 | 康强电子 | 华龙电子 |
|--------------|------|------|
| 1 年以下（含 1 年） | 5% | 5% |
| 1~2 年（含 2 年） | 10% | 10% |
| 2~3（含 3 年） | 20% | 20% |
| 3~4（含 4 年） | 50% | 50% |
| 4~5（含 5 年） | 50% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

公司坏账准备提取政策与康强电子基本一致。

2011 年 12 月 31 日公司应收账款余额超过 100 万元的客户包括深圳深爱半导体股份有限公司、广州华微电子有限公司、深圳市晶导电子有限公司、汕头华汕电子器件有限公司、无锡红光微电子有限公司、佛山市蓝箭电子有限公司等 23 家企业，上述企业生产经营情况正常，没有客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项。公司对上述应收账款均按账龄分析法计提坏账准备。

2011 年 12 月 31 日，公司应收账款账龄及坏账准备提取情况如下表所示：

| 账龄 | 金额（万元） | 比例（%） | 坏账准备（万元） |
|--------------|-----------|-------|----------|
| 1 年以下（含 1 年） | 13,291.34 | 97.31 | 664.57 |
| 1-2 年（含 2 年） | 103.21 | 0.76 | 10.32 |
| 2-3 年（含 3 年） | 9.26 | 0.07 | 1.85 |
| 3-4 年（含 4 年） | 62.47 | 0.46 | 31.24 |
| 4-5 年（含 5 年） | 51.36 | 0.38 | 41.09 |
| 5 年以上 | 139.34 | 1.02 | 139.34 |

截至 2011 年 12 月 31 日，一年期以内的应收账款余额占全部应收账款余额的比例为 97.31%。从应收账款账龄来看，一年期以内应收账款所占比例很高，反映出公司收入质量较好。

公司期末存在欠款的客户构成与公司历史上客户构成基本相似，公司历史上发生坏账较少，公司管理层认为计提的坏账准备是足额、充分的。

(2) 存货

报告期内存货的构成如下表：

单位：万元

| 项目 | 2011年12月31日 | | 2010年12月31日 | | 2009年12月31日 | |
|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 原材料 | 6,115.43 | 55.57 | 5,364.56 | 67.05 | 3,114.52 | 64.91 |
| 在产品 | 2,377.88 | 21.61 | 1,195.81 | 14.95 | 811.83 | 16.92 |
| 委托加工物资 | 912.01 | 8.29 | 223.70 | 2.80 | 25.92 | 0.54 |
| 库存商品 | 1,600.34 | 14.54 | 1,216.48 | 15.20 | 846.20 | 17.63 |
| 合计 | 11,005.67 | 100.00 | 8,000.54 | 100.00 | 4,798.47 | 100.00 |

1) 存货金额波动情况分析

2010年末存货余额较2009年末上升3,202.07万元，升幅为66.73%，其中原材料上升2,250.04万元，升幅为72.24%，在产品上升383.98万元，升幅为47.30%，库存商品上升370.28万元，升幅为43.76%，委托加工物资上升197.78万元。

2010年存货余额上升3,202.07万元的主要原因是生产规模的扩大，2010年9月，发行人全资子公司泰州华龙正式投入生产运营，新增引线框架产能100亿只，泰州华龙2010年期末存货余额为1260万元。此外，华龙电子在2010年末根据订单情况适当增加铜带库存量，2009年末华龙电子铜带库存量为406吨，2010年末上升至589吨，同时由于铜价的上升导致期末原材料金额大幅上升。

2011年末存货余额较2010年末上升3,005.13万元，升幅为37.56%，其中原材料上升2,250.04万元，升幅为14.00%，在产品上升1,182.07万元，升幅为98.85%，库存商品上升383.86万元，升幅为31.55%，委托加工物资上升688.31万元。

2011年末原材料上升的主要原因是库存的铜废角料、电镀液金额大幅上升。2011年公司将铜废角料委托铜带供应商重新加工成铜带的金额上升，导致期末库存的铜废角料和委托加工物资上升。其次，生产规模扩大也导致期末在产品和库存商品金额上升。

2) 存货跌价准备提取情况

期末公司根据存货成本与可变现净值孰低原则计价并计提存货跌价准备。

公司2009年末存货跌价准备金额为29.15万元，2010年存货跌价准备金额为9.20万元，2011年存货跌价准备金额85.21万元。

(3) 其他应收款

报告期各期末其他应收款情况如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | 2009.12.31 |
|-------|------------|------------|------------|
| 其他应收款 | 350.27 | 635.09 | 603.84 |

2011 年末其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

2、非流动资产构成分析

单位：万元

| 项目 | 2011 年 12 月 31 日 | | 2010 年 12 月 31 日 | | 2009 年 12 月 31 日 | |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 固定资产 | 12,989.97 | 61.76 | 13,173.96 | 75.74 | 7,485.08 | 62.40 |
| 在建工程 | 848.71 | 4.04 | 40.32 | 0.23 | 669.54 | 5.58 |
| 无形资产 | 6,121.96 | 29.11 | 3,154.97 | 18.14 | 3,020.99 | 25.18 |
| 开发支出 | - | - | - | - | 127.19 | 1.06 |
| 长期待摊费用 | 765.08 | 3.64 | 795.37 | 4.57 | 589.40 | 4.91 |
| 递延所得税资产 | 307.47 | 1.46 | 230.14 | 1.32 | 103.20 | 0.86 |
| 非流动资产合计 | 21,033.19 | 100.00 | 17,394.76 | 100.00 | 11,995.40 | 100.00 |

公司的非流动资产主要有固定资产、无形资产和长期待摊费用构成。

（1）固定资产

报告期内公司固定资产原值变动情况如下表所示：

单位：万元

| | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
|------------|----------|-----------|----------|--------|-----------|
| 2009.1.1 | 2,095.39 | 6,150.19 | 597.38 | 477.93 | 9,320.89 |
| 本年增加 | 70.00 | 1,160.02 | 55.18 | 44.99 | 1,330.18 |
| 本年减少 | 0.00 | 184.06 | 12.00 | 0.00 | 196.06 |
| 2009.12.31 | 2,165.39 | 7,126.14 | 640.56 | 522.92 | 10,455.02 |
| 本年增加 | 2,937.84 | 3,421.68 | 414.50 | 135.16 | 6,909.18 |
| 本年减少 | 0.34 | 451.98 | 18.21 | - | 470.53 |
| 2010.12.31 | 5,102.89 | 10,095.84 | 1,036.84 | 658.08 | 16,893.66 |
| 本期增加 | 195.60 | 949.81 | 110.63 | 36.65 | 1,292.69 |
| 本期减少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.34 |
| 2011.12.31 | 5,298.49 | 11,045.66 | 1,147.47 | 694.39 | 18,186.01 |

报告期内公司固定资产规模逐年增加，2011 年末固定资产原值为 18,186.01 万元，较 2009 年末增加 7,730.99 万元，主要是由于房屋建筑物和机器设备的增加所致。2010 年 9 月公司子公司泰州华龙投入试生产，当年房屋及建筑物及生产经营相关的机器设备大幅增加。固定资产的增加与公司产能扩张匹配，报告期内产能从 91 亿只引线框架扩大到 250 亿只。

2011 年年末，公司未发现需要计提减值损失的固定资产，公司固定资产原值为 18,186.01 万元，财务成新率为 71.43%，其中，房屋建筑物为 87.17%，机器

设备为 68.34%，成新率较高，说明主要设备相对较新，尚可使用年限较长。

(2) 无形资产

报告期各期末无形资产账面价值如下表所示：

单位：万元

| | 2011.12.31 | 2010.12.31 | 2009.12.31 |
|----------|------------|------------|------------|
| 土地使用权 | 5,744.90 | 2,649.09 | 2,704.92 |
| 专利权 | 362.38 | 490.66 | 308.82 |
| ERP 管理软件 | 14.68 | 15.22 | 7.25 |
| 合计 | 6,121.96 | 3,154.97 | 3,020.99 |

2011 年公司购买位于东钱湖镇红林村 110 亩土地使用权，购买成本为 3,199.79 万元，已取得甬东旅国用（2011）第 36-085 号土地使用权证。

公司对专利权均按 5 年受益期进行摊销，每年年末对各项专利权进行减值测试，未发现需要提取减值准备的情况。

(3) 长期待摊费用

报告期各期末长期待摊费用账面价值如下表所示：

单位：万元

| | 2011.12.31 | 2010.12.31 | 2009.12.31 |
|---------|------------|------------|------------|
| 模具 | 640.41 | 695.79 | 511.61 |
| 铜带车间装修费 | 84.50 | 25.93 | 77.79 |
| 框架料盘 | 40.17 | 73.65 | - |
| 合计 | 765.08 | 795.37 | 589.40 |

公司每种型号的产品都有一种模具与其对应。模具为公司自行生产，其使用期限超过 1 年。公司长期待摊费用中的模具按两年受益期进行摊销。

(二) 负债构成分析

报告期公司负债构成如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2011 年 12 月 31 日 | | 2010 年 12 月 31 日 | | 2009 年 12 月 31 日 | |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 流动负债 | 30,505.27 | 98.23 | 26,929.29 | 97.80 | 17,805.93 | 99.79 |
| 非流动负债 | 548.15 | 1.77 | 607.01 | 2.20 | 49.20 | 0.21 |
| 负债合计 | 31,053.42 | 100.00 | 27,536.30 | 100.00 | 17,855.13 | 100.00 |

本公司的负债主要由流动负债构成。

公司负债以流动负债为主，其主要原因是短期贷款较长期贷款利率低，公司为了控制财务费用，尽可能通过短期贷款来满足公司营运资金的需求。

1、流动负债构成分析

单位:万元

| 项目 | 2011年12月31日 | | 2010年12月31日 | | 2009年12月31日 | |
|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 短期借款 | 15,560.00 | 51.01 | 9,210.00 | 34.20 | 5,360.00 | 30.10 |
| 应付票据 | 6,475.24 | 21.23 | 6,900.00 | 25.62 | 5,100.00 | 28.64 |
| 应付账款 | 7,100.53 | 23.28 | 8,556.52 | 31.77 | 5,172.61 | 29.05 |
| 预收款项 | 117.45 | 0.39 | 126.68 | 0.47 | 96.21 | 0.54 |
| 应付职工薪酬 | - | - | 28.58 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 应交税费 | -29.79 | -0.10 | 228.47 | 0.85 | 208.83 | 1.17 |
| 其他应付款 | 1,281.84 | 4.20 | 1,879.03 | 6.98 | 1,868.28 | 10.49 |
| 流动负债合计 | 30,505.27 | 100.00 | 26,929.29 | 100.00 | 17,805.93 | 100.00 |

(1) 短期借款

报告期各期末短期借款具体情况如下表所示:

单位:万元

| 借款类别 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | 2009.12.31 |
|------|------------|------------|------------|
| 抵押借款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 500.00 |
| 保证借款 | 7,560.00 | 4,710.00 | 4,860.00 |
| 质押借款 | 3,000.00 | 2,000.00 | - |
| 信用借款 | 2,500.00 | - | - |
| 合计 | 15,560.00 | 9,210.00 | 5,360.00 |

2010年末公司银行借款余额较前期增加 3,850.00 万元,主要系公司经营规模扩张,资金缺乏扩大银行贷款规模所致。2011年较前期增加 6,350.00 万元主要系公司购买位于东钱湖镇红林村土地,缺乏资金扩大银行贷款规模所致。

(2) 应付票据和应付账款

2010年12月31日应付账款金额比上年末增加的主要原因是子公司泰州华龙本年正式投入生产运营,导致原材料及设备采购金额增加。

(3) 其他应付款

2009年子公司泰州华龙新增应付泰州市鑫海投资有限公司 1,277.39 万元,该笔款项为泰州市海陵工业园为鼓励投资,解决企业初期流动资金困难而给予的资金扶持。根据《项目发展扶持协议》,泰州华龙无需支付利息或资金占用费。

2、非流动负债构成分析

2011年12月31日其他非流动负债余额为 548.15 万元,主要是技改项目设备投资拨款。

根据财政部投资评审中心评审的“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”

科技重大专项预算评审报告（项目编号：2009ZX02010），公司共应收到补贴款 673.00 万元，并于 2010 年度、2011 年度分别收到 639.35 万元、33.65 万元，根据与损益相关部分在相关费用发生当期转入损益；与资产相关部分按所采购设备的使用年限 10 年进行分摊，本期共确认补贴收入 86.36 万元。

根据宁波市经济委员会、宁波市财政局 2009 年 6 月 22 日印发的“甬经技术〔2009〕136 号”《关于下达宁波市 2009 年度先进装备制造业重点技改项目及“5+5”产业升级促调技改项目第一批补助资金的通知》，宁波市为鼓励重点优势企业和新兴产业的技术改造，给予符合相关条件的企业补助款。本公司 2009 年共收到 61.50 万元补贴款，根据对应补贴款所采购设备的使用年限 10 年进行分摊确认本期补贴收入 6.15 万元。

（三）偿债能力分析

报告期流动比率、速动比率、资产负债率、息税折旧摊销前利润及利息保障倍数如下表所示：

| 财务指标 | 2011/2011.12.31 | 2009/2010.12.31 | 2009/2009.12.31 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 流动比率 | 1.01 | 1.03 | 1.13 |
| 速动比率 | 0.65 | 0.73 | 0.86 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 54.44 | 56.80 | 53.12 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 6,762.45 | 5,892.54 | 4,743.88 |
| 利息保障倍数 | 5.68 | 10.91 | 11.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 417.18 | 4,032.65 | 2,689.76 |
| 净利润（万元） | 3,244.67 | 3,254.79 | 2,726.88 |

报告期内公司的流动比率和速动比率较为稳定，但维持在较低水平，显示公司有一定的短期偿债压力。

报告期内公司的资产负债率在 53%--60%之间，处于合理水平。

2009 年以及 2010 年，公司利息保障倍数均在 11 倍左右。自公司设立以来，公司从未发生过逾期偿还借款本金及逾期支付利息的情况，并与各银行建立了良好信用关系。2011 年利息保障倍数较低主要原因为公司本年借款平均余额比 2010 年增加约 5100 万元，且央行三次上调贷款利率，造成利息支出增加 393.30 万元。

2009 年以及 2010 年公司均不存在经营活动产生的现金流量净额远低于当期净利润的情况。2011 年经营活动产生的现金流量净额为 417.18 万元，大幅低于同期的净利润 3,244.67 万元，主要原因是 2011 年度存货上升 3,005.21 万元，经营性应付项目余额减少 4,854.59 万元，导致经营性现金流出金额大幅上升。

公司同行业上市公司康强电子近三年的偿债能力指标如下表所示：

| 财务指标 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---------------|-------|-------|-------|
| 流动比率 | 1.14 | 1.34 | 1.36 |
| 速动比率 | 0.84 | 0.85 | 0.96 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 54.08 | 45.69 | 40.94 |
| 利息保障倍数 | 1.16 | 3.83 | 3.99 |

康强电子流动比率、速动比率指标优于本公司；利息保障倍数指标弱于本公司；2011年两公司资产负债率（母公司）指标基本一致。

（四）发行人资产周转能力分析

1、应收账款周转率分析

| 财务指标 | 2011 | 2010 | 2009 |
|-------------|------|------|------|
| 应收账款周转率（次） | 3.72 | 4.12 | 3.76 |
| 应收账款周转天数（天） | 98 | 89 | 96 |

报告期内公司应收账款周转率较为稳定，回款期在三个月左右。

公司应收账款周转水平（货款回收期）主要取决于公司的销售方式、结算方式（商业信用政策）等，客户结构调整、货款催收管理水平也对其有一定影响。

公司销售业务采用直销的销售模式，结算方式上主要采用银行承兑汇票、电汇、信用证方式，少量采取汇票、现金等方式，回款期一般在2-3个月。对于信誉良好的大客户，公司会根据具体情况给予适当延长的信用期。

2、存货周转率分析

| 财务指标 | 2011 | 2010 | 2009 |
|-----------|------|------|------|
| 存货周转率（次） | 4.47 | 6.48 | 5.87 |
| 存货周转天数（天） | 82 | 56 | 61 |

2011年存货周转率下降的主要原因是公司增加利用铜废角料委托铜带供应商加工铜带的业务量，导致库存的铜废角料金额以及委托加工物资上升，从而降低了存货周转率。

公司一直在稳步提高原材料供应链管理，进一步缩减主要原材料铜带库存周期，降低铜价波动给公司带来的不利影响。

3、资产周转率同行业比较

| 财务指标 | 2011 | 2010 | 2009 |
|-------------|------|------|------|
| 华龙电子应收账款周转率 | 3.72 | 4.12 | 3.76 |
| 康强电子应收账款周转率 | 4.85 | 4.02 | 3.01 |
| 华龙电子存货周转率 | 4.47 | 6.48 | 5.87 |
| 康强电子存货周转率 | 4.95 | 3.88 | 3.92 |

（康强电子数据来源于上市公司年报）

2009年、2010年本公司的应收账款周转率和存货周转率均优于同行业上市公司康强电子；2011年康强电子周转率上升，本公司相关指标则有所下降。

二、盈利能力分析

（一）报告期内经营成果总体分析

报告期内，公司的利润构成及变动情况如下：

单位：万元，%

| 项目 | 2011年度 | | 2010年度 | | 2009年度 |
|------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| | 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | 金额 |
| 营业收入 | 52,048.46 | 3.90 | 50,096.76 | 54.66 | 32,390.82 |
| 其中：主营业务收入 | 47,963.03 | 14.29 | 41,966.79 | 72.12 | 24,381.93 |
| 毛利额 | 9,534.11 | 10.29 | 8,644.64 | 53.62 | 5,627.21 |
| 其中：主营业务毛利额 | 9,495.58 | 14.32 | 8,305.99 | 55.08 | 5,355.97 |
| 期间费用 | 6,259.51 | 30.95 | 4,779.97 | 78.28 | 2,681.11 |
| 资产减值损失 | 91.01 | -62.78 | 244.50 | 1161.86 | 19.38 |
| 营业利润 | 3,018.43 | -15.39 | 3,567.60 | 22.23 | 2,918.70 |
| 利润总额 | 3,631.03 | -4.31 | 3,794.70 | 20.07 | 3,160.51 |
| 所得税费用 | 386.36 | -28.44 | 539.91 | 24.51 | 433.63 |
| 净利润 | 3,244.67 | -0.31 | 3,254.79 | 19.36 | 2,726.88 |

由上表可见，公司的利润总额主要来自营业利润。报告期内，公司的营业收入由2009年的32,390.82万元增加到2011年的52,048.46万元，增长60.69%；毛利额由2009年的5,627.21万元增加到2011年的9,534.11万元，增长69.43%。报告期内公司主营业务收入和主营业务毛利额保持稳定增长。

2011年期间费用比2010年增加1,479.55万元，主要原因是为保证公司未来发展，在宁波购置一处土地使用权，以及业务规模扩大导致资金需求量较大，同时由于银行多次加息、宏观资金面偏紧导致贴现增加等因素，2011年财务费用比2010年增加869.57万元，增加较多。

报告期内，公司盈利相关指标情况如下：

| 盈利指标 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
|---------|--------|--------|--------|
| 主营业务毛利率 | 19.80% | 19.79% | 21.97% |
| 期间费用率 | 12.03% | 9.54% | 8.28% |

注：主营业务毛利率 = (主营业务收入 - 主营业务成本) / 同期主营业务收入；

期间费用率 = 期间费用 / 同期营业收入。

（二）营业收入分析

1、收入构成

（1）按业务类别划分

单位：万元，%

| 项目 | 2011 | | 2010 | | 2009 |
|--------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
| | 金额 | 增长率 | 金额 | 增长率 | 金额 |
| 主营业务收入 | 47,963.03 | 14.29 | 41,966.79 | 72.12 | 24,381.93 |
| 其他业务收入 | 4,085.43 | -49.75 | 8,129.97 | 1.51 | 8,008.90 |
| 营业收入合计 | 52,048.46 | 3.90 | 50,096.76 | 54.66 | 32,390.82 |

公司主营业务收入全部为引线框架产品销售收入，报告期内公司主营业务突出，近三年公司主营业务占营业收入的比重分别为75.27%、83.77%和92.15%，呈上升的趋势。其他业务收入主要是铜废角料销售收入。

公司近三年营业收入分别为32,390.82万元、50,096.76万元及52,048.46万元。2010年由于泰州华龙投产，产能扩大，当年营业收入较2009年增长54.66%。2011年其他业务收入较2010年减少4,044.54万元，但主营业务收入较2010年增加5,996.24万元，营业收入继续增加。

（2）按产品类别划分

报告期内公司主营业务收入按产品类别划分情况如下：

单位：万元

| 主营业务产品类别 | 2011 | | 2010 | | 2009 | |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 分立器件用引线框架 | 42,045.37 | 87.66 | 37,387.00 | 89.09 | 22,005.35 | 90.25 |
| 集成电路用引线框架 | 5,917.60 | 12.34 | 4,579.78 | 10.91 | 2,376.57 | 9.75 |
| 合计 | 47,962.97 | 100 | 41,966.79 | 100 | 24,381.93 | 100 |

公司产品为引线框架，根据用途不同，可分为分立器件用引线框架和集成电路用引线框架。报告期内，公司主营业务收入主要来自于分立器件用引线框架收入，该产品为公司收入和利润提供稳定保障。

公司分立器件引线框架产品中中高端产品的比重逐步上升，其中包括应用于汽车电子、功率场效应管（VDMOS）、高端电源开关等新型电力电子器件封装的TO252系列、TO220、TO3P系列引线框架以及大型LED模块封装用功率模块系列引线框架。同时公司正在积极研发LED封装引线框架等高端分立器件引线框架产品。

公司目前批量生产集成电路封装用引线框架品种主要是DIP系列引线框架。公司集成电路用引线框架的销售额占主营业务收入比例呈上升趋势，2011年集成电路用引线框架的销售额占主营业务收入比例已超过12%。

2、营业收入变化及原因

公司近三年营业收入分别为 32,390.82 万元、50,096.76 万元及 52,048.46 万元，2010 年营业收入较 2009 年增加 17,705.93 万元、增长比率为 54.66%，主要是由于主营业务收入的大幅增加所致。

(1) 主营业务收入变化分析

公司近三年主营业务收入分别为 24,381.93 万元、41,966.79 万元和 47,962.97 万元，2010 年增幅较大。

① 2010 年度、2009 年度主营业务收入变动情况分析

2009 年、2010 年各季度主营业务收入变化情况如下表所示：

单位：万元

| 期间 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 合计 |
|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2010 年度 | 8,479.40 | 10,413.59 | 11,276.26 | 11,797.53 | 41,966.79 |
| 2009 年度 | 2,668.69 | 5,217.30 | 7,730.57 | 8,765.36 | 24,381.93 |
| 同比增长 | 217.74% | 99.60% | 45.87% | 34.59% | 72.12% |

受国际金融危机的影响，2008 年四季度至 2009 年一季度，我国半导体行业整体下滑，至 2009 年第二季度全球半导体市场“V”型复苏趋势基本确立。公司自 2009 年第二季度开始销售情况有所恢复，至 2009 年末已恢复至金融危机前的经营状况，从其销售状况及产品毛利率来看比金融危机前还有所提高。2010 年度，华龙电子引线框架继续保持了较高的出货量。

公司 2010 年主营业务收入增加中销量与单价的影响分别如下：

| 2010 年度 | | 2009 年度 | | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 销量（万只） | 主营业务收入 | 销量（万只） | 主营业务收入 | 收入增加 |
| 1,498,431.17 | 419,667,854.72 | 1,033,253.97 | 243,819,251.53 | 175,848,603.19 |
| 销量影响收入 | 销量影响比重 | 单价影响收入 | 单价影响比重 | 2010 年合计影响 |
| 140,687,847.16 | 80.01% | 35,160,756.03 | 19.99% | 175,848,603.19 |

公司产销量大幅增长是主营业务收入增长的主要因素，其增长原因为：

A、从内部生产能力来看，公司本部在 2009 年 4 月完成扩产，生产能力由年产 91.46 亿只增加至 150 亿只；泰州华龙于 2010 年 9 月开始试生产，新增产能为 100 亿只（2010 年全年实际产能为 25 亿只）。2009 年发行人总体产能接近 135 亿只，2010 年总体产能接近 175 亿只，产能增幅为 29.63%；

B、从外部市场来看，由于金融危机使下游封装企业压缩库存，金融危机后市场出现对引线框架产品需求的强力反弹，因此公司诸多产品在 2009 年下半年开始直至 2010 年全年均出现供不应求的状况。

产品销售价格上升是主营业务收入增长的次要因素。公司产品定价以铜价为基准（根据上海有色金属网最新铜价）再加上一定的加工费、目标利润确定。2009 年上海有色金属网平均铜价为 42,378.36 元/吨，2010 年上海有色金属网平均铜价为 59,099.71 元/吨，2010 年平均铜价较 2009 年上升约 17000 元/吨、上涨比率为 43%，相应地导致公司产品单价上升，因此影响 2010 年收入增加 3,516.08 万元。

②2010 年度、2009 年度公司市场开拓与维护、客户变动情况

2010 年度公司主营业务收入较上年增加 17,584.86 万元、增长比率为 72.12%。2009 年及 2010 年公司的前五大客户销售情况（见下表），前五大客户销售占比在 2010 年与 2009 年仅相差 1.17%，变化不大，但两年销售金额的平均上升幅度达到 68.09%。公司的主要客户相对比较稳定，主要是由于下游封装行业集中度较高，而主要客户销售金额的普遍上升则体现了半导体行业自 2009 年下半年至 2010 年全面复苏的特点，下游封装企业表现出的需求旺盛的态势，带动了公司销量的全面上升。

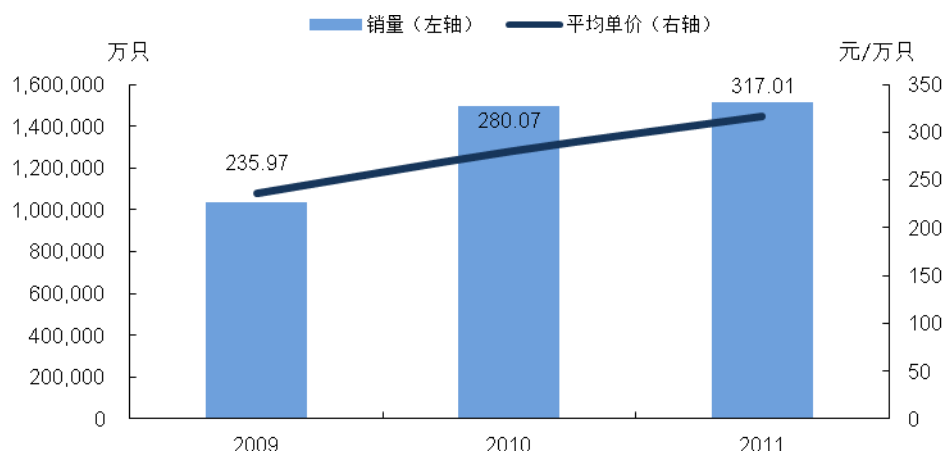
| 客户名称 | 收入金额 | 占主营业务收入比例 |
|----------------|----------------|-----------|
| 2009 年度 | | |
| 宁波明昕微电子股份有限公司 | 34,316,517.76 | 14.07% |
| 佛山市蓝箭电子有限公司 | 28,341,402.33 | 11.62% |
| 无锡华润华晶电子有限公司 | 23,486,952.26 | 9.63% |
| 深圳深爱半导体股份有限公司 | 19,420,564.06 | 7.97% |
| 深圳市晶导电子有限公司 | 15,925,781.30 | 6.53% |
| 合计 | 121,491,217.71 | 49.83% |
| 2010 年 | | |
| 宁波明昕微电子股份有限公司 | 68,921,236.99 | 16.42% |
| 佛山市蓝箭电子有限公司 | 48,657,665.41 | 11.59% |
| 无锡华润华晶电子有限公司 | 32,298,406.10 | 7.70% |
| 深圳市晶导电子有限公司 | 29,461,592.43 | 7.02% |
| 深圳深爱半导体股份有限公司 | 24,875,562.53 | 5.93% |
| 合计 | 204,214,463.46 | 48.66% |
| 收入增加 | 82,723,245.75 | |

收入增幅

68.09%

(2) 主营业务收入分产品分析

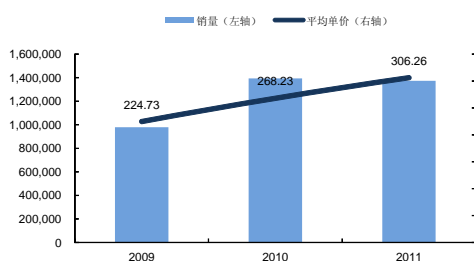
报告期引线框架销量、平均单价波动情况



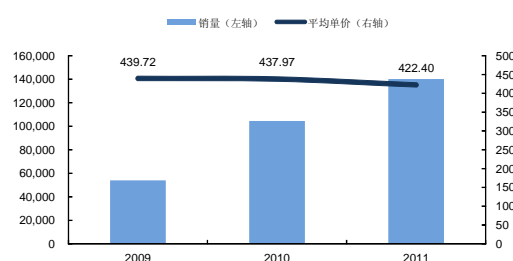
从上图可以看出，报告期内，公司引线框架的销量和平均售价都有所上升，2010年销量相比2009年上升45.02%，2011年销量比2010年略有增长。

报告期内公司分立器件引线框架和集成电路引线框架产品的平均售价和销量数据如下图所示：

报告期分立器件引线框架销量、平均单价波动情况



报告期集成电路引线框架销量、平均单价波动情况



报告期内分立器件引线框架平均售价逐年上升，主要受到铜价变化趋势及公司主要产品结构变化的影响。2011年分立器件引线框架销售收入较2010年上升12.46%，销量与2010年基本持平。

2011年集成电路引线框架销售收入较2010年上升1,337.82万元，升幅为29.21%，销量较2010年上升93.48%；2010年集成电路引线框架销售收入较2009年上升2,203.21万元，升幅为92.71%，销量较2010年上升33.97%；主要原因是公司的集成电路引线框架设计和制造能力得到提高，销量稳步增长，价格平稳。

从上图比较可以看出，报告期内集成电路引线框架产品销量增速显著高于分立器件引线框架。

(3) 其他业务收入变化分析

公司其他业务收入主要是铜角料销售及少量废品框架销售。铜角料系主要原材料铜带的废角料，可以再加工成铜带，公司将其销售给专门的铜材冶炼加工企业或铜材贸易公司。

公司其他业务收入2010年与2009年基本持平，2011年比2010年减少4,044.5万元。其他业务收入减少主要是随着公司铜带车间产能增加以及委托加工业务量增加，外销铜角料销量减少。2009、2010和2011年铜角料销售量分别为2,375.20吨、1,514.57吨和692.80吨。

3、报告期内主营业务收入变化与同行业比较

公司主营业务为引线框架的生产销售，与同行业上市公司包括康强电子。2008年度至2011年度公司与华龙电子引线框架业务销售收入如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 2009 年度 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 公司主营业务收入 | 47,963.03 | 41,966.79 | 24,381.93 |
| 增幅 | 14.29% | 72.12% | |
| 公司营业收入 | 52,048.46 | 50,096.76 | 32,390.82 |
| 增幅 | 3.90% | 54.66% | |
| 康强电子引线框架收入 | 63,393.60 | 48,729.86 | 33,366.46 |
| 增幅 | 30.09% | 46.04% | |

公司主营业务收入为引线框架产品收入，营业收入为引线框架产品和铜废角料销售收入。鉴于康强电子未单独列示铜废角料销售收入，因此将华龙电子营业收入与康强电子引线框架收入变动趋势进行比较较为合理。

从上表可以看到华龙电子营业收入的波动趋势与康强电子引线框架产品销售收入波动趋势基本一致。2009年受金融危机影响营业收入有所下降，由于华龙电子2009年4月扩大了产能，在金融危机后市场恢复过程中销售收入增长较快，2009年华龙电子的营业收入降幅较小；2010年整个行业都处于产销两旺状态，受泰州华龙投产的影响，华龙电子营业收入的增幅略高于康强电子的销售收入的增幅；2011年康强电子引线框架销售收入增幅超过本公司。

4、报告期各期四季度客户情况分析

2009年第四季度前十大销售客户如下表所示：

单位：万元，%

| 序号 | 客户名称 | 销售收入 | 占比 | 应收账款余额 | 占比 |
|----|---------------|----------|-------|----------|-------|
| 1 | 宁波明昕微电子股份有限公司 | 1,393.87 | 15.90 | 1,054.73 | 10.62 |

| | | | | | |
|----|---------------|----------|-------|----------|-------|
| 2 | 佛山市蓝箭电子有限公司 | 1,210.77 | 13.81 | 820.71 | 8.26 |
| 3 | 无锡华润华晶电子有限公司 | 917.27 | 10.46 | 471.48 | 4.75 |
| 4 | 深圳市晶导电子有限公司 | 578.91 | 6.60 | 644.74 | 6.49 |
| 5 | 深圳深爱半导体股份有限公司 | 540.03 | 6.16 | 380.80 | 3.83 |
| 6 | 吉林华微电子股份有限公司 | 515.56 | 5.88 | 587.96 | 5.92 |
| 7 | 四川大雁微电子有限公司 | 507.55 | 5.79 | 803.55 | 8.09 |
| 8 | 南通富士通微电子有限公司 | 482.01 | 5.50 | 376.71 | 3.79 |
| 9 | 无锡红光微电子有限公司 | 293.43 | 3.35 | 563.03 | 5.67 |
| 10 | 汕头华汕电子器件有限公司 | 268.09 | 3.06 | 674.90 | 6.79 |
| | 合计 | 6,707.48 | 76.52 | 6,378.60 | 64.21 |

2009年二季度开始半导体行业从金融危机的影响中开始恢复。

2010年第四季度前十大销售客户如下表所示：

单位：万元，%

| 序号 | 客户名称 | 销售收入 | 占比 | 应收账款余额 | 占比 |
|----|---------------|----------|-------|----------|-------|
| 1 | 宁波明昕微电子股份有限公司 | 1,865.58 | 15.81 | 3,196.37 | 22.27 |
| 2 | 佛山市蓝箭电子有限公司 | 1,304.61 | 11.06 | 988.39 | 6.88 |
| 3 | 无锡华润华晶电子有限公司 | 1,015.12 | 8.60 | 783.11 | 5.45 |
| 4 | 深圳市晶导电子有限公司 | 965.12 | 8.18 | 931.25 | 6.49 |
| 5 | 广州华微电子有限公司 | 805.66 | 6.83 | 895.22 | 6.24 |
| 6 | 南通富士通微电子有限公司 | 783.69 | 6.64 | 539.16 | 3.76 |
| 7 | 深圳深爱半导体股份有限公司 | 597.70 | 5.07 | 379.87 | 2.65 |
| 8 | 汕尾德昌电子有限公司 | 588.68 | 4.99 | 224.00 | 1.56 |
| 9 | 四川大雁微电子有限公司 | 440.41 | 3.73 | 600.09 | 4.18 |
| 10 | 无锡红光微电子有限公司 | 440.37 | 3.73 | 837.08 | 5.83 |
| | 合计 | 8,806.94 | 74.65 | 9,374.54 | 65.30 |

2010年半导体行业继续保持较高的产销量，公司2010年四季度对主要客户的销售额同比有所上升。

2011年第四季度前十大销售客户如下表所示：

单位：万元，%

| 序号 | 客户名称 | 销售收入 | 占比 | 应收账款余额 | 占比 |
|----|---------------|----------|-------|----------|-------|
| 1 | 深圳深爱半导体股份有限公司 | 2,128.96 | 19.79 | 1,840.98 | 13.48 |
| 2 | 佛山市蓝箭电子有限公司 | 1,187.22 | 11.04 | 789.05 | 5.78 |
| 3 | 天水华天科技股份有限公司 | 841.75 | 7.83 | 632.78 | 4.63 |
| 4 | 广州华微电子有限公司 | 811.79 | 7.55 | 1,262.92 | 9.25 |
| 5 | 无锡华润华晶电子有限公司 | 727.70 | 6.77 | 532.21 | 3.90 |
| 6 | 深圳市晶导电子有限公司 | 693.34 | 6.45 | 1,120.51 | 8.20 |
| 7 | 南通富士通微电子有限公司 | 546.80 | 5.08 | 405.12 | 2.97 |
| 8 | 无锡红光微电子有限公司 | 544.89 | 5.07 | 853.71 | 6.25 |
| 9 | 宁波明昕微电子股份有限公司 | 347.84 | 3.23 | 411.64 | 3.01 |
| 10 | 汕头华汕电子器件有限公司 | 313.60 | 2.92 | 903.75 | 6.62 |
| | 合计 | 8,143.88 | 75.73 | 8,752.68 | 64.09 |

2011年四季度公司对深圳深爱半导体股份有限公司销售收入同比增长较

大，主要原因是该公司在 2011 年新增产能投产，引线框架需求量上升。

（三）成本和毛利率分析

| 营业成本构成 | 2011 | 2010 | 2009 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 主营业务成本 | 38,467.45 | 33,660.79 | 19,025.95 |
| 其他业务成本 | 4,046.90 | 7,791.32 | 7,737.66 |
| 营业成本 | 42,514.34 | 41,452.12 | 26,763.61 |

1、营业成本构成分析

报告期内，由于产能扩大，2010 年营业成本比 2009 年上升 14,688.51 万元，其中主营业务成本上升 14,634.84 万元，其他业务成本基本持平。2011 年主营业务成本比 2010 年上升 4,806.65 万元，其他业务成本下降 3,744.43 万元，营业成本总体上升 1,062.23 万元。其他业务成本为公司销售生产过程中产生的铜废角料的成本，其他业务成本下降的主要原因是公司铜带车间产能增加以及铜废角料委托加工业务量上升，对外销售铜废角料量减少。

公司主营业务成本明细分类如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2011 | | 2010 | | 2009 | |
|------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 金额 | 占比% | 金额 | 占比% | 金额 | 占比% |
| 直接材料 | 33,762.30 | 87.77 | 29,968.20 | 89.03 | 16,514.53 | 86.80 |
| 直接人工 | 1,488.18 | 3.87 | 1,407.02 | 4.18 | 932.27 | 4.90 |
| 制造费用 | 3,216.96 | 8.36 | 2,285.57 | 6.79 | 1,579.15 | 8.30 |
| 合计 | 38,467.45 | 100.00 | 33,660.79 | 100.00 | 19,025.95 | 100.00 |

营业成本中直接材料成本所占比例较大，2009 年、2010 年和 2011 年占比分别为 86.80%、89.03%和 87.77%，基本保持稳定。

2、主营业务毛利率分析

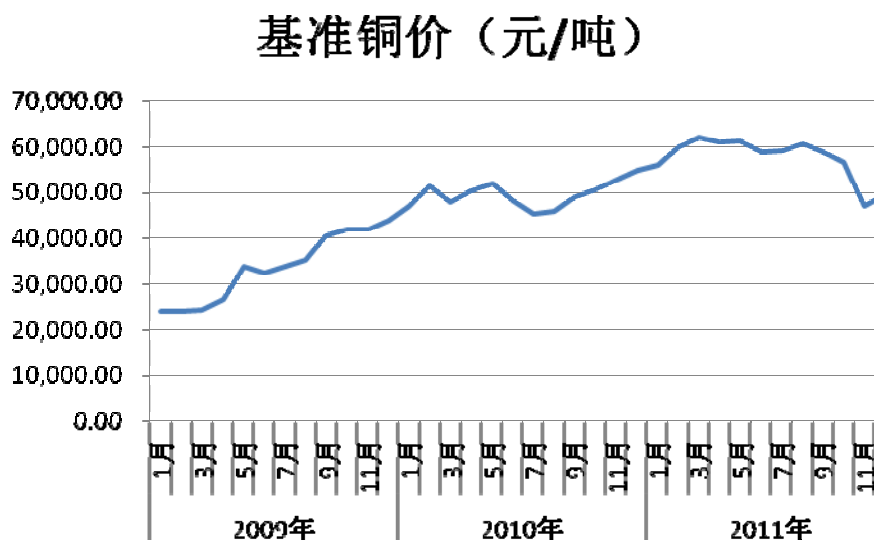
| 产品类别 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---------|--------|--------|--------|
| 主营业务毛利率 | 19.80% | 19.79% | 21.97% |

公司产品毛利率水平主要受行业特点和公司产品定价模式决定。引线框架行业是典型的料重工轻的行业，铜带成本占主营业务成本的比重在 70%左右。公司的定价模式是“原材料成本+加工费+目标毛利”，原材料成本根据单位产品所消耗的铜带数量与当期铜价共同确定，加工费主要考虑模具成本、人工成本、设备折旧及水电费，目标毛利则根据产品的市场供求状况由双方协商确定。

通常来说，铜价是确定引线框架销售价格的主要参照物，加工费相对固定，目标毛利的变化与公司的议价能力有关，公司根据客户需求所开发的定制产品，在市场上同种产品供应商数量少时，公司可以获得较高的毛利额，此类产品的毛

利水平随着供应商数量的增加而减少；此外，由于铜价是确定引线框架销售价格的主要参照物，而产品毛利的主要影响因素是市场供求状况，产品毛利额受铜价影响较小，因此当铜价处于高位时，产品毛利率相对较低，而铜价处于低位时产品毛利率相对较高。

报告期内铜价波动状况如下图所示：



（基准铜价是指每月25日铜价月平均价格，华龙电子主要以基准铜价为依据测算下个月各产品的报价，数据来源于上海有色网）

从上图可以看出，报告期内铜价持续上升。受铜价波动的影响，2009年铜价处于低位时，公司的主营业务毛利率较高，2010年及2011年铜价处于高位时，主营业务毛利率相对较低。

鉴于主营业务毛利率除了受到产品盈利能力影响外，还受到铜价影响，因此以下根据主营业务毛利额的波动情况对公司产品盈利情况进行分析。

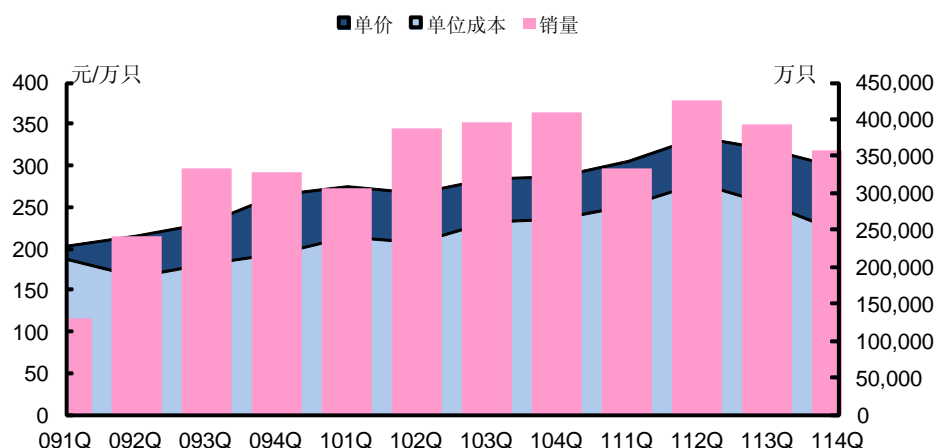
（1）单位销售价格、单位成本和单位毛利

单位：元/万只

| 项目 | 2011 | 2010 | 2009 |
|--------|--------|--------|--------|
| 单位销售价格 | 317.01 | 280.07 | 235.97 |
| 单位成本 | 254.25 | 224.64 | 184.14 |
| 单位毛利 | 62.76 | 55.43 | 51.83 |

单位毛利在报告期各季度间波动具体情况如图所示：

公司引线框架产品单价、单位成本和销量波动情况



1) 根据铜价调整产品售价，避免铜价波动对产品单位毛利的影响

公司在生产经营过程中尽可能避免铜价波动对生产经营的影响。公司每个月月底会预测下个月所需的铜带数量并向供应商采购，公司与供应商之间铜带采购价格主要以现货铜价加合理加工费确定；同时，公司会依据基准铜价计算确定各客户下个月所执行的产品售价。通过上述模式，公司能够较好的避免铜价波动对生产经营的不利影响。

从上图可以看到，报告期内公司产品售价、单位成本波动与铜价波动趋势基本一致。2009年一季度由于受金融危机影响，引线框架单位毛利较低。2009年二季度伴随着市场回暖，引线框架产品单位毛利逐步回升，产品销量也逐步增加。2009年三季度后，在铜价逐步上升的市场环境中，公司保持了较为稳定的单位毛利。

从“公司引线框架产品单价、单位成本和销量波动情况”图中也可发现，除了2008年4季度前后受到金融危机影响外，公司单位产品毛利基本保持稳定，在正常的市场环境下铜价波动对公司的单位产品毛利影响不大。

2) 通过生产工艺改进以及研发高附加值产品获取更高的单位产品毛利

2010年公司产品的单位毛利比2009年略有提升，达到55.43元/万只，2011年公司产品的单位毛利进一步上升至62.76元/万只，主要原因是TO220系列、TO251系列和TO3PN系列等附加值较高品种继续保持较高的产销量。

单位：万元，%

| 产品系列 | 2011 | | 2010 | | 2009 | |
|------|------|----|------|----|------|----|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |

| | | | | | | |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| TO-92 铜 | 8,922.48 | 18.60 | 8,686.53 | 20.70 | 6,148.89 | 25.22 |
| TO-92 铁 | 941.38 | 1.96 | 723.12 | 1.72 | 785.89 | 3.22 |
| TO-126 | 5,243.66 | 10.93 | 5,944.23 | 14.16 | 4,451.18 | 18.26 |
| TO-220 | 18,568.72 | 38.71 | 15,850.64 | 37.77 | 7,757.37 | 31.82 |
| TO-251 | 1,953.77 | 4.07 | 1,917.60 | 4.57 | 927.56 | 3.80 |
| TO-3PN | 2,047.35 | 4.27 | 1,234.18 | 2.94 | 555.24 | 2.28 |
| SOT | 4,368.05 | 9.11 | 3,030.71 | 7.22 | 1,379.24 | 5.66 |
| DIP | 5,917.60 | 12.34 | 4,579.78 | 10.91 | 2,376.57 | 9.75 |
| 主营业务收入 | 47,963.03 | 100.00 | 41,966.79 | 100.00 | 24,381.93 | 100.00 |

从上表可以看出，TO220系列销售收入占比由2009年31.82%上升至2011年的38.71%，TO251系列和TO3PN系列的占比也有所上升。上述系列产品广泛应用于节能灯、电子整流器、电脑、汽车电子等领域。

公司能够根据客户需求开发市场供需缺口较大或者主要依赖进口的产品，并在一段时间内通过该产品获得较高毛利。

（2）毛利率同行业比较

目前上市公司中从事半导体封装用引线框架生产的企业有宁波康强电子股份有限公司，根据该公司披露数据，报告期康强电子引线框架产品的毛利率与本公司同口径计算的毛利率如下表所示：

| | 2011 | 2010 | 2009 |
|------------|-------|-------|-------|
| 康强电子可比毛利率% | 11.02 | 17.22 | 16.36 |
| 华龙电子可比毛利率% | 18.32 | 17.26 | 17.37 |

（注：此处毛利率均为引线框架与铜废角料销售的综合毛利率）

2009年和2010年，公司毛利率与康强电子毛利率基本一致，2011年公司毛利率高于康强电子毛利率。康强电子在其2011年年度报告中披露毛利率下降的主要原因是“报告期内原辅材料价格的剧烈波动对公司成本控制带来较大压力。”

公司2011年继续执行了每月月底根据铜价水平调整下月销售价格的政策，较好的避免了铜价波动对生产经营带来的不利影响，使公司的毛利率保持稳定。

（四）报告期利润构成及经营情况分析

1、报告期内利润的主要来源

单位：万元

| 项目 | 2011 | 2010 | 2009 |
|----------|----------|----------|----------|
| 主营业务销售毛利 | 9,495.58 | 8,305.99 | 5,355.97 |
| 其他业务销售毛利 | 38.54 | 338.65 | 271.24 |
| 销售毛利合计 | 9,534.11 | 8,644.64 | 5,627.21 |

报告期内销售毛利主要来自主营业务毛利，其他业务销售毛利占比较小。其

他业务收入主要是铜角料销售收入。

2010年主营业务毛利8,305.99万元，比2009年增长55.08%；2011年主营业务毛利9,495.58万元，比2010年增长14.32%。

2、期间费用

单位：万元

| 项 目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 销售费用 | 240.16 | 201.43 | 134.47 |
| 管理费用 | 4,237.85 | 3,666.60 | 2,170.07 |
| 财务费用 | 1,781.50 | 911.93 | 376.57 |
| 期间费用合计 | 6259.51 | 4,779.96 | 2,681.11 |
| 营业收入 | 52,048.46 | 50,096.76 | 32,390.82 |
| 销售费用占比 | 0.46% | 0.40% | 0.42% |
| 管理费用占比 | 8.14% | 7.32% | 6.70% |
| 财务费用占比 | 3.42% | 1.82% | 1.16% |
| 期间费用占比 | 12.03% | 9.54% | 8.28% |

报告期内公司期间费用逐年上升，占营业收入比重逐年提高。具体来看：

(1) 报告期内公司销售费用占营业收入比例保持稳定且维持在较低水平，公司与主要客户之间关系稳定，销售压力较小；在新市场和新客户开拓方面，根据实际的生产经营能力，采用稳健和渐进的方式进行，因此三年来销售费用保持缓慢增长。

公司销售费用主要由运输费构成，具体情况如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2011 | 2010 | 2009 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 运输费 | 238.66 | 197.06 | 129.06 |
| 其他 | 1.50 | 4.37 | 5.40 |
| 销售费用合计 | 240.16 | 201.43 | 134.47 |
| 营业收入 | 52,048.46 | 50,096.76 | 32,390.82 |
| 销售费用占营业收入比例(%) | 0.46 | 0.40 | 0.42 |

发行人所处行业的销售模式决定了销售费用率较低。公司直接面向下游厂商销售，产品通过下游厂商的质量认证后，公司可以与其保持长年稳定的合作关系，期间所发生的客户维护成本较少。因此，发行人与同行业上市公司康强电子从事销售业务人员的人数较少，华龙电子的销售人员为4人，康强电子的销售人员为11人。

康强电子销售费用具体构成如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2011 | 2010 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------|----------|----------|
| 运杂费 | 830.62 | 669.20 |
| 维修费 | 116.62 | 97.51 |
| 物料消耗 | 64.74 | 0.00 |
| 差旅费 | 47.37 | 52.35 |
| 报关费 | 27.69 | 5.37 |
| 其他 | 149.00 | 223.83 |
| 合计 | 1,236.03 | 1,048.27 |

康强电子的销售费用主要由运杂费构成。康强电子销售费用率如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2011 | 2010 | 2009 |
|----------------|------------|------------|-----------|
| 销售费用 | 1,236.03 | 1,048.27 | 836.41 |
| 营业收入 | 150,271.71 | 103,972.93 | 63,352.22 |
| 销售费用占营业收入比例（%） | 0.82 | 1.01 | 1.32 |

2011年本公司的运输费用率为0.46%，康强电子的运杂费率为0.55%，两公司的运输费率接近。与康强电子相比，华龙电子的维修费、物料消耗等费用计入制造费用科目，销售人员差旅费与管理人员的差旅费合并计入管理费用，公司销售费用率偏低。

（2）报告期内公司管理费用逐年增加，占营业收入的比重逐年上升。

管理费用2010年较2009年大幅增加，其原因为子公司泰州华龙2010年正式投入生产运营，其管理费用大幅增加。同时，连续三年的增长主要是随着本公司生产规模的扩大及产品品种的新增，相应技术开发费增加所致。

华龙电子与康强电子销售费用和管理费用合计数占营业收入比例比较如下：

单位：%

| 项目 | 2011 | 2010 | 2009 |
|------|------|------|------|
| 华龙电子 | 8.60 | 7.72 | 7.11 |
| 康强电子 | 6.73 | 7.31 | 7.68 |

华龙电子与康强电子销售费用和管理费用合计数占营业收入的比例基本一致。

保荐机构和会计师核查后认为公司报告期内销售费用、管理费用真实、完整，核算符合企业会计准则的规定，且销售费用、管理费用与公司业务规模、经营状况等相匹配。

（3）报告期内财务费用增加较大。

| 项目 | 2011 | 2010 | 2009 |
|------|--------|--------|--------|
| 利息支出 | 776.40 | 383.10 | 300.67 |
| 利息收入 | -66.88 | -44.49 | -82.16 |

| | | | |
|-------|----------|--------|--------|
| 汇兑损益 | -7.38 | 1.00 | 0.77 |
| 银行手续费 | 65.57 | 37.34 | 20.56 |
| 票据贴现息 | 1,013.79 | 534.99 | 136.74 |
| 合计 | 1,781.50 | 911.93 | 376.57 |

从上表可以看出，对公司财务费用的影响较大的主要是利息支出和票据贴现。

2010年财务费用与2009年相比增加较多，主要原因是2010年应收票据贴现额比2009年增加约7,000万元，票据贴现率比2009年上升了约10%。

2011年财务费用与2010年度相比大幅增加869.57万元，主要原因是公司2011年新购置一处土地对营运资金占用较大，本年借款平均余额比2010年增加约5,100万元，2011年应收票据贴现额比2010年增加约7,146万元，同时央行三次上调利率，导致2011年财务费用大幅上升。

3、资产减值损失

单位：万元

| 项 目 | 2011 | 2010 | 2009 |
|--------|-------|--------|---------|
| 坏账损失 | 9.12 | 260.24 | 139.19 |
| 存货跌价准备 | 81.89 | -15.74 | -119.81 |
| 合计 | 91.01 | 244.50 | 19.38 |

报告期内因为铜价回升，导致存货跌价的不利因素消除，2009年转回存货跌价准备119.81万元，2010年转回存货跌价准备15.74万元。2010年度坏账损失比2009年大幅增加，主要系应收账款余额在2010年年末大幅增加。

4、营业外收支

单位：万元

| 项 目 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---------------|--------|--------|--------|
| 营业外收入 | 665.54 | 233.60 | 258.89 |
| 营业外支出 | 52.94 | 6.50 | 17.09 |
| 营业外收支净额 | 612.60 | 227.10 | 241.80 |
| 营业外收支净额占利润总额比 | 16.87% | 5.98% | 7.65% |

公司营业外收入主要是政府补助，营业外支出主要是水利建设基金、捐赠等。报告期内，营业外收支净额占利润总额比重较小。

(1) 营业外收入

报告期内营业外收入情况如下：

单位：万元

| 项 目 | 2011 | 2010 | 2009 |
|-----|------|------|------|
|-----|------|------|------|

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| 政府补助 | 664.32 | 228.85 | 258.89 |
| 固定资产处置利得 | - | 4.76 | - |
| 其他 | 1.22 | - | - |
| 合计 | 665.54 | 233.60 | 258.89 |

营业外收入主要是政府补助。

(2) 营业外支出

报告期内营业外支出情况如下：

单位：万元

| 项 目 | 2011 | 2010 | 2009 |
|-----------|-------|------|-------|
| 非流动资产处置损失 | 0.10 | - | 0.94 |
| 赞助捐赠支出 | 40.60 | 6.50 | 15.40 |
| 水利基金 | 3.00 | - | - |
| 其他 | 9.24 | - | 0.75 |
| 合计 | 52.94 | 6.50 | 17.09 |

5、所得税

单位：万元

| 项 目 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---------|--------|---------|--------|
| 当期所得税费用 | 463.68 | 666.84 | 273.34 |
| 递延所得税费用 | -77.32 | -126.94 | 160.29 |
| 合计 | 386.36 | 539.91 | 433.63 |

2009年递延所得税费用增加较多，主要是08年计提的存货跌价准备转销及转回共535.06万元，递延所得税资产减少从而导致递延所得税费用增加。

2010年递延所得税费用减少较多，主要是由于2010年取得“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”补贴款639.35万元并于当年确认损益75.39万元，递延所得税资产增加从而导致递延所得税费用减少。

(1) 报告期内公司享受的所得税税率

公司2009年、2010年、2011年企业所得税税率为15%。依据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）文件，高新技术企业可按15%的税率进行所得税预缴申报或享受过渡性税收优惠。公司于2009年9月15日被宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局认定为高新技术企业（证书号GR200933100019），有效期三年，2009年度至2011年度可享受15%所得税优惠税率。

经保荐机构核查，公司高新技术企业的申报与认定程序合法有效。就公司申报高新技术企业事宜，公司实际控制人陈亚龙承诺如下：如公司因申报高新技术企业事项不符合相关规定导致公司被税务机关追缴相应税款，相关补缴义务由本

人全部承担。

本公司控股子公司泰州华龙、宁波铭龙的所得税税率均为25%。

(2) 报告期内享受的税收优惠情况

根据财政部、国家税务总局《关于印发<技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法>的通知》(财税字[1999]290号文件),企业技术改造项目国产设备投资的40%可从企业技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免。

2009年本公司应纳所得税380.76万元,经税务机关认定的以前年度购买国产设备尚可抵免企业所得税额107.41万元,所以本年度应计提所得税273.34万元。

2010年递延所得税费用减少较多,主要是由于2010年取得“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”补贴款639.35万元并于当年确认损益75.39万元,递延所得税资产增加从而导致递延所得税费用减少。

(五) 影响盈利能力的主要因素

1、主要产品销售价格变动对盈利水平的影响

(1) 公司产品定价政策

公司的定价模式是“原材料成本+加工费+目标毛利”。此种定价模式有利于降低原材料价格波动对公司经营业绩带来的风险。

公司产品销售存在两种模式,(1)与客户签订短期合同,价格根据上海有色金属网铜价测算出成本加上一定的目标利润确定;(2)根据客户要求,对未来的销售价格进行锁定。具体操作方法是,公司与客户达成锁定价格的大额供货意向后,立即与铜带供应商签订“锁铜”协议,将所需铜带的价格锁定,在此基础上,测算出成本加上一定的目标利润向客户报价并签订锁定价格的销售合同。

公司产品定价以铜价为基准,铜价波动对公司经营业绩的风险大幅降低,客户要求锁定销售价格时采取上述“锁铜”模式,铜价波动所产生的风险基本规避。

(2) 报告期内产品销售价格变动及对利润的影响分析

| 产品类型 | 单位 | 2011 | 2010 | 2009 |
|------|------|--------|--------|--------|
| 引线框架 | 元/万只 | 317.01 | 280.07 | 235.97 |

公司产品销售单价受铜价的波动影响较大。公司采取前述定价政策降低铜价波动对公司经营成果的影响。如果公司产品定价政策、原材料采购政策未能得到有效执行,产品价格波动会对公司经营产生较大影响。

公司引线框架产品销售价格对毛利的敏感性系数为5.05，产品售价上浮10%，公司毛利上升50.50%。

2、原材料价格变动对利润的影响

(1) 原材料采购定价政策

公司经过多年的经营拥有稳定优质的供应商，也凭借其突出的市场地位，拥有较强的议价能力。目前公司对主要原材料铜带的定价依据有两种：上月平均价或者当天价，在铜价上升情况下，公司会提前一个月与供应商协商确定采取用上月平均价进行采购的策略。

其次，在主要原材料铜带的采购方式上，公司采取多种方式为避免铜价波动对公司经营带来的不利影响。若有客户要求用“锁铜”价对产品价格进行锁定，公司便会向采购商提出用锁定方式采购同等数量的铜带。公司对铜带供应商的议价能力较强，在以上“锁铜”的协议中，一般会约定在上海金属交易所的铜价低于一定价格时，价格另行调整。

通过上述措施，公司的原材料采购价格风险得到较好的控制。

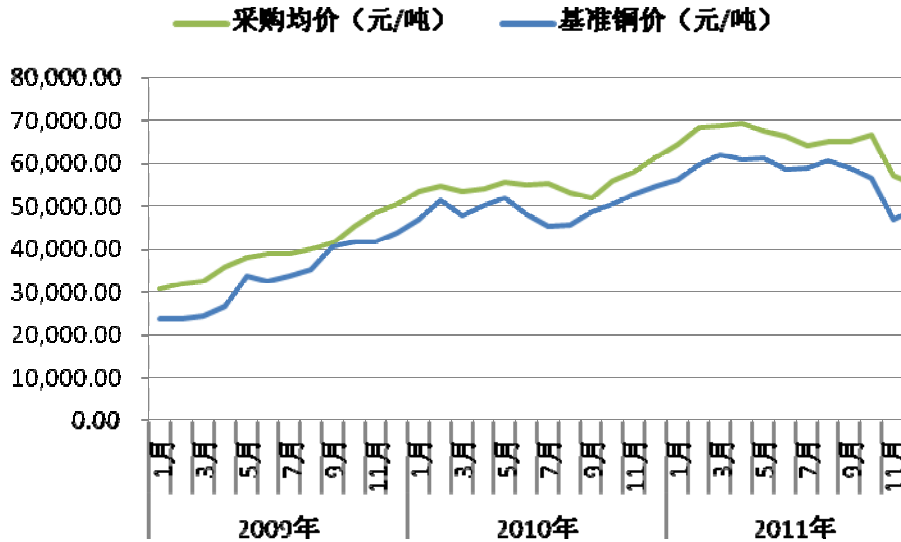
(2) 原材料价格变动及对利润的影响分析

公司单位产品成本中铜带成本约占70%，因此以下主要对铜带采购价格进行分析。

| 名称 | 单位 | 2011 | 2010 | 2009 |
|-------|------|-------|-------|------|
| 铜带采购价 | 万元/吨 | 6.49 | 5.44 | 4.10 |
| 变动 | % | 19.30 | 32.68 | |

报告期内铜带平均采购价格波动较大，2010年铜带平均采购价格上涨至5.44万元/吨，2011年上涨到6.49万元/吨。公司铜带采购价格变化主要受铜价涨跌影响，另外，铜带有平带、异型带、进口料、国产料等的区别，也是造成采购定价高低的因素。

下图为报告期内国内铜价（基准铜价）走势及公司铜带采购平均价的走势，从图中可以看出，公司铜带采购价走势与国内现铜价走势基本保持同步波动。



2011年铜带采购价格对毛利的敏感性系数为-2.84,表明按照当前生产工艺和产品结构,铜带价格上升10%,毛利额将下降28.40%。公司主要原材料铜带的价格近年来波动较大,但公司较好的执行了产品定价政策和原材料采购政策,报告期内铜价波动对公司盈利的影响较小。

(3) 客户资源

公司经过多年的发展,拥有众多规模大、信用好、关系稳固的优质客户。老客户尤其是优质大客户的维护及新客户的开发状况,对本公司产品销售影响较大。本公司将进一步稳固与客户关系,以保证公司盈利能力的连续性和稳定性。

(4) 新产品的开发力度

半导体行业属于技术更新较快的行业,新型的封装技术的出现会导致封装材料行业市场需求结构发生变化。公司将凭借模具开发的优势,紧扣市场需求,开发附加值高,供需缺口大的品种,以提高公司的盈利能力。

(六) 非经常性损益分析

单位: 万元

| 项 目 | 2011 | 2010 | 2009 |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| 扣除所得税影响后的非经常性损益净额 | 532.66 | 204.44 | 214.98 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3,244.67 | 3,254.79 | 2,726.88 |
| 非经常性损益净额占净利润的比例 (%) | 16.42 | 6.28 | 7.88 |
| 归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,712.01 | 3,050.35 | 2,511.90 |

公司报告期内的非经常性损益主要来自政府奖励和补贴收入。公司的非经常性损益占净利润比例不高,不会对公司的经营成果产生重大影响,不会影响公司

盈利能力的稳定性。

三、现金流量分析

单位：万元

| 项 目 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 417.18 | 4,032.65 | 2,551.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,674.53 | -5,827.86 | -2,036.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,573.60 | 3,466.90 | -300.67 |
| 汇率变动对现金的影响额 | 7.38 | -0.01 | -0.77 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -676.38 | 1,671.68 | 213.79 |

(一) 经营活动产生的现金流量分析

单位：万元

| 项 目 | 2011 | 2010 | 2009 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,760.78 | 51,382.76 | 28,046.67 |
| 收到的税费返还 | - | 189.61 | 133.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,222.24 | 2,312.79 | 1,753.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,983.01 | 53,885.16 | 29,933.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,368.52 | 41,436.64 | 21,919.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,516.77 | 3,151.25 | 1,902.51 |
| 支付的各项税费 | 2,181.05 | 1,678.61 | 1,078.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,499.50 | 2,609.62 | 2,344.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,565.84 | 48,876.11 | 27,244.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 417.18 | 5,009.04 | 2,689.76 |

2009年、2010年及2011年公司经营活动产生的现金流量净额为2,689.76万元、5,009.04万元和417.18万元，近三年净利润分别为2,726.88万元、3,254.79万元和3,244.67万元。

发行人经营活动产生的现金流量净额与同期净利润之间的关系如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2011 | 2010 | 2009 |
|----------------|-----------|-----------|----------|
| 净利润 | 3,244.67 | 3,254.79 | 2,726.88 |
| 加：不涉及现金支付成本费用 | 2,446.03 | 1,959.25 | 1,302.08 |
| 营业外收支未付现部分 | 0.10 | -4.76 | 0.94 |
| 投资收益与公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 | -9.93 |
| 财务费用不属于经营付现的部分 | 769.02 | 384.09 | 301.44 |
| 所得税费用非经营的部分 | -77.32 | -126.94 | 160.29 |
| 存货期初期末差额部分 | -3,005.12 | -3,232.35 | -895.68 |
| 经营性应收应付项目付现的部分 | -2,960.20 | 2,774.96 | -896.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 417.18 | 5,009.04 | 2,689.76 |

注：“不涉及现金支付成本费用”主要为资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等。

2011 年经营活动产生的现金流量净额为 417.18 万元，大幅低于同期的净利润 3,244.67 万元，主要原因是 2011 年度存货上升 3,005.21 万元，同时经营性应付项目余额减少，导致经营性现金流出金额大幅上升。

2010 年度经营活动产生的现金流量净额超过同期净利润 1,754.25 万元，主要是公司在与长期供应商沟通后适当延长了应付账款的付款周期，2010 年末应付账款余额大幅上升。

2009 年度经营活动产生的现金流量净额与当年净利润大体相当，当年公司在历经 2008 年金融危机后迅速反弹，随着半导体行业的整体回暖，产销量均得到一定程度的提高，公司经营状况平稳，收支较为平衡。

（二）投资活动产生的现金流量分析

单位：万元

| 项目 | 2011 | 2010 | 2009 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 收回投资收到的现金 | - | 120.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 1.34 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | - | 11.77 | 9.80 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 133.11 | 9.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,674.53 | 6,959.50 | 1,912.38 |
| 投资支付的现金 | - | - | 100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,674.53 | 6,959.50 | 2,012.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,674.53 | -6,826.39 | -2,002.58 |

报告期内公司生产经营规模扩大，因此每年均有大量购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流出。

（三）筹资活动产生的现金流量分析

| 项目 | 2011 | 2010 | 2009 |
|-------------------|-----------|----------|----------|
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 20,310.00 | 9,660.00 | 6,360.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,310.00 | 9,660.00 | 6,360.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,960.00 | 5,810.00 | 6,360.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 776.40 | 383.10 | 300.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,736.40 | 6,193.10 | 6,660.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,573.60 | 3,466.90 | -300.67 |

本公司 2009 年度、2010 年和 2011 年筹资活动产生的现金流量净额分别为 -300.67 万元、3,466.90 万元和 5,573.60 万元。

公司主要利用银行借款作为主要筹资手段，报告期内公司生产经营规模扩

大，借款规模逐年扩大，筹资活动产生的现金流入总体呈现上升趋势。

四、资本性支出分析

（一）报告期资本性支出情况

资本性支出，是指购置、建造固定资产以及对外投资的支出。本公司及控股子公司报告期内重大的资本性支出情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2011 | 2010 | 2009 |
|--------|----------|----------|----------|
| 房屋建筑物 | 195.60 | 2,937.84 | 70.00 |
| 机器设备 | 949.81 | 3,421.68 | 1,160.02 |
| 其他固定资产 | 147.27 | 549.66 | 769.71 |
| 土地 | 3,199.79 | 0.00 | 0.60 |
| 合计 | 4,492.47 | 6,909.18 | 2,000.32 |

从上表可以看出，公司2010年、2011年的资本性支出较大，主要原因为2010年公司进行泰州华龙的厂房建设以及相关生产设备的购置安装，2010年泰州华龙投入生产运营后，公司产能扩大至250亿只；2011年公司购买了位于东钱湖镇红林村32701平方米土地，并取得了甬东旅国用（2011）第36-085号国有土地使用证。

（二）未来可预见的资本性支出计划

截至本招股说明书签署日，除本次股票发行募集资金的投资计划外，公司无其它可预见的重大资本性支出计划。

本次发行对公司主营业务和经营成果的影响参见本招股说明书“募集资金运用”章节的有关内容。

五、财务状况和盈利能力的趋势分析

（一）财务状况

公司资产结构中流动资产、非流动资产所占比重合理，资产负债率较高，流动负债占负债比重较高。公司流动比率、速动比率偏低，短期偿债能力仍待提高。随着业务规模的不断扩大，预计公司今后几年固定资产绝对值仍会增加，主营业务收入能保持稳定增长，资产结构仍能保持合理状态。公司经营活动产生的现金流状况良好，预计今后几年公司仍将保持良好的现金流量。

（二）盈利能力

近几年的财务指标显示公司具有持续增强的盈利能力，公司将充分把握本次

申请公开发行上市的机会，通过直接融资扩大公司的经营规模和资产规模，在行业稳步发展的情况下，进一步巩固公司在本行业的地位。

公司管理层认为，公司将继续保持稳定增长的发展趋势。

第十二章 业务发展目标

一、发展计划

（一）发展战略

根据发展规划，公司至 2014 年的中期目标：

1、发展目标：成为国内领先、国际先进的半导体塑封引线框架制造企业，在半导体引线框架行业中创国内第一品牌，力争 2014 年公司营业额达到 8 亿元。

2、核心业务：以半导体塑封引线框架为核心业务，重点发展高精度集成电路、贴片器件、功率器件和汽车功率器件引线框架等核心产品，提高精密级进模的设计制造能力。

3、发展方式：扎实积累企业发展要素和战略性资源，通过公司上市募集资金、企业并购重组实现产业扩张和快速增长。

（二）未来三年内的整体发展计划

1、产品计划

（1）高精度集成电路引线框架，以国家 02 重大科技专项配套项目实施为契机，形成 LQFP 系列引线框架的产业化生产能力。为国内重点集成电路封装企业提供完全可以取代进口的高质量引线框架。

（2）贴片式 LED 系列引线框架的产业化，有利于企业扩大市场份额，发展高利润产品，也有利于推动国家低碳经济政策落实。

（3）功率器件特别是功率模块在未来新型汽车特别是新能源汽车中扮演着至关重要角色，为这些功率器件配套的引线框架是公司未来三年研发的重点之一。

（4）高档塑封模的开发，进一步完善了公司的产业链，同时也为及时将新产品推向市场创造了条件。

2、市场计划

2010 年公司产品在国内半导体封装行业中市场占有率为 8%左右，未来通过扩大产能，更新产品品种，进一步提升公司的市场占有率，具体途径如下：

(1) TO、SOT 系列分立器件用引线框架质量进一步提高和产能增加,可以基本消除目前供不应求的状况,满足了客户日益增长的需求。

(2) DIP、SOP、QFP 等第一代和第二代集成电路用引线框架的产业化,提高了公司市场竞争力,可以满足高档集成电路封装材料的国产化,使产品逐步走向国际市场。

(3) 目前 BGA、PGA、CSP、MCM、SIP 等先进封装技术已经在国内部分企业中逐步应用,工程技术中心的技术升级,有利于公司及时跟踪国际先进技术,使公司保持行业中的技术领先地位。

3、研发计划

2010 年已将现公司高精度塑封引线框架工程(技术)中心由市级升级为省级工程(技术)中心,计划于 2014 年升级为国家级工程(技术)中心。

工程(技术)中心现有研发人员 60 余人,其中中高级技术人员 10 人,是一支具有独立研发高速精密冲压模具和电镀工艺新技术的开发团队,计划到 2014 年形成一支 150 人的研发队伍。

在现有工程技术中心的基础上进行技术升级,在原有设计制造新产品模具 60 副的能力基础上,新增 108 副模具设计制造能力,形成年模具总设计制造能力为 168 副的生产规模,其中 144 副高速精密级进冲裁模,24 副高精密塑封模。

4、人力资源计划

人力资源的开发和优化配置是公司发展的重要环节,根据公司未来三年的发展计划,需要引进大量优秀技术人才,公司将执行如下人力资源计划:

(1) 继续倡导以人为本的企业文化,创造优良的工作生活环境,进一步完善技术骨干的优惠政策,提高员工对企业的满意度,充分发挥员工的专业技能。

(2) 加大人才引进的力度,特别是高级技术人才和管理人才的引进。

(3) 在现有基础上进一步加强对公司员工的培训力度,全面提高员工的综合工作能力和技术业务水平。重点抓好检验员的技术能力培训和公司管理部门有关人员企业管理能力的提高。

(4) 加强人才激励机制建设,对技术骨干和高级管理人员实行年薪制,逐步试行股权激励计划。

5、管理计划

公司将一如既往以人为本,建立和健全各项规章制度,加强企业文化建设,

为员工创造和提供一个和谐流畅、规范有序的工作环境，充分发挥全体员工的工作主观能动性。

按照《上市公司治理准则》规定，建立有效的决策机制和内部管理机制，做到企业决策科学化，运行管理规范化。根据公司的发展，适时调整管理组织机构，建立一支科学、合理、高效的管理团队，以适应企业不断发展的需要。

6、营销计划

公司在国内已经建立了成熟稳定的销售和服务网络，基本覆盖了国内主要客户。随着募集资金项目的实施，公司将进一步加强重点客户的销售力量，并逐步拓展高端市场。

公司将完善营销人员的招聘、培训、激励等管理制度的建设，培育一支高素质和开发能力强的企业营销团队。2014 年使公司产品国内市场占有率达到 11% 左右。

公司将逐步充实具备专业知识的集成电路塑封模具销售工程师，开拓和建立一支塑封模具销售队伍。

二、拟订上述计划所依据的假设条件

本公司在拟订发展目标时，主要依据以下假设条件：

- 1、公司持续良好经营；
- 2、国家有关政策及社会经济环境未出现重大变化；
- 3、本次上市公开发行计划顺利实施，拟投资项目如期完成并产生预期效益。

三、实施上述计划将面临的主要困难

在实施本计划时，公司面临的主要困难是：国家产业政策是否发生重大变化；国际引线框架行业强国对我国市场产生的压力；高级技术人才和管理人才是否能够如期引进；公司内部管理能否适应快速发展的需求；能否建立稳定的融资渠道等不确定因素。

四、业务发展规划与现有业务的关系

上述业务发展规划是在现有业务基础上，按照公司发展的战略目标和要求制定的。发展规划的实施，将使公司主营业务在业务广度和深度上得到全方位的发展，使公司产品结构更为合理，产品的科技含量和市场竞争力大幅度的提高，从而全面提升公司的综合实力，有助于巩固和进一步提高公司在行业中的领先地位。

位。

现有产品主要有集成电路和分立器件封装用两大类引线框架，在产品结构上，产品覆盖了 TO、SOT 系列分立器件用引线框架和 DIP、SOP、QFP 等第一代和第二代集成电路用引线框架，通过募资项目的实施，将大幅提高 DIP、SOP、QFP 等第一代和第二代集成电路用引线框架以及功率器件引线框架在公司总产量中的比例，2014 年使公司产品国内市场占有率达到 11%左右。

五、确保实现上述发展计划的主要途径

本次募集资金对于本公司实现前述发展目标至关重要，主要体现在：

1、募集资金为实现业务发展提供了充足的资金保障，保证了公司能够紧随行业发展趋势，保持产品先进性的同时，也为公司进一步再筹措资金建立了与资本市场的通道。

2、通过募集资金项目的实施，及时引进国外先进技术设备，提高了产品质量，同时也迅速扩大了产能，保持了公司在行业中的技术和规模优势。提高了企业市场竞争能力。

3、本次发行上市将大大提高公司的社会知名度，增强了公司对高级技术人才和管理人才的吸引力，突现了公司人才竞争优势，进一步有利于业务发展目标的实现。

本业务发展目标是本公司在当前经济形势和市场环境下，对可预见的将来作出的发展计划和安排。投资者不应该排除本公司根据经济形势变化和经营实际状况对本发展目标进行修正、调整和完善的可能性。

第十三章 募集资金运用

一、本次募集资金投资项目概况

经公司2010年第一次临时股东大会决议通过，公司本次拟向社会公开发行2,500万股，占发行后公司总股本的25%，实际募集资金扣除发行费用的净额为【】万元，将用于对泰州华龙增资实施“年产半导体引线框架、接插件等电子电器配件300亿只项目”（以下简称“300亿只引线框架项目”）、公司实施“高精度塑封引线框架工程（技术）中心升级项目”（以下简称“引线框架工程中心升级项目”）及主营业务发展所需的营运资金。

公司所募集的全部资金将存储在董事会决定的专门账户集中管理，做到专款专用，募集资金专门账户开户银行为【】，开户账号为【】。

本次募集资金投向经公司股东大会审议批准，由董事会负责具体实施，根据项目轻重缓急顺序拟用于以下项目：

单位:万元

| 项目名称 | 总投资 | 备案号 |
|---------------------|--------|---------------|
| 1、300亿只引线框架项目 | 18,000 | 泰发改备[2010]15号 |
| 2、引线框架工程中心升级项目 | 5,000 | 甬经信技核[2012]1号 |
| 3、用于公司主营业务发展所需的营运资金 | 【】 | |

上述两项目预计资金投入的时间进度如下表所示：

单位：万元

| 项目名称 | 建设期 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 合计 |
|----------------|------|------|------|------|------|-----|-------|
| 1、300亿只引线框架项目 | 30个月 | 7109 | 2270 | 4803 | 2820 | 999 | 18000 |
| 2、引线框架工程中心升级项目 | 18个月 | 2436 | 2126 | 438 | - | - | 5000 |
| 合计 | | 9545 | 4396 | 5241 | 2820 | 999 | 23000 |

引线框架扩产项目分两期实施，总建设期为30个月。目前一期工程已建设完毕并投产，公司以自有资金先期投入8,154.90万元，二期工程待募集资金到位后尽快安排实施。

公司将严格按照相关规定使用本次公开发行募集资金，募集资金如有不足，资金缺口由公司自行解决。

二、本次募集资金投资项目具体情况

（一）年产半导体引线框架、接插件等电子电器配件 300 亿只项目

本项目拟由发行人控股子公司泰州华龙在江苏省泰州市海陵工业园区兴建，项目将新增引线框架产能 300 亿只，项目总投资 18,000 万元，建设期 30 个月。项目达产后泰州华龙引线框架产能将达到 300 亿只。

本项目已获江苏省泰州市发展和改革委员会同意并备案（备案号：泰发改备[2010]15 号）。

1、项目投资必要性分析

（1）国内半导体行业需求旺盛，未来仍将保持高速发展

我国是整机产品的生产大国，彩电、冰箱、洗衣机、空调、汽车、手机、PC、数字影碟机等产量在世界均名列前茅，对各种电接插元件需求呈持续旺盛的态势。从 2005 年开始我国就成为世界半导体消费第一大国，2008 年我国半导体消费金额占到全球销售额的 38.3%。整机业的快速发展给我国半导体行业带来了较好的市场机遇。

在经历了 2008 年金融危机后，国家颁布了一系列措施促进国内需求增长，尤其是《电子信息产业调整和振兴规划》的颁布以及家电下乡、第三代移动通信网络、下一代互联网、数字广播电视网络、宽带光纤接入网络和数字化影院建设等一系列扩大内需措施的实施，电子信息产业的发展空间进一步拓展，直接拉动国内半导体消费需求。2010 年我国半导体消费额占全球销售额的比例上升到 42.4%。

尽管近年来我国半导体行业通过快速发展，规模得到了迅速提升，国内半导体需求的自给率逐步提升，但是截至目前供需缺口仍然较大。根据 CSIA 的统计，2010 年我国半导体产业销售额 2,575.6 亿元，同期我国半导体总需求为 8,477.0 亿元，我国半导体产业的总供给仅能满足国内需求的 30.38%。

在巨大需求的拉动下，一方面国内企业由于产能和技术水平的提高，生产规模将逐步变大，另一方面国外企业将生产基地逐步向国内转移，我国的半导体行业面临较为长期的发展机遇。根据中国半导体行业协会的预测，我国半导体产业在未来 5 年内仍将保持高速发展。伴随着我国半导体产业的快速发展，引线框架等上游基础产业也将面临重大的发展机遇。

(2) 公司目前急需扩大现有产能，提升产品结构

报告期内，公司主要产品的产能、产量数据如下表所示：

| | 2011 | 2010 | 2009 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 产能（万只） | 2,500,000 | 1,750,000 | 1,355,600 |
| 产量（万只） | 1,525,320 | 1,509,752 | 1,048,867 |

注：2009年、2010年产能系全年加权平均数。

引线框架企业的产能一般以生产框架的只数来粗略框定，其中包含了不同的引线框架产品结构。生产不同类型的引线框架需要耗用的工时差别较大，其中TO-92系列引线框架和SOT系列引线框架每班平均产量最大，约相当于TO-220系列引线框架每班平均产量的7-10倍。由于冲制设备的通用性，所以准确衡量设备的利用率需要将产能折算成标准产能和标准产量来计算。以全部按照生产TO-92系列产品为标准，折标后公司主要产品的产能、产量和产能利用率数据如下表所示：

| | 2011 | 2010 | 2009 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 标准产能（万只） | 4,134,417 | 3,191,750 | 2,610,146 |
| 标准产量（万只） | 2,983,765 | 2,892,865 | 1,911,903 |
| 产能利用率（%） | 72.17 | 90.64 | 73.25 |

公司报告期内主要产品产销率如下表所示：

| | 2011 | 2010 | 2009 |
|-----------|-------|-------|--------|
| 分立框架用引线框架 | 99.44 | 99.27 | 98.37 |
| 集成电路用引线框架 | 96.82 | 99.15 | 100.93 |

为了适应我国半导体行业快速发展的要求，公司急需扩大现有产能和提升产品结构，争取在我国半导体产业快速发展过程中取得更大的市场份额。

2、产品市场前景分析

根据市场运行状况，顺应市场发展，本项目总产品方案初步设计如下：

一期产品：TO-92系列65亿只、TO-126系列11亿只、SOT-23系列24亿只。

二期产品：TO-92系列55亿只、TO-126系列24亿只、TO-220系列17亿只、TO-251系列15亿只、TSOT-3-5系列6亿只、SOT-223系列6亿只、SOT-23系列26亿只、DIP系列12亿只、SOP系列15亿只、LQFP/QFP系列8亿只、LED系列等16亿只。

上述产品生产设备及工艺基本一致，差别仅仅体现在生产不同产品所需要的模具不同，因此公司会根据市场需求状况对上述产品结构进行适当的调整。

本项目达产后，初步设计的产品方案如下表所示：

| 类别 | 产品系列 | 年产量（亿只） | 备注 |
|---------------|------------------|---------|-----------|
| 分立器件用引线 框架 | TO-92系列 | 120 | |
| | TO-126系列 | 35 | 功率器件封装 |
| | TO-220系列 | 17 | 功率器件封装 |
| | TO-251系列 | 15 | 功率器件封装 |
| | TSOT-3-5系列 | 6 | 功率器件封装 |
| | SOT-223系列 | 6 | 功率器件封装 |
| | SOT-23系列 | 50 | 功率器件封装 |
| | LED系列等 | 16 | 光电器件封装 |
| 集成电路用引线 框架 | DIP系列 | 12 | |
| | SOP(SSOP/TSOP)系列 | 15 | |
| | LQFP/QFP/QFN系列 | 8 | 大规模集成电路封装 |
| 合计 | | 300 | |

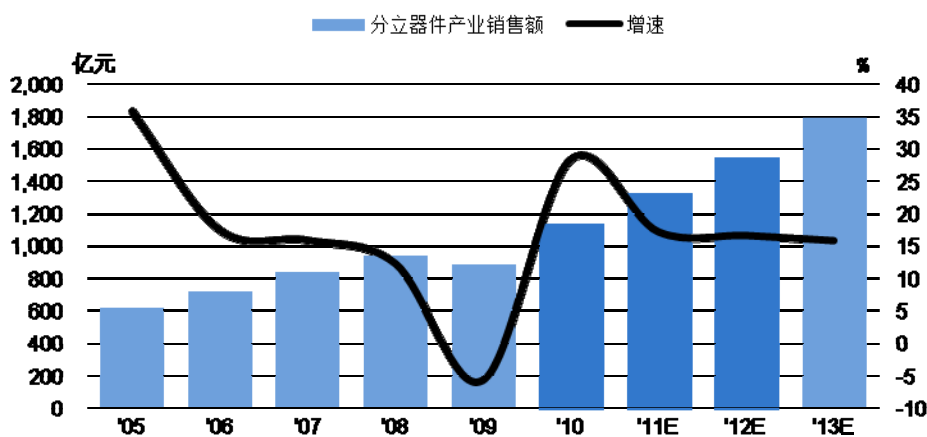
(1) 目标市场分析

公司直接下游行业为半导体封装测试行业。分立器件与集成电路的封装量直接决定了引线框架的需求量。

1、分立器件市场发展预测

根据中国半导体行业协会统计，近几年我国分立器件市场销售额以及未来三年的预测情况如下表所示：

我国分立器件产业销售额及增速

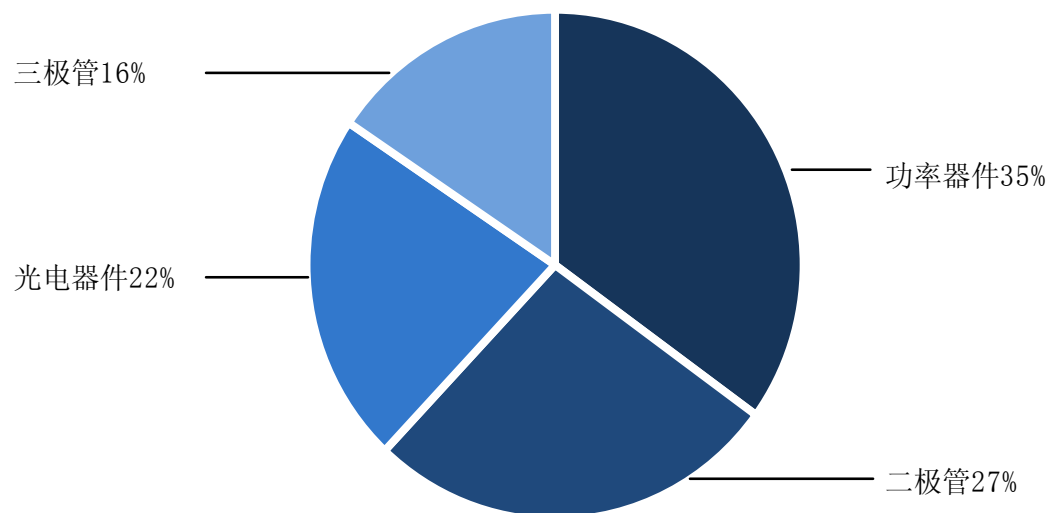


数据来源：中国半导体行业协会

分立器件包括二极管、三极管、光电器件和功率器件四大类。近几年上述四大类产品中光电二极管的销售额增长最为迅速，功率晶体管是国内分立器件市场中销售额最大的产品，二极管、三极管的市场增幅则比较平稳。2008 年我国分

立器件主要产品结构如下图所示：

2008年中国分立器件产品结构



数据来源：《中国分立器件封测产业调研报告》

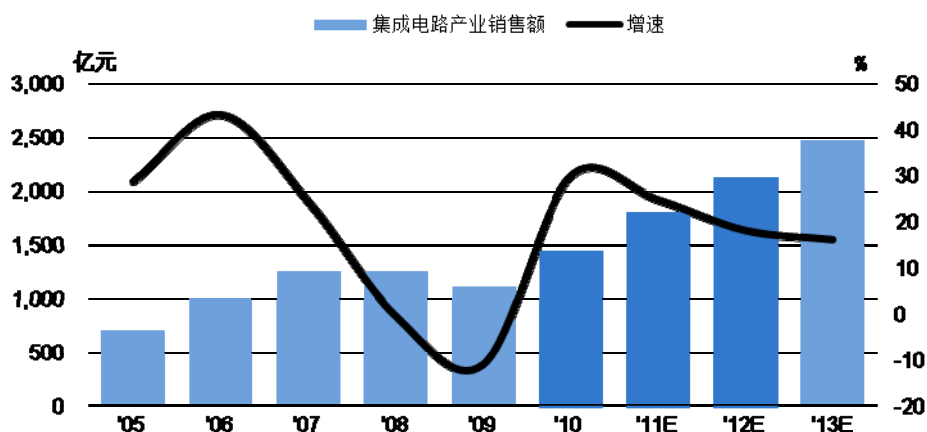
2009年8月国家发展改革委、工业和信息化部发布《关于进一步做好电子信息产业振兴和技术改造项目组织工作的通知》，制定了我国电子信息产业技术进步和技术改造投资方向，其中在分立器件方面提出半导体发光二极管和半导体电力电子器件（又称功率器件）为重点支持项目。半导体发光二极管项目重点支持大功率、高亮度半导体发光二极管的外延片和芯片制造、封装、光源模块及相关材料等；半导体电力电子器件项目重点支持功率场效应管（VDMOS）、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、快恢复二极管（FRD）等新型半导体电力电子器件的开发与产业化。

公司在本次募集资金项目实施后新增的产能将主要用于生产功率器件、光电器件封装用引线框架品种。

2、集成电路市场发展预测

根据中国半导体行业协会统计，近几年我国集成电路市场规模以及未来三年的预测情况如下表所示：

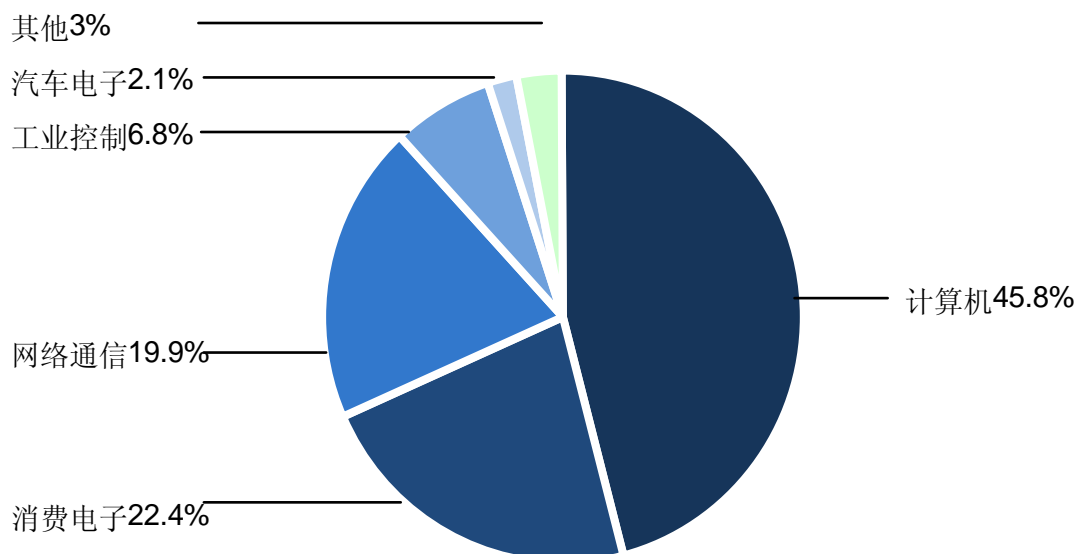
我国集成电路产业销售额及增速



数据来源：中国半导体行业协会

从集成电路市场应用结构来看，2009 年集成电路市场应用结构如下图所示：

中国集成电路市场应用结构



数据来源：CSIA

受金融危机影响，中国集成电路市场 2008、2009 年的增速则分别为 6.2%、-5.0%。在经历了 2008 年金融危机后，国家颁布了一系列措施促进国内需求增长，尤其是《电子信息产业调整和振兴规划》的颁布以及家电下乡、第三代移动通信网络、下一代互联网、数字广播电视网络、宽带光纤接入网络和数字化影院建设等一系列扩大内需措施的实施，电子信息产业的发展空间进一步拓展，直接拉动国内半导体消费需求。

中国半导体行业协会预测，未来 3 年中国集成电路市场发展速度将保持在 10%以上。分领域来看，计算机领域仍然将是未来带动市场发展最重要的领域，汽车电子和 IC 卡领域虽然可能保持相对较高的发展速度，但是由于所占份额太小，对整体市场无法产生较大影响，其它领域市场将会随着全球经济的好转有一定程度的复苏。未来智能手机、笔记本电脑、液晶电视，电子书、智能表，监控和医疗电子产品等将可能成为推动集成电路市场发展的热点产品。整体来看，从 2010 年开始，中国集成电路市场已步入一轮新的成长期，但市场的发展速度将不会再现前几年的高速增长态势，平稳增长将成为未来中国集成电路市场发展的主要形式。

未来几年，中国汽车电子类集成电路市场的发展速度将保持最快；计算机类、消费类、网络通信类和工控类将随集成电路整体市场波动，整体上保持相对平稳的发展速度。计算机领域仍然是中国集成电路市场最大的应用；其比重将一直保持在中国集成电路市场 45%左右；其次是消费类和网络通信类，二者将占有超过 40%的市场比重。

（2）竞争对手分析

请参见招股说明书第六节三（二）主要竞争对手情况。

（3）本项目的销售计划及销售措施

本次实施引线框架扩产项目是公司结合目前引线框架行业供求状况、未来行业发展趋势以及公司自身产能利用情况确定的。

本项目完成后，公司引线框架产能将显著增加，公司将着力在以下方面采取积极措施来开拓市场。首先，通过销售人员做好现有客户维护工作，并安排技术人员参与重点客户的半导体产品设计，进而根据客户的要求专门设计、定制客户特别需要的引线框架；其次，公司将继续实施成本领先的价格策略，具体表现为同等技术水平和质量的产品，公司产品定价比同技术水平的进口产品低约 10%~30%，以此来争取新客户，获取进口产品市场份额。

3、投资概算情况

本项目总投资 18,000 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

| 序号 | 工程和费用名称 | 金额 | 占总投资的百分比 (%) |
|-------|---------|--------|--------------|
| 1 | 建设投资 | 15,064 | 83.69 |
| 1.1 | 工程费用 | 11,570 | 64.28 |
| 1.1.1 | 建设工程费 | 5,273 | 29.29 |

| 序号 | 工程和费用名称 | 金额 | 占总投资的百分比(%) |
|-------|----------|--------|-------------|
| 1.1.2 | 设备购置安装费 | 6,297 | 34.98 |
| 1.2 | 工程建设其他费用 | 2,877 | 15.98 |
| 1.3 | 预备费 | 617 | 3.43 |
| 2 | 建设期利息 | 485 | 2.69 |
| 3 | 铺底流动资金 | 2,451 | 13.62 |
| 4 | 总投资 | 18,000 | 100.00 |

(1) 固定资产投资总额

本项目固定资产主要由新建厂房、土地购置以及生产设备购置构成，其中，设备购置安装 6297 万元，建筑工程费 5273 万元，工程建设其他费用 2877 万元，预备费 617 万元。

(2) 流动资金估算

根据该项目的建设及运营特点，铺底流动资金 2451 万元。

4、主要生产设备

项目新增主要设备如下：

| 设备名称 | 数量 | 金额(万元) |
|---------------|----|--------|
| 台湾高速冲床 | 22 | 1440 |
| 日本高速冲床 | 10 | 1600 |
| 全自动电镀生产线 | 9 | 1660 |
| 全自动切断生产线 | 30 | 400 |
| 20T 纯水设备 | 1 | 100 |
| 全自动废水处理回用系统工程 | 1 | 600 |
| 辅助设备 | 21 | 200 |
| 各类量具、相关检测设备 | 5 | 217 |
| 变配电设备 | 1 | 80 |
| 合计 | -- | 6297 |

5、项目的技术水平和生产工艺流程

(1) 技术水平

目前公司产品覆盖了 TO、SOT 系列分立器件用引线框架和 DIP、SOP、QFP 等第一代和第二代集成电路用引线框架，是目前国内产品品种较为丰富的引线框架生产企业。本项目的实施除了扩大现有产品产能外，将新增 LQFP/QFP 系列、LED 系列引线框架产品，其中，LQFP/QFP 系列引线框架为公司承担的国家重大科技专项中的研发成果，具有自主知识产权。公司生产上述新增产品的核心生产技术及其取得方式如下表所示：

| 产品系列 | 核心技术 | 取得方式 |
|-----------------|------------------|---------------|
| LQFP/QFP 系列引线框架 | 1、LQFP 引线脚共面性制造技 | 自主开发,拥有完全知识产权 |

| | | |
|------------|--|--|
| | 术 2、全自动贴胶成型技术 3、高精度环岛电镀技术 | |
| LED 系列引线框架 | 1、高精度正反面喷镀技术 2、多只一致性注塑制造技术 3、多只一致性折边成型制造技术 | |

(2) 工艺流程

产品工艺流程同本公司现有引线框架产品工艺流程，详见本招股说明第六章“业务与技术”之四“主营业务情况”。

6、主要原材料、辅助材料和能源供应情况

本项目所需主要原材料和辅助材料与公司目前生产所需原材料和辅助材料品种基本一致，均可以利用现有供应渠道得以解决，原材料和辅助材料供应充分。

本项目主要所需能源为电力，电力供应充分。

7、投资项目的选址

本项目拟建于江苏省泰州市海陵工业园区，征地手续已于 2009 年完成，并已取得相关的土地使用权证（土地使用权证号泰州国用（2009）第 7016 号）。

8、投资项目可能存在的环保问题及采取措施

本项目产生的主要污染物及拟采取的措施如下表所示：

| 主要污染物 | 拟采取的措施 |
|-----------------------------------|---|
| 废气：电镀过程中挥发的硫酸雾 | 在每个镀槽上方安装集风罩，将工艺废气集中后由碱水喷淋酸雾吸收塔吸收后排放 |
| 废水：电镀过程中产生的含氰铜废水、含氰银废水、含镍废水、含酸铜废水 | 拟投资 700 万元分别设置自动废水处理装置，不同的废水经过不同的处理工艺，废水经处理后约 80%循环回用，其余废水达到《电镀污染物排放标准》后经泰州市第一城南污水处理厂管网达标排放 |
| 固废：电镀工序产生的废渣、废品 | 委托有资质处理单位进行处理 |
| 噪音：冲制车间的噪音 | 采取建筑物隔音措施、基础减振和设置隔音操作室 |

本项目委托泰州市环境科学研究所出具环境影响报告书，并经泰州市环境保护局批复（泰环计[2009]45 号）。

9、项目组织方式和进展情况

(1) 项目组织方式

本项目由发行人控股子公司泰州华龙电子有限公司实施。

由于本次增资子公司泰州华龙属本公司全资拥有，增资资金直接增加泰州华龙的注册资本和实收资本，没有溢价或折价产生。泰州华龙股东会已同意增资事宜，股东也已签署了增资协议，待公司募集资金到位后，将由本公司直接投入泰州华龙。

1) 泰州华龙基本情况

住 所： 泰州市海陵工业园泰祥路西侧、凤凰东路北侧

法定代表人： 陈亚龙

成立时间： 2008年7月31日

注册资本： 5000万元

实收资本： 5000万元

注册号： 321200000015091

股权结构： 公司持有其99%股权，铭龙技术持有1%股权

经营范围： 电子元件、继电器配件、电声器配件、接插件、电器配件、半导体器件及半导体引线框架生产销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2) 泰州华龙最近一年资产负债表和利润表

① 资产负债表

| | | 单位:万元 |
|---------|------------|-----------|
| 项 目 | 2011.12.31 | |
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | | 207.18 |
| 应收帐款 | | 288.52 |
| 预付款项 | | 73.14 |
| 其他应收款 | | 86.73 |
| 存货 | | 2,157.11 |
| | 流动资产合计 | 2,812.67 |
| 非流动资产： | | |
| 固定资产 | | 5,425.45 |
| 在建工程 | | 848.71 |
| 无形资产 | | 2,152.78 |
| 长期待摊费用 | | 8.02 |
| 递延所得税资产 | | 63.97 |
| | 非流动资产合计 | 8,498.94 |
| | 资 产 总 计 | 11,311.61 |
| | | - |
| 流动负债： | | |
| | | - |

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| 短期借款 | | 1,000.00 |
| 应付账款 | | 4,543.55 |
| 应交税费 | | -447.34 |
| 其他应付款 | | 1,487.39 |
| | 流动负债合计 | 6,583.59 |
| | 负债合计 | 6,583.59 |
| 股东权益： | | - |
| 股本 | | 5,000.00 |
| 未分配利润 | | -271.98 |
| 归属于母公司股东权益小计 | | 4,728.02 |
| | 股东权益合计 | 4,728.02 |
| | 负债和股东权益总计 | 11,311.61 |

② 利润表

单位:万元

| 项目 | 2011 年度 |
|--------------------|-----------|
| 一、营业收入 | 19,514.34 |
| 减：营业成本 | 18,941.54 |
| 销售费用 | 38.65 |
| 管理费用 | 469.62 |
| 财务费用 | 51.36 |
| 资产减值损失 | 7.55 |
| 二、营业利润 | 5.62 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 3.25 |
| 减：所得税费用 | -63.97 |
| 四、净利润(净亏损以“-”填列) | 67.22 |

(2) 项目进展情况

本项目分两期建设，总建设期为 30 个月。目前一期工程已完工并投入生产。公司以自有资金投入一期工程建设，截止 2011 年 12 月 31 日，公司合计投入自有资金 8,154.90 万元。二期工程待募集资金到位后尽快安排实施。

10、投资项目的经济效益分析

本项目全部完工后，经济效益指标如下表所示：

| 计算指标 | 所得税前 | 所得税后 |
|-----------------|--------|--------|
| 项目财务内部收益率(%) | 38.50 | 29.80 |
| 财务净现值(ic=12%)万元 | 22,507 | 14,642 |
| 投资回收期(年) | 5.09 | 5.78 |

（二）高精度塑封引线框架工程（技术）中心升级项目

1、项目投资必要性

（1）模具制造能力是引线框架企业的核心竞争力

模具是引线框架生产过程中关键的工艺装备。在冲压法生产引线框架过程中，冲制材料铜带由模具经高速冲床自动冲压形成引线框架。引线框架的成型以及是否能够满足下游封装的需求，都依赖于冲压模具的精确度。随着封装技术的发展，集成电路和分立器件都朝着更小的外形、更高的性能方向发展，这就对半导体封装材料引线框架精密度提出更高的要求，引线框架也逐步向多脚数、小尺寸、高精度方向发展。精密模具制造技术逐渐成为冲压法生产引线框架的核心，模具生产技术水平的高低，成为衡量一个引线框架生产企业制造水平高低的重要标志，并在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力。

模具制造能力的高低主要体现在模具设计、零配件制造以及模具的装配等三个方面。

模具设计是引线框架制造的核心和关键技术，是制造引线框架的前提。冲压模具设计的好坏直接关系到模具的精度、寿命和生产效率。冲压模具设计技术，主要取决于模具设计人员的技术水平和经验积累。模具的结构和制造精度决定了引线框架的档次和质量。模具的精度也影响到产品的成本。

零配件是安装在冲压模具上的工作零件，应用于与材料的直接接触，使材料发生形变，裁切材料。工作零件精确度直接影响模具的精确度，从而影响到引线框架的精确度。工作零件的精确度主要取决于机械加工设备精度以及操作人员的技术水平和经验积累。

冲压模具的装配技术也是引线框架制造的关键技术。冲压模具装配的好坏直接影响所冲制的引线框架产品的精度和稳定性。冲压模具的装配技术主要取决于模具装配工人的技术水平和经验。

（2）公司产能扩张导致对模具需求量上升

公司原有模具中心具备年产 60 副冲压模具的生产能力，与公司原有 150 亿只引线框架产能相配套。在泰州华龙年产半导体引线框架、接插件等电子电器配件 300 亿只项目达产后，公司引线框架产能将达到 450 亿只，公司需要对现有的冲压模具生产能力进行扩产。本项目实施完成后，可以形成每年设计制造 144 副高速精密级进冲裁模和 24 副高精度塑封模的生产能力。

另一方面，公司计划在现有设备的基础上补充引进精密模具的关键加工设

备，在达到新产品模具设计制造和日常维修的备品备件基本自给能力的同时，具备高精度塑封模具的设计制造能力。

目前公司产品品种主要为 TO、SOT 及 SOP 等系列产品，随着本次募投项目的实施，公司将新增薄型小外形 TSOP、窄间距 QFP 和 LED 系列引线框架，高精度产品的增加也对模具制造提出了更高要求。因此，工程（技术）中心的模具制造种类需要进一步增加。

2、产品市场前景分析

本项目主要是对企业现有工程（技术）中心进行升级，主要引进精密模具先进加工设备，提升引线框架冲压模具的设计制造能力，同时对集成电路塑封模具进行研发。本项目实施后，公司新增 108 副模具设计制造能力，其中 84 副高速精密级进冲裁模，24 副高精度塑封模。

本项目实施后，在高速精密级进冲裁模方面将重点研发大规模集成电路、功率模块、表面贴装用引线框架模具的设计与生产技术，使公司在国内引线框架生产企业中高速精密级进冲裁模具的设计制造能力处于行业龙头地位。高速精密级进冲裁模为公司引线框架产能扩张相配套，不对外销售。

本项目实施后公司将具备高精度塑封模设计生产能力。塑料封装模具是半导体器件塑料封装工艺中关键性的工装。封装工艺流程如下图所示：



在塑封工序中，塑封材料需要借助塑封模具成型，它可以保证包裹电路芯片的塑料具备规定的尺寸和形状，并具有良好的电性能和物理学性能，使其满足电子产品的使用要求。塑封模的设计成功与否，直接影响电子元器件的质量及最终的使用性能。

塑封模的客户群与公司现有客户群相同，公司的客户中对塑封模存在稳定的需求。据公司进行的市场调查，2009 年公司前 5 大客户每年对塑封模具的需求量如下表所示：

| 客户名称 | 塑封模年需求量（副） |
|---------------|------------|
| 宁波明昕微电子股份有限公司 | 10 |
| 佛山市蓝箭电子有限公司 | 8 |
| 无锡华润华晶电子有限公司 | 10 |
| 深圳深爱半导体股份有限公司 | 7 |
| 深圳市晶导电子有限公司 | 7 |

项目实施后，将形成高档集成电路塑封模具的设计制造能力，这一技术弥补了本企业产品单一的缺陷，对于进一步完善企业产业链，巩固和提高在行业中的技术领先地位十分重要。

3、投资概算情况

本项目新增总投资 5000 万元，其中固定资产投资 4060 万元，流动资金 940 万元。

(1) 固定资产投资总额

本项目固定资产主要由厂房改造以及生产设备购置构成，其中，厂房改造费用以及其他费用 187 万元，设备购置 3,680 万元，预备费 193 万元。

(2) 流动资金估算

根据该项目的建设及运营特点，本铺底流动资金 940 万元。

4、主要设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 (万元) | 投资 (万元) |
|----|------------|-------------------|----|------------|------------|
| 1 | 高精度线切割机床 | ROBOFIL 440CC | 2 | 131 | 262 |
| 2 | 高精度线切割机床 | ROBOFIL 2030SI-TW | 1 | 230 | 230 |
| 3 | 高精度线切割机床 | ROBOFIL 240CCS | 3 | 102 | 306 |
| 4 | 高精度线切割机床 | AC VERTEX 1F | 1 | 250 | 250 |
| 5 | CNC 光学曲线磨 | GLS-C8 | 6 | 155 | 930 |
| 6 | 精密坐标磨床 | S35 | 2 | 350 | 700 |
| 7 | 精密平面磨床 | LGS-614S | 18 | 6 | 108 |
| 8 | 精密平面磨床 | K-P48 | 4 | 65 | 260 |
| 9 | 精密电火花加工机床 | 35P | 2 | 124 | 248 |
| 10 | 加工中心 | | 1 | 95 | 95 |
| 11 | 60 吨精密高速冲床 | MICRON C60 | 2 | 45 | 90 |
| 12 | 250 吨塑封压机 | | 1 | 25 | 25 |
| 13 | 表面轮廓和粗糙度仪 | SE-2300 | 1 | 20 | 20 |
| 14 | 万能工具显微镜 | 501F | 4 | 9 | 36 |
| 15 | 轮廓投影仪 | PH-3500 | 2 | 9.5 | 19 |
| 16 | 其他测量仪器 | | | | 101 |

5、项目的技术水平和工艺方案

本项目在原有设计制造新产品模具 60 副的能力基础上，新增 108 副模具设计制造能力，形成年模具总设计制造能力为 168 副的生产规模，其中 144 副高速精密级进冲裁模，24 副高精度塑封模。

(1) 质量标准

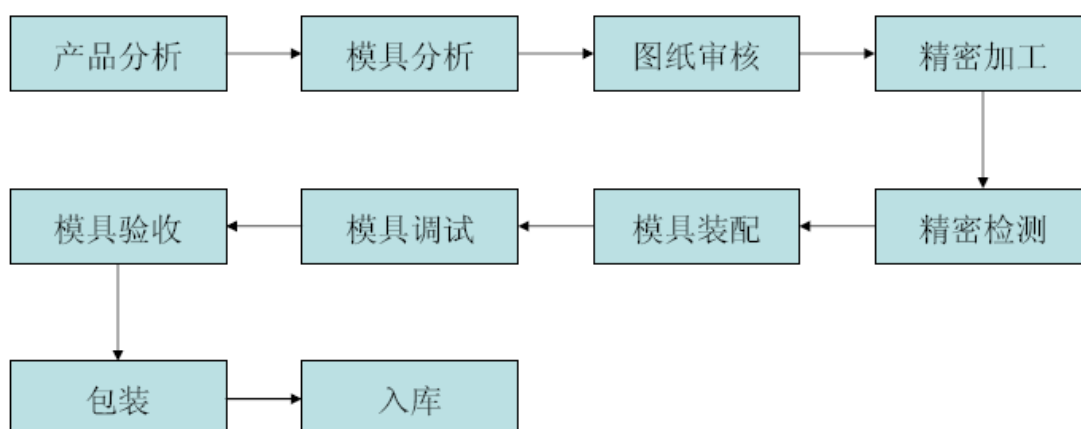
高速精密级进冲裁模产品自用，执行企业标准。公司拥有多年模具设计、制造经验，所制造的模具在新产品研发设计以及产品大批量生产过程中取得较好的效果。

塑封模对精确度、可靠性、可操作性及寿命的要求很高，技术上主要解决模具高精度、长寿命的要求，目标是达到国内领先、国际先进的水平。塑封模主要技术指标如下表所示：

| 项目 | 技术指标 |
|-------------|---------------------|
| 成型镶件布距制造精度 | 0.0002mm |
| 分型面高度一致性精度 | 0.0002mm |
| 分型面表面粗糙度 | Ra0.05 |
| 型腔表面粗糙度 | 光面 Ra0.05、亚光面 Ra0.2 |
| 成型镶件硬度 | HRC60-64 |
| 封装后产品尺寸精度 | 0.05mm |
| 封装后X、Y 方向错度 | <0.03mm |
| 寿命 | 40 次 |

(2) 工艺流程

高速精密级进冲裁模和塑封模的生产工艺流程相近，如下图所示：



6、主要原材料、辅助材料和能源供应情况

本项目所需主要原材料包括硬质合金、合金工具钢和 45# 钢等，均可以利用现有供应渠道得以解决，原材料供应充分。

本项目主要所需能源为电力，可向宁波市电力局购买，电力供应充分。

7、投资项目的选址

本项目利用宁波华龙电子高精度塑封引线框架工程（技术）中心现有厂房改造升级，不新增建筑面积。

8、项目竣工时间及新增产量和营销情况

本项目建设期为 18 个月，预计在 2012 年 12 月完成竣工验收。项目达产后，预计每年设计制造 108 副高速精密级进冲裁模的生产能力，该新增产能与泰州华龙新增 300 亿只引线框架项目相配套。

9、投资项目可能存在的环保问题及采取措施

本项目运营过程中对环境影响较小。本项目委托宁波市环境保护科学研究设计院出具环境影响报告表，并经宁波市东钱湖旅游度假区环境保护局审批。

10、项目组织方式和进展情况

本项目由华龙电子负责组织实施，目前该项目已完成前期准备工作，该项目建设期为18个月，公司将结合募集资金到位情况及公司实际情况开展项目建设。

11、投资项目的经济效益分析

本项目产出包含高速精密级进冲裁模和高精度塑封模，由于高速精密级进冲裁模不对外销售，此部分产出的效益分析通过节约成本方式进行测算，本项目经济效益指标如下表所示：

| 计算指标 | 所得税前 | 所得税后 |
|-----------------|-------|-------|
| 项目财务内部收益率（%） | 35.52 | 25.36 |
| 财务净现值（ic=12%）万元 | 5,262 | 2,889 |
| 投资回收期（年） | 4.4 | 5.33 |

（三）补充营运资金

1、补充营运资金的必要性

（1）公司采购模式的需要

公司生产所需原材料主要为铜带，在采购时尽可能保证所签订铜带采购合同

与产品销售合同相匹配，以缩短铜带库存周期，避免铜价波动对公司经营带来的影响。承接订单后，公司进行备料排产，备料充分度越高，产品交期越具保证，公司订单承接能力越强，因此备料环节对营运资金的占用程度与订单量、业务规模、交期保证度等因素呈正相关关系。同时，公司产品销售的收款周期长于铜带采购的付款周期，采购铜带对营运资金的占用较大。因此，公司必须准备充足的流动资金以保证公司的正常运营。

（2）公司财务特点分析

1) 银行贷款等财务杠杆较高

| 财务指标 | 2011/2011.12.31 | 2010/2010.12.31 | 2009/2009.12.31 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 资产负债率（母公司）（%） | 54.43 | 56.80 | 53.12 |
| 利息支出（万元） | 776.40 | 383.10 | 300.67 |
| 票据贴现息（万元） | 1,013.79 | 534.99 | 136.74 |

近年来，公司的资产负债率较高，主要原因在于公司为抓住市场机遇，适当运用财务杠杆，通过负债融资补充公司流动资金，扩大生产规模，抢占重要市场所致。报告期内公司主要利用银行贷款和票据贴现补充流动资金，支撑公司业务快速增长。

目前较高的资产负债率水平限制了公司向银行大额贷款的空间，限制了公司的举债能力，因此，补充流动资金，改善公司财务结构，降低公司负债率，缓解公司资金面紧张的局面，有利于公司及时把握市场需求。

2) 公司业务高速发展，存货、应收账款增长所需流动资金相应增加

报告期内，公司营业收入增长了63.82%，随着公司业务规模的扩张，应收账款由9,933.74万元增长至12,768.59，增长了28.54%，存货由4,798.47万元增长至11,005.67万元，增幅达129.36%，应收账款、存货增长所需流动资金相应增加。未来，随着公司募集资金扩大产能项目的逐步实施，公司将继续保持高速增长态势，公司也需要投入更多的营运资金以确保稳健、高效经营。

2、补充营运资金的管理安排

对于本次补充营运资金部分，公司将实行以下管理安排：

（1）专户管理。公司将严格按照深交所有关募集资金管理规定，将该部分资金存储在董事会决定的专门账户。

（2）严格将营运资金用于公司主营业务。公司将紧紧围绕主营业务进行资金安排，主要用于日常经营，将预先做好资金预算，合理安排资金投放时间，提高资金使用效率，实现效益最大化。

(3) 建立科学的计划体系，通过制定采购计划、资金使用计划、费用预算计划等方式平滑资金使用强度，并通过完善供应商管理制度和采购价格预警机制减少原材料、设备、人工价格波动对公司成本的影响，降低经营风险。

(4) 建立客户信用档案，对供应商的产品质量进行考评和建档，进行信用等级设置，对考评不合格的供应商进行淘汰，减少因原材料质量不合格导致的经营风险。

(5) 加强财务管理，完善收付款制度，加强对应收账款的管理及催收制度，建立并完善资金预警机制，提高公司资金管控能力。

3、补充营运资金对公司业务发展的影响

营运资金得到补充后，将增强公司的生产经营能力，降低财务风险，支持公司业务拓展，保障公司的持续创新能力。

三、本次募集资金运用对发行人财务状况及经营成果的影响

(一) 募集资金运用对公司的综合影响

本次募集资金到位后，公司将增加 2,500 万股股本，总股本将由 7,500 万股增加至 10,000 万股。公司将因此引入多元投资主体，使公司的股本结构更趋合理，更有利于建立更为完善的法人治理结构。

本次募集资金投资项目建成投产后，公司的生产能力将显著上升，产品的市场份额将进一步提高。

本次募集资金投资项目实施完成后所形成的新增生产能力及其对研发、销售等方面的积极影响，将提升公司的技术水平和国际化水平，为公司进一步的发展奠定良好的基础，增强公司的核心竞争力。

(二) 本次募集资金运用对公司财务状况和经营成果的综合影响

本次募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响具体表现在：

1、对净资产和每股净资产的影响

募集资金到位后，公司的净资产和全面摊薄的每股净资产均将大幅度增长，公司的实力将显著上升。

2、对公司资产结构的影响

募集资金到位后，在公司负债总额不变的情况下，公司的资产负债率将显著下降，公司的资产结构得以优化，举债融资的能力将大大提高。

3、对净资产收益率和盈利能力的影响

由于募集资金投资项目在短期内难以完全产生效益，而募集资金的到位将使公司净资产值大幅度提高，因此，短期内公司的净资产收益率将有所下降。随着募集资金投资项目的建成投产，主营业务收入和净利润水平将相应增长，公司的盈利能力将进一步增强。

第十四章 股利分配政策

一、股份公司设立前的利润分配政策

华龙有限章程规定，公司税后利润按下列顺序分配：

- 1、弥补上年度亏损；
- 2、提取利润的10%列入盈余公积；
- 3、分配股东红利

二、股份公司设立后的股利分配政策

公司章程规定，本公司的税后利润按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取10%的法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付普通股股东股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定或股东约定不按持股比例分配的除外。股东大会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

三、报告期股利分配情况

报告期内未进行过股利分配。

四、发行后股利分配政策

本公司于2012年2月10日召开2011年度股东大会，审议通过了上市后适

用的《公司章程（草案）》修正案，修订了第一百六十三条关于公司利润分配政策的记载。根据修订后上市后适用的《公司章程（草案）》，公司上市后的利润分配政策如下：

（一）利润分配原则

公司利润分配应充分重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。

公司在董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见。

公司可以根据盈利状况进行中期现金分红。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

（二）利润分配议案审议程序

公司董事会制订公司利润分配预案，公司监事会对利润分配预案进行审议并出具书面意见，公司独立董事发表独立意见，报公司股东大会审议决定。

如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的预案中不含现金分配方式的，应在定期报告中披露作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，公司独立董事应对此发表独立意见、公司监事会应对此进行审议并出具书面意见。

（三）利润分配形式

公司可以采取现金方式、股票方式、现金和股票相结合的方式或法律允许的其他方式分配股利。

在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，由股东大会审议决定。

在满足上述现金方式分配比例的前提下，董事会可根据公司股本规模、经营规模等因素，拟定股票方式分配预案，由股东大会审议决定。

（四）利润分配政策的修订

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见，监事会应对此事项进行审议并出具书面意见。

调整利润分配政策的议案经董事会审议通过，独立董事发表独立意见，且监事会对此事项进行审议并出具书面意见后提交股东大会审议决定，董事会应对利润分配政策调整向股东大会做出书面说明。

审议调整利润分配政策议案的股东大会除安排现场会议投票外，还应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等上市公司股东大会网络投票系统为社会公众股东参加股东大会提供便利，网络投票按照中国证监会和证券交易所的有关规定执行。

五、公司未来三年的具体股利分配计划

2012年2月10日，公司2011年度股东大会审议并通过了《关于宁波华龙电子股份有限公司2012-2014年度分红计划的议案》。决议未来三年（2012-2014年）公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

六、发行完成前滚存利润的分配安排

根据发行人2010年第一次临时股东大会决议，本次公开发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。

第十五章 其他重要事项

一、信息披露制度

根据《公司法》、《证券法》等有关法律的要求，本公司已制定了较为严格的信息披露基本制度和较为完备的投资人服务计划。公司股票如果能成功发行并上市，将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关要求进一步完善和严格信息披露制度和投资人服务计划，更好地履行信息披露制度。

（一）公司信息披露媒体

公司信息披露制定刊载报刊为《中国证券报》和其他中国证监会指定报刊。公司定期报告、章程、招股说明书除载于上述报纸之外，还载于中国证监会、证券交易所指定的证券交易所网站。

（二）为投资者服务计划

1、严格认真履行信息披露义务，投资者将通过本公司公开信息的披露对本公司进行了解。

2、公司在发行上市等重大事件发生时，除按法定程序进行信息披露外，还将通过网上路演等形式为投资者服务。

3、认真做好投资者的咨询服务及接待工作，开辟专用通讯渠道，以满足投资者的沟通需要。

4、建立完善的档案资料保管制度，在法律法规允许的前提下，保证投资者获取及时、全面的资料查询。

5、依法开好每年的股东大会，让投资者对会议决议事项充分发表意见，并获得最大的信息量。

（三）负责信息披露和投资者服务的机构

- 1、负责机构：证券部
- 2、负责人：张秉
- 3、咨询电话：（0574）88378368-8005
- 4、传真：（0574）88378258

二、重大合同

截至本招股书出具之日，公司及其控股子公司正在履行的重大合同如下：

（一）采购合同或协议

截至本招股书出具之日，公司及其控股子公司正在履行的重大采购合同或协议如下：

2012年1月19日，发行人与中铝华中签署《供货框架协议》，双方约定由发行人根据自身需求确定向中铝华中购货，具体交易的标的、数量、价格、交货日期等由双方共同确认的订单为准。该协议有效期自2012年1月1日起至2012年12月31日止，期满双方如无异议，协议自动顺延一年。

（二）重大抵押、借款、应收账款保理业务合同

1、抵押合同

| 编号 | 合同签订日期 | 合同到期日期 | 合同编号 | 担保人 | 抵押物 | 债权人 | 保证范围 (万元) |
|----|--------------------|--------------------|---------------------------|----------|---|----------------|--------------|
| 1 | 2011年 5月16 日 | 2014年 5月16 日 | ZQ9417201100 000040 | 发行人 | 房屋所有权证书编号为甬房权证东旅字第F200903471号；土地使用权证书编号为甬东旅国用2010第36-007号 | 浦发银行鄞州支行 | 880 |
| 2 | 2011年 6月13 日 | 2012年 6月13 日 | 最抵授字第 20110014214 号 | 泰州华 龙 | 土地使用权权属证书编号为泰州国用(2009)第7016号 | 宁波鄞州农村合作银行五乡支行 | 1900 |
| 3 | 2012年 3月9日 | 2015年 3月6日 | 821006201200 01746 | 发行人 | 土地使用权权属证书编号为甬东旅国用2010第36-085号 | 农行钱湖支行 | 720 |
| 4 | 2012年 3月13 日 | 2013年 2月22 日 | 821006201200 01839 | 发行人 | 土地使用权权属证书编号为甬东旅国用2009第36-0033号 | 农行钱湖支行 | 3670 |

2、借款合同

| 编号 | 签订时间 | 借款合同号 | 贷款人 | 贷款到 期日 | 贷款利 率 | 贷款金额 (万元) | 担保方式 |
|----|----------------|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------|--------------|--|
| 1 | 2011年5 月24日 | 82010120110 004602 | 农行鄞 州支行 | 2012年 5月23 日 | 基准下 浮 10%， 按月调 整 | 600 | 由 8201005220110 000003号《最高 额保证合同》提 供保证担保 |

| | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|------|---|
| 2 | 2011年6月16日 | 鄞银（五乡支行）借字第20110026509号 | 宁波鄞州农村合作银行五乡支行 | 2012年6月13日 | 基准上浮7%，按月调整 | 1200 | 由鄞银（五乡支行）最抵字第20110014214号抵押合同、鄞银（五乡支行）最保字第20110615号保证合同提供担保 |
| 3 | 2011年9月14日 | 82010120110007825 | 农行鄞州支行 | 2012年9月13日 | 基准下浮10%，按月调整 | 810 | 由820100522011000003号《最高额保证合同》提供保证担保 |
| 4 | 2011年11月4日 | 94172011280639 | 浦发银行鄞州支行 | 2012年11月4日 | 基准上浮25%，按季调整 | 700 | 由ZQ94172011000040号《最高额抵押合同》提供抵押担保 |
| 5 | 2012年3月12日 | 82010120120001973 | 农行钱湖支行 | 2012年3月12日 | 基准下浮10% | 500 | 由82100620120001746号《最高额保证合同》提供保证担保 |
| 6 | 2012年3月14日 | 82010120120002073 | 农行钱湖支行 | 2013年2月13日 | 基准下浮10% | 950 | 由82100620120001839号《最高额抵押合同》提供抵押担保 |
| 7 | 2012年3月19日 | 82010120120002210 | 农行钱湖支行 | 2013年2月8日 | 基准下浮10% | 900 | 由82100620120001839号《最高额抵押合同》提供抵押担保 |
| 8 | 2012年3月21日 | 82010120120002288 | 农行钱湖支行 | 2013年3月21日 | 基准下浮10% | 650 | 由82100620120001839号《最高额抵押合同》提供抵押担保 |

3、应收账款保理业务合同

2011年7月12日，公司与工行宁波东门支行签订了编号为2011(EFR)00057号的有追索权的《国内保理业务合同》，合同约定的保理融资额为2000万元，融资利率为基准利率下浮10%，按月调整。

（三）其他重要合同

1、发行人与海通证券于2010年6月25日签订《保荐协议》，发行人聘请海通

证券作为公司首次公开发行股票保荐机构。

2、发行人与海通证券于2010年6月25日签订《承销协议》，就承销本次公司发行人民币普通股股票事宜进行了具体的约定。

3、2009年1月22日，发行人与泰州市鑫海投资有限公司签订《项目发展扶持协议》，泰州市鑫海投资有限公司提供资金1,277.39万元用于泰州华龙的建设，使用期为两年。2011年1月22日，发行人与泰州市鑫海投资有限公司签订《项目发展扶持协议》延期协议，予以延期两年。

三、对外担保

截至本招股说明书签署之日，公司不存在对外担保事项。

四、重大诉讼或仲裁

截至本招股说明书签署之日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署之日，公司的控股股东或实际控制人、控股子公司，以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

五、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况

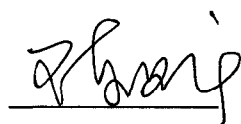
截至本招股说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼情况。

第十六章 董事、监事、高级管理人员 及有关中介机构声明

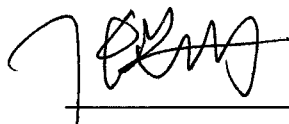
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

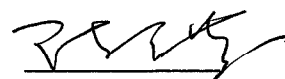
全体董事签名：



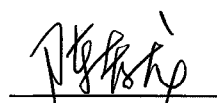
陈亚龙



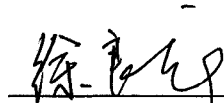
张善国



陈召芬



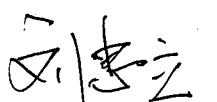
陈孝龙



徐良龙



石磊



刘忠立

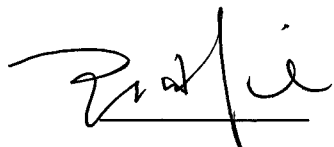


王建章

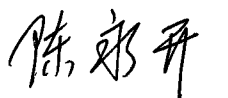


包新民

全体监事签名:



王国强

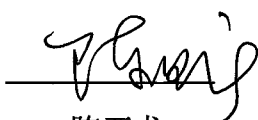


陈永开

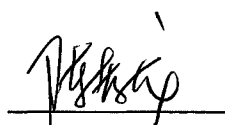


李东亚

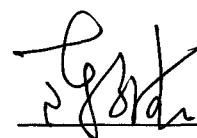
全体高级管理人员签名:



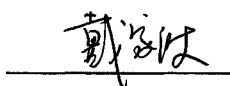
陈亚龙



陈孝龙



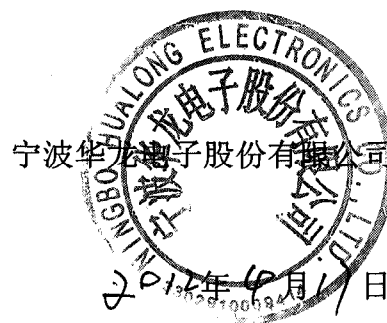
陈永德



戴家波



张秉



二、保荐机构（主承销商）声明

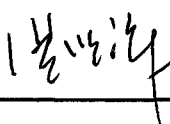
本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：



丁颖芳

保荐代表人：



洪晓辉



刘昊

法定代表人：



王开国



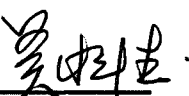
发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：


徐军
顾海涛

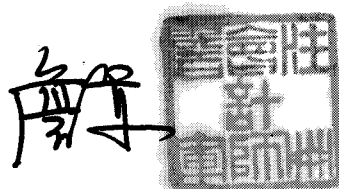
律师事务所负责人：


吴明德

四、承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

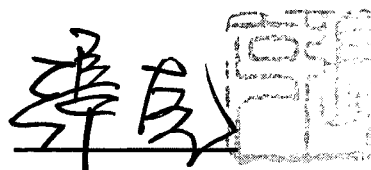


詹军



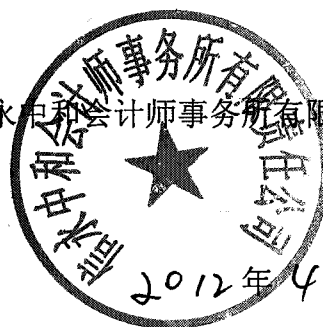
叶胜平

审计机构负责人：



张克

信永中和会计师事务所有限责任公司



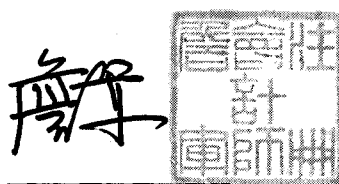
2012年4月1日

(仅供宁波华龙电子股份有限公司首次公开发行股票之用)


五、承担验资业务的机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构2008年9月25日出具的验资报告（XYZH/2007SHA1013-3）无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



詹军



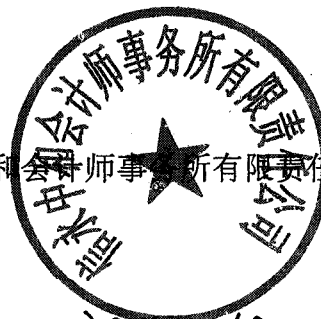
叶胜平

验资机构负责人：



张克

信永中和会计师事务所有限责任公司



2012年4月11日

（仅供宁波华龙电子股份有限公司首次公开发行股票之用）

第十七章 备查文件

一、备查文件目录

- (一) 发行保荐书；
- (二) 财务报表及审计报告；
- (三) 内部控制鉴证报告；
- (四) 经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- (五) 法律意见书及律师工作报告；
- (六) 公司章程（草案）；
- (七) 中国证监会核准本次发行的文件；
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间

1、宁波华龙电子股份有限公司

联系地址：浙江省宁波市东钱湖旧宅村工业园

联系电话：（0574）88378368

传 真：（0574）88378258

联 系 人：张秉

2、海通证券股份有限公司

联系地址：上海市广东路689号14楼海通证券投资银行部

电 话：（021）23219000

传 真：（021）63411627

保荐代表人：洪晓辉、刘昊

项目协办人：丁颖芳

项目组成员：黄洁卉、郑友贤

3、查阅时间：

周一至周五：上午8：30—11：30 下午2：30—5：00